

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

# 江苏中科科化新材料股份有限公司

Jiangsu Zhongke Kehua New Materials Co., Ltd.

(江苏省泰州市海陵工业园区梅兰东路70号)



## 首次公开发行股票并在科创板上市

### 招股说明书

(申报稿)

本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐机构（主承销商）

**CMS 招商证券**

(深圳市福田区福田街道福华一路 111 号)

## 发行人声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

## 致投资者声明

公司是一家专注于半导体封装材料研发、生产和销售的国家级专精特新“小巨人”企业，主要产品中高端环氧塑封料正在加速替代日系厂商的市场份额。通过本次上市，公司将提升核心竞争力、服务国家战略，为我国半导体产业链全面自主可控贡献力量。

### 一、公司上市的目的

#### （一）服务我国半导体产业链全面自主可控战略

半导体封装是半导体产业的关键环节，直接影响芯片性能及终端产品的竞争力。“后摩尔时代”集成电路通过先进封装技术提升芯片整体性能已成为趋势，封装材料对于封装技术的更新迭代起到至关重要的作用。环氧塑封料应用于90%以上的芯片封装，是支撑半导体产业发展的关键材料。

目前全球环氧塑封料市场由外资厂商主导、国产化率较低，高端市场基本被日系厂商垄断。面对日益复杂的国际环境和地缘政治格局，环氧塑封料的国产化进程关系到我国整个半导体产业的稳定与发展。公司计划通过本次上市提高品牌影响力，提升产品迭代和规模化供应能力，加速替代日系厂商的市场份额，为我国封装材料供应链稳定性和半导体产业链全面自主可控贡献力量。

#### （二）提升核心竞争力，助力公司成为全球领先的半导体封装材料供应商

通过本次上市，公司将在产品布局、技术创新和人才引进等方面进一步加大投入，加快推进高端产品研发和产线建设，从而提升核心竞争力和行业地位；同时，本次上市将提高公司的市场影响力，有助于已研发成功的高端产品得到更多下游封装厂商与终端客户的认可，获得更多的业务机会，助力公司成为全球领先的半导体封装材料供应商。

公司将以本次上市为契机，持续优化治理结构、提高管理水平、增强信息透明度，为公司稳健发展提供制度保障。公司也将借助本次上市，优化利润分配政策、强化股东回报机制，提升投资价值，与投资者共同促进公司高质量发展，为社会创造长期价值。

### 二、公司现代企业制度的建立健全情况

公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求建立了现代企业制度，完善了由股东会、董事会及审计委员会等专门委员会、高级管理人员组成的法人治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责明确、相互制衡、规范运作、科学高效的公司治理机制。公司建立健全了合理的内部控制制度，相关机构和人员能够规范履行职责，形成了有效的内部控制环境。

### 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划

公司本次融资充分考虑了国家产业政策、行业发展趋势和市场竞争格局等因素，募集资金将用于“半导体封装用中高端环氧塑封料研发及产业化项目”和补充流动资金，紧密围绕公司主营业务并投向科技创新领域。

本次融资有助于公司提高研发创新和生产能力、优化产品布局、加速实现新产品的市场导入，促进中高端环氧塑封料国产化水平的提升；本次融资有助于公司优化资本结构、提高抗风险能力，为公司把握行业机遇、实施战略布局提供资金支持。本次融资将助力公司深化核心竞争优势，全面提升综合实力，为未来发展战略的实现提供坚实支撑，具有必要性。

### 四、公司持续经营能力及未来发展规划

#### （一）公司具备良好的持续经营能力

报告期内，公司营业收入分别为 20,009.34 万元、25,023.82 万元、33,095.78 万元和 15,904.23 万元，主要来源于中高端环氧塑封料的业务收入。

受益于半导体产业的持续发展和封装材料国产化进程的加速，中高端环氧塑封料的市场需求总体呈增长态势，具有较大发展空间。公司自设立以来始终专注于环氧塑封料的研发创新和产业化，在技术积累、产品研发、生产工艺和质量保障等方面具备较强的竞争优势，与华润微、蓝箭电子、捷捷微电、银河微电、通富微电、华天科技、富满微、气派科技、日月新集团、韩国 KEC 集团等下游知名厂商建立了长期、稳定的合作关系。目前，公司在中端环氧塑封料领域已形成规模效应，成功替代部分日系厂商的国内市场份额；高端环氧塑封料已陆续通过下游封测厂商的考核验证，部分产品已实现量产并向客户供应。

多年来，公司持续提升产品品质与服务水平，市场份额不断扩大。依据公开

数据测算，公司 2024 年环氧塑封料业务规模在内资厂商中位列第二，在中高端环氧塑封料国产替代方面的贡献名列前茅。公司经营业绩稳步增长，具备良好的持续经营能力。

## （二）公司未来发展规划

公司积极响应国家创新驱动发展战略，深度融入新时代高质量发展格局，以新产品研发和工艺创新为驱动，通过增强技术优势、优化产品布局、深化产业链协同，致力于成为具有全球影响力的半导体封装材料供应商。

公司将稳步实施上述战略规划：

一、立足国内市场需求，把握国产替代的发展机遇，加快实现对日系竞品的替代；通过构建覆盖先进封装、高端应用和特殊应用的产品体系，不断提升产品竞争力，巩固并扩大市场份额。同时，逐步拓展海外市场，成为与国际领先厂商比肩的本土半导体封装材料企业。

二、在主营业务稳步发展的基础上，进一步优化产品布局，实现资源的高效利用。同时，通过资源整合与协同创新，探索并购产业链中拥有先进技术、核心专利或优质客户资源的企业（包括外资、境外企业），“内生增长与外延拓展”相结合，快速提升综合实力和行业影响力，实现跨越式发展。

三、面向半导体封装技术的发展趋势，布局前沿材料的研发，重点突破高耐热性、高导热率及适应异构集成等新型封装材料，构建以环氧塑封料为核心、多品类新型封装材料协同发展的产品体系，以前瞻性的技术研发助力公司实现长远发展目标。

董事长签名：

卢绪奎

江苏中科科化新材料股份有限公司



## 本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	本次拟发行股份不超过 2,200 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），不低于发行后公司总股本的 25% 本次发行全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份的情况 本次发行可以采用超额配售选择权，超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的 15%
每股面值	人民币 1.00 元
每股发行价格	人民币【】元
预计发行日期	【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所和板块	上海证券交易所科创板
发行后总股本	不超过 8,800 万股 (不含采用超额配售选择权发行的股票数量)
保荐人（主承销商）	招商证券股份有限公司
招股说明书签署日期	【】年【】月【】日

## 目 录

<b>致投资者声明</b>	<b>2</b>
一、公司上市的目的	2
二、公司现代企业制度的建立健全情况	2
三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划	3
四、公司持续经营能力及未来发展规划	3
<b>本次发行概况</b>	<b>5</b>
<b>第一节 释义</b>	<b>10</b>
一、一般释义	10
二、专业释义	12
<b>第二节 概览</b>	<b>16</b>
一、重大事项提示	16
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况	18
三、本次发行概况	19
四、发行人主营业务经营情况	20
五、发行人符合科创板定位相关情况	21
六、发行人报告期的主要财务数据及财务指标	22
七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息	22
八、发行人选择的具体上市标准	23
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项	23
十、募集资金运用与未来发展规划	23
十一、其他对发行人有重大影响的事项	24
<b>第三节 风险因素</b>	<b>25</b>
一、与发行人相关的风险	25
二、与行业相关的风险	27
三、其他风险	28
<b>第四节 发行人基本情况</b>	<b>29</b>
一、发行人基本情况	29
二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况	29

三、发行人成立以来的重要事件 .....	34
四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况 .....	34
五、发行人的股权结构 .....	34
六、发行人控股公司、参股公司及分公司情况 .....	35
七、控股股东、实际控制人及持股 5%以上主要股东的基本情况 .....	35
八、特别表决权股份或类似安排的情况 .....	39
九、协议控制架构的情况 .....	39
十、发行人控股股东重大违法情况 .....	39
十一、发行人股本情况 .....	40
十二、发行人董事、高级管理人员及核心技术人员 .....	45
十三、已经制定或实施的股权激励及相关安排 .....	55
十四、发行人员工情况及社会保障情况 .....	59
<b>第五节 业务与技术 .....</b>	<b>63</b>
一、主营业务及主要产品的基本情况 .....	63
二、发行人所处行业基本情况 .....	73
三、发行人产品销售情况和主要客户 .....	96
四、发行人采购情况和主要供应商 .....	97
五、发行人主要固定资产和无形资产 .....	100
六、发行人核心技术及研发情况 .....	102
七、公司的环境保护及安全生产情况 .....	116
八、发行人境外经营情况 .....	117
<b>第六节 财务会计信息与管理层分析 .....</b>	<b>118</b>
一、财务报表 .....	118
二、审计意见 .....	121
三、关键审计事项及重要性水平的判断标准 .....	121
四、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况 .....	123
五、重要会计政策、会计估计 .....	124
六、经注册会计师核验的非经常性损益表 .....	137
七、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策 .....	138
八、主要财务指标 .....	139

九、分部信息 .....	141
十、经营成果分析 .....	142
十一、资产质量分析 .....	159
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 .....	177
十三、股利分配分析 .....	184
十四、现金流量分析 .....	185
十五、重大资本性支出分析 .....	188
十六、资产负债日后事项、或有事项及其他重要事项 .....	189
十七、盈利预测报告 .....	189
<b>第七节 募集资金运用与未来发展规划 .....</b>	<b>190</b>
一、募集资金运用概况 .....	190
二、募集资金投资项目可行性及与发行人主要业务、核心技术的关系 ..	192
三、募集资金投资项目具体情况 .....	194
四、未来发展规划 .....	195
<b>第八节 公司治理与独立性 .....</b>	<b>197</b>
一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况 .....	197
二、发行人内部控制制度情况 .....	197
三、发行人报告期内违法违规情况 .....	199
四、报告期内发行人资金占用和对外担保情况 .....	199
五、面向市场独立持续经营的能力情况 .....	199
六、同业竞争 .....	201
七、关联方及关联交易 .....	202
<b>第九节 投资者保护 .....</b>	<b>217</b>
一、本次发行前滚存利润分配安排 .....	217
二、发行人股利分配政策 .....	217
三、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，不存在尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情况 .....	223
<b>第十节 其他重要事项 .....</b>	<b>224</b>
一、重大合同 .....	224
二、对外担保情况 .....	228

三、重大诉讼或仲裁情况 .....	228
<b>第十一节 声明 .....</b>	<b>232</b>
一、发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明 .....	232
二、发行人控股股东声明 .....	235
三、保荐人（主承销商）声明 .....	236
四、发行人律师声明 .....	238
五、审计机构声明 .....	239
六、资产评估机构声明 .....	240
七、验资机构声明 .....	241
八、验资复核机构声明 .....	243
<b>第十二节 附件 .....</b>	<b>244</b>
一、备查文件及文件查阅方式 .....	244
二、公司专利情况 .....	245
三、中科院化学所、京泰君联、泰富投资控制企业情况 .....	248
四、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况查阅时间和地点 .....	250
五、与投资者保护相关的承诺 .....	252
六、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项 .....	277
七、股东会、董事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明 .....	283
八、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 .....	285
九、募集资金具体运用情况 .....	286

## 第一节 释义

在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称或术语具有如下含义：

### 一、一般释义

发行人、中科科化、股份公司、公司	指	江苏中科科化新材料股份有限公司
科化有限、有限公司	指	江苏科化新材料科技有限公司（曾用名：科化新材料泰州有限公司），系发行人前身
控股股东、北京科化	指	北京科化新材料科技有限公司
科化新技术公司	指	北京科化化学新技术公司（曾用名：中国科学院化学所新技术发展公司），系北京科化前身
中科院	指	中国科学院
中科院化学所	指	中国科学院化学研究所
京泰君联	指	北京京泰君联科技有限公司
泰富投资	指	泰州泰富文化投资有限公司
奋斗韶华	指	泰州市奋斗韶华科技创业投资合伙企业（有限合伙）
国科瑞华	指	深圳市国科瑞华三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）
上海瓯立	指	上海瓯立企业管理合伙企业（有限合伙）
中化创新	指	中化创新（泉州）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
泰州东泽	指	泰州东泽产业投资基金（有限合伙）
金玉诺科	指	共青城金玉诺科投资管理合伙企业（有限合伙）
合翼科技	指	南京合翼科技创新投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：南京建信合翼科技创新投资合伙企业（有限合伙））
中福泉州	指	中福（泉州）企业管理合伙企业（有限合伙）
国科正道	指	北京国科正道投资中心(有限合伙)
首科化	指	北京首科化微电子有限公司
华润微	指	华润微电子有限公司（688396.SH）
蓝箭电子	指	佛山市蓝箭电子股份有限公司（301348.SZ）
研导电子	指	东莞市研导电子材料有限公司
深圳锐骏	指	深圳市锐骏半导体股份有限公司
金誉半导体	指	深圳市金誉半导体股份有限公司
捷捷微电	指	江苏捷捷微电子股份有限公司（300623.SZ）
银河微电	指	常州银河世纪微电子股份有限公司（688689.SH）
华天集团	指	天水华天电子集团股份有限公司，系华天科技、华羿微电的控股股东
华天科技	指	天水华天科技股份有限公司（002185.SZ）
华羿微电	指	华羿微电子股份有限公司
长电科技	指	江苏长电科技股份有限公司（600584.SH）（2024年11月控股股东变更为磐石润企（深圳）信息管理有限公司、实际控制人变更为中国华润有限公司后，与华润微为同一控

		制下企业)
富满微	指	富满微电子集团股份有限公司(300671.SZ)
气派科技	指	气派科技股份有限公司(688216.SH)
通富微电	指	通富微电子股份有限公司(002156.SZ)
华达微	指	南通华达微电子集团有限公司,系通富微电的控股股东
亚芯微电	指	浙江亚芯微电子股份有限公司
日月新集团	指	日月新半导体(苏州)有限公司、日月新半导体(昆山)有限公司、日月新半导体(威海)有限公司三家企业的统称,原为全球领先的半导体封测企业日月光集团(ASE Group)在苏州、威海、昆山设立的企业
KEC集团	指	总部位于韩国的知名半导体封测企业及其关联方,在无锡、泰国等地设有公司,其中无锡公司名称为无锡开益禧半导体有限公司
比亚迪半导体	指	比亚迪半导体股份有限公司
兴航科技	指	郑州兴航科技有限公司
福顺半导体	指	福建福顺半导体制造有限公司
联瑞新材	指	江苏联瑞新材料股份有限公司(688300.SH)
圣泉集团	指	济南圣泉集团股份有限公司(605589.SH),公司主要供应商山东圣泉新材料股份有限公司的控股股东
衡封新材	指	上海衡封新材料科技有限公司
邦陆通商	指	邦陆通商株式会社
中恒新材	指	蚌埠中恒新材料科技有限责任公司
宇部兴产	指	宇部兴产(上海)有限公司
华海诚科	指	江苏华海诚科新材料股份有限公司(688535.SH)
衡所华威	指	衡所华威电子有限公司
康强电子	指	宁波康强电子股份有限公司(002119.SZ)
飞凯材料	指	上海飞凯材料科技股份有限公司(300398.SZ)
昆山兴凯	指	昆山兴凯半导体材料有限公司,系飞凯材料的控股子公司
德邦科技	指	烟台德邦科技股份有限公司(688035.SH)
中共中央	指	中国共产党中央委员会
全国人大	指	中华人民共和国全国人民代表大会
国务院	指	中华人民共和国国务院
国家发改委、国家发展改革委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部、国家工信部、工业和信息化部	指	中华人民共和国工业和信息化部
自然资源部	指	中华人民共和国自然资源部
财政部	指	中华人民共和国财政部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
江苏省工信厅	指	江苏省工业和信息化厅
江苏省科技厅	指	江苏省科学技术厅
泰州市工信局	指	泰州市工业和信息化局

山东省科技厅	指	山东省科学技术厅
泰州市科技局	指	泰州市科学技术局
SIA	指	Semiconductor Industry Association, 中文全称为美国半导体行业协会
SEMI	指	Semiconductor Equipment and Materials International, 中文全称为国际半导体设备材料产业协会（简称国际半导体协会）
WSTS	指	World Semiconductor Trade Statistics, 中文全称为世界半导体贸易统计组织
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所、交易所	指	上海证券交易所
保荐机构、保荐人	指	招商证券股份有限公司
发行人律师、海润天睿	指	北京海润天睿律师事务所
会计师、致同	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构、中京民信	指	中京民信（北京）资产评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《首次公开发行股票注册管理办法》
《科创板上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《暂行规定》	指	《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》
本招股说明书	指	《江苏中科科化新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》
募投项目	指	募集资金投资项目
《公司章程》	指	《江苏中科科化新材料股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》	指	《江苏中科科化新材料股份有限公司章程（草案）》
报告期、最近三年及一期	指	2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月
最近三年	指	2022 年度、2023 年度、2024 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 二、专业释义

### （一）常规术语

环氧塑封料、EMC	指	全称为环氧树脂模塑料（Epoxy Molding Compound），一种以环氧树脂为基体树脂，添加固化剂、填料及多种功能添加剂制作而成的热固性化学材料
半导体	指	一种导电性可受控制，常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，是构成各类信息技术产品的基本元素
集成电路、IC	指	Integrated Circuit，是通过半导体工艺将晶体管、电阻、电容等电子元件及其互连线集成在半导体晶片上的微型化电路模块，可实现信号处理、放大、运算或逻辑控制等功能
分立器件	指	二极管、晶体管等具有独立封装结构、实现单一或特定功能的半导体元件

先进封装	指	采用更精细、复杂的技术与工艺,对半导体进行封装,以实现更高性能、更小尺寸、更低功耗等目标,目前国内主流先进封装形式包括QFP/LQFP、QFN/DFN/PDFN、BGA、FC、SiP、CSP、WLP/PLP、2.5/3D封装等
传统封装	指	采用相对成熟的技术与工艺,对半导体进行封装,目前国内主流封装形式主要包括D0、SMX、桥块、DIP、TO、SOT、SOP等
硅微粉	指	以结晶石英、熔融石英等为原料,经研磨、精密分级、除杂等多道工艺加工而成的二氧化硅粉体材料,具有化学性质稳定、耐高温、绝缘性优异、硬度高及膨胀系数低等特点
环氧树脂	指	一类由环氧氯丙烷与双酚类化合物经缩聚反应生产的、含有环氧基团的热固性高分子聚合物,具有高粘接强度、耐化学腐蚀、机械性能优异、绝缘性优异及耐高温等特点
酚醛树脂	指	一种由酚类与醛类经缩聚反应生成的热固性聚合物,具有耐高温、刚性高、电绝缘性优异及阻燃等特性
偶联剂	指	一种双官能团有机化合物,分子两端分别含可与无机材料表面反应的极性基团以及可与有机聚合物结合的非极性基团,通过化学键合作用增强无机-有机界面结合力,改善复合材料力学性能、界面稳定性等
脱模剂	指	一种介于模具和制品之间的功能性物质,通过降低界面张力防止制品与模具粘连,确保制品完整脱模且不影响其表面质量与性能
第三代半导体	指	以碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等宽禁带半导体材料为代表,具有高击穿电场、高热导率及高电子迁移率,适用于高频、高压、高温及高功率电子器件的新型半导体技术
IPM	指	Intelligent Power Module,中文全称为智能功率模块,一种高度集成的电子器件,集功率半导体器件、驱动电路、保护电路及控制逻辑于一体,具备过流、过压、过热等自诊断与保护功能,可实现高效电能转换与智能化控制,广泛应用于电机驱动、逆变器等领域
IGBT 模块	指	Insulated Gate Bipolar Transistor,中文全称为绝缘栅双极晶体管,一种由金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)与双极结型晶体管(BJT)复合而成的功率半导体器件,兼具高输入阻抗、低导通损耗及快速开关特性,适用于高压、大电流场景,广泛应用于电机驱动、变频器等领域
PCN	指	Product Change Notice,中文全称为产品变更通知,是指封装厂商的设计、制造或测试过程已经确定并开始执行后,在需要对既定的技术规格、参数、流程或供应商等进行修改时,由封装厂商向其终端客户所发出的通知文件,以确保产品在持续改进过程中始终保持一致性、可靠性和可追溯性
摩尔定律	指	由戈登·摩尔(Gordon Moore)在1965年提出的经验性观察,其核心内容是:集成电路上可容纳的晶体管数目大约每18到24个月增加一倍,同时处理器的性能也相应提升一倍,而成本则相对降低

## (二) 与封装形式相关的术语

D0	指	Diode Outline,二极管外形封装,是一类用于二极管等半导体器件的标准封装形式
SMX	指	Small Outline Diode Package,小外形二极管封装,根据尺寸不同可具体分为SMA、SMB、SMC
桥块	指	一种将四个二极管以全波桥式整流电路形式集成在一个封装内的功率半导体器件
DIP	指	Dual In-line Package,双列直插式封装,是一种两侧带有两排平

		行直插引脚的封装形式
T0	指	Transistor Outline, 晶体管外壳封装, 是一类用于晶体管等半导体器件的标准封装形式
SOP	指	Small Outline Package, 小外形封装, 是一种两侧具有翼形或 J 形引脚的封装形式, 主要用于集成电路封装
SOT	指	Small Outline Transistor, 小外形晶体管贴片封装, 与 SOP 类似, 倾重于分立器件封装
DPAK、D2PAK	指	一种主要用于大功率半导体器件 (MOSFET 等) 的表面贴装封装
QFP	指	Quad Flat Package, 四侧引脚扁平封装, 是一种引脚从封装体四个侧面引出呈扁平状的封装形式
LQFP	指	Low-profile Quad Flat Package, 薄型四边引线扁平封装, 与 QFP 类似, 倾重于薄型设计
QFN	指	Quad Flat No-lead, 方形扁平无引脚封装, 是一种封装底部四周的焊盘实现电气连接的封装形式
DFN	指	Dual Flat No-lead, 双列扁平无引脚封装, 是一种封装底部两侧的焊盘实现电气连接的封装形式
PDFN	指	Power Quad Flat No-lead, 功率双列扁平无引脚封装, 与 DFN 类似, 倾重于高功率应用
BGA	指	Ball Grid Array, 球栅阵列封装, 是一种在封装底部以阵列形式排布焊球来实现电气连接的封装形式
CSP	指	Chip Scale Package, 芯片级封装, 是一种封装尺寸与芯片本身几乎相同的封装形式, 通过将引脚分布在芯片四周或底部实现高密度集成
FC	指	Flip Chip, 倒装芯片封装, 是一种通过将芯片面朝下直接焊接到基板上, 利用凸点实现电气连接的高密度封装技术
MUF	指	Molded Underfill, 中文全称为模塑底部填充材料, 是指当倒装芯片连接在带有互联凸块的有机基板上时, 可以将包括芯片和基板之间的缝隙在内的整个器件进行一次性封装的填充材料, 特别适用于倒装芯片封装
SiP	指	System-In-a-Package, 系统级封装, 是将多种功能芯片和器件集成在一个模块内, 实现完整系统功能的封装形式
Fan-In/FI	指	扇入型封装, 是一种将芯片所有输入/输出 (I/O) 端口集中布局在芯片内部区域的封装技术
Fan-Out/FO	指	扇出型封装, 是一种通过重布线层 (RDL) 将芯片的 I/O 端口扩展至芯片物理边界之外的封装技术
WLP	指	Wafer Level Package, 晶圆级封装, 在整片晶圆上进行封装测试后再切割成单个芯片的封装形式, 根据扇入/扇出封装可进一步分为 FIWLP、FOWLP
PLP	指	Panel Level Package, 面板级封装, 以面板为载体进行芯片封装, 根据扇入/扇出封装可进一步分为 FIPLP、FOPLP
Chiplet	指	又称芯粒, 是一种基于异构集成的模块化芯片设计方式, 通过先进封装技术将多个独立制程的晶片 (Die) 集成于同一封装体内, 形成系统级芯片 (SoC)
2.5D 封装	指	通过硅中介层或有机基板横向集成多颗芯片, 利用硅通孔 (TSV) 实现高密度互连, 典型应用于 HBM 内存与逻辑芯片协同封装
3D 封装	指	采用垂直堆叠架构, 芯片间通过凸块直接键合, 实现层间信号传输与功耗优化, 主要用于存算一体芯片及超薄器件集成

### (三) 与环氧塑封料技术指标相关的术语

胶化时间、GT	指	主要反映了环氧塑封料的反应活性
螺旋长度、SF	指	主要反映了环氧塑封料的流动性能
热膨胀系数、CTE	指	指材料温度每变化 1 摄氏度时, 其长度变化与原始长度之比, 其中温度低于 Tg 时的 CTE 称为 CTE1, 温度高于 Tg 的 CTE 称为 CTE2
玻璃化转变温度	指	指非晶态聚合物在玻璃态向高弹态转变时的温度, 一般高分子材料的许多特性在 Tg 附近发生急剧变化
弯曲强度	指	主要反映了材料抵抗弯曲不断裂的能力
弯曲模量	指	主要反映了材料在弹性极限内抵抗弯曲变形的能力
应力	指	指材料在固化、温度变化或外力作用下内部产生的非均匀分布的内力, 主要由热膨胀系数失配、固化收缩以及机械约束等因素引发, 可能导致封装体开裂、界面分层或芯片损伤
连续模塑性	指	指在一定温度和压力条件下, 环氧塑封料在模具内连续成型时保持半导体器件外观与内部分层良好的能力
翘曲	指	指在不对称封装时半导体器件因材料内部应力分布不均导致的非均匀形变现象
介电常数	指	是衡量材料在电场作用下极化能力的物理参数, 表征其对电场响应的强弱
热导率	指	是衡量材料传导热量能力的物理参数, 表征单位时间内、单位温差下通过单位厚度的材料传递的热量

#### (四) 与环氧塑封料考核验证相关的术语

湿敏等级试验、MSL	指	Moisture Sensitivity Level Test, 是一种评估电子器件在吸湿后承受高温回流焊时抗分层或损伤能力的标准化测试, 是环氧塑封料核心考核项目
高温高湿试验、THT	指	High Temperature and High Humidity Test, 是一种通过将电子器件或材料置于恒定高温和高湿度环境中, 评估其在湿热条件下抗老化、抗腐蚀及抗分层能力的可靠性测试方法
高压蒸煮试验、PCT	指	Pressure Cooker Test, 是一种通过高温、高湿及高压环境加速模拟极端湿热条件的可靠性测试方法, 用于评估材料的抗吸湿渗透、抗分层及抗腐蚀能力
高温贮存试验、HTST	指	High Temperature Storage Test, 是一种通过将电子器件或材料在恒定高温环境下长时间存储, 评估其耐高温老化能力及长期可靠性的测试方法, 用于检测材料老化、界面分层等失效机制
高低温循环试验、TCT	指	Temperature Cycling Test, 是一种通过反复快速切换极端高温与低温环境, 评估电子器件或材料因热膨胀系数 (CTE) 失配导致焊点断裂、界面分层、封装体开裂等现象的可靠性测试方法
高加速偏置试验、HAST	指	Highly Accelerated Stress Test, 是一种在高温、高湿、高压及外加电偏置条件下加速模拟湿热环境对电子器件的侵蚀效应的可靠性测试方法, 用于评估封装材料抗吸湿渗透、抗腐蚀及抗电介质失效的能力

除特别说明外, 本招股说明书中所有数值均保留两位小数, 若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五入原因造成。

除特别说明外, 本招股说明书中引用的第三方数据不存在专门为本次发行准备的情形, 亦不存在发行人为相关第三方报告专门支付费用或提供帮助的情形。

## 第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

### 一、重大事项提示

#### （一）特别风险提示

##### 1、公司所处细分市场容量较小的风险

公司主要产品为环氧塑封料。根据《中国半导体支撑业发展状况报告（2024年编）》数据测算，2024年我国环氧塑封料市场规模约为60.21亿元，细分市场规模相对较小。

报告期内公司的业务增量主要来自环氧塑封料市场规模的总体增长以及对日系厂商市场份额的加速替代。如果下游市场需求放缓或国产替代进程受阻，公司可能面临成长空间受限的风险。

##### 2、产品认证及下游客户PCN变更不确定性风险

环氧塑封料的性能直接影响芯片的可靠性、终端产品的稳定性、使用寿命及功能表现，每种型号的产品均需通过下游封测厂商严格的考核认证程序才能实现批量销售，且考核维度和考核项目数量较多，通常认证周期较长。如涉及下游客户PCN变更，在产品通过考核验证后，封测厂商还需取得终端客户的同意，才能确认批量采购。

如公司产品未能及时通过客户的考核认证，或涉及客户PCN变更时未能及时获得终端客户的同意，可能影响公司的市场开拓进度和经营业绩。

##### 3、新产品产业化进度滞后的风险

为巩固核心竞争力并提升市场份额，持续满足下游先进封装技术和高端应用的需求，公司需持续推进新产品的开发和推广。如果在开发过程中遭遇技术瓶颈，或者因技术指标波动、性能标准提高等原因导致考核验证周期延长，可能延误新产品产业化的关键节点。此外，如果竞争对手的同类产品率先通过客户验证，公司可能面临订单获取滞后的风险，对市场竞争造成不利影响。

##### 4、产能消化不及预期的风险

报告期内，公司的产能利用率为79.50%、90.80%、84.99%和72.26%，最近

一期产能利用率有所下降，主要原因是部分产线于 2023 年第四季度投产，产能尚处于爬坡阶段。本次募投项目达产后，公司将新增 22,500 吨环氧塑封料的设计产能。随着市场开拓和产品陆续导入客户并实现量产，新增产能将逐步消化，但产能利用率的提升取决于市场需求、客户开拓、产品开发和考核验证进度等多种因素，具有一定不确定性。如果未来市场环境发生变化、半导体封装材料国产化进程放缓、关键客户考核验证周期延长，或者市场竞争加剧，公司可能面临新增产能无法及时消化的风险。

### 5、公司无实际控制人的风险

截至本招股说明书签署日，北京科化持有公司 64.57%的股份。自公司成立至今，北京科化始终为公司的第一大股东，持股比例保持 50%以上，处于绝对控股地位，为公司控股股东。

截至本招股说明书签署日，北京科化的股权结构为：中科院化学所持股 41.86%、泰富投资持股 29.07%、京泰君联持股 29.07%；北京科化的董事会成员为 3 名，分别由中科院化学所、泰富投资、京泰君联各提名 1 名。北京科化的股权结构、董事会构成已经保持 10 年以上的长期稳定状态，不存在任何单一股东对其股东会决议或董事会决议具有决定性影响，北京科化无实际控制人，故公司无实际控制人。

公司无实际控制人，可能影响重大事项的决策效率，贻误发展机遇。

### （二）本次发行相关主体作出的重要承诺

公司及相关责任主体已按照中国证监会及上交所等监管机构的要求，就股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限、股东持股及减持意向、稳定股价等重要事项作出相关承诺，具体情况参见本招股说明书“第十二节 附件 五、与投资者保护相关的承诺”和“六、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项”。

### （三）利润分配政策的安排

为切实维护股东权益，保持股利分配政策的持续性和稳定性，提高股东对公司经营和分配的监督，稳定投资者预期，公司制定了明确、清晰的上市后股东分红回报规划。公司发行上市后的利润分配政策、现金分红的最低比例、上市后三年内利润分配计划和长期回报规划参见本招股说明书“第九节 投资者保护 二、

发行人股利分配政策”。

## 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况

(一) 发行人基本情况			
发行人名称	江苏中科科化新材料股份有限公司	成立日期	2011年10月9日
注册资本	6,600万元人民币	法定代表人	卢绪奎
注册地址	泰州市海陵工业园区梅兰东路70号	主要生产经营地址	泰州市海陵工业园区梅兰东路70号
控股股东	北京科化新材料科技有限公司	实际控制人	无
行业分类	计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)	在其他交易场所(申请)挂牌或上市的情况	无
(二) 本次发行的有关中介机构			
保荐人	招商证券股份有限公司	主承销商	招商证券股份有限公司
发行人律师	北京海润天睿律师事务所	其他承销机构	无
审计机构	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	评估机构	中京民信(北京)资产评估有限公司
发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系		发行人股东经层层穿透，保荐机构(主承销商)招商证券及其实际控制人招商局集团有限公司的下属子公司存在少量间接持股情况，相关主体合计间接持有发行人股份比例低于千分之一，其中招商证券在间接股东层面(穿透至少4层以上)持股比例极少(间接持有发行人股份比例低于百万分之一)。该等间接投资行为系相关间接层面投资主体所作出的独立投资决策，并非招商证券及其关联方主动对发行人进行投资 除上述情形外，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关系	
(三) 本次发行其他有关机构			
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	收款银行	【】
其他与本次发行有关的机构		-	

注：根据国家企业信用信息公示系统、巨潮资讯网、企查查等数据平台的股权穿透信息，直接穿透计算间接持股比例；不含二级市场股票等证券投资，但持有上市公司5%以上股份的除外。

### 三、本次发行概况

(一) 本次发行的基本情况			
股票种类	人民币普通股(A股)		
每股面值	人民币1.00元		
发行股数	不超过2,200万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量)	占发行后总股本比例	不低于25.00%
其中：发行新股数量	不超过2,200万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量)	占发行后总股本比例	不低于25.00%
股东公开发售股份数量	-	占发行后总股本比例	-
发行后总股本	不超过8,800万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量)		
每股发行价格	【】元		
发行市盈率	【】倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照【】年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算)		
发行前每股净资产	【】元(截至【】年【】月【】日经审计的所有者权益除以本次发行前总股本计算)	发行前每股收益	【】元(按照【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行前总股本计算)
发行后每股净资产	【】元(截至【】年【】月【】日经审计的净资产加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)	发行后每股收益	【】元(按照【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行市净率	【】倍(以每股发行价格除以本次发行前每股净资产计算)		
预测净利润(如有)	不适用		
发行方式	采用向网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或监管部门认可的其他发行方式		
发行对象	符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立上海证券交易所股票交易账户且符合相关法律法规关于科创板股票投资者条件的投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外)或监管机构规定的其他对象		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	【】万元		
募集资金净额	【】万元		
募集资金投资项目	半导体封装用中高端环氧塑封料研发及产业化项目 补充流动资金		
发行费用概算	本次发行费用【】万元,明细如下:		

	<p>1、保荐及承销费用: 【】万元</p> <p>2、审计及验资费用: 【】万元</p> <p>3、律师费用: 【】万元</p> <p>4、用于本次发行的信息披露费用: 【】万元</p> <p>5、发行手续费用及其他: 【】万元</p> <p>上述发行费用均不含增值税</p>
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况	若公司决定实施高管及员工战略配售，则在本次公开发行股票注册后、发行前，履行内部程序审议该事项的具体方案，并依法进行披露
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况	保荐人将安排相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行。保荐人及相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件
公开发售股份股东名称、持股数量及公开发售股份数量、发行费用的分摊原则（如有）	本次发行不涉及股东公开发售，不涉及发行费用分摊，发行费用全部由发行人承担
<b>（二）本次发行上市的重要日期</b>	
刊登发行公告日期	【】年【】月【】日
开始询价推介日期	【】年【】月【】日
刊登定价公告日期	【】年【】月【】日
申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日
股票上市日期	【】年【】月【】日

## 四、发行人主营业务经营情况

### （一）主要业务及产品

公司专注于半导体封装材料的研发、生产和销售，主要产品为环氧塑封料，是半导体封装环节的关键主材料，广泛应用于消费电子、汽车电子、工业控制、通信、计算机等终端应用领域。公司聚焦中高端市场，报告期内中高端环氧塑封料产品销售收入快速增长，且占比不断提升。

具体情况参见本招股说明书“第五节 业务与技术 一、主营业务及主要产品”的基本情况（一）主营业务情况及（二）主要产品及服务”。

### （二）主要经营模式

公司主要经营模式参见本招股说明书“第五节 业务与技术 一、主营业务及主要产品”的基本情况（三）主要经营模式”。

### （三）销售渠道及重要客户

报告期内，公司采用直销为主、贸易为辅的销售模式。公司持续突破环氧塑封料领域的技术瓶颈，获得下游客户认可，市场占有率稳步增长。截至本招股说明书签署日，公司已与华润微（688396.SH）、蓝箭电子（301348.SZ）、捷捷微电（300623.SZ）、银河微电（688689.SH）、通富微电（002156.SZ）、华天科技（002185.SZ）、富满微（300671.SZ）、气派科技（688216.SH）、日月新集团、KEC集团等下游知名厂商建立了长期、稳定的合作关系，并获华润微“2023年度优秀供应商”、“2024年度最佳协同供应商”等荣誉。

#### （四）主要原材料采购及主要供应商

公司生产所需的主要原材料包括填料（硅微粉等）、树脂（环氧树脂、酚醛树脂等）和助剂（偶联剂、促进剂、改性剂、阻燃剂等）。报告期内原材料的主要供应商包括联瑞新材（688300.SH）、圣泉集团（605589.SH）、衡封新材、邦陆通商、中恒新材、宇部兴产等。

#### （五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

目前我国半导体封装材料的国产化率仍然较低，公司是少数具备中高端环氧塑封料产品自主研发和规模化生产能力的内资厂商。报告期内，公司环氧塑封料业务规模在内资厂商中的排名稳步提升至第二，部分中高端产品已实现对日系竞品的替代。

具体情况参见本招股说明书“第五节 业务与技术 二、发行人所处行业的基本情况（六）发行人市场地位和行业竞争格局”。

### 五、发行人符合科创板定位相关情况

#### （一）发行人符合行业领域要求

公司所属行业领域	<input checked="" type="checkbox"/> 新一代信息技术	1、根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，公司所处行业为“1 新一代信息技术产业”-“1.3 电子核心产业”-“1.3.1 集成电路”中的“集成电路材料”，细分的重点产品具体为封装材料 2、根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》和《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，公司所在行业归属于“1 新一代信息技术产业”-“1.2 电子核心产业”-“1.2.3 高储能和关键电子材料制造”-“3985* 电子专用材料制造” 3、根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，公司所处行业属于“二十八、信息产业”-“6. 电子
	<input type="checkbox"/> 高端装备	
	<input type="checkbox"/> 新材料	
	<input type="checkbox"/> 新能源	
	<input type="checkbox"/> 节能环保	
	<input type="checkbox"/> 生物医药	
	<input type="checkbox"/> 符合科创板定位的	

	其他领域	元器件生产专用材料” – “封装和装联材料”  公司主营业务为半导体封装材料的研发、生产和销售，主要产品为环氧塑封料，符合产业政策和国家经济发展战略
--	------	--

## （二）发行人符合科创属性要求

根据《科创属性评价指引（试行）》和《暂行规定》，公司符合科创属性相关指标的要求，具体情况如下：

科创属性评价标准一	是否符合	指标情况
最近三年累计研发投入占营业收入比例 $\geq 5\%$ ，或最近三年累计研发投入金额 $\geq 8,000$ 万元	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	最近三年，公司研发投入分别为 1,123.94 万元、1,641.83 万元和 1,806.33 万元，累计研发投入 4,572.10 万元，占营业收入比例为 5.85%
研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	截至 2024 年末，公司共有研发人员 44 人，占员工总数的 15.44%
应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利（含国防专利） $\geq 7$ 项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	截至本招股说明书签署日，公司应用于主营业务并能够产业化的发明专利 30 项
最近三年营业收入复合增长率 $\geq 25\%$ ，或最近一年营业收入金额 $\geq 3$ 亿	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	最近三年，公司营业收入分别为 20,009.34 万元、25,023.82 万元和 33,095.78 万元，最近一年营业收入在 3 亿元以上

## 六、发行人报告期的主要财务数据及财务指标

项目	2025 年 6 月 30 日/ 2025 年 1-6 月	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年度	2023 年 12 月 31 日/ 2023 年度	2022 年 12 月 31 日/ 2022 年度
资产总额（万元）	58,753.58	60,454.88	53,502.60	55,247.12
归属于母公司所有者权益（万元）	40,650.14	38,907.63	35,704.61	34,196.77
资产负债率（%）	30.81	35.64	33.27	38.10
营业收入（万元）	15,904.23	33,095.78	25,023.82	20,009.34
归属于母公司所有者的净利润（万元）	1,553.16	3,389.85	1,002.83	474.37
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	1,515.53	3,195.99	767.85	-34.68
基本每股收益（元）	0.24	0.51	0.15	0.08
稀释每股收益（元）	0.24	0.51	0.15	0.08
加权平均净资产收益率（%）	3.90	9.10	2.87	2.00
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-924.07	1,275.55	-3,413.09	-603.65
现金分红（万元）	-	660.00	-	660.00
研发投入占营业收入的比例（%）	5.85	5.46	6.56	5.62

## 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息

公司财务报告审计截止日为 2025 年 6 月 30 日。财务报告审计截止日至本

招股说明书签署日之间，公司的经营状况正常，公司所处行业的产业政策、市场环境、税收政策等未发生重大变化，公司的经营模式、主要原材料采购情况、主要产品销售情况、主要客户和供应商构成以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。公司生产经营的内外部环境未发生重大变化，不存在导致公司经营业绩异常波动的重大不利因素。

## 八、发行人选择的具体上市标准

公司结合自身情况，选择适用《科创板上市规则》第 2.1.2 条规定的上市标准中的“（一）预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。

根据公司经营情况、结合最近一次外部股权融资情况和同行业可比上市公司的市场估值情况，公司预计市值不低于 10 亿元；公司最近一年营业收入为 33,095.78 万元、归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为 3,195.99 万元，满足最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。

综上，公司符合《科创板上市规则》第 2.1.2 条规定的第（一）项标准。

## 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项

截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理的特殊安排。

## 十、募集资金运用与未来发展规划

### （一）募集资金运用

经公司董事会和股东会审议通过，本次发行募集资金在扣除发行费用后的净额将用于与公司主营业务相关的投资项目，具体如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目		项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	半导体封装用中高端环氧塑封料研发及产业化项目	1.1 半导体封装用中高端环氧塑封料产业化项目	42,000.00	42,000.00
		1.2 半导体封装用中高端环氧塑封料研发中心建设项目	9,800.00	9,800.00
2	补充流动资金		8,000.00	8,000.00
合计			59,800.00	59,800.00

本次募集资金到位后，公司将根据实际经营情况，结合公司的财务状况、发展规划，按项目的轻重缓急将募集资金投入各项目实施。本次募集资金到位前，公司可根据项目进度以自筹资金先行投入，待本次募集资金到位后予以置换。

若本次募集资金规模不能满足拟投资项目资金需求，公司将通过自筹资金解决差额部分；若有超出，超出部分将按照相关法律法规以及中国证监会和上交所的有关规定履行相应程序后使用。

## **（二）未来发展规划**

公司积极响应国家创新驱动发展战略，深度融入新时代高质量发展格局，以新产品研发和工艺创新为驱动，通过增强技术优势、优化产品布局、深化产业链协同，致力于成为具有全球影响力的半导体封装材料供应商。

本次募集资金运用与未来发展规划具体情况参见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。

## **十一、其他对发行人有重大影响的事项**

截至本招股说明书签署日，不存在其他对公司有重大影响的事项。

## 第三节 风险因素

投资者在评价发行人本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料和数据外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。

### 一、与发行人相关的风险

#### （一）经营风险

##### 1、产品认证及下游客户 PCN 变更不确定性风险

参见本招股说明书“第二节 概览 一、重大事项提示（一）特别风险提示”。

##### 2、供应商集中度较高的风险

报告期内，公司向前五名原材料供应商合计采购金额占当期原材料采购总额的比例分别为 61.30%、60.00%、60.70% 和 61.16%，供应商集中度相对较高。如果未来主要供应商生产经营发生不利变化，或因国际贸易关系等因素与公司业务合作关系发生变化，可能会影响公司原材料短期供应的稳定性，进而对公司的生产经营造成不利影响。

#### （二）技术风险

##### 1、新产品产业化进度滞后的风险

参见本招股说明书“第二节 概览 一、重大事项提示（一）特别风险提示”。

##### 2、技术人员流失风险

半导体封装材料行业属于典型的技术密集型行业，公司核心竞争力与核心技术团队的稳定性密切相关。如公司出现关键技术人员大量流失的情况，可能导致新产品研发受阻、工艺技术秘密外泄或客户项目衔接断层等风险，进而影响产品开发速度与客户黏性，对公司的持续创新能力及市场地位造成不利影响。

#### （三）财务风险

##### 1、应收账款回收的风险

报告期各期末，公司应收账款的账面余额分别为 8,354.61 万元、11,674.17 万元、13,823.35 万元和 14,078.85 万元，占资产总额的比例分别为 15.12%、21.82%、22.87% 和 23.96%；随着公司经营规模的扩大，应收账款余额可能进一

步增加。较高的应收账款余额将影响公司的资金周转效率。如果公司未能对应收账款采取严格的管理措施或客户信用状况发生恶化,可能导致公司增加计提坏账准备、产生应收账款坏账、影响营运资金和现金流状况,进而对公司经营业绩产生不利影响。

## 2、税收优惠政策变化的风险

报告期内,公司享受高新技术企业所得税的税收优惠及研发费用加计扣除政策,并按照《财政部 税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》等规定享受集成电路企业进项税额加计抵减政策,各期税收优惠合计影响金额分别为 273.69 万元、306.61 万元、1,572.55 万元及 494.05 万元。如果国家有关税收优惠的法律、法规、政策等发生重大调整,或者公司未来不能持续取得高新技术企业资格或不能持续满足相关税收优惠条件,将对公司的经营业绩造成一定不利影响。

## 3、整体变更时存在累计未弥补亏损的风险

公司整体变更为股份公司时存在累计未弥补亏损。截至整体变更基准日 2022 年 7 月 31 日,公司未分配利润为-893.51 万元。在整体变更为股份公司后,随着公司业务的稳步发展,未分配利润为负的情形已消除,截至报告期末,公司未分配利润为 5,067.66 万元。如未来公司盈利能力下降或遭受其他不可预期的风险出现亏损,将对未分配利润造成不利影响。

## （四）法律风险

### 1、知识产权保护风险

作为技术密集型企业,公司知识产权较多。如果未来发生核心技术人员流失或者研发生产环节出现技术秘密外泄等情况,可能导致公司技术壁垒弱化。此外,虽然公司已建立完备的专利布局和知识产权保护体系,但仍存在与同行业竞争者发生知识产权纠纷的可能性,从而对公司正常经营秩序造成一定影响。

### 2、对赌协议风险

公司、奋斗韶华、京泰君联及公司董事长、总经理卢绪奎曾与国科瑞华、上海瓯立、中化创新、泰州东泽等 9 名股东约定了股份回购等特殊权利条款。其中,公司作为回购义务人的回购条款已终止,且自始无效。

奋斗韶华、京泰君联和卢绪奎作为回购义务人的回购条款、其他特殊股东权

利条款和关于公司治理的特殊约定已终止或自公司上市申请被证券交易所受理之日起自动终止，如上市申请未被受理、受理后主动撤回、上市申请未能通过证券交易所审核或中国证监会注册情形时，前述条款将恢复效力。如触发上述恢复条件，可能会触发公司管理层和员工持股平台进行股份回购等情形，对公司股权结构和日常经营的稳定性造成不利影响。

## （五）募投项目相关的风险

### 1、募投项目实施风险

公司本次募投项目的可行性分析是基于当前国内外市场经济环境、行业发展趋势、产品价格、原材料供应等因素作为假设性条件。募投项目需要一定的建设期和达产期，在项目实施过程中，如果上述条件发生重大变化、项目建设进度延缓、经营管理不当，公司可能面临募投项目无法顺利实施的风险；募投项目投产后，如果市场环境、产品价格、客户需求等因素发生较大变化，可能会对募投项目的经济效益造成负面影响，致使投资收益低于预期。

### 2、产能消化不及预期的风险

参见本招股说明书“第二节 概览 一、重大事项提示（一）特别风险提示”。

## （六）公司无实际控制人的风险

参见本招股说明书“第二节 概览 一、重大事项提示（一）特别风险提示”。

## 二、与行业相关的风险

### （一）公司所处细分市场容量较小的风险

参见本招股说明书“第二节 概览 一、重大事项提示（一）特别风险提示”。

### （二）市场竞争加剧的风险

随着国家对半导体行业在产业政策、财税政策等方面给予全方位的支持，半导体封装材料行业竞争日趋激烈，如果现有厂商加速扩产，行业新进入者技术突破或者日系厂商采取降价策略，可能导致市场份额受到挤压或导致价格体系松动，对公司构成一定的市场竞争压力。

### （三）宏观经济和行业周期波动的风险

半导体封装材料行业是半导体产业链中的上游关键支撑性行业，其景气程度

与半导体产业的发展息息相关。短期来看，受宏观经济周期性波动、市场供需关系变动等因素影响，半导体封装材料行业也存在阶段性波动，可能出现市场需求放缓等情形，进而影响公司的盈利水平。

### 三、其他风险

#### （一）本次发行摊薄即期回报的风险

本次发行完成后，公司总股本和净资产规模将大幅增加。由于本次募投项目的实施和预期效益的实现需要一定时间，短期内公司经营业绩仍主要依赖于现有业务的发展。在公司总股本和净资产规模大幅增长的情况下，每股收益、加权平均净资产收益率等指标存在短期内被摊薄的风险。

#### （二）发行失败风险

公司股票拟在上海证券交易所科创板上市，除公司经营和财务状况外，发行结果还可能受到宏观经济形势、资本市场走势和各类重大突发事件等因素影响，存在未能达到预计市值上市条件的风险，以及因投资者认购不足而导致的发行失败风险。

## 第四节 发行人基本情况

### 一、发行人基本情况

中文名称	江苏中科科化新材料股份有限公司	
英文名称	Jiangsu Zhongke Kehua New Materials Co., Ltd.	
注册资本	6,600 万元人民币	
法定代表人	卢绪奎	
有限公司成立日期	2011 年 10 月 9 日	
股份公司成立日期	2022 年 11 月 28 日	
住所	泰州市海陵工业园区梅兰东路 70 号	
邮政编码	225300	
电话号码	0523-86659016	
传真号码	0523-86659585	
互联网网址	www.scienchem.com.cn	
电子信箱	zqb@scienchem.com.cn	
信息披露和投资者关系	负责部门	证券部
	负责人	伊高领（董事会秘书）
	联系电话	0523-86659016

### 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况

#### （一）有限公司设立情况

公司前身为科化有限，成立于 2011 年 10 月 9 日，由北京科化出资设立。科化有限设立时的公司名称为“科化新材料泰州有限公司”，注册资本为 2,000.00 万元。2020 年 1 月，公司名称变更为“江苏科化新材料科技有限公司”。

2011 年 9 月 29 日，泰州兴瑞会计师事务所有限公司出具《验资报告》（泰瑞会验字[2011]376 号），审验证明：截至 2011 年 9 月 28 日，科化有限（筹）已收到股东缴纳的注册资本 2,000.00 万元，出资方式为货币出资。

2011 年 10 月 9 日，科化有限取得江苏省泰州工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：321200000024963）。

科化有限设立时的注册资本为 2,000.00 万元，股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	持股比例（%）
1	北京科化	2,000.00	100.00

## （二）股份公司设立情况

### 1、整体变更设立股份公司情况

中科科化系由科化有限整体变更设立的股份有限公司。

2022年10月21日，致同出具《审计报告》（致同审字[2022]第110B025048号），截至2022年7月31日，科化有限经审计的净资产为34,686.31万元。

2022年10月24日，中京民信出具《资产评估报告》（京信评报字[2022]第476号），截至评估基准日2022年7月31日，科化有限的净资产评估值为45,094.29万元。

2022年11月17日，科化有限通过股东会决议，同意整体变更设立股份有限公司，由有限公司全体股东作为发起人，以有限公司截至2022年7月31日经审计的净资产34,686.31万元折合股份公司股本6,600.00万股，超出股本总额的净资产计入股份公司资本公积。同日，科化有限全体股东签署了《江苏中科科化新材料股份有限公司发起人协议书》。

2022年11月18日，中科科化召开创立大会，同意科化有限整体变更设立股份有限公司。

2022年11月21日，致同出具《验资报告》（致同验字[2022]第110C000702号），审验证明：截至2022年11月18日，全体发起人已按发起人协议书、章程的规定，以其拥有的科化有限截至2022年7月31日的净资产作价折股投入，其中6,600.00万元折合公司的股本，每股面值1元，余额转为资本公积。

2022年11月28日，中科科化就本次整体变更办理了工商变更登记手续，并取得泰州市行政审批局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91321200583724034G）。

股份公司设立时，中科科化的注册资本为6,600.00万元，总股本为6,600.00万股，股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例（%）
1	北京科化	4,261.68	64.57
2	国科瑞华	610.65	9.25
3	上海瓯立	431.78	6.54
4	奋斗韶华	426.17	6.46
5	中化创新	293.61	4.45
6	泰州东泽	185.04	2.80

序号	股东名称	持股数量	持股比例 (%)
7	金玉诺科	185.04	2.80
8	周峰	123.37	1.87
9	合翼科技	61.68	0.93
10	中福泉州	14.80	0.22
11	国科正道	6.17	0.09
合计		6,600.00	100.00

公司对科化有限整体变更为股份公司时的财务报表进行追溯调整,根据致同出具的《专项审计报告》(致同专字[2025]第110C021362号),截至整体变更基准日2022年7月31日,科化有限追溯调整后经审计的净资产为33,764.73万元。2025年9月22日,中京民信出具《江苏科化新材料科技有限公司股份制改造涉及的江苏科化新材料科技有限公司股东全部权益价值追溯资产评估报告》(京信评报字[2025]第639号),截至评估基准日2022年7月31日,科化有限的净资产评估值为44,189.29万元。

公司分别于2025年9月22日、2025年10月11日召开第一届董事会第十一次会议及2025年第三次临时股东会,审议通过《关于确认整体变更基准日公司净资产值调整等相关事项的议案》,对整体变更基准日净资产项目进行追溯调整,调整后的净资产为33,764.73万元,以上述调整后的净资产折合股份公司股本总额66,000,000股,每股面值1元,超出股本的部分计入股份公司的资本公积;科化有限整体变更时各发起人持有的股份公司股份数量与持股比例保持不变;调整后整体变更基准日净资产值仍高于股份公司设立时的注册资本,不影响公司整体改制的过程和结果,不影响整体改制的合法有效性,不会导致发起人出资不实。

2025年10月11日,公司全体发起人签署《<江苏中科科化新材料股份有限公司发起人协议书>之补充协议》,就调整后的净资产值及折股方案进行了补充约定。全体发起人确认上述调整事项不影响公司整体变更时登记的注册资本及各发起人在公司中的股份数量及其持股比例,不会导致发起人出资不实,不存在损害股东和债权人利益的情形;全体发起人确认就上述净资产调整相关事项与公司及股东之间均不存在争议或潜在纠纷。

2025年11月7日,致同出具《验资复核报告》(致同专字[2025]第110A022323号),经复核,科化有限整体变更基准日净资产值调整后仍高于股份公司设立时的注册资本,各发起人出资全部到位。

## 2、发行人整体变更时存在未弥补亏损的情况

### (1) 整体变更时存在未弥补亏损的基本情况

公司整体变更时存在累计未弥补亏损。根据致同出具《专项审计报告》（致同专字[2025]第 110C021362 号），截至 2022 年 7 月 31 日，科化有限经审计的净资产为 33,764.73 万元，其中实收资本为 3,097.37 万元、资本公积为 31,110.49 万元、盈余公积为 450.38 万元、未分配利润为-893.51 万元。

科化有限整体变更设立股份公司时未分配利润为负，主要原因是公司追溯调整前期财务报表，导致已向股东分配的金额超过可供分配的利润。

(2) 未分配利润为负的情形消除情况，整体变更后的变化情况和发展趋势，与报告期内盈利水平变动的匹配关系，对未来盈利能力的影响

公司整体变更为股份公司后，经营规模和盈利能力整体保持良好水平，公司未分配利润为负的情形已消除，不会对未来盈利能力造成重大影响。截至报告期末，发行人未分配利润为 5,067.66 万元，未分配利润为负的情形已经消除。

报告期内，公司经营情况良好，未分配利润与当期盈利水平变动关系如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月/ 2025 年 6 月 30 日	2024 年度/ 2024 年 12 月 31 日	2023 年度/ 2023 年 12 月 31 日	2022 年度/ 2022 年 12 月 31 日
营业收入	15,904.23	33,095.78	25,023.82	20,009.34
净利润	1,553.16	3,389.85	1,002.83	474.37
未分配利润	5,067.66	3,514.50	1,123.64	213.85

## (三) 报告期内股本和股东变化情况

### 1、报告期初的股本和股东情况

报告期初，发行人为有限公司，注册资本为 2,200.00 万元，股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	持股比例 (%)
1	北京科化	2,000.00	90.91
2	奋斗韶华	200.00	9.09
合计		2,200.00	100.00

### 2、报告期内的股本和股东变化情况

#### (1) 2022 年 4 月，科化有限增资

2022 年 4 月 8 日，科化有限通过股东会决议，同意公司注册资本由 2,200.00 万元增加至 3,097.37 万元，新增注册资本 897.37 万元，由国科瑞华、上海瓯立、

中化创新等 9 名投资者认购。

2022 年 4 月 13 日，科化有限与 9 名投资者签署《增资协议书》，约定本次增资价款合计 31,000.00 万元，其中 897.37 万元计入注册资本，其余计入资本公积。

本次增资的具体情况如下：

单位：万元

序号	增资方	增资额	增资比例（%）	增资价款
1	国科瑞华	286.58	9.25	9,900.00
2	上海瓯立	202.63	6.54	7,000.00
3	中化创新	137.79	4.45	4,760.00
4	泰州东泽	86.84	2.80	3,000.00
5	金玉诺科	86.84	2.80	3,000.00
6	周峰	57.89	1.87	2,000.00
7	合翼科技	28.95	0.93	1,000.00
8	中福泉州	6.95	0.22	240.00
9	国科正道	2.89	0.09	100.00
合计		897.37	28.97	31,000.00

2022 年 9 月 5 日，江苏方成会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（方成会验字[2022]B-007 号），审验证明：截至 2022 年 4 月 27 日，科化有限已收到股东缴纳的新增注册资本 897.37 万元，出资方式为货币出资。

2022 年 4 月 22 日，科化有限就本次增资办理了工商变更登记，并取得泰州市行政审批局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91321200583724034G）。

本次增资完成后，科化有限的注册资本变更为 3,097.37 万元，股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	持股比例（%）
1	北京科化	2,000.00	64.57
2	国科瑞华	286.58	9.25
3	上海瓯立	202.63	6.54
4	奋斗韶华	200.00	6.46
5	中化创新	137.79	4.45
6	泰州东泽	86.84	2.80
7	金玉诺科	86.84	2.80
8	周峰	57.89	1.87
9	合翼科技	28.95	0.93
10	中福泉州	6.95	0.22
11	国科正道	2.89	0.09
合计		3,097.37	100.00

## (2) 2022 年 11 月，公司整体变更为股份有限公司

2022 年 11 月 28 日，科化有限整体变更为股份有限公司，具体情况参见本节“二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况（二）股份公司设立情况”。

整体变更为股份有限公司后，中科科化总股本为 6,600.00 万股，股权结构如下：

单位：万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例（%）
1	北京科化	4,261.68	64.57
2	国科瑞华	610.65	9.25
3	上海瓯立	431.78	6.54
4	奋斗韶华	426.17	6.46
5	中化创新	293.61	4.45
6	泰州东泽	185.04	2.80
7	金玉诺科	185.04	2.80
8	周峰	123.37	1.87
9	合翼科技	61.68	0.93
10	中福泉州	14.80	0.22
11	国科正道	6.17	0.09
合计		6,600.00	100.00

自股份公司设立以来至本招股说明书签署日，公司股本和股权结构未发生变化。

## 三、发行人成立以来的重要事件

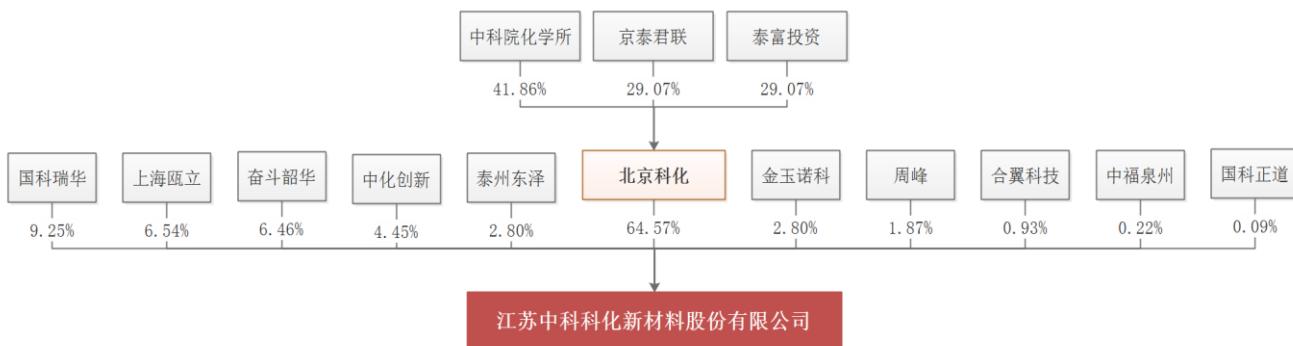
公司自成立以来，不存在重大资产重组等重大事件。

## 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况

公司自设立以来，不存在在其他证券市场上市/挂牌的情形。

## 五、发行人的股权结构

截至本招股说明书签署日，公司股权结构图如下：



## 六、发行人控股公司、参股公司及分公司情况

截至本招股说明书签署日，公司无控股公司、参股公司。公司设立 1 家分公司，具体情况如下：

公司名称	江苏中科科化新材料股份有限公司北京分公司
成立时间	2021 年 3 月 19 日
经营场所	北京市昌平区沙河镇松兰堡村沙河工业区临 168 号
负责人	王善学
经营范围	电子专用材料的技术开发、技术咨询、技术服务；销售电子专用材料、机械设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口

## 七、控股股东、实际控制人及持股 5%以上主要股东的基本情况

### （一）控股股东、实际控制人的基本情况

#### 1、控股股东

截至本招股说明书签署日，北京科化持有公司 64.57%的股份，为公司控股股东。

#### （1）基本情况

公司名称	北京科化新材料科技有限公司
成立时间	1984 年 8 月 20 日
注册资本	4,300.00 万元
实收资本	4,300.00 万元
注册地和主要生产经营地	北京市昌平区沙河镇松兰堡村沙河工业区临 168 号
法定代表人	张晓伟
经营范围	制造高分子聚合物（除高压聚乙烯、聚丙烯）以及其助剂（以上项目限分公司经营）；技术开发；销售机器设备、仪器仪表、零配件；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术咨询、技术服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）
主营业务及其与发行人主营业务的关系	北京科化为投资控股型公司，其全资子公司首科化主要从事 LED 专用材料的研发及产业化，与发行人主营业务不构成同业竞争

#### （2）股东构成

截至本招股说明书签署日，北京科化的股权结构如下：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例（%）
1	中科院化学所	1,800.00	41.86
2	泰富投资	1,250.00	29.07
3	京泰君联	1,250.00	29.07
	合计	4,300.00	100.00

### （3）主要财务数据

单位：万元

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025年6月30日/2025年1-6月	4,611.72	4,588.48	10.81	-46.33
2024年12月31日/2024年度	4,779.28	4,634.81	33.67	451.53

注：以上数据已经致同审计。

## 2、实际控制人

公司的控股股东北京科化无实际控制人，因此公司无实际控制人。具体如下：

北京科化的股权结构为：中科院化学所持股 41.86%、泰富投资持股 29.07%、京泰君联持股 29.07%；北京科化的董事会成员为 3 名，分别由中科院化学所、泰富投资、京泰君联各提名 1 名。北京科化的股权结构、董事会构成已经保持 10 年以上的长期稳定状态，不存在任何单一股东对北京科化股东会决议或董事会决议具有决定性影响。

北京科化全体股东已确认北京科化无实际控制人且已承诺不谋求北京科化及发行人的实际控制权。

（1）2024 年 6 月，中科院化学所确认自 2002 年 3 月首钢总公司增资入股北京科化后，中科院化学所持有北京科化的股权比例降至 41.86%并保持至今，根据《公司法》等相关法律法规，中科院化学所不再对北京科化构成实际控制，北京科化亦未纳入其合并报表范围。自上述之日起，中科院化学所按照《公司法》等法律法规及北京科化公司章程规定，仅作为股东行使相关权利，并未参与北京科化的日常经营决策和管理工作。中科院化学所承诺至中科科化股票上市之日起 36 个月内，不谋求北京科化及中科科化的实际控制权。

（2）2024 年 6 月，泰富投资、京泰君联确认自其成为北京科化股东之日起，未对北京科化构成实际控制，并且承诺至中科科化股票上市之日起 36 个月内，不谋求北京科化及中科科化的实际控制权。

报告期内，公司有控股股东但无实际控制人的状态未发生变更。

### 3、控股股东直接或间接持有的公司股份是否存在质押或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，控股股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。

## （二）持有发行人 5%以上股份的其他主要股东基本情况

持有公司 5%以上股份的其他主要股东为国科瑞华、上海瓯立和奋斗韶华。

### 1、国科瑞华

截至本招股说明书签署日，国科瑞华持有公司 610.65 万股股份，持股比例为 9.25%，其基本情况如下：

公司名称	深圳市国科瑞华三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）
成立时间	2020 年 2 月 4 日
出资额	450,000.00 万元
注册地	深圳市宝安区新桥街道黄埔社区洪田路 155 号创新智慧港 1 栋 1711
执行事务合伙人	国科瑞华（深圳）科技有限公司（委派代表：孙华）
经营范围	创业投资、股权投资业务；创业投资、股权投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务
主营业务及其与发行人主营业务的关系	主营业务为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，与发行人的主营业务不存在直接关联

截至本招股说明书签署日，国科瑞华合伙人及出资情况如下：

单位：万元、%

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额	出资比例
1	深圳市引导基金投资有限公司	有限合伙人	112,500.00	25.00
2	中国石油集团资本有限责任公司	有限合伙人	80,000.00	17.78
3	北京国科瑞孚股权投资基金（有限合伙）	有限合伙人	50,900.00	11.31
4	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	有限合伙人	45,000.00	10.00
5	北京国科汇金股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	45,000.00	10.00
6	深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司	有限合伙人	37,350.00	8.30
7	天津天保控股有限公司	有限合伙人	30,000.00	6.67
8	国泰君安证裕投资有限公司	有限合伙人	15,000.00	3.33
9	北京国科爱思技术服务合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	6,250.00	1.39
10	国科瑞华（深圳）科技有限公司	普通合伙人	6,000.00	1.33
11	共青城中实科技产业投资有限公司	有限合伙人	5,000.00	1.11
12	重庆渝富控股集团有限公司	有限合伙人	5,000.00	1.11
13	北京人寿保险股份有限公司	有限合伙人	5,000.00	1.11
14	长城人寿保险股份有限公司	有限合伙人	3,000.00	0.67

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额	出资比例
15	北京中关村创业投资发展有限公司	有限合伙人	2,000.00	0.44
16	光控领航（深圳）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2,000.00	0.44
合计			450,000.00	100.00

## 2、上海瓯立

截至本招股说明书签署日，上海瓯立持有公司 431.78 万股股份，持股比例为 6.54%，其基本情况如下：

公司名称	上海瓯立企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2021 年 12 月 24 日
出资额	100.00 万元
注册地	上海市崇明区中兴镇兴工路 37 号（上海广福经济开发区）
执行事务合伙人	蔡文华
经营范围	一般项目：企业管理，企业管理咨询，商务信息咨询（不含投资类咨询），经济信息咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），市场营销策划，企业形象策划
主营业务及其与发行人主营业务的关系	主营业务为股权投资，与发行人的主营业务不存在直接关联

截至本招股说明书签署日，上海瓯立合伙人及出资情况如下：

单位：万元、%

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额	出资比例
1	阮荣光	有限合伙人	99.00	99.00
2	蔡文华	普通合伙人	1.00	1.00
合计			100.00	100.00

## 3、奋斗韶华

截至本招股说明书签署日，奋斗韶华持有公司 426.17 万股股份，持股比例为 6.46%，其基本情况如下：

公司名称	泰州市奋斗韶华科技创业投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2021 年 7 月 8 日
出资额	789.19 万元
注册地	泰州市海陵区海陵工业园区梅兰东路 70 号
执行事务合伙人	卢绪奎
经营范围	一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；创业空间服务；科技推广和应用服务
主营业务及其与发行人主营业务的关系	发行人员工持股平台，无具体经营业务，与发行人主营业务不存在直接关系

截至本招股说明书签署日，奋斗韶华合伙人及出资情况如下：

单位：万元、%

序号	姓名	公司职务	合伙人性质	出资额	出资比例
1	卢绪奎	董事长、总经理	普通合伙人	138.70	17.58
2	姚克	副总经理	有限合伙人	65.70	8.33
3	李刚	首席科学家	有限合伙人	51.10	6.48
4	伊高领	董事会秘书、 财务总监	有限合伙人	51.10	6.48
5	王善学	董事、副总经理、 技术中心主任	有限合伙人	51.10	6.48
6	曹延生	品质总监	有限合伙人	51.10	6.48
7	王全胜	设备动力部部长	有限合伙人	36.50	4.63
8	李易松	销售部部长	有限合伙人	29.20	3.70
9	李海亮	资深高级工程师	有限合伙人	29.20	3.70
10	马小元	审计部部长	有限合伙人	29.20	3.70
11	陈继东	北京分公司副总经理	有限合伙人	29.20	3.70
12	孙海平	销售部副部长	有限合伙人	25.55	3.24
13	林小剑	采购部部长	有限合伙人	25.55	3.24
14	宋永成	副总经理	有限合伙人	19.73	2.50
15	梅胡杰	研发总监	有限合伙人	19.73	2.50
16	张之魁	技术总监	有限合伙人	19.73	2.50
17	闵玉勤	资深高级工程师	有限合伙人	18.25	2.31
18	许大伟	综合部副部长	有限合伙人	18.25	2.31
19	徐伟	制造部副部长	有限合伙人	18.25	2.31
20	陈思	制造部副部长	有限合伙人	18.25	2.31
21	张晓峰	制造部部长	有限合伙人	10.95	1.39
22	武玉乐	品保部副部长	有限合伙人	10.95	1.39
23	王群芳	品保部高级工程师	有限合伙人	7.30	0.93
24	常治国	研发工程师	有限合伙人	7.30	0.93
25	李卓	资深高级工程师	有限合伙人	7.30	0.93
<b>合计</b>				<b>789.19</b>	<b>100.00</b>

## 八、特别表决权股份或类似安排的情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。

## 九、协议控制架构的情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在协议控制架构情况。

## 十、发行人控股股东重大违法情况

报告期内，公司控股股东不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪的情形，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

## 十一、发行人股本情况

### (一) 本次发行前后的股本情况

本次发行前,公司总股本为 6,600.00 万股,本次拟发行股份不超过 2,200.00 万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量),不低于发行后公司总股本的 25%,公司股东本次不公开发售股份。假设本次公开发行股票数量为 2,200.00 万股,本次发行前后公司股本结构如下:

单位:股、%

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后	
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
1	北京科化	42,616,794	64.57	42,616,794	48.43
2	国科瑞华	6,106,518	9.25	6,106,518	6.94
3	上海瓯立	4,317,786	6.54	4,317,786	4.91
4	奋斗韶华	4,261,686	6.46	4,261,686	4.84
5	中化创新	2,936,076	4.45	2,936,076	3.34
6	泰州东泽	1,850,442	2.80	1,850,442	2.10
7	金玉诺科	1,850,442	2.80	1,850,442	2.10
8	周峰	1,233,672	1.87	1,233,672	1.40
9	合翼科技	616,836	0.93	616,836	0.70
10	中福泉州	148,038	0.22	148,038	0.17
11	国科正道	61,710	0.09	61,710	0.07
12	社会公众股	-	-	22,000,000	25.00
合计		66,000,000	100.00	88,000,000	100.00

### (二) 本次发行前发行人前十名股东情况

截至本招股说明书签署日,公司前十名股东情况如下:

单位:万股、%

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	北京科化	4,261.68	64.57
2	国科瑞华	610.65	9.25
3	上海瓯立	431.78	6.54
4	奋斗韶华	426.17	6.46
5	中化创新	293.61	4.45
6	泰州东泽	185.04	2.80
7	金玉诺科	185.04	2.80
8	周峰	123.37	1.87
9	合翼科技	61.68	0.93
10	中福泉州	14.80	0.22
合计		6,593.83	99.91

### (三) 本次发行前公司前十名自然人股东及其在发行人处任职情况

截至本招股说明书签署日，公司共有 1 名自然人股东，姓名为周峰，持有公司 123.37 万股股份，持股比例为 1.87%。周峰在发行人处担任董事。

#### （四）国有股份、外资股份情况

截至本招股说明书签署日，公司股东不存在按照《上市公司国有股权监督管理办法》、《上市公司国有股东标识管理暂行规定》等法律法规应标识“SS”或“CS”的国有股东，公司亦不存在外资股东。

#### （五）发行人股东中涉及私募投资基金备案情况

截至本招股说明书签署日，公司共有 11 名股东，其中机构股东 10 名，自然人股东 1 名。机构股东中 5 名股东为私募投资基金，均已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金登记备案办法》等规定进行登记或备案，具体情况如下：

序号	股东名称	基金备案号	基金管理人	管理人登记编号
1	国科瑞华	SJU046	中国科技产业投资管理有限公司	P1000510
2	中化创新	STJ195	中化创科私募基金管理（天津）有限公司	P1070145
3	泰州东泽	SSX586	湖州赛泽基业私募基金管理有限公司	P1032779
4	金玉诺科	STW587	西藏金石兰玉创业投资管理合伙企业（有限合伙）	P1067339
5	合翼科技	SLG329	建信（北京）投资基金管理有限责任公司	P1001087

公司其他 5 名机构股东不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金登记备案办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，不需要按照前述规定办理私募投资基金备案手续或私募投资基金管理人登记手续。

#### （六）发行人申报前十二个月内新增股东情况

公司申报前十二个月不存在新增股东的情况。

#### （七）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

本次发行前，各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例如下：

序号	关联股东	持股比例（%）	关联关系
1	北京科化	64.57	奋斗韶华是发行人的员工持股平台，其中 20 名合

序号	关联股东	持股比例 (%)	关联关系
	奋斗韶华	6.46	伙人持有京泰君联的股权； 京泰君联是北京科化的员工持股平台，持有北京科化 29.07%的股权；
	周峰	1.87	周峰担任北京科化董事，其父亲周宝祥、配偶潘春年持股的泰富投资持有北京科化 29.07%的股权
2	国科瑞华	9.25	国科正道是国科瑞华私募基金管理人的员工跟投平台
	国科正道	0.09	
3	中化创新	4.45	中福泉州是中化创新私募基金管理人的员工跟投平台，中福泉州持有中化创新 0.19%的出资额
	中福泉州	0.22	

## （八）股东公开发售股份对发行人的控制权、治理结构及生产经营产生的影响

本次发行不涉及原股东公开发售股份。

## （九）发行人股东特殊权利安排的约定与清理情况

### 1、特殊股东权利条款签署情况

2022 年 4 月 13 日，公司、奋斗韶华、京泰君联、卢绪奎与国科瑞华、上海瓯立、中化创新、泰州东泽、金玉诺科、周峰、合翼科技、中福泉州、国科正道 9 名股东签署了《江苏科化新材料科技有限公司股东协议书》（以下简称“《股东协议书》”），约定如出现下列情形之一，前述 9 名股东有权要求退出持有的发行人股权，退出方式包括发行人减资、管理层股东（卢绪奎、奋斗韶华及京泰君联，下同）回购或者向第三方转让股权：

（1）出现下列任一情形：①公司在 2025 年 12 月 31 日前未能具备上市申报条件；②公司在 2026 年 12 月 31 日前未能完成上市申报，或申报材料未被正式受理，或受理后主动撤回申请的。

（2）公司的核心业务发生重大变化；

（3）控股股东北京科化的各股东无法通过有效表决达成有效决议从而形成僵局，导致公司无法正常召开股东会或董事会；

（4）公司进入破产清算程序。

《股东协议书》中还约定了优先认购权、股权转让限制、优先购买权、共同出售权及优先出售权、反稀释条款、最优惠条款、清算时的分配权和关于公司治理等特殊条款。

### 2、特殊股东权利条款解除情况

2025年4月30日，公司、奋斗韶华、京泰君联、卢绪奎与上述9名股东共同签署补充协议，约定：

(1) 公司作为回购义务人的回购条款（即以公司减资方式回购）自补充协议签署之日起终止，且自始无效；

(2) 管理层股东作为回购义务人的回购条款（即管理层股东回购或向第三方转让股权）、特殊股东权利条款（优先认购权、股权转让限制、优先购买权等）自发行人上市申请被证券交易所受理之日起自动终止，且自下述任一情形发生之日起自始恢复其原有效力且视同未曾终止：①公司上市申请未被证券交易所受理；②公司上市申请被证券交易所受理后主动撤回的；③公司上市申请未能通过证券交易所审核或中国证监会注册的（第③项不属于回购触发条件）。

(3) 关于公司治理（包括但不限于投资人一票否决权、董事委派权）等约定与《公司章程》及上市审核规则的相关规定不一致的，均以《公司章程》及上市审核规则的规定为准，前述不一致条款自补充协议生效之日起自动终止。在符合法律法规规定的前提下，前述不一致条款自下述任一情形发生之日起自始恢复其原有效力且视同未曾终止：①公司上市申请未被证券交易所受理；②公司上市申请被证券交易所受理后主动撤回的；③公司上市申请未能通过证券交易所审核或中国证监会注册的。

综上所述，发行人作为回购义务人的回购条款已终止，且自始无效，对回购责任约定“自始无效”的相关协议签订日在财务报告出具日之前。公司管理层股东作为回购义务人的回购条款、特殊股东权利条款自发行人递交上市申请并被证券交易所受理之日起自动终止，关于公司治理的特殊约定自补充协议生效之日起自动终止，上述条款存在附条件恢复安排。发行人不存在可能导致公司控制权发生变化的约定，相关协议不与公司市值挂钩，不存在严重影响公司持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形，符合《监管规则适用指引——发行类第4号》的相关要求。

## **(十) 历史沿革中的股权代持情形及形成、演变、解除过程**

发行人历史沿革过程中不存在股权代持的情形。

发行人的控股股东北京科化历史沿革中曾存在股权代持的情形。北京科化的前身科化新技术公司系经中科院批准，由中科院化学所设立的全民所有制企业。

2001 年 12 月科化新技术公司改制为北京科化并引入自然人持股，当时的自然人股东曾存在股权代持的情形；至 2012 年 8 月相关股权代持情况已解除。

北京科化股权代持的形成、演变、解除具体过程如下：

### 1、北京科化股权代持的形成及演变过程

#### （1）科化新技术公司的改制情况

根据《北京科化化学新技术公司股份制改制方案》，科化新技术公司改制为北京科化，北京科化设立时的注册资本为 2,500.00 万元，其中：中科院化学所以科化新技术公司经评估确认的净资产 1,796.82 万元和现金 3.18 万元，合计出资 1,800.00 万元，占注册资本的 72%；自然人以现金出资 700.00 万元，占注册资本的 28%。

2001 年 12 月 20 日，中科院高技术产业发展局出具《关于同意北京科化化学新技术公司改制方案的批复》（产字[2001]195 号），同意改制方案。2001 年 12 月 29 日，北京科化取得改制后的《企业法人营业执照》。

#### （2）北京科化自然人股东代持的形成及演变过程

科化新技术公司改制为北京科化时，实际出资的自然人为 80 名；由于《公司法》规定有限责任公司股东人数上限为 50 名，为便于工商登记和股权管理，由 6 名自然人作为工商登记的股东（以下简称“名义股东”）代持股权。同时，北京科化考虑到设立后进一步落实奖励高管人才及技术团队的政策，设置了预留份额，并于 2002 年将部分预留份额授予了 6 名其他自然人股东，自此形成 6 名名义股东代 86 名实际出资人持有北京科化出资额的情形。

### 2、股权代持的解除过程

自北京科化改制设立至 2012 年 5 月，共有 53 名实际出资人通过北京科化股权回购的方式退出并解除与名义股东的代持关系，北京科化已回购的份额仍登记在相应的名义股东名下。截至 2012 年 5 月，尚有 33 名实际出资人通过名义股东持有北京科化股权。

为调整北京科化股权结构、解决股权代持问题并实施股权激励，2012 年 5 月，京泰君联受让 6 名自然人股东名下登记的 700.00 万元出资额（包括 33 名实际出资人持有的股权、北京科化已回购份额及剩余预留份额）。2012 年 8 月，北京科化办理完成 6 名名义股东向京泰君联转让股权的工商变更登记，北京科化历史沿革中的股权代持情况至此已全部解除。

北京科化已于 2025 年 6 月 4 日、2025 年 6 月 10 日及 2025 年 6 月 14 日在北京日报、北京晚报刊登关于其历史沿革情况核实的公告及相关提示性公告，截至本招股说明书签署日，北京科化未收到任何人员提出异议。

## 十二、发行人董事、高级管理人员及核心技术人员

### （一）董事、审计委员会成员、高级管理人员与核心技术人员情况

#### 1、董事会成员简介

截至本招股说明书签署日，公司董事会成员共 9 名，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，公司现任董事基本情况如下：

序号	姓名	职位	提名人	任职期限
1	卢绪奎	董事长、总经理	北京科化	2025 年 10 月至 2028 年 10 月
2	傅东升	董事	北京科化	2025 年 10 月至 2028 年 10 月
3	周峰	董事	北京科化	2025 年 10 月至 2028 年 10 月
4	王善学	董事、副总经理	北京科化	2025 年 10 月至 2028 年 10 月
5	张文良	董事	国科瑞华	2025 年 10 月至 2028 年 10 月
6	王锐	职工代表董事	职工代表大会	2025 年 10 月至 2028 年 10 月
7	潘林	独立董事	董事会	2025 年 10 月至 2028 年 10 月
8	洪磊	独立董事	董事会	2025 年 10 月至 2028 年 10 月
9	宋正奇	独立董事	董事会	2025 年 10 月至 2028 年 10 月

公司董事的主要简历如下：

卢绪奎先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 7 月至 2001 年 2 月，历任中科院化学所助理研究员、高级工程师；2001 年 3 月至 2004 年 12 月，任江苏扬州科技局副局长（挂职）；2005 年 2 月至 2005 年 4 月，借调中国科学院人事教育局；2005 年 5 月至 2022 年 7 月，历任北京科化副总经理，总经理、董事；2009 年 12 月至 2022 年 7 月，历任首科化董事、董事长；2011 年 10 月至今，任中科科化董事长、总经理。

傅东升先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2012 年 7 月至今，先后担任中科院化学所科技处主管、副处长，重大任务处处长；2023 年 12 月至今，任北京科化董事长；2022 年 4 月至今，任中科科化董事。

周峰先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学 EMBA。2006 年 9 月至今，任泰州嘉利制衣有限公司执行董事、总经理；2013 年 12 月至今，任北京科化董事；2014 年 3 月至今，任中科科化董事。

王善学先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004 年 12 月至 2005 年 3 月，任北京东方仿真软件技术有限公司研发工程师；2005 年 4 月至 2021 年 3 月，历任北京科化技术开发部工程师及部长助理、技术质量部部长、技术部部长及产品总监、运营总监、研发总监；2017 年 2 月至 2021 年 3 月，任中科科化董事；2021 年 4 月至今，任中科科化董事、副总经理，并自 2024 年 7 月起担任技术中心负责人。

张文良先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016 年 7 月至今，任中国科技产业投资管理有限公司投资总监；2023 年 4 月至今，任中科科化董事。

王锐先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年 7 月至 2013 年 1 月，任首科化研发工程师；2013 年 2 月至 2021 年 3 月，任北京科化研发部高级经理；2022 年 7 月至今，任首科化监事；2023 年 12 月至今，任北京科化监事；2021 年 4 月至今，先后担任中科科化研发工程师、泰州研发中心副主任；2024 年 3 月至今，先后担任中科科化监事、职工代表董事。

潘林先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986 年 7 月至 2012 年 12 月，历任中国电子科技集团公司第五十三研究所助理工程师、副处长、处长、所长助理、副所长；2012 年 12 月至 2020 年 5 月，任中国电子科技集团公司第四十六研究所所长、党委副书记；2020 年 5 月至 2022 年 11 月，任中电科半导体材料有限公司监事会主席；2022 年 12 月至今，任中电科蓝天科技股份有限公司董事；兼任中国电子材料行业协会理事长；2024 年 6 月至今，任中科科化独立董事。

洪磊先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2003 年 2 月至 2016 年 11 月，任江苏天宏华信会计师事务所有限公司副所长；2016 年 11 月至今，任上会会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所副所长；兼任江苏银行股份有限公司独立董事、紫金财产保险股份有限公司独立董事、徐州矿务集团有限公司外部董事；2024 年 6 月至今，任中科科化独立董事。

宋正奇先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 3 月至 2008 年 1 月，历任上海市金茂律师事务所律师助理、律师；2008 年 1 月至 2012 年 9 月，历任上海金茂凯德律师事务所律师、合伙人；2012 年 9 月至今，先后担任上海市锦天城律师事务所律师、合伙人、高级合伙人；2024 年 6

月至今，任中科科化独立董事。

## 2、审计委员会成员简介

报告期初至 2025 年 5 月，公司设置监事会。2025 年 5 月 10 日，公司召开股东大会，审议通过公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，本届审计委员会成员为洪磊、潘林、傅东升，由洪磊担任召集人。

前述审计委员会成员的简历参见本节“十二、发行人董事、高级管理人员及核心技术人员（一）董事、审计委员会成员、高级管理人员与核心技术人员情况 1、董事会成员简介”。

## 3、高级管理人员简介

截至本招股说明书签署日，公司高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	职位
1	卢绪奎	董事长、总经理
2	王善学	董事、副总经理
3	宋永成	副总经理
4	姚克	副总经理
5	伊高领	董事会秘书、财务总监

公司高级管理人员的主要简历如下：

卢绪奎先生，公司董事长、总经理，个人简历参见本节“十二、发行人董事、高级管理人员及核心技术人员（一）董事、审计委员会成员、高级管理人员与核心技术人员情况 1、董事会成员简介”。

王善学先生，公司董事、副总经理，个人简历参见本节“十二、发行人董事、高级管理人员及核心技术人员（一）董事、审计委员会成员、高级管理人员与核心技术人员情况 1、董事会成员简介”。

宋永成先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996 年 4 月至 2002 年 8 月，任日本东芝株式会社技术部技术担当；2002 年 8 月至 2003 年 3 月，任日本京瓷化学株式会社技术部技术主务；2003 年 3 月至 2014 年 3 月，任京瓷化学（无锡）有限公司总经理，2014 年 4 月至 2016 年 3 月，历任日本京瓷化学株式会社海外支援部部长、化成品事业部部长；2016 年 5 月至 2025 年 2 月，任无锡鹤见技术服务有限公司执行董事、总经理；2023 年 7 月至今，任中科科化副总经理。

姚克先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005

年 10 月至 2021 年 3 月, 历任北京科化采购员、销售经理、销售总监、副总经理; 2017 年 3 月至 2022 年 7 月, 任首科化董事; 2021 年 4 月至今, 任中科科化副总经理。

伊高领先生, 1979 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 注册会计师非执业会员。2002 年 5 月至 2006 年 4 月, 任深圳首钢实业公司财务经理; 2006 年 5 月至 2021 年 3 月, 历任北京科化财务总监、行政总监; 2011 年 11 月至 2022 年 7 月, 任首科化董事、财务总监; 2021 年 4 月至 2022 年 11 月, 任中科科化财务总监; 2022 年 11 月至今, 任中科科化董事会秘书、财务总监。

#### 4、核心技术人员简介

截至本招股说明书签署日, 公司核心技术人员基本情况如下:

序号	姓名	职位
1	王善学	董事、副总经理、技术中心主任
2	李刚	首席科学家
3	梅胡杰	研发总监
4	张之魁	技术总监
5	闵玉勤	资深高级工程师

公司核心技术人员的主要简历如下:

王善学先生, 公司董事、副总经理、技术中心主任, 个人简历参见本节“十二、发行人董事、高级管理人员及核心技术人员 (一) 董事、审计委员会成员、高级管理人员与核心技术人员情况 1、董事会成员简介”。

李刚先生, 1969 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历。1991 年 8 月至 2002 年 5 月, 任中科院化学所工程师; 2002 年 6 月至 2021 年 3 月, 历任北京科化副总工程师、总工程师; 2011 年 10 月至 2022 年 7 月, 任首科化董事; 2021 年 4 月至今, 任中科科化首席科学家。

梅胡杰先生, 1980 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 博士研究生学历。2008 年 3 月至 2012 年 4 月, 任汉高华威电子有限公司高级研发工程师; 2012 年 5 月至 2017 年 3 月, 任爱博斯迪科化学 (上海) 有限公司研发经理; 2017 年 4 月至 2022 年 10 月, 任衡所华威电子有限公司研发经理、首席战略官; 2022 年 12 月至今, 任中科科化研发总监。

张之魁先生, 1983 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历。2008 年 10 月至 2013 年 3 月, 任日立化成工业 (苏州) 有限公司技术主任;

2013年4月至2018年9月，任金刚化工（昆山）有限公司技术经理；2018年9月至2018年11月，任贺利氏招远（常熟）电子材料有限公司销售经理；2018年12月至2023年1月，任金刚化工（昆山）有限公司技术经理；2023年1月至今，先后担任中科科化产品总监、技术总监。

闵玉勤先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2017年6月至2020年1月，任江苏太阳集团有限公司研发中心副主任；2020年2月至今，先后担任中科科化技术总监、总工程师、资深高级工程师。

## 5、董事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况及所兼职单位与发行人的关联关系

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员及核心技术人员在公司之外的其他机构兼职情况如下：

姓名	公司职务	兼职单位	兼职职务	关联关系
卢绪奎	董事长 总经理	奋斗韶华	执行事务合伙人	公司的员工持股平台
		京泰君联	执行董事	公司及控股股东的员工持股平台
		北京国特杜仲科技发展有限公司	总经理	公司董事长、总经理担任总经理的企业（已吊销）
傅东升	董事	北京科化	董事长	公司控股股东
		北京中科北化科技管理有限公司	执行董事、总经理	公司董事担任执行董事、总经理的企业
		北京新化正隆科技有限公司	董事长	公司董事担任董事长的企业
		山东中科恒联生物基材料有限公司	副董事长	公司董事担任副董事长的企业
		广东中科华通新材料科技有限公司	副董事长	公司董事担任副董事长的企业
		中科纳米技术工程中心有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
		浙江中科恒泰新材料科技有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
		中科先行工程塑料国家工程研究中心股份有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
周峰	董事	北京科化	董事	公司控股股东
		泰州市润峰电子科技有限公司	执行董事、总经理	公司间接持股5%以上法人股东泰富投资的全资子公司，公司董事担任执行董事、总经理的企业
		泰州嘉和制衣有限公司	总经理	公司董事担任总经理的企业
		泰州嘉利制衣有限公司	执行董事、总经理	公司董事担任执行董事、总经理的企业
		泰州市海洋服装水洗有限公司	总经理	公司董事担任总经理的企业，已吊销

姓名	公司职务	兼职单位	兼职职务	关联关系
		泰州市嘉和中央厨房配餐有限公司	监事	公司董事持股 70.00%并担任监事的企业
		泰州市海陵区泰华服饰有限公司	监事	—
张文良	董事	南京集溢半导体科技有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
		大庆溢泰半导体材料有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
		深圳通锐微电子技术有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
		四川易冲科技有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
王锐	职工代表 董事	北京科化	监事	公司控股股东
		首科化	监事	公司控股股东的全资子公司
潘林	独立董事	中电科蓝天科技股份有限公司	董事	—
		中国电子材料行业协会	理事长	—
洪磊	独立董事	江苏银行股份有限公司	独立董事	—
		紫金财产保险股份有限公司	独立董事	—
		徐州矿务集团有限公司	外部董事	—
		江苏省注册会计师协会	专业技术委员会副主任	—

除上述情形外，公司董事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他兼职情况。

## 6、董事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员及核心技术人员相互之间不存在亲属关系。

## 7、董事、高级管理人员和核心技术人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况

公司董事、高级管理人员和核心技术人员最近三年不涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。

## （二）公司与董事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及其履行情况

公司与在公司专职的董事、高级管理人员及核心技术人员均签署了劳动合同及保密协议，与独立董事签署了聘任合同。截至本招股说明书签署日，上述合同均正常履行，不存在违约的情形。

除上述协议外，公司董事、高级管理人员及核心技术人员未与公司签订对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的其他协议。

### （三）董事、取消监事会前在任监事/审计委员会成员、高级管理人员及核心技术人员近两年的变动情况

#### 1、董事变动情况

期间	董事会成员	变动原因
2023年初至 2023年4月	卢绪奎、傅东升、周峰、王善学、孙丛姗	-
2023年4月至 2024年6月	卢绪奎、傅东升、周峰、王善学、张文良	机构股东调整提名董事，孙丛姗因个人原因辞去董事职务，股东大会选举张文良担任公司董事
2024年6月至 2025年5月	卢绪奎、傅东升、周峰、王善学、张文良、潘林、洪磊、宋正奇	为完善公司法人治理结构，新增潘林、洪磊、宋正奇三位独立董事
2025年5月 至今	卢绪奎、傅东升、周峰、王善学、张文良、王锐、潘林、洪磊、宋正奇	增加王锐担任职工代表董事，进一步完善公司治理结构

2023年初，公司董事会成员为卢绪奎（董事长）、傅东升、周峰、王善学、孙丛姗。

2023年4月，公司召开股东大会，原董事孙丛姗因个人原因辞去公司董事职务，公司增补张文良为董事。

2024年6月，公司召开股东大会，为完善公司法人治理结构，新增潘林、洪磊、宋正奇三位独立董事。

2025年5月，公司召开职工代表大会，选举王锐担任职工代表董事。

发行人董事的上述变动履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，最近两年董事没有发生重大不利变化。

#### 2、取消监事会前在任监事/审计委员会成员变动情况

期间	监事会成员	变动原因
2023年初至 2024年3月	韩晓娜、阮荣光、殷雅蓓	-
2024年3月至 2024年6月	韩晓娜、王锐、殷雅蓓	阮荣光因个人原因辞去监事，公司增补王锐担任监事
2024年6月至 2025年4月	韩晓娜、王锐、黄娟	殷雅蓓因离职而辞去职工代表监事，公司职工代表大会选举黄娟担任职工代表监事

期间	监事会成员	变动原因
2025年5月至今	-	公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权

2023年初，公司监事会成员为韩晓娜（监事会主席）、阮荣光、殷雅蓓（职工代表监事）。

2024年3月，公司召开股东大会，原监事阮荣光因个人原因辞去公司监事职务，增补王锐担任公司监事。

2024年6月，公司召开职工代表大会，由于原职工代表监事殷雅蓓离职，选举黄娟担任公司职工代表监事。

2025年5月，公司召开股东大会，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，审计委员会成员为洪磊、潘林、傅东升，由洪磊担任召集人。

公司监事的上述变动及取消监事会均履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，最近两年监事没有发生重大不利变化。

### 3、高级管理人员变动情况

姓名	职务		
	2023年初至2023年7月	2023年7月至2024年6月	2024年6月至今
卢绪奎		总经理	
王善学		副总经理	
姚克		副总经理	
伊高领		董事会秘书、财务总监	
李刚	首席科学家		
	根据当时《公司章程》，首席科学家为高级管理人员		修改《公司章程》后不属于高级管理人员
曹延生	副总经理	-	
宋永成	-		副总经理

2023年初，公司高级管理人员为卢绪奎、王善学、姚克、伊高领、李刚、曹延生。

2023年7月，公司董事会聘任宋永成为副总经理，免去曹延生副总经理职务。

2024年6月，公司修改《公司章程》，首席科学家不再属于公司的高级管理人员，因此李刚作为公司的首席科学家，不再属于高级管理人员。

公司高级管理人员的上述变动履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，最近两年高级管理人员没有发生重大不利变化。

### 4、核心技术人员变动情况

最近两年公司核心技术人员为王善学、李刚、梅胡杰、张之魁和闵玉勤，未发生变化。

#### （四）董事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员及核心技术人员不存在与公司及其业务相关的其他对外投资情况。除持有公司、公司及控股股东的员工持股平台股权/出资额外，公司董事、高级管理人员及核心技术人员主要对外投资情况如下：

姓名	公司职务	企业名称	持股/出资比例（%）
周峰	董事	泰州嘉泰电子科技有限公司	100.00
		泰州市嘉和中央厨房配餐有限公司	70.00
		泰州嘉和制衣有限公司	72.78
		泰州市海陵区泰华服饰有限公司	26.00
		泰州市海洋服装水洗有限公司	20.00
张文良	董事	深圳市航顺芯片技术研发有限公司	0.11
		北京国科启航咨询中心（有限合伙）	0.55
		北京国科正道投资中心（有限合伙）	0.34
		四川易冲科技有限公司	0.04
		广州显芯科技有限公司	0.04
		浙江绍兴鼎晶生物医药科技股份有限公司	0.0017
洪磊	独立董事	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	0.90
宋永成	副总经理	无锡鹤见技术服务有限公司	50.00
		无锡鹤见企业管理咨询有限公司	50.00

上述人员的对外投资与发行人业务不存在利益冲突。

#### （五）董事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况

单位：万股、%

序号	姓名	职位/关系	直接持股		间接持股			合计持股比例
			直接持股数量	直接持股比例	间接持股主体	间接持股数量	间接持股比例	
1	卢绪奎	董事长、总经理	-	-	奋斗韶华 京泰君联	275.02	4.17	4.17
2	周峰	董事	123.37	1.87	-	-	-	1.87
3	周宝祥	周峰的父亲	-	-	泰富投资	867.20	13.14	13.14
4	潘春年	周峰的配偶	-	-	泰富投资	371.66	5.63	5.63
5	王善学	董事、副总经理、 核心技术人员	-	-	奋斗韶华 京泰君联	113.36	1.72	1.72
6	张文良	董事	-	-	国科正道 国科瑞华	0.03	0.0004	0.0004
7	王锐	职工代表董事	-	-	京泰君联	9.53	0.14	0.14

序号	姓名	职位/关系	直接持股		间接持股			合计持股比例
			直接持股数量	直接持股比例	间接持股主体	间接持股数量	间接持股比例	
8	宋永成	副总经理	-	-	奋斗韶华	10.65	0.16	0.16
9	姚克	副总经理	-	-	奋斗韶华 京泰君联	149.83	2.27	2.27
10	伊高领	董事会秘书、 财务总监	-	-	奋斗韶华 京泰君联	113.36	1.72	1.72
11	李刚	首席科学家、 核心技术人员	-	-	奋斗韶华 京泰君联	122.89	1.86	1.86
12	梅胡杰	研发总监、 核心技术人员	-	-	奋斗韶华	10.65	0.16	0.16
13	张之魁	技术总监、 核心技术人员	-	-	奋斗韶华	10.65	0.16	0.16
14	闵玉勤	资深高级工程师、 核心技术人员	-	-	奋斗韶华	9.86	0.15	0.15

注：张文良通过国科正道及国科瑞华的相关跟投平台间接持有发行人股份。

除上述情形外，公司董事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

截至本招股说明书签署日，公司董事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有的发行人股份不存在质押、冻结、发生诉讼纠纷或其它有争议的情况。

## （六）董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员领取薪酬情况

### 1、薪酬组成、确认依据及所履行的程序

报告期内，在公司专职的董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员、核心技术人员的薪酬主要由工资、奖金、社会保险、住房公积金等组成，独立董事领取独立董事津贴，其他外部董事、外部监事不领取发行人薪酬。

公司董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定薪酬计划或方案，对公司薪酬制度执行情况进行监督。

### 2、薪酬总额占利润总额的比重

报告期内，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬总额占利润总额的比例情况如下：

单位：万元、%

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
薪酬总额	391.18	961.61	813.67	557.64
利润总额	1,777.70	3,898.26	1,100.67	549.69
占比	22.00	24.67	73.92	101.45

注：上述薪酬包含当期卸任或新增人员当期的全部薪酬，包含公司缴纳的社保、住房公积金，未包含股份支付金额。

### 3、最近一年从发行人领取薪酬的情况

2024 年度，公司董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及核心技术人员从发行人或发行人关联企业领取收入的情况如下：

单位：万元

姓名	职务	薪酬	是否从关联企业领取薪酬
卢绪奎	董事长、总经理	133.86	否
傅东升	董事	-	是，从中科院化学所领取薪酬
张文良	董事	-	否
周峰	董事	-	是，从泰州嘉泰电子科技有限公司领取薪酬
王善学	董事、副总经理	86.52	否
王锐	职工代表董事，原监事	40.85	否
潘林	独立董事	4.08	否
洪磊	独立董事	4.08	否
宋正奇	独立董事	4.08	否
韩晓娜	原监事会主席，自 2025 年 5 月起不再担任监事	-	是，从中科院化学所领取薪酬
黄娟	原职工代表监事，自 2025 年 5 月起不再担任监事	14.09	否
殷雅蓓	原职工代表监事，自 2024 年 6 月起不再担任监事	8.17	否
阮荣光	原监事，自 2024 年 3 月起不再担任监事	-	是，从上海邦虎物业管理有限公司领取薪酬
宋永成	副总经理	122.02	否
姚克	副总经理	168.48	否
伊高领	董事会秘书、财务总监	83.34	否
李刚	首席科学家、核心技术人员	90.14	否
梅胡杰	研发总监、核心技术人员	85.34	否
张之魁	技术总监、核心技术人员	67.47	否
闵玉勤	资深高级工程师、核心技术人员	49.09	否

注：①上述薪酬包含当年度卸任或新增人员当年度的全部薪酬，包含公司缴纳部分社保、住房公积金，未包含股份支付金额。

②卢绪奎、李刚拥有中科院化学所编制，中科院化学所代为缴纳社会保险及职业年金，费用由发行人全额承担。

## 十三、已经制定或实施的股权激励及相关安排

截至本招股说明书签署日，奋斗韶华为公司的员工持股平台，京泰君联为公司及北京科化的员工持股平台。公司不存在已制定尚未实施的员工持股计划的情况。

## (一) 本次发行申报前已经制定或实施的股权激励的基本情况

### 1、持股平台具体情况

#### (1) 奋斗韶华

截至本招股说明书签署日，奋斗韶华直接持有发行人 6.46%的股份。奋斗韶华的基本信息参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况 七、控股股东、实际控制人及持股 5%以上主要股东的基本情况 (二) 持有发行人 5%以上股份的其他主要股东基本情况”。

#### (2) 京泰君联

截至本招股说明书签署日，京泰君联通过北京科化间接持有发行人 18.77%的股份。京泰君联的基本情况如下：

公司名称	北京京泰君联科技有限公司
成立时间	2012 年 5 月 16 日
注册资本	1,300.00 万元
注册地	北京市昌平区沙河镇松兰堡村沙河工业区临 168 号
法定代表人	卢绪奎
经营范围	技术推广、技术服务；投资服务；销售化工产品(不含危险化学品)、电子产品；技术进出口；货物进出口；代理进出口
主营业务及其与发行人主营业务的关系	无具体经营业务，与发行人主营业务不存在直接关系

截至本招股说明书签署日，京泰君联股东及出资情况如下：

单位：万元、%

序号	股东姓名	出资额	任职情况	出资比例
1	卢绪奎	210.00	发行人董事长、总经理	16.15
2	姚克	120.00	发行人副总经理	9.23
3	李刚	100.00	发行人首席科学家	7.69
4	王善学	90.00	发行人董事、副总经理、技术中心主任	6.92
5	伊高领	90.00	发行人董事会秘书、财务总监	6.92
6	张秋华	80.00	北京科化原行政总监，已退休	6.15
7	曹延生	60.00	发行人品质总监	4.62
8	于永江	60.00	北京科化及其子公司原法律顾问，已离职	4.62
9	李易松	50.00	发行人销售部部长	3.85
10	周洪涛	50.00	北京科化原副总经理，已离职	3.85
11	林小剑	45.00	发行人采购部部长	3.46
12	孙海平	40.00	发行人销售部副部长	3.08
13	陈继东	35.00	发行人北京分公司副总经理	2.69
14	李海亮	30.00	发行人资深高级工程师	2.31
15	吕文松	30.00	北京科化原深圳分公司负责人，已离职	2.31
16	王全胜	25.00	发行人设备动力部部长	1.92
17	许大伟	22.50	发行人综合部副部长	1.73

序号	股东姓名	出资额	任职情况	出资比例
18	徐伟	20.00	发行人制造部副部长	1.54
19	马小元	20.00	发行人审计部部长	1.54
20	常治国	19.50	发行人研发工程师	1.50
21	陈思	13.00	发行人制造部副部长	1.00
22	杜剑	10.00	首科化副总经理	0.77
23	高峰	10.00	发行人销售专员	0.77
24	张晓伟	10.00	北京科化董事、总经理	0.77
25	陈立龙	10.00	发行人销售专员	0.77
26	王锐	10.00	发行人职工代表董事、泰州研发中心副主任	0.77
27	武玉乐	10.00	发行人品保部副部长	0.77
28	马骥	10.00	发行人销售专员	0.77
29	张晓峰	10.00	发行人制造部部长	0.77
30	李卓	10.00	发行人资深高级工程师	0.77
合计		1,300.00	-	100.00

## 2、主要安排

### （1）员工持股平台的股份锁定期

根据奋斗韶华出具的关于股份锁定、持股意向及减持意向的承诺及合伙协议的约定，自公司股票上市之日起 12 个月内，奋斗韶华不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。

京泰君联持有北京科化 29.07%的股份，根据北京科化出具的股份锁定及减持意向的承诺，自公司股票上市之日起 36 个月内，北京科化不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。

具体股份锁定安排参见本招股说明书“第十二节 附件 五、与投资者保护相关的承诺”。

### （2）员工持股平台对合伙份额转让的约定

#### ①奋斗韶华

《泰州市奋斗韶华科技创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》及补充协议对合伙人份额转让或退出做出了明确约定：

合伙人同意并承诺在发行人的服务期限不少于自合伙人取得出资额之日起 60 个月，退出方式分为强制退出、非强制退出，具体如下：

退出方式	具体内容
强制退出	<p>合伙人被强制退出合伙企业，适应于以下三种情形：</p> <p>1、因合伙人违反劳动法及相关法律法规、被依法追究刑事责任、严重不符合发行人内部员工绩效考核标准和规则等，被发行人依法辞退的；</p> <p>2、合伙人存在恶意损害合伙企业、发行人或其股东利益的重大情形；</p> <p>3、因合伙人故意或重大过错，造成合伙企业、发行人或其股东利益的重大损害。</p> <p>若合伙人被强制退出合伙企业，则无论承诺服务期限是否已届满，且无论发行人是否已实现上市或被上市公司收购，合伙人均承诺无条件以下述公式计算的价格为限转让其届时所持全部出资额（计算结果为负数的，则转让价格为零）：</p> $\text{转让价格} = \text{实际支付的取得该出资额的价格} - \text{已实际取得的分红合计数}.$
非强制退出	<p>（一）承诺服务期届满前，若合伙人与发行人协商一致而解除劳动关系</p> <p>1、若发行人未实现上市或被上市公司收购，则：转让价格=实际支付的取得该出资额的价格 <math>\times (1+2\% \times \text{实际持有该出资额天数}/365)</math> - 已实际取得的分红合计数。</p> <p>2、若发行人已实现上市或被上市公司收购，则：转让价格=实际支付的取得该出资额的价格 + (转让日该出资额的公允价格 - 实际支付的取得该出资额的价格) <math>\times \text{实际持有该出资额月数}/60</math>。</p> <p>（二）承诺服务期限届满之前，合伙人因婚姻、债务纠纷等原因需要对所持出资额进行处置</p> <p>1、若发行人未实现上市或被上市公司收购，则：转让价格=实际支付的取得该出资额的价格 <math>\times (1+3\% \times \text{实际持有该出资额天数}/365)</math> - 已实际取得的分红合计数。</p> <p>2、若发行人已实现上市或被上市公司收购，则：转让价格=实际支付的取得该出资额的价格 + (转让日该出资额的公允价格 - 实际支付的取得该出资额的价格) <math>\times \text{实际持有该出资额月数}/60</math>。</p> <p>（三）承诺服务期限届满之前，合伙人因疾病、死亡等客观原因而与发行人终止《劳动合同》</p> <p>1、若发行人未实现上市或被上市公司收购，则：转让价格=实际支付的取得该出资额的价格 <math>\times (1+4\% \times \text{实际持有该出资额天数}/365)</math> - 已实际取得的分红合计数。</p> <p>2、若发行人已实现上市或被上市公司收购，则：转让价格=实际支付的取得该出资额的价格 + (转让日该出资额的公允价格 - 实际支付的取得该出资额的价格) <math>\times \text{实际持有该出资额月数}/60</math>。</p>
承诺服务期届满后退出	<p>承诺服务期限届满之后，除前述规定的强制退出情形外，合伙人或其合法继承人可以选择以下任一方式：</p> <p>1、继续持有出资额。</p> <p>2、若发行人未实现上市或被上市公司收购，则由转让方和受让方协商确定转让价格。</p> <p>3、若发行人已实现上市或被上市公司收购，转让价格为转让日该出资额的公允价格。</p>

## ②京泰君联

《北京京泰君联科技有限公司出资协议书》关于股权的限制与转让约定如下：

出资人发生严重损害京泰君联及北京科化利益的情形，或者自京泰君联设立之日起五年内，因主观原因与北京科化解除、终止劳动合同的，代表三分之二以上表决权的股东有权决定以特定价格回购其股权或指定其他出资人以特定价格

受让其股权，特定价格是指股东会作出决定当日该股权的实际价值与其原始出资额之间的孰低者。

出资人自京泰君联设立之日起为京泰君联及北京科化服务满五年，而又没有发生严重损害京泰君联及北京科化利益情形的，因主观或者非主观原因与北京科化解除、终止劳动合同，均可以分享京泰君联及北京科化股权增值的收益，并继续持有京泰君联股权。

股东之间可以相互转让其全部或者部分股权，但须经过半数表决权的股东同意。除继承关系外，股东不得向股东以外的人转让其出资。

## （二）股权激励对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响

通过实施上述股权激励，有利于充分调动员工积极性、激发员工潜能、保持管理团队和人才队伍的稳定，为公司持续、稳定、快速发展提供了重要保障。

为公允地反映股权激励对公司财务状况的影响，公司对股权激励确认了股份支付费用。公司的股份支付费用按照授予对象的所属部门及职能分别计入销售费用、管理费用、研发支出或营业成本等会计科目，具体情况如下：

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
管理费用	91.67	185.08	251.37	206.82
销售费用	31.24	156.96	82.12	67.61
研发费用	39.93	78.11	94.60	76.48
营业成本	26.51	53.02	69.68	59.11
合计	189.35	473.18	497.77	410.02

公司无实际控制人且报告期内未发生变化，上述股权激励未对公司控制权变化造成影响。

## 十四、发行人员工情况及社会保障情况

### （一）员工基本情况

#### 1、员工人数及变动

报告期各期末，公司员工人数及变动情况如下：

单位：人、%

2025年6月30日		2024年12月31日		2023年12月31日		2022年12月31日	
员工人数	变动率	员工人数	变动率	员工人数	变动率	员工人数	变动率
308	8.07	285	17.77	242	-5.47	256	-

## 2、员工专业结构

截至 2025 年 6 月 30 日，公司员工的专业结构情况如下：

专业结构	员工人数(人)	占比(%)
研发人员	46	14.94
生产人员	192	62.34
销售人员	16	5.19
行政管理人员及其他	54	17.53
合计	308	100.00

## 3、员工受教育程度

截至 2025 年 6 月 30 日，公司员工受教育程度如下：

受教育程度	员工人数(人)	占比(%)
硕士及以上	28	9.09
本科	61	19.81
大专	49	15.91
大专以下	170	55.19
合计	308	100.00

## 4、员工年龄分布

截至 2025 年 6 月 30 日，公司员工的年龄分布情况如下：

年龄分布	员工人数(人)	占比(%)
30 岁及以下	61	19.81
31-40 岁	145	47.08
41-50 岁	74	24.03
51 岁及以上	28	9.09
合计	308	100.00

## (二) 社会保障及住房公积金制度执行情况

报告期各期末，公司社会保险和住房公积金缴纳情况如下：

单位：人、%

项目	社会保险缴纳情况							
	2025 年 6 月 30 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	人数	占比	人数	占比	人数	占比	人数	占比
在册员工总数	308	100.00	285	100.00	242	100.00	256	100.00
公司缴纳人数	293	95.13	269	94.39	233	96.28	239	93.36
退休返聘无需缴纳人数	10	3.25	10	3.51	9	3.72	7	2.73
未缴纳人数	5	1.62	6	2.11	—	—	10	3.91
其中：当月入职	5	1.62	6	2.11	—	—	2	0.78
自愿放弃	—	—	—	—	—	—	2	0.78
公司未缴纳	—	—	—	—	—	—	6	2.34
住房公积金缴纳情况								

项目	2025年6月30日		2024年12月31日		2023年12月31日		2022年12月31日	
	人数	占比	人数	占比	人数	占比	人数	占比
在册员工总数	308	100.00	285	100.00	242	100.00	256	100.00
公司缴纳人数	294	95.45	269	94.39	210	86.78	212	82.81
退休返聘无需缴纳人数	10	3.25	10	3.51	9	3.72	7	2.73
未缴纳人数	4	1.30	6	2.11	23	9.50	37	14.45
其中：当月入职	4	1.30	6	2.11	—	—	1	0.39
自愿放弃	—	—	—	—	16	6.61	16	6.25
公司未缴纳	—	—	—	—	7	2.89	20	7.81

注：公司缴纳人数包含卢绪奎、李刚，其拥有中科院化学所编制，中科院化学所代为缴纳社会保险及住房公积金，费用由发行人承担。

报告期内，公司存在未为部分员工缴纳社会保险和住房公积金的情形，主要原因包括：（1）部分员工为退休返聘人员，无需缴纳社会保险、住房公积金；（2）部分员工当月入职，公司尚未完成社会保险、住房公积金缴纳手续；（3）部分员工自愿放弃缴纳。截至报告期末，公司已不存在因员工自愿放弃而未缴纳社会保险、住房公积金的情形。

根据公司及分公司所在地人力资源和社会保障主管部门、住房公积金主管部门出具的证明或回复、《江苏省企业上市合法合规信息核查报告》、《市场主体专用信用报告（有无违法违规信息查询版）》，公司及分公司报告期内不存在受到人力资源和社会保障主管部门、住房公积金主管部门行政处罚的情形。

公司的控股股东北京科化已出具承诺：若发行人因本次发行上市前执行社会保险和住房公积金政策事宜，被有关政府部门要求补缴社会保险或住房公积金，导致发行人需要承担任何补缴款项、赔偿、罚款、损失及其他支出，本公司承诺将承担由此产生的全部费用和损失，并承诺此后不向发行人追偿，确保发行人免受任何损失和损害。

### （三）劳务派遣用工情况

公司存在劳务派遣用工，报告期各期末劳务派遣用工具体情况如下：

单位：人、%

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
劳务派遣用工人数	18	17	39	7
公司员工人数	308	285	242	256
用工总人数	326	302	281	263
劳务派遣用工占比	5.52	5.63	13.88	2.66

报告期内，随着公司生产经营规模的扩大，为应对阶段性用工需求，公司通过增加劳务派遣人员以补充生产岗位缺口，导致劳务派遣用工比例曾超过 10%。公司已通过增加自主招工、劳务派遣人员竞争上岗等方式，将劳务派遣用工占比降至 10%以下，并持续规范运行。

根据泰州市海陵区人力资源和社会保障局出具的证明和《江苏省企业上市合法合规信息核查报告》，公司报告期内未因违反劳动和社会保障法律法规被行政处罚。

公司的控股股东北京科化已出具承诺：若发行人因劳务派遣用工超过法定比例或者其他劳动用工事项被有关政府部门处以罚款或被追究其他法律责任，导致发行人需要承担任何赔偿、罚款或损失，本公司承诺将承担由此产生的全部费用和损失，并承诺此后不向发行人追偿，确保发行人免受任何损失和损害。

## 第五节 业务与技术

### 一、主营业务及主要产品的基本情况

#### （一）主营业务情况

公司是一家专注于半导体封装材料研发、生产和销售的国家级专精特新“小巨人”企业，主要产品为环氧塑封料。

公司在主营业务领域拥有深厚的技术底蕴和发展传承。公司的控股股东北京科化成立于 1984 年，系我国最早的环氧塑封料产业化基地之一，先后参加了国家“七五”、“八五”、“九五”环氧塑封料攻关计划项目，并在“十五”、“十一五”期间承担了国家高技术研究发展计划（863 计划）和国家 02 科技重大专项项目中与环氧塑封料相关的子课题。2011 年 10 月，北京科化全资设立科化有限，从事半导体封装用环氧塑封料的研发及产业化。

历经十余年的创新发展，公司已成为少数具备中高端环氧塑封料自主研发和规模化生产能力的内资厂商之一。2022 年度和 2023 年度，公司环氧塑封料业务规模分别位居内资厂商第四名和第三名，2024 年度升至第二名，行业地位稳步提升。

公司的技术实力和产品性能得到权威部门和客户的广泛认可。高端环氧塑封料代表产品被中国电子材料行业协会鉴定为“性能达到国际同类产品先进水平”；中端环氧塑封料代表产品被江苏省工信厅鉴定为“国内领先”。依托自身技术实力，公司独立承担了多个省市级重大科技项目，正在参与国家科技部 2025 年国家重点研发计划专项项目。

2025 年 5 月，公司成功入选“江苏省先进级智能工厂”名单，成为省内环氧封装材料领域智能制造标杆企业。2025 年 7 月，公司高端环氧塑封料代表产品 KHG900 系列成功入选江苏省工信厅《江苏省重点推广应用的新技术新产品目录（2025 年）》首批次认定的 33 项新材料之一。2025 年 10 月，公司成功入选工信部第七批国家级专精特新“小巨人”企业名单。

公司与华润微(688396.SH)、蓝箭电子(301348.SZ)、捷捷微电(300623.SZ)、银河微电(688689.SH)、通富微电(002156.SZ)、华天科技(002185.SZ)、富满微(300671.SZ)、气派科技(688216.SH)、日月新集团、KEC 集团等下游

知名厂商建立了长期、稳定的合作关系，并获华润微“2023年度优秀供应商”、“2024年度最佳协同供应商”等荣誉。



图：公司下游主要知名客户

## （二）主要产品及服务

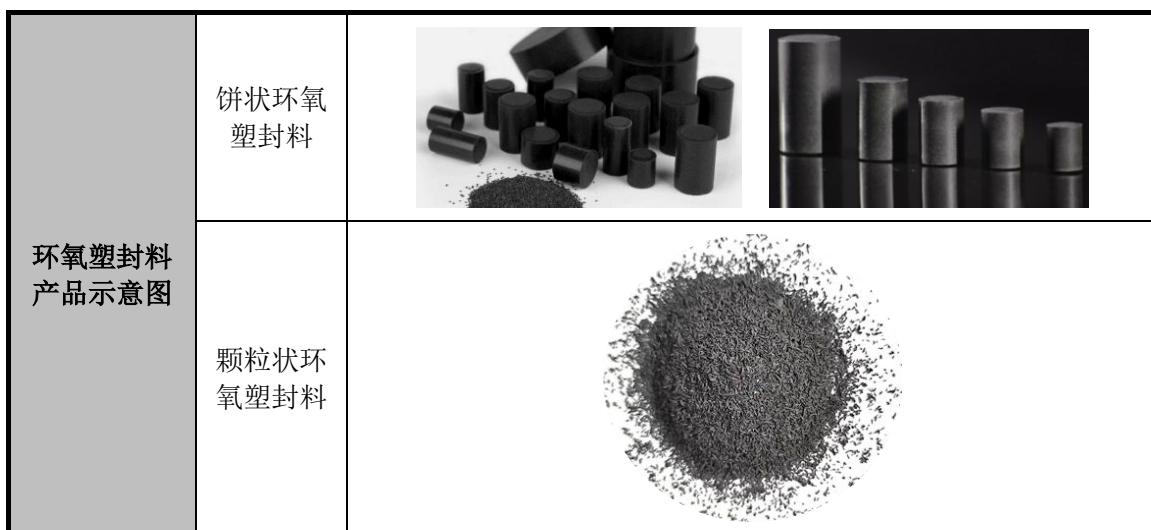
报告期内，公司主营业务收入均来自环氧塑封料销售，按产品性能分为基础型、中端和高端三类，具体构成如下：

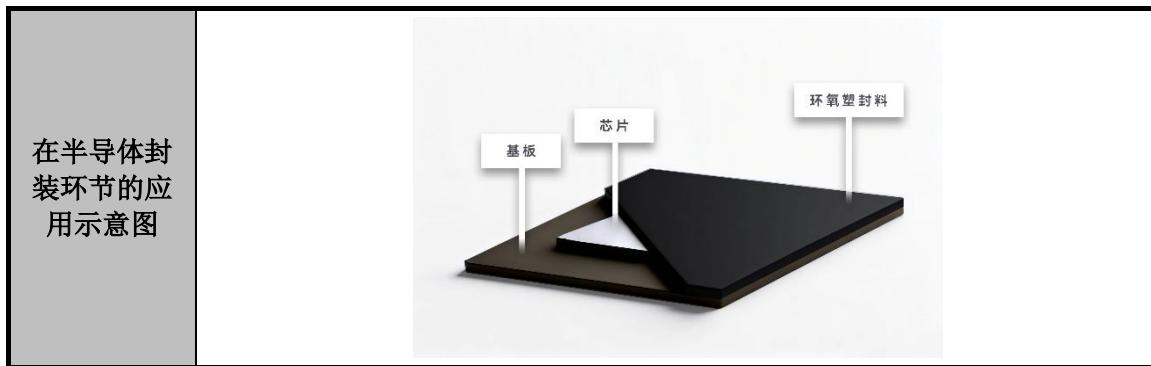
单位：万元、%

产品类别	2025年1-6月		2024年度		2023年度		2022年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
基础型	3,034.74	19.08	7,056.32	21.32	6,740.90	27.01	6,380.14	31.90
中端	11,662.80	73.34	23,923.51	72.29	16,396.11	65.71	12,932.87	64.66
高端	1,204.84	7.58	2,111.82	6.38	1,816.63	7.28	689.86	3.45
合计	15,902.38	100.00	33,091.65	100.00	24,953.63	100.00	20,002.88	100.00

### 1、环氧塑封料是半导体封装环节的关键主材料

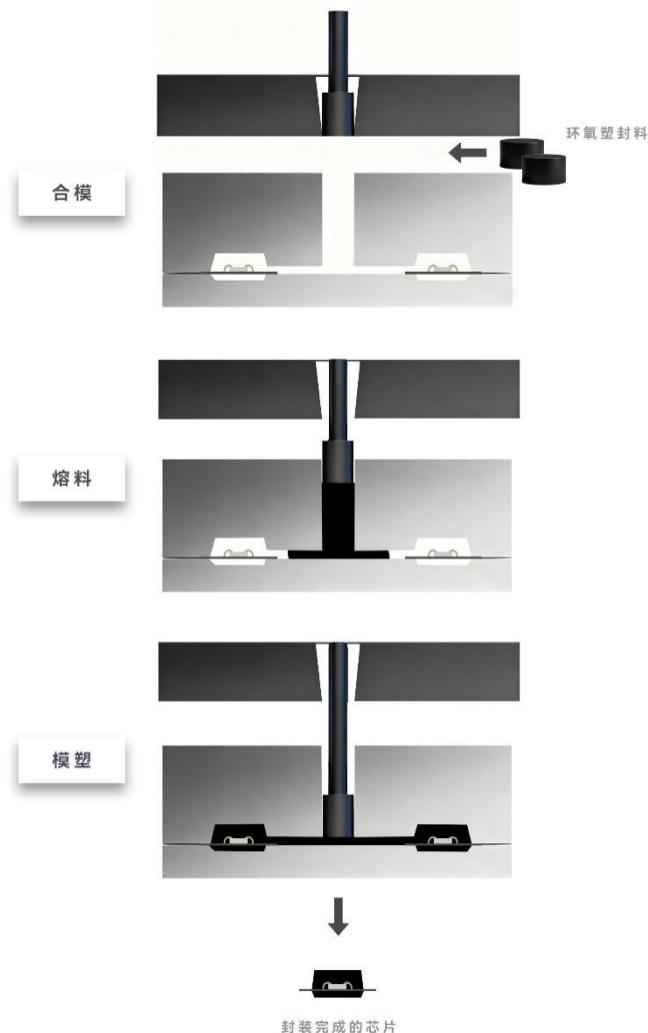
半导体封装是半导体制造的后道工序与关键环节，其作用在于保护芯片性能，并实现芯片内部功能的外部延伸。环氧塑封料系半导体封装环节的关键主材料，环氧塑封料产品及其在半导体封装环节的应用示意图如下：





注：除饼状、颗粒状环氧塑封料外，还包括液体环氧塑封料、片状环氧塑封料等产品，未在上表列示。

在半导体封装环节，以传递式模塑封装为例，将环氧塑封料熔融压入模具型腔内，将芯片或分立器件包裹其中，并在交联固化成型后具有一定结构外型。封装后的制件不仅具备良好的机械稳定性、耐湿性和耐热性等性能，还能有效隔离外部环境影响，最终实现优异的机械、电学、力学和热学性能。



图：环氧塑封料应用示意图

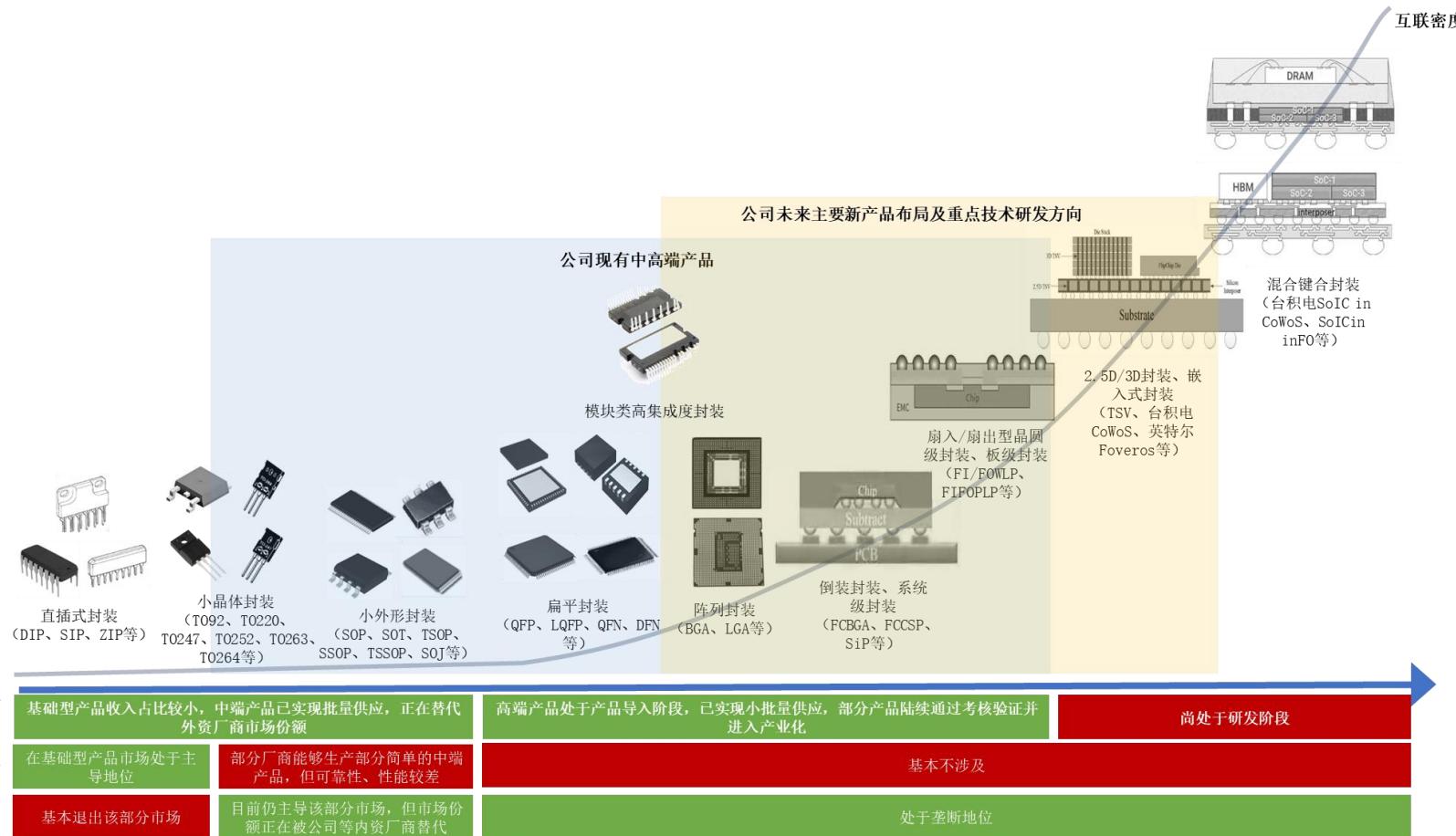
## 2、公司主要产品为半导体封装用中高端环氧塑封料

环氧塑封料产品的性能主要由封装形式和应用场景等因素共同决定。公司的环氧塑封料产品按照性能分为基础型、中端、高端三类，具体分类标准如下：

产品类型	市场份额情况	国内市场竞争格局	产品系列	产品的技术特点和性能表现	下游主要封装形式
基础型	约占国内整体市场份额的10%-20%	由内资厂商主导，日系厂商已逐步退出	KHG100/ KH9200	填料比例在所有系列中最低，产品性能仅满足简单封装需求	DO、SMX、桥块、DIP、TO等
			KHG200/ KH9100	在KHG100系列基础上通过优化配方，使产品在填料比例与KHG100系列接近的情况下，实现更低的应力	
			KHG300/ KH9300	产品的可靠性进一步升级，具体表现为：产品在回流焊工艺下不发生分层。同时，通过提高产品的填料比例，实现较100系列、200系列更低的应力以及更强的粘接力	
中端	约占国内整体市场的50%-60%，是目前国产替代空间最大的细分市场，也是目前公司正在加速进行国产替代的主要市场	主要由日系厂商主导，以公司为代表的少数内资厂商正在加速替代	KHG400/ KH9400	公司针对全包封器件重点开发的高导热产品，产品热导率达到2.0W/m·K以上，高于基础型产品的热导率	TO、SOP/SOT等
			KHG500	产品具有更高的可靠性，与基础型产品之间标志性差异主要在于产品的湿敏等级达到MSL3级以上；同时，产品应力较基础型产品进一步降低	
			KHG600	主要是KHG500系列的升级产品；公司针对行业发展趋势、市场需求等对产品进行了一定调整、优化与升级	
高端	约占国内整体市场份额的30%	基本由日系厂商垄断，内资厂商除了在少数客户和个别产品型号上实现量产，绝大多数产品处于导入阶段；以公司为代表的少数内资厂商拥有技术储备，产品逐步开始通过下游客户考核验证，并批量供应	KHG700	KHG700、KHG800和KHG900系列主要是公司针对先进封装、高端应用（汽车电子、工业控制等）、特殊应用（第三代半导体等）对环氧塑封料性能的多元化要求，对产品在不同性能维度上进行升级 KHG700系列在性能上的升级包括：针对集成度更高的功率模组封装开发的产品，针对第三代半导体高温工作环境开发的高Tg型产品，湿敏等级达到MSL1级的产品，针对大规模集成电路封装开发MSL3级产品等	TO、SOP/SOT、QFP/LQFP、QFN/DFN/PDFN、BGA/LGA、存储卡、智能卡、IPM/IGBT模块等
			KHG800	KHG800系列在性能上的升级包括：针对SIP模块封装开发的拥有更高热导率的产品（热导率进一步提升至3.0W/m·K以上），针对QFN、BGA、存储卡等封装开发的低翘曲产品等	
			KHG900	KHG900系列在性能上的升级包括： ①针对底部填充工艺开发的MUF型环氧塑封料，产品在具备较高可靠性的同时，具有良好的填充性 ②颗粒状环氧塑封料（GMC），形态与传统EMC存在一定差异，主要用于FOWLP/FOPLP先进封装，具备良好的布料和成型性、较低的固化收缩率等特点，精准匹配FOWLP/FOPLP封装工艺	FC、FOWLP/FOPLP等

我国半导体封装材料市场长期由外资厂商主导，目前环氧塑封料的整体国产化率约为30%，而在决定产业竞争力的中高端领域，国产替代进程相对缓慢，

国产化率低于 20%，高端领域基本由日系厂商垄断。面对日益复杂的国际局势和地缘政治格局，半导体封装材料供应链可能面临多重挑战，进而影响整个半导体产业的稳定与发展。公司通过持续的研发和产业化建设，形成了较为完善的产品布局，在中高端环氧塑封料领域已逐步实现对日系竞品的替代，加速推进国产化进程。



图：公司目前中高端产品布局情况

注：1、根据应用领域对产品性能的要求，部分 T0 类产品为中高端产品。

2、上图主要按照封装形式列示，公司新产品布局及重点技术研发方向还包括高端应用、特殊应用等方向，未在上图中显示。

### （三）主要经营模式

#### 1、研发模式

公司将技术创新与积累作为可持续发展的核心基础，建立了覆盖研发战略规划、研发立项与产品技术开发、客户应用与产品改进直至迭代升级的全流程研发管理体系。公司的研发机制兼顾前瞻性布局与市场需求导向，研发的重点聚焦于产品配方和生产工艺的开发及优化。

（1）**研发战略规划**：紧密围绕国家战略方向，研判半导体封测产业技术趋势及重点客户需求，结合关键原材料行业动态和公司研发基础，制定中长期产品技术开发战略规划，形成近期研发计划。

（2）**研发立项及产品技术开发**：开展目标产品的市场分析及开发可行性研究，推进关键技术（包括关键原材料、关键工艺、测试方法）的专项攻关，完成产品配方设计、性能测试与优化、工艺开发及稳定性评估、内部模拟评价等环节，最终实现产品定型。

（3）**客户应用与产品改进**：密切跟踪产品在客户端考核验证的进展与结果，针对重点客户需求开展定制化改进，持续提升产品与客户应用场景的适配性。

（4）**产品迭代升级**：基于批量使用反馈的共性问题，进行产品的二次开发，实现关键性能的持续迭代与升级。

#### 2、采购模式

公司主要采用“以产定采、合理库存”的采购模式，确保原材料供应与生产需求精准对接。公司制造部综合考量生产计划和各类原材料库存等因素，制定物料需求计划；采购部根据物料需求计划实施采购，与供应商签订采购合同并持续跟踪合同执行情况，确保物料按期、按量交付。

物料到货后，仓库工作人员对物料的品种、规格或型号、数量或重量等信息进行核对。公司品保部进行质量检验，确保物料符合质量标准，通过检验后办理入库手续。

#### 3、生产模式

公司主要采用“以销定产、合理备货”的生产模式，确保生产与市场需求紧密对接。公司一般根据下游客户提出的需求制定生产计划并排期生产。对于需求量大且客户经常采购的部分型号产品，公司会综合考虑生产计划、原材料库存及

采购周期等因素进行适当的备货，以保持生产与销售的平衡。公司拥有专业的生产管理团队，能够及时响应下游客户的各类需求，并根据市场情况进行快速调整。

#### 4、销售模式

公司采用直销为主、贸易为辅的销售模式。直销模式下公司将产品直接销售给半导体封测厂商等终端客户，贸易模式下公司将产品以买断形式销售给贸易商客户。直销模式有助于公司更好地理解客户需求，提供定制化服务，增强客户黏性；贸易模式有助于公司拓宽销售渠道，扩大对终端客户的覆盖度。

公司对直销客户和贸易商客户的定价方法和原则总体一致，根据产品成本、市场状况、客户关系及订单量等因素综合制定价格策略，旨在实现公司与客户之间的互利共赢。

通常情况下，公司与主要客户确定合作意向后首先签订框架合同，约定双方的合作模式，后续客户再根据自身需求向公司下达具体订单；未签订框架合同的客户一般直接向公司下达订单。公司依据订单安排生产和发货。

公司与个别客户采用寄售模式，具体流程为：公司与客户签订寄售合同，在收到客户发货通知后，在约定时间内将货物运至客户指定仓库，客户按照实际需求领用货物，公司在客户实际领用并经双方对账无误后确认销售收入。

#### 5、公司采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势

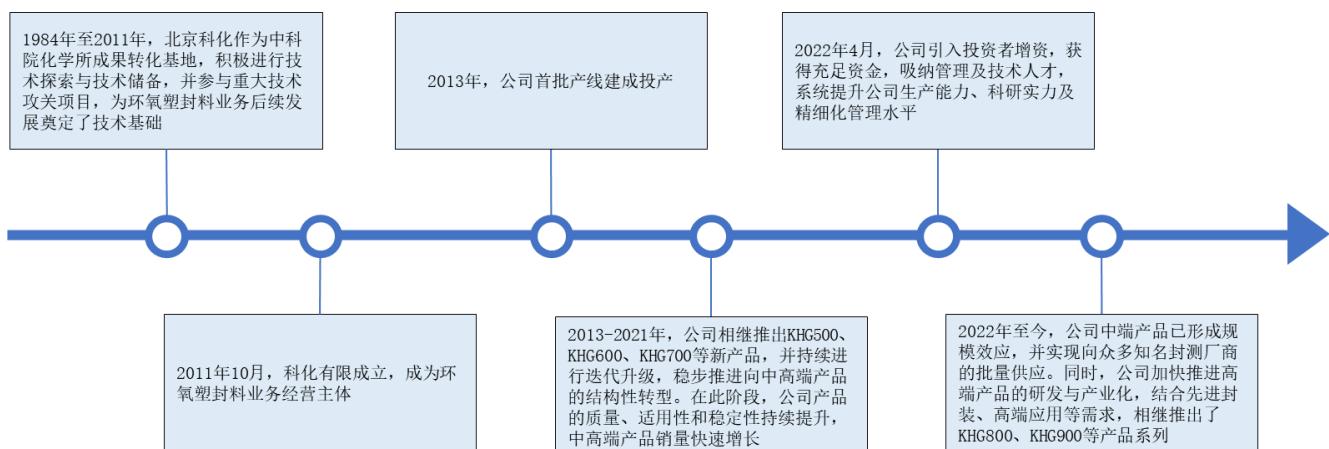
公司采用目前经营模式是基于自身战略规划和发展阶段，结合行业整体态势、主要原材料和产品市场供需情况等多方面因素综合确定的，符合行业特点，能够满足业务发展需要。

影响公司经营模式的关键因素包括产业政策导向、行业竞争格局、上下游供需特点、公司发展战略等。报告期内，公司各项经营活动均围绕现有模式稳步推进，未发生重大变化；预计未来短期内公司经营模式将继续保持基本稳定。公司将持续关注各关键因素的发展动态，适时、审慎地对经营模式进行优化调整，持续增强其与市场环境和公司发展阶段的适配性。

#### （四）设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况

公司自设立以来专注于半导体封装材料的研发和产业化，在环氧塑封料领域持续开展自主创新，实现新产品和新技术的开发与升级迭代。公司的主要发展

历程如下：



图：公司及业务前身主要发展历程

### 1、第一阶段（1984-2011 年）：北京科化在环氧塑封料领域进行技术探索与技术储备，为公司业务发展奠定基础

1984 年，中科院化学所创立北京科化作为成果转化基地。“七五”至“九五”期间，北京科化通过参与国家环氧塑封料攻关计划项目，成功开发出 KH407、KH950 等产品系列，掌握了基础配方设计、工艺适配等关键技术。在“十五”、“十一五”期间，北京科化又承担了两个国家重大科技项目，积累了丰富的研发和生产经验，为后续技术演进与业务拓展奠定了重要基础。

### 2、第二阶段（2011-2021 年）：公司成立并成为环氧塑封料业务的经营主体，制定并逐步实现向中高端产品转型的差异化竞争策略

2011 年 10 月，北京科化全资设立科化有限，作为环氧塑封料业务的经营主体。2013 年，公司首批产线建成投产，初期主要生产、销售基础型产品及少量中端产品。在发展过程中，公司逐步确立了以中高端市场为核心的差异化竞争策略，主动规避低端同质化竞争。凭借自主创新，公司构建了新型配方体系，持续推进 KHG400/KH9400、KHG500 等产品系列的迭代升级，并陆续推出 KHG600、KHG700 等新产品系列，稳步推进向中高端产品的结构性转型。

### 3、第三阶段（2022 年至今）：公司引入投资者充实资本金，加快生产线建设，进一步提升科研和管理水平，聚焦中高端市场

2022 年 4 月，公司引入投资者增资 3.10 亿元，为生产线建设与技术管理升级提供资金保障。公司持续引进行业优秀管理与技术人才，系统提升生产能力、科研实力与精细化管理水平。

在此阶段，公司加快推进中高端环氧塑封料的研发与产业化，相继推出面向先进封装、汽车电子、工业控制等高端应用及第三代半导体等特殊应用的KHG800、KHG900系列。同时，公司中高端产品已实现对华润微、通富微电、蓝箭电子、捷捷微电等众多知名封测厂商的批量供应，销售收入及占比持续提升，业务结构进一步优化。

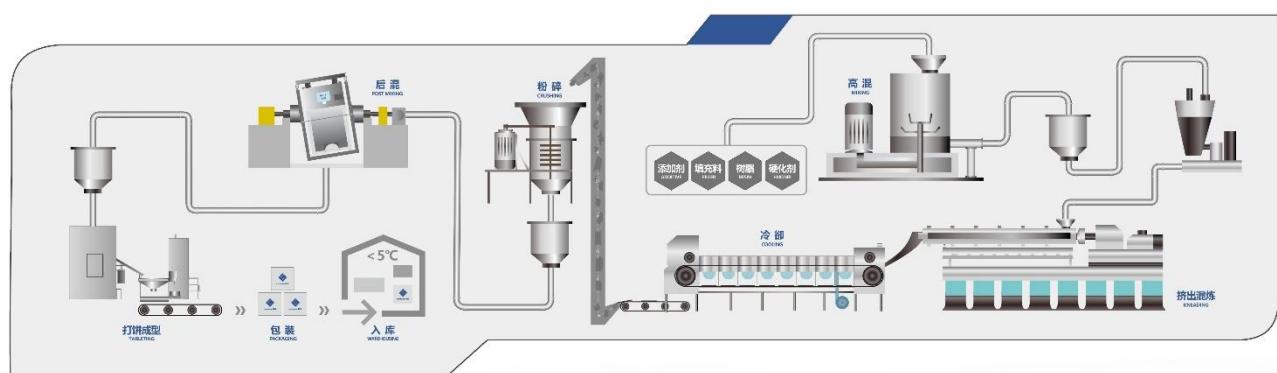
### （五）发行人主要业务经营情况和核心技术产业化情况

报告期内，公司主营业务收入分别为20,002.88万元、24,953.63万元、33,091.65万元和15,902.38万元，整体保持持续增长态势，其中，中高端环氧塑封料作为公司核心产品系列，销售收入分别为13,622.74万元、18,212.74万元、26,035.33万元和12,867.64万元，占主营业务收入的比例分别为68.10%、72.99%、78.68%和80.92%，收入规模及占比均逐年提升。

公司核心技术体系聚焦于中高端环氧塑封料的配方设计、工艺优化及性能提升，相关技术已全面应用于主营业务产品并实现规模化量产，核心技术的产业化是公司主营业务持续增长的关键因素。

### （六）发行人主要产品的工艺流程图

以典型的饼状环氧塑封料产品为例，其生产流程主要涉及预处理、高混、挤出混炼、冷却、粉碎、成型等工序，具体工艺流程图如下：



图：环氧塑封料生产工艺流程图

### （七）报告期内代表性的业务指标情况

公司代表性业务指标主要为产品产量、销量、主营业务收入等，具体参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析 十、经营成果分析”和本节“三、发行人产品销售情况和主要客户”。

## （八）主要产品和业务符合产业政策和国家经济发展战略的情况

公司符合财政部、税务总局 2023 年发布的《关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》规定要求，是国家认可并鼓励发展的集成电路材料企业。

公司主要产品为环氧塑封料，属于半导体封装环节的关键主材料，符合产业政策和国家经济发展战略，具体情况参见本节“二、发行人所处行业基本情况”。

## （一）行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

### 1、所属行业

根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，公司所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”下属的“C3985 电子专用材料制造”。

根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》，公司所处行业为“1 新一代信息技术产业”-“1.3 电子核心产业”-“1.3.1 集成电路”中的“集成电路材料”，细分的重点产品为封装材料。

根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》和《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，公司所处行业属于“1 新一代信息技术产业”-“1.2 电子核心产业”-“1.2.3 高储能和关键电子材料制造”-“3985\*电子专用材料制造”。

根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，公司所处行业属于“二十八、信息产业”-“6. 电子元器件生产专用材料”-“封装和装联材料”。

### 2、行业主管部门、监管体制

公司所处行业的政府主管部门为工信部，行业自律性组织包括中国电子材料行业协会、中国半导体行业协会等。工信部和行业协会共同构成了半导体封装材料行业的管理体系，各企业在主管部门产业宏观调控、行业协会自律规范的约束下，面向市场自主经营、承担市场风险。

工信部主要负责承担电子信息产品制造的行业管理工作；组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产；组织协调国家有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化，促进电子信息技术推广应用。

中国电子材料行业协会下设半导体材料分会、磁性材料分会等专业机构，中国半导体行业协会下设集成电路分会、半导体分立器件分会、半导体封装分会、半导体支撑业分会等专业机构，负责行业自律、规范管理、协助制订标准、参与国际交流、提供决策支撑以及行业政策建议等。

### 3、主要法律法规及政策

近年来，国家各部委和地方政府陆续颁布多项政策支持半导体产业链上下游行业发展，有效加速了中高端环氧塑封料的国产化进程，具体如下：

序号	文件名称	发布时间	发布单位	相关内容
1	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划的建议》	2025 年	中国共产党第二十届中央委员会	培育壮大新兴产业和未来产业。着力打造新兴产业。实施产业创新工程，一体推进创新设施建设、技术研究开发、产品迭代升级，加快新能源、 <b>新材料</b> 、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展。完善产业生态，实施新技术新产品新场景大规模应用示范行动，加快新兴产业规模化发展 加强原始创新和关键核心技术攻关。完善新型举国体制，采取超常规措施，全链条推动 <b>集成电路</b> 、…… <b>先进材料</b> 、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破
2	《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	2024 年	工信部等七部委	推动有色金属、化工、无机非金属等 <b>先进基础材料</b> 升级，发展高性能碳纤维、 <b>先进半导体等关键战略材料</b> ，加快超导材料等前沿新材料创新应用
3	《财政部 税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》	2023 年	财政部 国家税务总局	为促进 <b>集成电路产业</b> 高质量发展，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许管理清单内的集成电路设计、生产、封测、装备、 <b>材料企业</b> ，按照当期可抵扣进项税额加计 15% 抵减应纳增值税税额
4	《制造业可靠性提升实施意见》	2023 年	工信部等五部门	提升… <b>芯片先进封装材料</b> 等电子材料性能，提高元器件 <b>封装</b> 及固化、外延均匀、缺陷控制等工艺水平，加强材料分析、破坏性物理分析、可靠性试验分析、板级可靠性分析、失效分析等分析评价技术研发和标准体系建设，推动在相关行业中的应用
5	《关于推动能源电子产业发展的指导意见》	2023 年	工信部等六部门	发展新能源用耐高温、耐高压、低损耗、高可靠 IGBT 器件及模块，SiC、GaN 等先进宽禁带半导体材料与先进拓扑结构和 <b>封装技术</b>
6	《“十四五”原材料工业发展规划》	2023 年	工信部 科技部 自然资源部	实施关键短板材料攻关行动，采用“揭榜挂帅”“赛马”等方式，支持材料生产、应用企业联合科研单位，开展宽禁带半导体及显示材料、 <b>集成电路关键材料</b> 、生物基材料、碳基材料、生物医用材料等协同攻关 聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术、 <b>集成电路关键材料</b> 、集成电路设计工具、基础软

序号	文件名称	发布时间	发布单位	相关内容
				件、工业软件、应用软件的关键核心技术研发，不断探索构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制 在先进存储、先进计算、先进制造、 <b>高端封装测试、关键装备材料</b> 、新一代半导体技术等领域，结合行业特点推动各类创新平台建设。科技部、国家发展改革委、工业和信息化部等部门优先支持相关创新平台实施研发项目
7	《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》	2022	中共中央 国务院	全面提升信息技术产业核心竞争力，推动人工智能、先进通信、 <b>集成电路</b> 、新型显示、先进计算等技术创新和应用。聚焦核心基础零部件及元器件、 <b>关键基础材料</b> 、关键基础软件、先进基础工艺和产业技术基础，引导产业链上下游联合攻关
8	《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》	2021年	工信部等六部委	依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟，开展协同创新，加大基础零部件、 <b>基础电子元器件…集成电路…</b> 等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用
9	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	2021年	全国人大	聚焦 <b>新一代信息技术</b> 、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能
10	《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》	2020年	国务院	指出 <b>集成电路</b> 产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。进一步提出财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场应用政策、国际合作政策等多方面鼓励政策
11	《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》	2020年	国家发改委 科技部 工信部 财政部	文件明确了聚焦重点产业投资领域，包括加快新材料产业强弱项。将围绕保障大飞机、微电子制造、深海采矿等重点领域产业链供应链稳定，加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、 <b>电子封装材料</b> 等领域实现突破

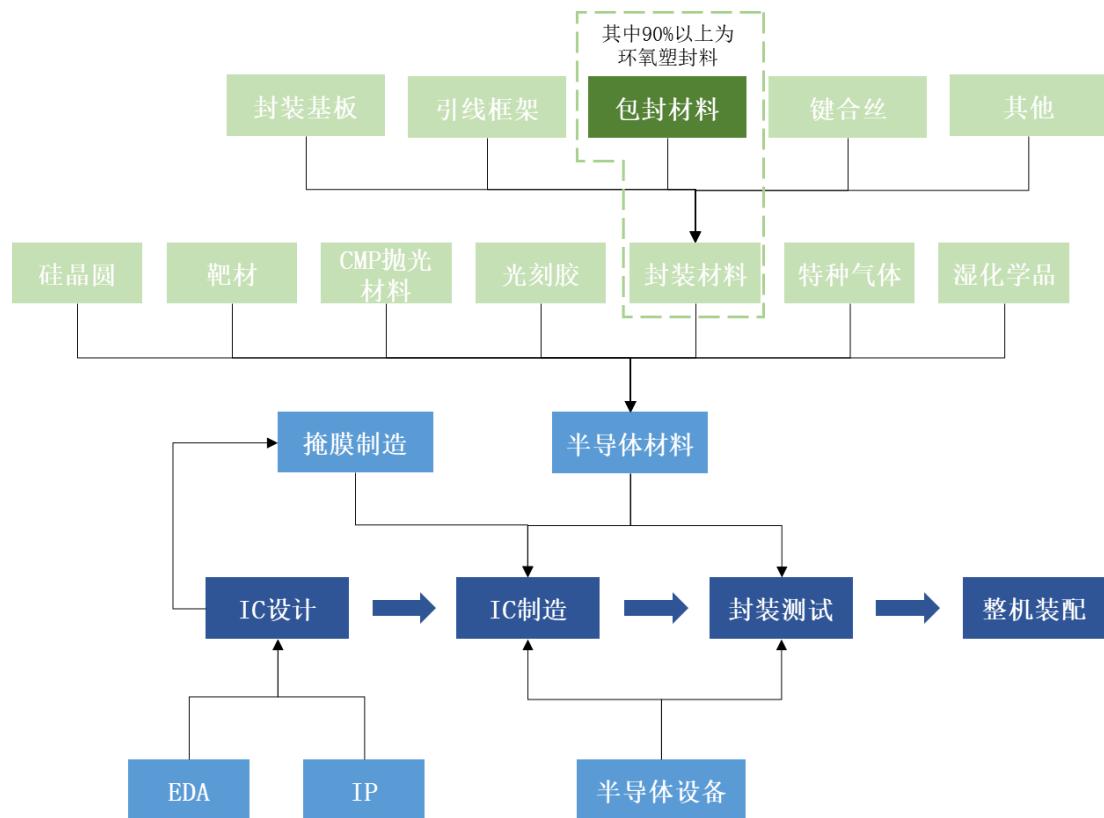
#### 4、近年来产业政策对公司经营发展的影响

环氧塑封料主要应用于国家战略新兴产业政策重点发展的集成电路领域，为半导体产业链的稳定运行提供坚实的材料支撑基础，是《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》、《战略性新兴产业分类（2018）》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》等政策鼓励重点发展的关键材料。公司主营业务和主要产品符合国家经济发展战略，符合国家产业政策鼓励方向。总体来看，国家相关产业政策的出台为公司业

务提供了良好的政策环境，有利于公司长远稳定发展。

## （二）发行人所处行业的发展状况

公司所属行业在半导体产业链中所处位置如下：



图：公司在半导体产业链中所处位置

### 1、半导体行业发展概况

在全球经济疲软、通货膨胀、消费需求减弱和地缘政治危机等多重不利因素的叠加影响下，2023 年全球半导体市场面临严峻的挑战，市场规模同比出现下滑。根据美国半导体行业协会（SIA）统计数据，2023 年全球半导体行业市场规模约为 5,269 亿美元，同比下降约 8.2%。2023 年下半年，全球半导体市场展现出一定的回暖趋势，尤其是第四季度，全球半导体销售额达到了 1,460 亿美元，同比增长 11.6%，环比增长 8.4%，为市场带来了较为积极的信号。

2024 年，全球半导体行业开始触底反弹。根据 SIA 最新统计数据，2024 年全球半导体行业市场规模约为 6,276 亿美元，同比增长 19.1%，预计 2025 年仍将保持较高增速。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测，2025 年全球半导体行业市场规模预计将达到 6,874 亿美元。

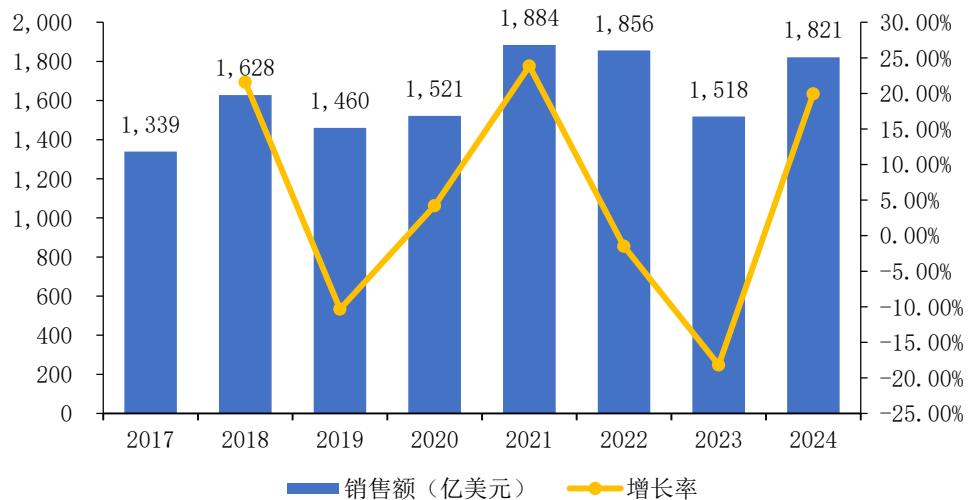
### 2015-2025年全球半导体市场规模及增长率



资料来源：中国半导体协会、SIA、WSTS

2024年，中国半导体产业与全球半导体产业同步回暖。根据SIA统计数据，2024年中国集成电路产业销售额为1,821.0亿美元，同比增长20.0%，呈快速增长态势。

### 2017-2024年中国集成电路产业销售额及增长率



资料来源：Wind、SIA

近年来，随着地缘政治冲突加剧，我国半导体产业自主可控需求进一步强化。随着国家政策红利持续释放，叠加国产化进程提速、技术突破与创新亮点频现的三重驱动力，我国半导体产业进入关键发展机遇期。

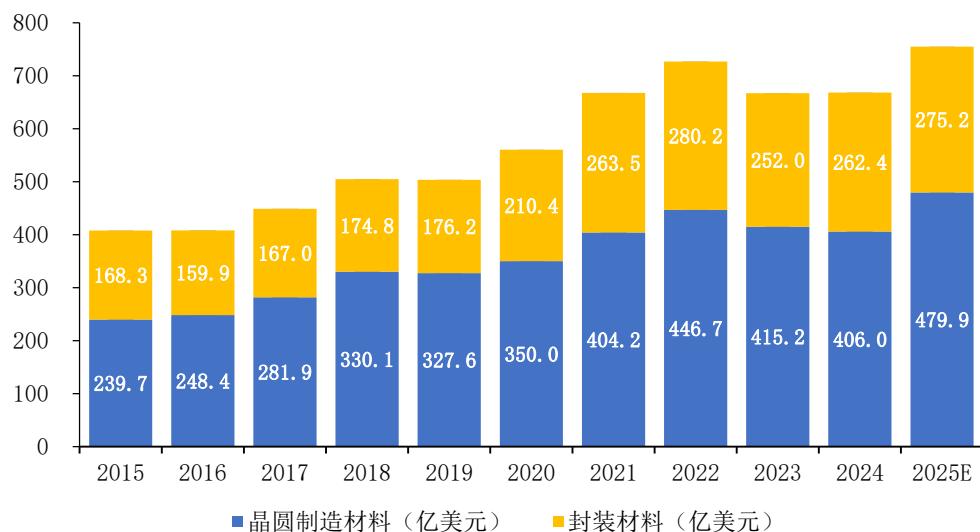
## 2、半导体材料与半导体封装材料行业发展概况

半导体材料行业在半导体产业链中处于上游位置，是半导体产业的基石。按

应用环节分类，半导体材料可以分为晶圆制造材料（硅晶圆、靶材、光刻胶、掩膜版等）和封装材料（以环氧塑封料为主的包封材料、封装基板、引线框架、键合丝等）。

根据 SEMI 统计数据，2023 年全球半导体材料市场规模降至 667.2 亿美元，同比下降 8.2%，其中晶圆制造材料市场规模为 415.2 亿美元，同比下降 7.1%；封装材料市场规模为 252.0 亿美元，同比下降 10.1%。根据中国半导体行业协会发布的《中国半导体支撑业发展状况报告（2024 年编）》，2024 年全球半导体材料市场规模约为 668.4 亿美元，其中晶圆制造材料市场规模进一步下降，但封装材料市场规模回升至 262.4 亿美元，同比增长 4.1%；预计 2025 年，全球封装材料市场规模将进一步增长至 275.2 亿美元。

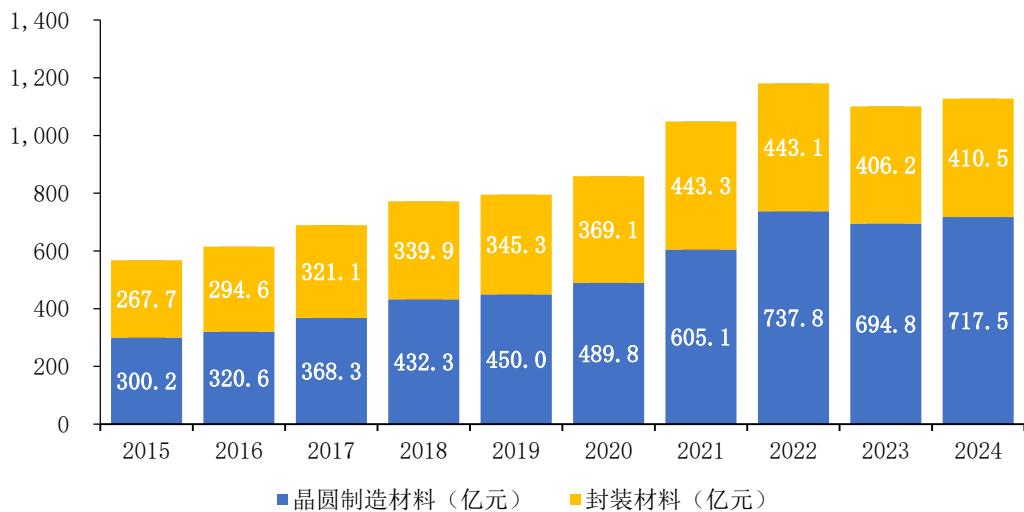
### 2015-2025年全球半导体材料市场规模及构成



资料来源：同花顺 iFIND、SEMI、中国半导体行业协会

中国半导体材料行业在 2023 年经历终端需求缩减、市场规模下滑的态势后，2024 年整体呈现恢复增长态势，与全球半导体材料行业的发展趋势基本一致。根据《中国半导体支撑业发展状况报告（2024 年编）》，2024 年中国半导体材料行业市场规模约为 1,128.0 亿元，同比增长 2.5%；其中，晶圆制造材料市场规模约为 717.5 亿元，封装材料市场规模约为 410.5 亿元，同比均有所增长。

### 2015-2024年中国半导体材料市场规模及构成



资料来源：中国半导体行业协会

中国半导体材料市场有着不俗的增长，但国产化水平仍有待提升。虽然当前我国已在部分材料领域实现规模化生产，但整体上仍对进口材料存在较高依赖。特别是在高端半导体材料领域，仍需从欧美日韩等国家进口。

随着国际贸易环境愈发复杂多变，国内晶圆厂商、封测厂商积极扩产以及终端产业的稳步发展，国内半导体材料厂商正迎来重要发展机遇。部分厂商积极加大研发投入，寻求技术突破，以期加速推进半导体材料的国产化进程，减少对国外技术的依赖。未来，中国半导体材料厂商有望实现快速成长，在全球市场中逐步占据更加重要的地位。

### 3、环氧塑封料行业发展概况

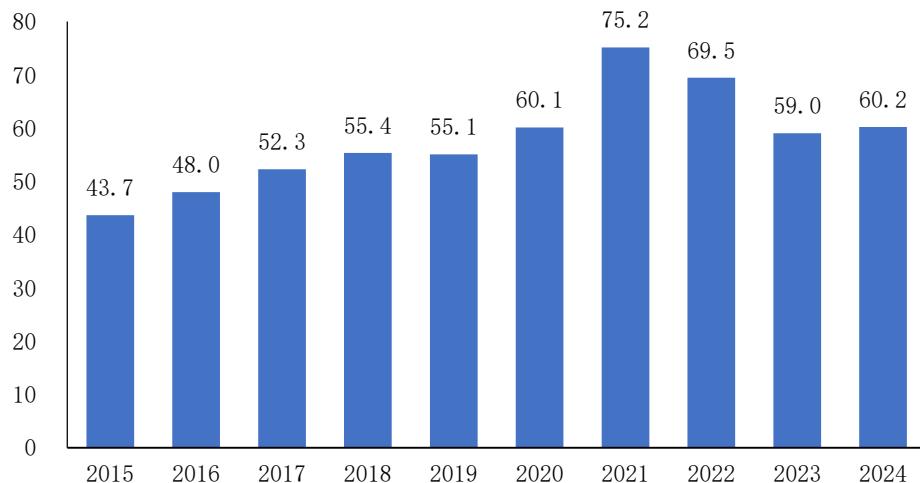
#### (1) 环氧塑封料是半导体封装环节的关键主材料

环氧塑封料是使用量较大的半导体封装材料单品，目前全球 90%以上的芯片采用环氧塑封料作为包封材料。

环氧塑封料行业作为半导体产业链中的关键支撑性行业，其发展趋势与半导体行业、半导体材料行业整体保持一致。根据《中国半导体支撑业发展状况报告（2024 年编）》，2015-2021 年，中国环氧塑封料市场规模呈现稳定增长态势，从 2015 年的 43.7 亿元增长至 2021 年的 75.2 亿元，年均复合增长率为 9.5%。2022 年和 2023 年，半导体行业终端需求整体有所缩减，导致环氧塑封料市场规模同步下滑；2024 年，环氧塑封料行业开始触底反弹，当年中国环氧塑封料市场规模约为 60.2 亿元，同比增长 2.0%。SIA、WSTS 和 SEMI 等权威机构均预测全

球半导体行业和半导体材料行业将继续增长，预计未来环氧塑封料行业也将保持增长态势。

中国环氧塑封料市场规模（亿元）



注：资料来源为中国半导体行业协会，市场规模依据包封材料市场规模的90%计算。

## （2）环氧塑封料与半导体封装呈现相互依存、相互促进的特点

经过数十年发展，半导体封装技术经历了直插式封装、小外形封装、扁平封装、阵列封装、系统级封装、倒装封装、晶圆级封装、板级封装、2.5D/3D封装等多个阶段，封装形式总体朝着小型化、高集成度、高功率密度等方向演进，同时汽车电子、工业控制等高端应用对封装技术的要求也趋于多元化，且标准不断提升，环氧塑封料的开发难度也随之提升。下游封装技术的演进过程大致如下：

序号	时期	封装技术	典型封装形式
1	20世纪70年代	直插式封装	DIP、ZIP等
2	20世纪80年代	小外形封装	SOP、SOT、TSOP、SSOP、TSSOP等
3		扁平封装	QFP、LQFP、QFN、DFN
4	20世纪90年代	阵列封装	BGA、LGA等
5	20世纪末、21世纪初	系统级封装（SiP）	
6	21世纪以后	倒装封装（FCBGA、FCCSP等）、晶圆级封装、板级封装、扇入型封装（FIWLP、FIPLP）、扇出型封装（FOWLP、FOPLP）、多维异构封装（2.5D/3D封装）、嵌入式封装（TSV、CoWoS等）、混合键合封装（SOIC in CoWoS等）	

注：仅代表相关封装技术出现的大致时间，相关封装技术后续持续进行升级迭代。

环氧塑封料行业的发展与封装技术发展呈现双向驱动关系，环氧塑封料随着封装技术的发展持续演进，同时也深刻影响着封装技术创新。封装行业具有“一代封装，一代材料”的特点，环氧塑封料厂商需要根据技术发展趋势和客户需求针对性地进行产品开发，持续推出适配的材料。

### （3）中高端环氧塑封料国产化进程加速

根据中国电子材料行业协会统计数据，中高端环氧塑封料已占据国内80%-90%市场份额，成为市场主流产品，其中，中端产品以50%-60%的市场占比构成最大细分领域，同时也是本土头部厂商国产替代的主战场。环氧塑封料整体国产化率处于较低水平，仅有少数内资厂商具备中高端产品研发生产能力，近年来这些企业通过技术创新和资源整合，正在快速突破日系厂商的技术壁垒。

随着国际经贸局势动荡加剧，国家对半导体全面自主可控的需求迫切，环氧塑封料的国产化进程正在不断加速。在此背景下，拥有中高端环氧塑封料规模化量产能力的本土头部厂商，凭借技术积累与产品、服务优势，正在重构市场竞争格局。

## （三）发行人所属行业在产业链中的地位和作用，与上、下游行业关联性

### 1、公司所属行业在产业链中的地位和作用

半导体封装材料是半导体产业链的重要组成部分，属于上游关键支撑行业。

面对后摩尔时代的技术瓶颈以及先进光刻系统等关键技术和设备被封锁的双重困境，封装技术正成为继芯片制造技术之后，我国半导体产业的另一个关键技术突围方向。在封装技术持续迭代过程中，封装材料作为工艺环节的关键材料，其性能和创新直接关系到封装环节的技术突破。只有通过自主研发和创新设计，持续推出与先进封装工艺需求相匹配的封装材料，才能突破技术封锁，为我国半导体产业链整体升级提供技术支撑。

### 2、与上、下游行业之间的关联性

#### （1）上游行业对公司所处行业的影响

环氧塑封料上游行业主要是精细化工行业及无机非金属矿物制品业。原材料主要包括树脂（环氧树脂、酚醛树脂等）、填料（硅微粉等）和助剂（偶联剂、促进剂、改性剂、阻燃剂等）。原材料的技术进步助力环氧塑封料产品性能的提升，进而促进环氧塑封料产品的技术迭代。

在国内，本土原材料厂商不断实现技术创新与突破，并与环氧塑封料头部内资厂商协同开展产品与技术开发、联合制定国家标准、联合申报重大科技项目，上游关键原材料的自主可控能力显著提升，保障了本土环氧塑封料行业的高质量发展。

## （2）下游行业对公司所处行业的影响

半导体封装材料行业深度嵌入半导体封测产业生态，直接服务半导体封测企业并辐射至汽车电子、工业控制、消费电子、通信等终端领域，因此终端领域的快速发展将带动半导体封装企业的产能扩张与工艺升级，进而促进半导体封装材料行业的规模提升与技术创新。

近年来，我国半导体产业整体保持快速增长态势，关键材料的国产化进程显著加速，同时人工智能、汽车电子、工业控制等高端应用以及第三代半导体等特殊应用领域需求增长驱动环氧塑封料向更高导热性、更高耐热性、更低翘曲度等方向发展，对中高端环氧塑封料的需求持续提升，促进内资环氧塑封料厂商向中高端转型，实现从规模扩张到价值提升的跨越，加速国产替代。

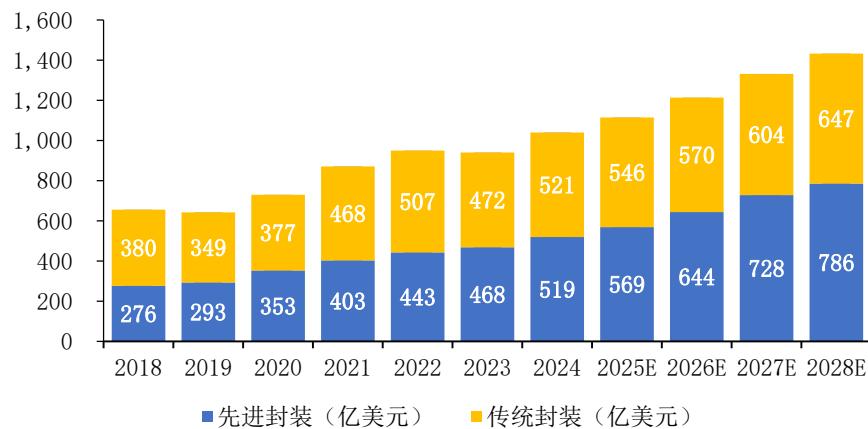
## 3、公司下游应用领域市场规模及发展前景分析

### （1）半导体封测行业发展概况

在半导体产业链中，封装测试处于芯片制造过程中的后道环节，涵盖了封装和测试两大环节，其中封装环节占据更高的价值比重。封装系指通过环氧塑封料等材料将芯片和器件包裹起来进行保护，使芯片电气特性保持稳定的同时，也使芯片免受外界环境的影响，对芯片的稳定性和可靠性具有重要意义。

根据 Yole 统计数据，2024 年全球半导体封装市场规模约为 1,040 亿美元，同比增长 10.6%。未来，全球半导体封装市场规模将持续走高；根据 Yole 预计，2028 年全球半导体封装市场规模将达到约 1,433 亿美元，2024–2028 年复合增长率达 8.3%。随着汽车电子、高端消费电子、人工智能、数据中心等终端应用领域的快速发展，先进封装技术已成为封装技术创新和市场增长的关键驱动力，全球先进封装市场规模及占比持续提升。根据 Yole 统计数据，2024 年全球先进封装市场规模约为 519 亿美元，与传统封装基本持平；预计 2028 年将增长至 786 亿美元，占比增至 54.8%。

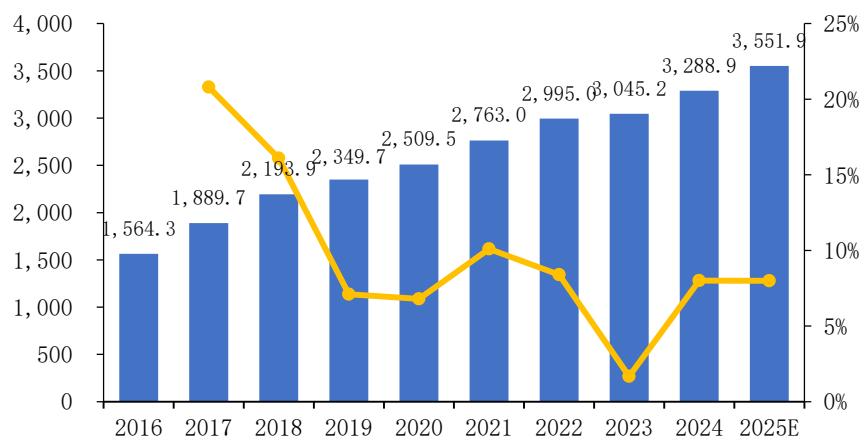
### 2018-2028年全球半导体封装市场规模



资料来源：Yole

近年来，受国家政策扶持、国内半导体设计与制造能力提升、科技创新催生人工智能等新兴应用场景等多重因素影响，中国半导体封测市场规模不断扩大。根据 Frost & Sullivan 统计数据，2024 年中国封测市场规模约为 3,288.9 亿元，同比增长 8.0%，预计 2025 年中国封测市场规模将达到 3,551.9 亿元，体现出巨大的发展潜力。

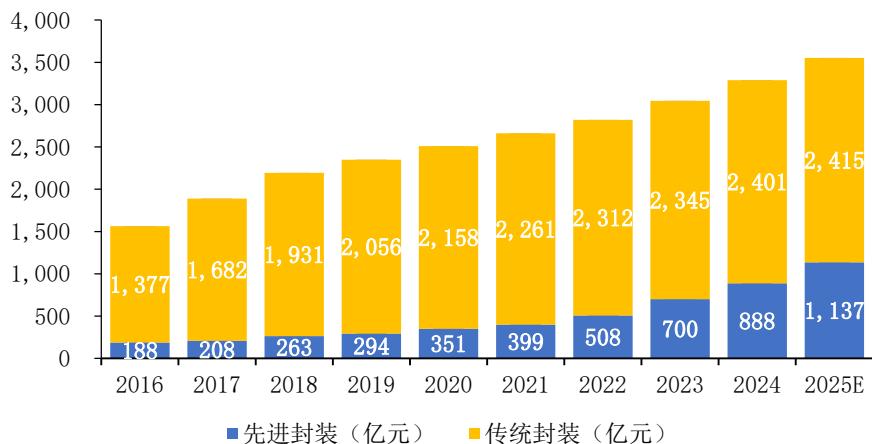
### 2016-2025年中国封测市场规模（亿元）



资料来源：甬兴证券研究所、Frost & Sullivan

全球封测市场中先进封装渗透率已接近 50%，而中国的先进封装市场渗透率仍存在显著差距。根据甬兴证券研究所报告，2024 年中国大陆先进封装占整体封装市场比例约为 27.0%，较全球平均水平低约 23 个百分点，但这一比例正在快速增长，预计 2025 年将提升至 32.0%。

### 2016-2025年中国大陆半导体封装市场规模



资料来源：甬兴证券研究所、Frost & Sullivan

总体来看，随着半导体封装技术的不断进步和封测市场规模的扩大，环氧塑封料的需求量也将随之增加。同时，随着先进封装重要性日益凸显，高端环氧塑封料市场将迎来更大的发展机遇。

#### （2）应用领域发展概况

未来几年，公司将重点围绕人工智能、汽车电子、工业控制等高端应用场景开展技术开发与新产品布局，前述应用领域的发展概况如下：

##### ①人工智能

人工智能的高速发展推动算力需求持续攀升，促进智能算力规模高速增长。截至 2024 年末，我国智能算力规模达 280 EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算），到 2025 年 6 月末进一步跃升至 788 EFLOPS，实现近三倍增长。在后摩尔时代，AI 芯片的算力提升与功耗控制越来越依赖于具有重布线层(RDL)、硅通孔(TSV)、硅中介层、微凸点等特征的先进封装技术；这些技术不仅支撑着算力产业的发展，也推动了算力产业对高端环氧塑封料的迫切需求。

##### ②汽车电子

随着全球汽车朝着智能化、电动化方向迈进，汽车电子行业进入高速成长期。根据中国汽车工业协会数据，2024 年我国新能源汽车销量达 1,286.6 万辆，同比增长 35.50%，连续 9 年保持全球销量第一。新能源汽车渗透率的快速提升以及 800V 高压平台的加速落地，推动车规级芯片、高精度控制模块等产品向高算力、高耐压方向迭代，环氧塑封料高导热、耐高温及抗吸湿的特性成为保障车规级芯片可靠性的关键要素。

### ③工业控制

工业控制领域，智能制造升级与能源转型驱动变频器、伺服系统及工业机器人等设备能效要求持续提升，工业级 IGBT、MCU 及高可靠性传感器市场稳步扩容。根据 Precedence Research 统计数据，2024 年全球工业自动化及控制系统市场规模达 2,065.3 亿美元，预计 2034 年将增长至 5,769.9 亿美元，2025-2034 年复合增长率达 10.82%。在“新基建”、“双碳目标”等国家级战略的推动下，中国工业控制市场规模也将快速增长，为环氧塑封料提供广阔的市场空间。

另外，以碳化硅、氮化镓为核心的第三代半导体材料凭借其高耐压、高频率、耐高温及低能耗等特性，正成为全球半导体产业升级的核心驱动力。随着新能源汽车、5G 通信、储能等领域的爆发式增长，第三代半导体在功率器件、射频器件等关键环节的应用渗透率持续提升。根据 Yole 预测，2022-2028 年全球碳化硅市场规模复合增长率将超过 30%，氮化镓市场亦将保持 20%以上增速。第三代半导体对封装提出更高要求，环氧塑封料的低介电损耗、高导热及高耐热等特性能够适配高频、高温场景下的长期可靠性需求。

## （四）行业面临机遇和挑战以及周期性特征

### 1、行业面临的机遇

#### （1）政策赋能为行业发展创造历史性窗口期

半导体供应链的稳定性对我国半导体产业至关重要，对于关键材料的国产替代迫在眉睫。国家高度重视半导体产业的自主可控与可持续发展，近年来出台了一系列扶持政策；同时，国家及地方政府通过专项资金支持与税收优惠等方式，持续为半导体产业赋能，加速国产替代进程。在此背景下，半导体封装材料行业将迎来长期高质量发展。

#### （2）先进封装和高端应用驱动封装材料向高附加值方向发展

《产业结构调整指导目录（2024 年本）》等政策明确提出扶持 BGA、SIP、FC、WLP、2.5D/3D 等先进封装技术，先进封装对封装材料性能提出了非常高的要求，驱动封装材料厂商向中高端转型。

同时，新兴应用领域的快速发展呈现出更加多元化的市场需求，例如新能源汽车的高导热需求以及对电子器件的高可靠性需求、SiC 和 GaN 等第三代半导体的耐高温需求、5G 通信的高频传输需求等，下游客户对封装材料性能的要求也

趋于定制化、多样化。新兴应用领域需求爆发驱动封装材料厂商针对不同的应用场景进行专项研发，推动封装材料厂商持续提升自主研发与创新能力，并将行业竞争维度从成本控制转向创新能力比拼。

### （3）全球产业链重构为半导体封装材料行业带来区域化红利

受地缘政治因素影响，半导体供应链正在发生区域性调整。中国大陆封测企业凭借技术突破和成本优势，逐步承接国际厂商的封装订单，产能快速扩张。在全球产业链重构的趋势影响下，能够适应市场需求、不断突破技术壁垒、持续创新并能规模化生产的本土封装材料厂商将迎来重大发展机遇。

## 2、行业面临的挑战

### （1）高端封装材料国产化进程较为缓慢

当前，各封装材料领域头部内资厂商正瞄准中高端市场进行布局并持续发力，已取得技术突破并逐步实现产业化，但高端产品的批量化供应仍存在不确定性，国产化进程较为缓慢。在环氧塑封料领域，高端产品的开发与考核验证周期相对更长，且产品在通过考核验证后仍面临PCN变更流程耗时较长的问题，部分封装厂商的终端客户可能因供应链惯性和风险规避等原因不同意PCN变更申请。因此，内资厂商实现高端封装材料的商业化落地和量产存在较高的壁垒。

### （2）国内配套供应链不够完善

半导体封装材料行业还面临供应链成熟度不足的深层制约。在环氧塑封料领域，高纯度酚醛树脂、低放射性硅微粉等特种材料仍依赖进口，本土供应商在工艺稳定性等方面与日系厂商存在一定差距。针对这一局面，头部内资环氧塑封料厂商正通过与本土供应商深度合作、共同开展技术攻关等模式，强化供应链协同，但从技术突破到供应链成熟仍需要一定周期。

### （3）先进封装和高端应用带来的技术研发和资金投入上的挑战

半导体封装材料行业具有高投入、长周期的特点，其发展壁垒正随着产业升级持续提升。在环氧塑封料领域，先进封装技术升级迭代和高端应用需求爆发，促使环氧塑封料厂商攻克高导热、低介电等材料性能极限，并构建涵盖配方设计、工艺优化、考核验证等各环节的技术体系。同时，车规级、工业级产品的生产也需要持续投入高端设备。因此，环氧塑封料厂商的技术和资金实力将在一定程度上影响其发展空间。

## 3、行业周期性特征

半导体封装材料行业的景气度与半导体产业周期高度同步。短期来看，受宏观经济周期性波动、市场供需关系变动等因素影响，半导体封装材料行业也存在阶段性波动。例如，2023 年前后半导体产业终端需求缩减，市场规模下滑，封装材料市场需求也相应下降。

长期来看，半导体行业已成为支撑国民经济与社会发展的基石性、引领性及战略性产业。在专项资金扶持、税收优惠及“揭榜挂帅”技术攻关机制等多重因素驱动下，我国半导体行业正在穿越短期周期波动，进入以国产替代为标志的长周期景气通道。环氧塑封料行业也将深度受益于半导体产业高端工艺技术发展和国产替代的时代机遇，获得产业升级的驱动力和持续增长的市场空间。

## （五）行业壁垒

### 1、技术与人才壁垒

半导体封装材料行业属于典型的技术密集型行业，需要长期的技术积累和研发投入。在环氧塑封料领域，行业内主要企业均拥有深厚的技术底蕴，例如：中科科化传承近四十年的技术积淀；衡所华威和华海诚科分别从 1983 年和 2010 年开始涉足该领域；住友电木、力森诺科等日系厂商则布局更早。持续的创新能力需要企业长期的技术研发和实践经验，对于新进入者而言技术壁垒较高。

此外，环氧塑封料产品的研发和生产需要专业人士的深度参与，包括配方设计、工艺优化、量产稳定性及品质管控等各个环节。行业内的专业人才主要来自于头部企业的长期培养，高端专业人才相对稀缺。对于新进入者而言，短期内培养专业人才的难度较高，同时可能因为技术实力、薪酬竞争力不足无法吸引行业优秀人才。

### 2、资金壁垒

半导体封装材料的研发和产业化是一项长周期的系统性工程，需要大量资金投入。从基础研究、技术与产品开发、考核验证到批量生产和品质管控，每个环节都需要企业的持续资金支持。行业内的规模化生产厂商通常具有较强的市场竞争力，新进入者在资金和技术方面均需要投入大量的资源。此外，由于产品的考核验证周期较长，投资回报周期也相应拉长，对于新进入者而言需要较多的资金储备。

### 3、市场与客户壁垒

半导体封装材料的直接下游客户为封测厂商，实行严格的考核验证体系。在环氧塑封料领域，封测厂商主要考核工艺性能（包括固化时间、螺旋长度等性能指标，以及连续成模性、气孔率等操作性指标）和应用性能（热性能、电性能等）等指标，主要考核项目包括湿敏等级试验（MSL）、高低温循环试验（TCT）、强加速湿热试验（HAST）、高压蒸煮试验（PCT）等。以TCT、HAST为例，单个试验要求产品在特定环境下测试500小时或500个循环。环氧塑封料产品的考核维度和考核项目数量多且耗时长，产品导入周期较长；下游客户对高端环氧塑封料的性能要求更高，考核验证周期更长，通常需要1-2年甚至更长时间才能通过验证，但产品一旦通过考核验证并量产，通常会形成较为稳定的合作关系。对于新进入者而言，只有在技术实力、生产工艺水平、品质管控、产品价格、售后服务等方面显著超过现有供应商时，才可能实现产品导入。

#### 4、供应链壁垒

我国半导体产业链的自主可控要求推动半导体封装材料行业加速构建完整、稳定的本土化供应链体系。在环氧塑封料领域，行业领先企业已与本土核心供应商建立了深度的协同合作关系，通过技术攻关实现了关键原材料（如环氧树脂、酚醛树脂、硅微粉等）的国产化突破。这种合作关系保障了供应商的长期稳定供货能力，促使供应商愿意投入资源，与环氧塑封料厂商共同成长。

对于新进入者而言，即便在技术上取得突破，仍需耗费较长时间进行原材料验证和供应链体系的搭建。

### （六）发行人市场地位和行业竞争格局

#### 1、发行人的市场地位及技术水平

##### （1）中端环氧塑封料市场

经江苏省工信厅组织专家鉴定，公司中端环氧塑封料技术达到国内领先水平，部分产品技术属国内首创。公司中端环氧塑封料已逐步替代住友电木、力森诺科等日系厂商产品，在国内占有较高的市场份额。

最近三年，公司中端环氧塑封料销售收入快速增长，复合增长率高达36.01%，成为公司主要收入来源。公司已成为蓝箭电子、捷捷微电、华达微、华润安盛、华羿微电、福顺半导体等客户的主要环氧塑封料供应商，对部分客户的供货量已超过住友电木、力森诺科等日系厂商，在国产替代方面表现突出。

## （2）高端环氧塑封料市场

公司高端环氧塑封料代表产品的技术指标与住友电木、力森诺科等日系厂商同类产品相当，能够实现相同的性能。经中国电子材料行业协会组织专家进行技术鉴定，公司高端环氧塑封料代表产品（KHG900G-A）“产品性能达到国际同类产品先进水平，填补国内空白”。2025年7月，KHG900系列成功入选江苏省工信厅《江苏省重点推广应用的新技术新产品目录（2025年）》首批次认定的33项新材料之一，入选该目录的材料均系在各自领域实现原始创新或显著技术突破的新材料产品。

在先进封装领域，公司与华润微、长电科技、通富微电、华天科技、华羿微电、日月新集团、矽品科技（苏州）有限公司、长沙安牧泉智能科技有限公司、无锡中微高科电子有限公司、气派科技、沛顿科技（深圳）有限公司、立芯科技（昆山）有限公司等多家行业知名封测企业开展合作，涵盖LQFP、PDFN/DFN/QFN、IPM/IGBT模块、BGA、SIP、WLP/PLP、FCCSP等多种先进封装形式。根据部分客户出具的考核验证报告，公司高端环氧塑封料代表产品能够满足其技术需求，与日系竞品处于同一技术水平，可实现替代。在汽车电子、工业控制等高端应用领域，公司车规级、工业级环氧塑封料产品已在比亚迪半导体、安森美（Onsemi）、捷捷微电、华润微等客户处实现供货。

报告期内，公司高端环氧塑封料已开始批量供应，2024年实现销售收入2,111.82万元，增长速度较快。随着产品逐步通过更多下游客户的考核验证，销售收入有望持续增长。未来，随着国产替代需求的逐步渗透，公司将凭借深厚的技术积淀与稳固的客户合作基础，迅速抢占高端环氧塑封料市场份额。

## 2、行业竞争格局情况

具体参见本节“二、发行人所处行业基本情况（二）发行人所处行业的发展状况 3、环氧塑封料行业发展概况”。

## 3、行业内主要企业

截至本招股说明书签署日，行业内国外领先企业主要包括住友电木、力森诺科，系公司中高端环氧塑封料产品替代的主要日系厂商；国内领先企业除发行人外，还包括衡所华威、华海诚科、昆山兴凯。同行业主要企业情况如下：

序号	企业名称	简介	市场地位	环氧塑封料领域的技术水平
1	住友电木	住友电木株式会社 (Sumitomo Bakelite Co., Ltd.) 是日本知名的塑料产品生产企业, 其塑料生产历史最早可追溯至 1911 年, 总部位于日本, 在上海、苏州、南通、东莞等地均设有制造基地; 住友电木下设信息通信材料营业总部、高性能塑料产品业务部、薄膜片材营业总部、工业功能材料营业总部等事业部门	住友电木将在塑料行业拥有较强的影响力。根据其 2024 财年年度报告, 2024 财年(报告期: 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日)住友电木营业收入 3,048 亿日元、净利润 195 亿元日元; 其中, 半导体材料业务实现营业收入 913 亿日元, 占营业收入的比例为 29.95%, 实现营业利润 190 亿日元	1、住友电木是目前全球领先的环氧塑封料厂商之一, 在中国中端环氧塑封料市场处于主导地位, 在中国高端环氧塑封料市场处于垄断地位 2、根据其 2024 财年年度报告, 截至 2025 年 3 月 31 日, 住友电木在全球持有的专利数量达 3,060 项, 其中半导体材料领域的专利数量达 926 项
2	力森诺科	力森诺科 (Resonac Corporation, 曾用名: 葛司蒂) 系 2022 年由昭和电工 (Showa Denko) 和日立化成 (Hitachi Chemical) 合并而成的综合性化工集团, 总部位于日本, 在苏州、南通、东莞、烟台等地均设有制造基地, 业务领域涉及半导体及电子材料、汽车材料、化工材料等	力森诺科是全球知名的半导体材料制造商。根据其 2024 年年度报告, 2024 年度力森诺科营业收入为 13,915 亿日元、净利润为 748 亿日元, 其中, 半导体及电子材料业务实现营业收入 4,451 亿日元, 占营业收入的比例为 32.04%, 实现营业利润 629 亿日元	1、力森诺科是目前全球领先的环氧塑封料厂商之一, 在中国中端环氧塑封料市场处于主导地位, 在中国高端环氧塑封料市场处于垄断地位 2、根据其 2023 年年度报告, 力森诺科在半导体领域的专利数量达 2,394 项
3	衡所华威	衡所华威电子有限公司成立于 2000 年, 衡所华威是一家从事半导体芯片封装材料研发、生产和销售的企业, 总部位于连云港, 主要产品为环氧塑封料	1、衡所华威与公司同属于第一梯队内资环氧塑封料厂商, 从 1983 年开始涉足环氧模塑料业务, 在国内具有较强的市场影响力 2、根据公开资料, 2024 年度衡所华威实现营业收入 46,781.44 万元, 其中环氧塑封料业务收入为 46,164.42 万元; 扣非后净利润为 4,291.73 万元	1、衡所华威是国家 863 计划成果转化基地、国家级博士后科研工作站和江苏省集成电路封装材料工程技术研究中心 2、衡所华威产品涵盖传统封装与先进封装。根据公开资料, 截至 2025 年 9 月, 衡所华威合计拥有 92 项专利, 其中发明专利 22 项 3、2024 年度, 衡所华威高性能类及先进封装类产品的合计收入占比为 72.18%
4	华海诚科	华海诚科成立于 2010 年, 是一家专注于半导体封装材料的研发及产业化的企业, 总部位于连云港, 主要产品包括环氧塑封料与电子胶黏剂	1、华海诚科与公司同属于第一梯队内资环氧塑封料厂商, 在国内具有较强的市场影响力 2、根据华海诚科 2024 年年度报告, 其 2024 年度实现营业收入 33,106.72 万元, 其中环氧塑封料业务收入为 31,589.62 万元; 扣非后净利润为 3,413.23 万元	1、华海诚科建有江苏省企业技术中心、江苏省新型电子封装材料工程技术研究中心、江苏省博士后创新实践基地、江苏省企业研究生工作站 2、华海诚科构建了可应用于传统封装与先进封装的产品体系。根据华海诚科 2024 年年度报告, 截至 2024 年末, 其在国内拥有 31 项发明专利

序号	企业名称	简介	市场地位	环氧塑封料领域的技术水平
				3、2024 年度，华海诚科高性能类及先进封装类产品的合计收入占比为 48.41%
5	昆山兴凯	昆山兴凯（原名：长兴电子材料（昆山）有限公司）成立于 1996 年，系飞凯材料(300398.SZ)的控股子公司，总部位于昆山，主要产品为环氧塑封料	1、昆山兴凯是元器件及 IC 封装所需材料领域供货商，部分基础封装用环氧塑封料、中端环氧塑封料产品具有一定的市场竞争力 2、根据飞凯材料 2024 年年度报告，2024 年度昆山兴凯实现营业收入 24,954.09 万元，净利润为 2,016.27 万元	1、昆山兴凯的产品以传统封装为主，并逐步由传统表面贴装、向先进基板类封装转型 2、经公开检索，截至 2025 年 10 月末，昆山兴凯拥有 21 项发明专利

注：①资料来源为相关公司官网、上市公司定期报告等公开资料。

②2025 年 10 月，华海诚科完成对衡所华威的收购，后者成为其全资子公司；为便于比较，上表仍将两家公司数据分别列示，未进行合并。

#### 4、公司与行业内主要企业的比较情况

目前，全球中高端环氧塑封料市场仍由住友电木、力森诺科两家日资厂商主导，尤其是高端市场基本由二者垄断。公司已实现技术突破，中高端产品的性能已达到国内领先、国际先进水平。中端产品已实现对日系竞品的替代，对多家客户的供货规模已超过住友电木、力森诺科；高端产品已能够替代日系竞品，但由于客户 PCN 变更流程等原因，产品导入周期较长，预计未来将逐步实现规模化替代并推动业务增长。

在内资环氧塑封料厂商中，公司综合实力居于领先地位。报告期内，公司环氧塑封料业务规模在内资厂商中的排名从第四名升至第二名，市场地位稳步提升；公司在中高端环氧塑封料国产替代方面的贡献名列前茅。

### （七）发行人竞争优势与劣势

#### 1、公司的竞争优势

##### （1）技术与产品优势

公司自主研发生产的中高端产品基本覆盖市场主流的封装形式，代表产品实现了对日系竞品的对标，技术实力受到下游封测厂商的广泛认可。截至本招股说明书签署日，公司拥有 45 项授权专利，其中发明专利 34 项，保障了公司在中高端环氧塑封料领域的技术及产品优势。

##### （2）国产化优势

现阶段，中高端环氧塑封料市场呈现“外资主导、内资突破”的二元格局，高端产品的进口依赖度仍较高。在地缘政治等因素影响下，半导体封装材料的自主可控战略价值凸显，国产替代窗口加速开启。公司作为中高端环氧塑封料国产替代的主力军，主要服务境内封测厂商，相较于日系厂商具有明显的客户服务优势和产品性价比优势。

##### （3）人才团队优势

公司拥有一支由资深行业专家领衔的研发团队，具备较强的技术创新能力，能够快速响应市场需求。公司生产团队由经验丰富的生产技术专家带领，能够应对复杂工艺要求，持续优化流程，提高生产效率和产品品质。公司拥有专业的销售团队，熟悉行业特点，能够有效开拓市场、妥善解决客户需求。专业的人才结构为公司巩固并持续提升市场竞争力提供了有力保障。

#### （4）客户资源优势

下游半导体封测厂商实行严格的供应商选择标准，从技术工艺、产品性能、价格水平、交付能力和服务机制等方面进行全面评估，对环氧塑封料产品也实行严格的考核验证，产品导入周期较长，但一旦达成业务合作，产品通过考核验证并实现规模化交付后，不会轻易更换供应商。公司与众多封测厂商建立了稳定的合作关系，报告期内已成为部分核心客户的主要环氧塑封料供应商，供货量超过住友电木、力森诺科等日系厂商。在半导体国产化、封测产能扩张、市场景气度回升及高端应用发展等多重因素的推动下，公司经营规模与市场占有率将进一步增长。

#### （5）供应链优势

公司持续推进供应链国产化进程，已与圣泉集团、联瑞新材等本土供应商建立了长期合作关系，采购产品覆盖环氧树脂、酚醛树脂、硅微粉等关键原材料，确保了供应链的稳定性。此外，公司与联瑞新材联合编制国家标准，与圣泉集团联合申报省级重大科技项目，深度开展合作，进一步深化供应链协同效应，为公司持续稳定发展提供有力支持。

#### （6）产品质量控制优势

公司高度重视产品质量管控，构建了完善的质量管理体系，先后通过了 ISO 14001 环境管理体系、ISO 9001 质量管理体系、IATF16949 质量管理体系、IECQ 有害物质过程管理体系、ISO 45001 职业健康安全管理体系认证。公司的质量管控涵盖原材料采购、生产制造、质量检测、仓储和运输等各环节，为下游客户提供高标准的交付保障，获得客户的广泛认可。

## 2、公司的竞争优势

#### （1）融资渠道单一

公司经营规模的持续扩张在多个方面产生资金需求：产能的高质量提升需要新增自动化生产线，技术创新与迭代需要持续投入先进研发设备并引入优秀人才，产品线的完善需要围绕不同封装技术和应用领域开展专项研发，市场拓展需要增强销售力量并完善销售网络，融资渠道单一将制约公司发展。本次成功上市后，公司资金状况将得到显著改善，公司将资金用于生产、研发等环节，有助于进一步增强市场竞争力，扩大市场份额，提升行业影响力。

#### （2）公司在全球市场的品牌知名度和影响力相对有限

现阶段，公司的战略目标在于加速推动中高端环氧塑封料的国产化进程。未来，随着经营规模持续扩大，公司将逐步拓展海外市场。公司在国际品牌建设方面尚处于起步阶段，与住友电木、力森诺科等跨国企业相比，全球市场的品牌知名度和影响力仍有较大差距，在拓展海外市场时可能因此面临一定竞争压力。

## （八）发行人与同行业可比上市公司比较情况

### 1、选取同行业可比上市公司的依据

行业内主要企业中，华海诚科（688535.SH）为科创板上市公司，其环氧塑封料收入占比超90%，因此公司将其作为可比同行业上市公司。

除华海诚科外，其他行业内主要企业均未在A股直接上市，但昆山兴凯系创业板上市公司飞凯材料（300398.SZ）的控股子公司，主要从事环氧塑封料业务，因此公司将飞凯材料也选为同行业可比上市公司。

除上述企业外，目前A股市场无其他在产品形态、业务模式等方面与公司相同或相似的上市公司。公司综合考虑产品结构、应用领域等指标，最终选取康强电子（002119.SZ）、德邦科技（688035.SH）作为补充的同行业可比上市公司。

### 2、与同行业可比上市公司的对比情况

公司与选取的同行业可比上市公司在主营业务、产品结构、应用领域等方面对比情况如下：

序号	公司名称	主营业务	主要产品及收入构成	应用领域	与公司的可比性
1	华海诚科	致力于半导体封装材料环氧塑封料和组装材料电子胶黏剂的研发、生产和销售	2024 年度主要产品及收入占比: 环氧塑封料 (95.42%) 电子胶黏剂 (4.58%)	半导体封装	主营业务为环氧塑封料且环氧塑封料业务收入占比超 90%
2	飞凯材料	主要从事电子化工材料的研发、生产和销售, 其控股子公司昆山兴凯是元器件及 IC 封装所需材料领域供货商	2024 年度主要产品及收入占比: 屏幕显示材料 (47.11%) 半导体材料 (23.40%) 紫外固化材料 (21.07%)	屏幕显示行业、集成电路行业、光纤光缆行业	控股子公司昆山兴凯主要从事环氧塑封料业务, 营业收入占飞凯材料的 8.55%
3	康强电子	主要从事半导体封装材料引线框架、键合丝等半导体封装材料的生产、销售	2024 年度主要产品及收入占比: 引线框架 (59.33%) 键合丝 (23.59%) 电极丝 (16.16%)	半导体封装	与公司同属于半导体封装材料行业, 在应用领域、下游客户等方面与公司具有一定可比性
4	德邦科技	专业从事高端电子封装材料研发及产业化, 主要产品形态为电子级粘合剂和功能性薄膜材料	2024 年度主要产品及收入占比: 集成电路封装材料 (11.63%) 智能终端封装材料 (22.20%) 新能源应用材料 (58.80%) 高端装备应用材料 (7.36%)	半导体、消费电子、动力电池、光伏等行业	主营业务中包含集成电路封装材料业务, 应用领域与公司具有一定可比性

资料来源: 上市公司定期报告等公开资料。

公司与选取的同行业可比上市公司在经营情况、关键财务指标等方面对比情况参见本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”。

### 三、发行人产品销售情况和主要客户

#### (一) 主要产品的产销情况

##### 1、主要产品产能、产量及销量情况

报告期内，公司主要产品的产能、产量及销量情况如下：

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
产量(吨)	4,769.34	10,198.92	7,990.82	6,598.60
产能(吨)	6,600.00	12,000.00	8,800.00	8,300.00
产能利用率	72.26%	84.99%	90.80%	79.50%
销量(吨)	4,629.97	9,873.66	7,695.74	6,501.68
产销率	97.08%	96.81%	96.31%	98.53%

注：①产销率=销量/实际产量\*100%。

②产能利用率=产量/产能\*100%；上表产能为公司的实际产能。

公司部分产线于 2023 年第四季度投产，产能尚处于爬坡阶段，因此 2024 年度及 2025 年 1-6 月产能利用率有所下降。

##### 2、主营业务收入按产品分类

报告期内，公司主营业务收入均来自环氧塑封料的销售，按照产品类别分类如下：

单位：万元、%

产品类别	2025年1-6月		2024年度		2023年度		2022年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
基础型	3,034.74	19.08	7,056.32	21.32	6,740.90	27.01	6,380.14	31.90
中端	11,662.80	73.34	23,923.51	72.29	16,396.11	65.71	12,932.87	64.66
高端	1,204.84	7.58	2,111.82	6.38	1,816.63	7.28	689.86	3.45
合计	15,902.38	100.00	33,091.65	100.00	24,953.63	100.00	20,002.88	100.00

#### (二) 主要客户情况

报告期内，公司前五大客户销售情况如下：

单位：万元、%

期间	序号	客户名称	销售金额	占主营业务收入的比例
2025年1-6月	1	捷捷微电	1,185.03	7.45
	2	研导电子	1,120.51	7.05
	3	蓝箭电子	779.15	4.90
	4	亚芯微电	662.98	4.17
	5	兴航科技	590.72	3.71

期间	序号	客户名称	销售金额	占主营业务收入的比例
		合计	4,338.39	27.28
2024 年度	1	研导电子	2,566.71	7.76
	2	捷捷微电	1,997.17	6.04
	3	华天集团	1,475.07	4.46
	4	蓝箭电子	1,470.66	4.44
	5	亚芯微电	1,368.31	4.13
		合计	8,877.92	26.83
2023 年度	1	研导电子	1,611.07	6.46
	2	蓝箭电子	1,354.93	5.43
	3	捷捷微电	1,351.06	5.41
	4	华天集团	1,155.47	4.63
	5	华润微	931.44	3.73
		合计	6,403.98	25.66
2022 年度	1	蓝箭电子	1,313.19	6.57
	2	捷捷微电	1,079.46	5.40
	3	华润微	986.76	4.93
	4	华达微	948.60	4.74
	5	华天集团	844.71	4.22
		合计	5,172.74	25.86

注：①研导电子包括同一控制下的东莞市研导电子材料有限公司、东莞市晶浦电子材料有限公司、东莞市晶浦电子科技有限公司、东莞市莞半微电子科技有限公司、常州晶浦半导体科技有限公司。

②捷捷微电包括江苏捷捷微电子股份有限公司及其子公司捷捷半导体有限公司。

③华润微包括同一控制下的无锡华润安盛科技有限公司、无锡华润华晶微电子有限公司、华润润安科技（重庆）有限公司、华润微电子（重庆）有限公司、杰群电子科技（东莞）有限公司、矽磐微电子（重庆）有限公司。

④华达微包括南通华达微电子集团股份有限公司及其同一控制下的通富微电子股份有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司。

⑤亚芯微电包括浙江亚芯微电子股份有限公司及其子公司安徽亚芯微电子有限公司、贵州亚芯微电子有限公司、湖北亚芯微电子有限公司。

⑥华天集团包括同一控制下的华羿微电子股份有限公司、天水华天科技股份有限公司、广东韶华科技有限公司。

报告期内，公司不存在对单一客户销售金额占比超过 50%的情况，不存在严重依赖个别客户的情况。报告期内，上述客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事（取消监事会前在任）、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。

#### 四、发行人采购情况和主要供应商

## (一) 采购原材料及能源的情况

### 1、主要原材料采购情况

公司生产所需的主要原材料包括填料（硅微粉等）、树脂（环氧树脂、酚醛树脂等）和助剂（包括偶联剂、促进剂、改性剂、阻燃剂等）。报告期内，随着业务规模的扩大和产品产销量的增长，公司主要原材料采购量呈现逐年上升趋势。

报告期内，公司原材料采购总额分别为 11,835.68 万元、13,982.26 万元、18,481.54 万元和 9,021.18 万元，主要采购内容、采购金额及其占比情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年 1-6 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
硅微粉	2,894.81	32.09	6,203.80	33.57	4,737.98	33.89	3,838.41	32.43
环氧树脂	2,444.32	27.10	4,847.49	26.23	3,602.26	25.76	3,410.52	28.82
酚醛树脂	1,437.84	15.94	2,955.50	15.99	2,308.10	16.51	1,644.93	13.90
主要助剂	1,704.55	18.90	3,162.51	17.11	2,327.56	16.65	2,076.06	17.54
其他	539.66	5.98	1,312.24	7.10	1,006.36	7.20	865.76	7.31
合计	9,021.18	100.00	18,481.54	100.00	13,982.26	100.00	11,835.68	100.00

报告期内，公司主要原材料的采购价格情况如下：

单位：元/千克

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
硅微粉	7.16	7.08	7.03	6.77
环氧树脂	55.60	52.70	49.28	53.14
酚醛树脂	57.39	54.96	57.91	46.81
主要助剂	143.38	142.33	144.99	136.74

报告期内，随着公司产品结构向中高端优化，采购的原材料规格相应提高，导致原材料均价整体呈现上升趋势。

### 2、能源采购情况

报告期内，公司采购的主要能源为电力和燃气，价格较为稳定，采购量随着公司业务规模的扩大而持续增长，具体情况如下：

能源类型	项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
电	耗用量（万度）	424.12	957.93	734.93	549.04
	金额（万元）	306.39	710.16	551.55	402.87
	平均价格（元/度）	0.72	0.74	0.75	0.73
燃气	耗用量（万 m <sup>3</sup> ）	5.27	7.65	7.46	7.17
	金额（万元）	20.13	29.02	29.60	26.60
	平均价格（元/m <sup>3</sup> ）	3.82	3.80	3.97	3.71

## (二) 报告期内主要原材料供应商情况

报告期内，公司向前五大原材料供应商采购情况如下：

单位: 万元、%

期间	序号	供应商名称	主要采购内容	采购金额	占原材料采购总额的比例
2025 年 1-6 月	1	联瑞新材	硅微粉	2,010.84	22.29
	2	圣泉集团	环氧树脂、酚醛树脂	1,516.71	16.81
	3	衡封新材	酚醛树脂	801.21	8.88
	4	邦陆通商	环氧树脂、酚醛树脂	657.11	7.28
	5	中恒新材	硅微粉	531.68	5.89
	合计		-	5,517.55	61.16
2024 年度	1	联瑞新材	硅微粉	4,616.47	24.98
	2	圣泉集团	环氧树脂、酚醛树脂	2,807.78	15.19
	3	衡封新材	酚醛树脂	1,533.96	8.30
	4	邦陆通商	环氧树脂、酚醛树脂	1,291.45	6.99
	5	中恒新材	硅微粉	969.48	5.25
	合计		-	11,219.14	60.70
2023 年度	1	联瑞新材	硅微粉	3,470.89	24.82
	2	圣泉集团	环氧树脂、酚醛树脂	2,061.52	14.74
	3	邦陆通商	环氧树脂、酚醛树脂	984.05	7.04
	4	衡封新材	酚醛树脂	966.61	6.91
	5	宇部兴产	酚醛树脂	906.46	6.48
	合计		-	8,389.54	60.00
2022 年度	1	联瑞新材	硅微粉	2,790.70	23.58
	2	圣泉集团	环氧树脂、酚醛树脂	2,166.38	18.30
	3	宇部兴产	酚醛树脂	952.39	8.05
	4	邦陆通商	环氧树脂、酚醛树脂	881.38	7.45
	5	中恒新材	硅微粉	463.96	3.92
	合计		-	7,254.81	61.30

注: 圣泉集团包括山东圣泉新材料股份有限公司及其子公司山东圣泉电子材料有限公司。

报告期内, 公司前五大供应商基本稳定, 公司不存在对单一供应商采购金额占比超过 50%的情况, 不存在严重依赖个别供应商的情况。

报告期内, 上述供应商与公司不存在关联关系。公司董事、监事(取消监事会前在任)、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在上述供应商中占有权益。

### (三) 报告期内外协加工情况

报告期内, 公司个别型号产品使用的部分原材料在预处理后设备清洗过程繁琐, 为加快生产效率, 同时出于经济性考虑, 公司采取了委外加工的方式对原材料进行预处理, 不涉及核心工序。报告期内, 公司委外加工金额分别为 2.82 万元、8.60 万元、14.88 万元和 2.90 万元, 占同期营业成本的比例分别为 0.02%、0.05%、0.06%和 0.03%, 金额和占比均较小。

## 五、发行人主要固定资产和无形资产

### (一) 主要固定资产

#### 1、固定资产构成情况

公司生产经营使用的固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备等。截至报告期末，公司固定资产情况如下：

单位：万元、%

项目	账面原值	累计折旧	账面价值	成新率
房屋及建筑物	15,411.64	3,493.04	11,918.60	77.34
机器设备	9,212.43	2,670.40	6,542.04	71.01
运输工具	126.55	59.71	66.84	52.82
电子设备及其他	1,435.53	938.80	496.73	34.60
合计	26,186.15	7,161.95	19,024.20	72.65

#### 2、房屋建筑物

##### (1) 自有房屋及建筑物

截至本招股说明书签署日，公司拥有的不动产情况如下：

产权人	产权证编号	房屋坐落	面积 (m <sup>2</sup> )	用途	取得方式	使用期限	是否抵押
中科科化	苏(2023)泰州市不动产权第2671218号	泰州市海陵工业园区梅兰东路70号	土地：56,011.00 房屋：73,122.16 m <sup>2</sup>	工业	出让 自建	2063年3月	否

##### (2) 房屋租赁情况

截至本招股说明书签署日，公司房屋租赁情况如下：

序号	承租人	出租方	位置	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期限	租赁用途
1	中科科化	首科化	北京市昌平区沙河镇松兰堡村沙河工业园区临168号	1,915.00	2025.1.1-2025.12.31	北京研发中心
2	中科科化	海陵区怡口商贸中心	泰州市海陵区凤凰东路2-102号	740.00	2025.9.23-2025.12.23	仓库
3	中科科化	深圳市中柱物流有限公司	深圳市宝安区石岩街道顺益路10号	524.36	2024.4.15-2026.3.31	仓库

注：①公司向首科化租赁的房产建于集体建设用地上，系首科化向北京市昌平区沙河镇松兰堡村股份经济合作社租赁取得，首科化未取得不动产权证。首科化租赁该集体土地已经农村（社区）股东代表大会会议三分之二以上表决通过，履行了相关审批程序。

②公司向海陵区怡口商贸中心、深圳市中柱物流有限公司租赁仓库，出租方均不是不动产产权人，出租方已取得产权人同意转租的授权文件。

根据公司所在地住房和城乡建设局、自然资源和规划局出具的证明，以及北

京市公共信用信息中心（信用中国（北京））针对北京分公司出具的《市场主体专用信用报告（有无违法违规信息查询版）》，公司及北京分公司报告期内不存在受到住建主管部门及自然资源主管部门行政处罚的情形。

公司的控股股东北京科化已出具承诺：若因发行人租赁的房屋未办理不动产权证书导致发行人无法正常使用租赁物业或被有关政府部门处罚或被追究其他法律责任，导致发行人需要承担任何赔偿、罚款、损失及其他支出（包括但不限于发行人寻找替代场所以及搬迁所发生的全部费用和损失），本公司承诺将承担由此产生的全部费用和损失，保障不因此影响发行人正常生产经营活动。若发行人因未办理房屋租赁备案登记被有关政府部门处以罚款或被追究其他法律责任，本公司承诺将承担由此产生的全部费用和损失。本公司承诺承担上述费用和损失后不向发行人追偿，确保发行人免受任何损失和损害。

## （二）主要无形资产

### 1、无形资产构成情况

公司无形资产主要包括土地使用权、软件、专利权及商标权。截至报告期末，公司无形资产情况如下：

单位：万元

项目	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值
土地使用权	2,064.96	464.59	-	1,600.37
软件	177.73	61.20	-	116.53
专利权	72.63	2.52	-	70.11
商标权	173.85	20.98	-	152.86
合计	2,489.17	549.29	-	1,939.89

### 2、土地使用权

截至本招股说明书签署日，公司拥有1处不动产权，已办理不动产权证，对应土地使用权情况参见本节“五、发行人主要固定资产和无形资产（一）主要固定资产”。

### 3、商标

截至本招股说明书签署日，公司在中国境内已取得注册商标4项，具体如下：

序号	注册商标	注册人	类别	注册号	有效期限	取得方式	权利限制
1		中科科化	第42类	58489982	2032年4月13日	原始取得	无
2		中科科化	第17类	53792962	2031年9月20日	原始取得	无

序号	注册商标	注册人	类别	注册号	有效期限	取得方式	权利限制
3		中科科化	第 17 类	5618309	2029 年 10 月 27 日	受让取得	无
4		中科科化	第 17 类	5618310	2029 年 10 月 27 日	受让取得	无

#### 4、专利

截至本招股说明书签署日,发行人拥有 34 项发明专利、11 项实用新型专利,具体情况参见本招股说明书“第十二节 附件 二、公司专利情况”。

#### 5、域名

截至本招股说明书签署日,发行人拥有 2 项域名,具体如下:

序号	注册人	域名	备案号	有效期限
1	中科科化	scienchem.com.cn	苏 ICP 备 2021050236 号-1	2027 年 4 月 18 日
2	中科科化	zkzhkh.com	苏 ICP 备 2021050236 号-3	2026 年 8 月 29 日

#### (三) 特许经营权情况

截至本招股说明书签署日,公司无特许经营权。

#### (四) 主要经营资质和认证证书

截至本招股说明书签署日,公司主要经营资质和认证证书如下:

序号	持有人	资质/证书名称	发证/认证单位	证书编号/批文号	有效期
1	中科科化	高新技术企业证书	江苏省科技厅、江苏省财政厅、国税总局江苏省税务局	GR202432009496	2027 年 12 月
2	中科科化	ISO 14001 环境管理体系认证证书	新世纪检验认证有限公司	016TJ23E30758R1M	2026 年 5 月
3	中科科化	ISO 9001 质量管理体系认证证书	新世纪检验认证有限公司	016TJ23Q31003R1M	2026 年 5 月
4	中科科化	ISO 45001 职业健康安全管理体系认证证书	新世纪检验认证有限公司	016TJ23S30710R1M	2026 年 5 月
5	中科科化	IATF16949 质量管理体系认证证书	SGS	IATF0534728	2027 年 7 月
6	中科科化	IECQ 证书(有害物质过程管理)	NQA	IECQ-H NQAGB 18.0004	2028 年 1 月
7	中科科化	固定污染源登记回执	-	91321200583724034G001W	2030 年 1 月
8	中科科化	进出口货物收发货人	泰州海关	3212963237	2099 年 12 月

### 六、发行人核心技术及研发情况

#### (一) 发行人的核心技术情况

半导体封装形式朝着小型化、高集成度、高功率密度等方向不断演进,同时市场需求也在持续发展,人工智能、汽车电子、工业控制等高端应用提升了对芯

片封装材料的性能要求，环氧塑封料产品的开发面临更高的技术难度。

公司积极响应封装技术发展趋势和客户需求，持续加大研发投入，经过多年的技术积累，已形成一系列涵盖配方和生产工艺的核心技术体系。尤其在中高端领域，公司拥有全面的技术储备，包括高粘接技术、低应力技术、高填料量球形硅微粉分散技术、翘曲控制技术等核心技术，这些技术可以有效应对产品粘接强度不足、内部应力升高、硅微粉分散及流动性不佳等行业共性问题，显著提升产品性能和竞争力。

### 1、核心技术的技术来源、先进性、具体表征及其应用情况

截至本招股说明书签署日，公司共有 20 项关键核心技术，主要围绕中高端环氧塑封料的配方及生产工艺关键技术展开，其技术来源、先进性、具体表征及其应用等情况如下：

类别	核心技术名称	主要应用产品类别	解决的难题	技术先进性及具体表征	保护措施	技术来源	核心技术所处阶段
配方技术	高粘接技术	中高端环氧塑封料为主，包含少部分基础型环氧塑封料	公司通过本技术有效解决了金属惰性较大、填料比例较高导致环氧塑封料粘接力降低的问题，进一步提升产品的可靠性	公司使用特种粘接改性剂组合技术，使环氧塑封料与封装体内部铜、银、镍等材料表面实现较好的浸润效果，进而形成稳固的化学键或分子间作用力，保证封装体内部环氧塑封料与各材料界面没有分层。该技术使得铜表面粘接力平均值由约 800N 提升至约 1,100N，银表面粘接力平均值由约 450N 提升至约 670N，镍表面粘接力平均值由约 600N 提升至约 800N，有效提升了产品的可靠性，并进一步将产品应用领域拓展至汽车电子、工业控制等领域	专利和技术秘密组合保护	在承接北京科化专利技术的基础上自主研发、迭代升级	正式应用
	低应力技术	中高端环氧塑封料为主，包含少部分基础型环氧塑封料	公司通过本技术有效降低了温度等因素变化形成的内应力，解决了内应力增加导致产品可靠性降低的问题，进一步提升产品的可靠性	公司选用特种应力改性剂，同时配合分散剂，改进了部分树脂体系（环氧树脂、酚醛树脂及促进剂）的相容性，有效提高了应力改性剂在环氧塑封料中的分散效果，进而实现更好的降低应力效果。该技术使得产品在室温下的弯曲模量降至 20GPa 以下，而目前国外领先企业公开资料披露的主流产品的弯曲模量一般在 30GPa 以下，公司产品优于住友电木等日系厂商的部分产品	技术秘密保护	自主研发	正式应用
	低离子控制技术	中高端环氧塑封料、基础型环氧塑封料	高电压器件产品中的 $\text{Na}^+$ 、 $\text{Cl}^-$ 含量过高将分别影响产品的电性能及耐腐蚀性能，进而影响产品的可靠性；公司通过本技术提高了高电压器件产品用环氧塑封料的可靠性	公司通过选用低离子含量的原材料，同时配合离子捕捉剂，获得低 $\text{Na}^+$ 、 $\text{Cl}^-$ 含量的环氧塑封料。该技术使得产品的 $\text{Na}^+$ 、 $\text{Cl}^-$ 含量分别低于 4ppm 和 8ppm，可以满足高电压器件的可靠性要求	技术秘密保护	自主研发	正式应用
	高填料量球形硅微粉分散技术	中高端环氧塑封料	公司通过本技术提高了环氧塑封料的填料比例，并使产品具有优异的工艺性能和可靠性	公司对具有良好流动性的球形熔融型二氧化硅微粉进行合理的粒径分布设计，并使用偶联剂、分散剂对硅微粉表面进行处理。通过本技术生产的环氧塑封料的硅微粉填料量接近 90%，使得产品的螺旋流动长度大于 130cm，具有优异的工艺性能；同时线膨胀系数低于 8ppm，吸水率低于 0.25%，而目前国外领先企业公开资料披露的主流产品的吸水率一般在 0.3% 以下，公司产品优于住友电木等日系厂商的部分产品	专利和技术秘密组合保护	在承接北京科化专利技术的基础上自主研发、迭代升级	正式应用
	高填料量角形硅微粉分散技术	全包封类中端环氧塑封料	公司通过本技术有效解决了部分应用于 TO-220F 封装形式产品所选用的角形结晶型二氧化硅微粉含量较高时硅微粉分散性和流动性明显下	公司使用偶联剂、分散剂对角形结晶型二氧化硅微粉表面进行处理，可在硅微粉填料量较高时使产品保持较高的封装外形良率，有效提升了半导体产品的封装良率	专利和技术秘密组合保护	在承接北京科化专利技术的基础上自主研发、迭代升级	正式应用

类别	核心技术名称	主要应用产品类别	解决的难题	技术先进性及具体表征	保护措施	技术来源	核心技术所处阶段
			降，导致半导体封装过程中产生外形缺陷的问题				
	高导热与填充性组合技术	应用于大功率器件的高端环氧塑封料	公司通过本技术使产品满足以电源模块为代表的大功率模组对环氧塑封料热导率和填充性的较高要求	公司通过偶联剂、分散剂等对小粒径氧化铝微粉进行表面处理，所生产的环氧塑封料热导率大于 $3W/m\cdot K$ ，满足导热要求较高的大功率模组的需求，同时填料比例保持在 85% 以上，使得内部器件较多、结构复杂的大功率模组具备较高填充性	专利和技术秘密组合保护	在承接北京科化专利技术的基础上自主研发、迭代升级	正式应用
	磁性器件塑封技术	用于电感分立元件或集成模块的磁性塑封料	公司通过本技术研制用于电感分立元件或高集成度模块的磁性塑封料，可使电感器件保持较高磁导率和较低磁损耗	公司使用特种分散助剂、特种树脂及特种粘接促进剂组合技术，使磁性填料在环氧塑封料中实现较高填料量的同时保持优异的流动性，并实现高导热、高磁导率和较低磁损耗，同时使环氧塑封料与塑封体内部的铜、银、镍及 PCB 基板表面实现良好的浸润效果，进而形成稳固的化学键或分子间作用力，满足高端高集成度电感器件封装的高可靠性要求	专利和技术秘密组合保护	自主研发	正式应用
	潜伏固化技术	高端环氧塑封料	公司通过本技术有效解决了随着芯片结构复杂度增加导致的填充难度增大、冲线风险增加等问题，有效提升了产品可靠性	公司使用潜伏固化促进剂，调整环氧塑封料的固化反应进程，使环氧塑封料在封装过程的前段时间的固化反应速度低，粘度整体保持较低水平，同时后段时间反应速度增大，实现快速固化。通过上述方式可实现较宽的封装工艺窗口，有利于更好地进行填充，减小填充过程对键合丝的冲击，并最终实现理想的固化成型效果	专利和技术秘密组合保护	在承接北京科化专利技术的基础上自主研发、迭代升级	正式应用
	翘曲控制技术	应用于单面封装的高端环氧塑封料	公司通过本技术改善了单面封装时由于封装体内部各材料热膨胀系数差异造成翘曲问题，有效提升了产品可靠性	公司通过优化环氧塑封料的 $T_g$ 、弯曲模量、热膨胀系数、固化收缩率等性能指标，改变塑封体的翘曲方向及程度，使塑封体在成型、后固化、回流焊等工序的翘曲度保持在合格水平，满足下游客户的需求	专利和技术秘密组合保护	自主研发	正式应用
	窄缝填充技术	应用于倒装芯片的高端环氧塑封料	公司通过本技术有效解决了倒装工艺中，芯片下方缝隙较小导致填充难度较大的问题，有效提高了产品可靠性和封装良率	公司选用最大粒径低于 $20\mu m$ 的二氧化硅微粉末，进行合理的粒径分布设计，配合特种潜伏性固化促进剂，使环氧塑封料具有良好的流动特性，同时满足最小 $40\mu m$ 窄缝的 FC 产品的封装需要，使封装体内外部均无气孔等瑕疵	专利和技术秘密组合保护	在承接北京科化专利技术的基础上自主研发、迭代升级	客户验证
	高 $T_g$ 低模量技术	应用于第三代半导体的高端环氧塑封料	公司通过本技术使产品满足以碳化硅为代表的第三代半导体中大功率器件和模组对高温保护特性的较高要求	公司选用特种环氧树脂，配合特种低应力改性剂，生产高 $T_g$ 、低弯曲模量的环氧塑封料。通过本技术生产的环氧塑封料的 $T_g$ 值达到 $210^{\circ}C$ 以上，同时室温和 $260^{\circ}C$ 环境下的弯曲模量分别低于 $13GPa$ 和 $0.8GPa$ ，可以保证大	专利和技术秘密组合保护	自主研发	客户验证

类别	核心技术名称	主要应用产品类别	解决的难题	技术先进性及具体表征	保护措施	技术来源	核心技术所处阶段
核心技术	高 Tg 低吸湿技术	应用于第三代半导体的高端环氧塑封料	公司通过本技术使产品满足器件对高温保护和低吸湿特性的较高要求	功率器件和模组在高温环境下的高可靠性 公司选用特种环氧树脂，配合低应力改性剂、粘接剂、脱模剂等配方组分，生产高 Tg、低吸湿性的环氧塑封料。通过本技术生产的环氧塑封料的 Tg 值达到 210℃以上，同时吸湿性小于 0.18%、高温下的弯曲模量小于 0.6GPa，可以保证大功率器件和模组在高温环境下的高可靠性，满足 MSL1 级要求	专利和技术秘密组合保护	自主研发	客户验证
	连续成模技术	中高端环氧塑封料为主，包含少部分基础型环氧塑封料	环氧塑封料在使用时可能出现脱模不畅或者连续成模的模具脏污问题，单纯在配方中提高脱模剂含量的做法难以满足相关要求，同时在产品表面易于形成留痕印记；公司开发相关技术有效解决了上述难题	公司开发了一种环氧塑封料添加剂组合，使产品脱模时能够在模具上形成一层保护层，有效提高脱模效果，提高抗污模的能力，有效提升产品的连续成模数；开发特定脱模剂以及相应加工工艺，使得塑封料成型后塑封体表面无明显印记	专利和技术秘密组合保护	自主研发	正式应用
	环保阻燃剂分散技术	中端环氧塑封料、基础型环氧塑封料	根据相关法律法规及客户的环保需求，公司选用环保阻燃剂替代传统非环保的溴锑阻燃体系，同时解决了环保阻燃剂易于团聚引发产品流动性、成型性、力学性能劣化的问题	公司通过优选环保阻燃剂体系和特定的物料粉碎工艺，将易于团聚的环保阻燃剂充分分散，在挤出熔融状态下充分混炼，实现更大程度的均匀分散，使产品阻燃性能达到 V-0 级别，同时获得良好的力学性能和脱模性能，同时还具备良好的流动性、成型性和可靠性	专利和技术秘密组合保护	自主研发	正式应用
生产工艺技术	预处理技术	通用技术	公司通过本技术提升了环氧塑封料的脱模性，有效解决了因脱模性较差导致封装体表面出现流痕、粘模的问题；同时有效提升环氧塑封料生产过程中混合的均匀性	公司通过使用特定脱模剂、分散剂等，使脱模剂在环氧塑封料中能更好地分散，从而保证环氧塑封料成型后具有良好的脱模性，避免破坏产品的粘接力，有效提升清模周期，延缓污模速度，有效提升客户的生产效率，同时避免产品产生流痕、粘模等瑕疵；同时，公司通过对混料磨料装置进行优化，避免不同材料、不同密度材料混合时产生分层，有效解决打散、贴合不充分等混合均匀性不好的问题，提升产品的良率和可靠性	专利和技术秘密组合保护	自主研发	正式应用
	挤出工艺技术	通用技术	公司通过本技术提升了环氧塑封料生产过程中的温度调节能力、混炼效果和稳定性	公司对挤出机传热系统进行优化，缩短了调整温度所需时间，实现了更好的控温能力。同时，公司根据不同产品特点对叶片组合进行相应设计，实现了环氧塑封料生产过程中更好的混炼效果	技术秘密保护	自主研发	正式应用
	颗粒状环氧塑封料制备技术	高端环氧塑封料中的颗粒状环氧塑封料	公司通过本技术掌握了用于晶圆级和板级等先进封装的颗粒状环氧塑封料制备工艺	公司通过自研造粒机及其他部分装置，在挤出工序后制成直径较小、尺寸规范的颗粒，满足晶圆级和板级封装等先进封装所使用的压缩封装工艺的要求	专利和技术秘密组合保护	自主研发	正式应用

类别	核心技术名称	主要应用产品类别	解决的难题	技术先进性及具体表征	保护措施	技术来源	核心技术所处阶段
	除铁技术	通用技术	公司通过本技术有效降低了带入到环氧塑封料的铁含量	公司将强磁力磁棒进行组合，自制多层除铁设备，在产线中接触环氧塑封料的多个点位上进行安装，将产品铁含量控制在 30-100ppm 以内	专利和技术秘密组合保护	自主研发	正式应用
	自动称饼设备技术	通用技术	公司通过本技术有效提高了生产和研发效率	在传统生产工艺中，一般对饼重实行一定比例抽检。公司通过自研自动称饼设备，实现了对特定饼料重量的自动化 100% 检验	技术秘密保护	自主研发	正式应用
	饼料出料技术	通用技术	公司通过本技术有效减少了环氧塑封料碰撞摩擦造成饼料磨损	公司通过对饼料排队出料装置进行优化，有效减少了多个饼料在滑饼槽中相互之间碰撞摩擦损耗，进一步提升了产品品质	专利和技术秘密组合保护	自主研发	正式应用

截至本招股说明书签署日，公司共有 45 项授权专利，其中发明专利 34 项，具体情况参见本招股说明书“第十二节 附件 二、公司专利情况”。

## 2、核心技术在主营业务的应用和贡献情况

公司核心技术在主营业务中得到广泛应用,报告期内公司核心技术业务收入占营业收入的比例在99%以上。

### （二）公司科研实力和成果情况

#### 1、公司拥有一支资深行业专家领衔的专业研发团队

具体情况参见本节“六、发行人核心技术及研发情况（六）发行人的核心技术人员及研发人员情况”。

#### 2、参与的重大科研项目

公司在环氧塑封料领域拥有深厚的发展传承,在公司成立前,控股股东北京科化在“七五”至“十一五”期间承担或参与了多个与环氧塑封料相关的国家级重大科技项目,具体情况如下:

序号	课题名称	课题执行时间	参与身份
1	5 μ 技术用环氧塑封料的研制与中试	“七五”期间	参与单位
2	大规模集成电路( LSI )用环氧塑封料制造技术研究	“八五”期间	参与单位
3	0.5 μ 技术用环氧塑封料的研制与中试	“九五”期间	参与单位
4	0.35 μ 技术用环氧塑封料的研制		
5	ULSI 电路封装用环氧封装料的规模化制备技术	“十五”期间	独立承担
6	LQFP 绿色环保型塑封料的研发与产业化	“十一五”期间	独立承担

2011年公司成立后,承接了北京科化的经营团队和相关技术,成为专门从事环氧塑封料研发及产业化的经营主体。公司独立承担了多个省市级重大科技项目,目前正在参与2025年国家重点研发计划重点项目,具体情况如下:

序号	项目名称	委托单位	发行人角色	执行时间	项目进展
1	2025年国家重点研发计划重点专项“先进高分子材料研发用关键单体试剂”项目	国家科技部	参与单位	2025年-2027年	正在实施
2	2024年山东省重点研发计划“半导体用特种环氧树脂研发及产业化”项目	山东省科技厅	参与单位	2024年-2027年	正在实施
3	第三代半导体器件封装用高端环氧塑封料的研发及产业化项目	泰州市科技局	实施单位	2023年-2025年	项目验收
4	倒装芯片封装用MUF型环氧塑封料研发及产业化项目	江苏省工信厅	实施单位	2023年-2024年	已完成
5	超大规模集成电路用环保型环氧塑封料的研发及产业化项目	泰州市科技局	实施单位	2018年-2020年	已完成
6	环保型环氧塑封料关键技术研发项目	江苏省科技厅	实施单位	2016年-2019年	已完成

#### 3、研发平台

公司设有“江苏省企业技术中心”、“江苏省微电子封装材料工程技术研究中心”、“江苏省微电子封装材料工程研究中心”等研发平台。同时，公司也是中科院化学所的成果转化基地之一。

#### 4、重要荣誉及奖项

近年来，公司获得的重要奖项及荣誉情况如下：

序号	荣誉称号及奖项名称	颁发单位	颁发时间
1	专精特新“小巨人”企业	工信部	2025年
2	江苏省首批次新材料（KHG900系列）	江苏省工信厅	2025年
3	2025年江苏省先进级智能工厂	江苏省工信厅	2025年
4	2024年度最佳协同供应商奖	华润微	2025年
5	2023年度优秀供应商	华润微	2024年
6	江苏省专精特新中小企业	江苏省工信厅	2024年
7	2023年度泰州市科技创新奖	泰州市人民政府	2023年
8	江苏省专精特新小巨人企业	江苏省工信厅	2021年
9	2021年度江苏省专精特新产品	江苏省工信厅	2021年
10	2020年度海陵区企业技术创新奖	泰州市人民政府	2021年
11	泰州市管理创新先进企业	泰州市工信局	2020年
12	江苏省民营科技企业	江苏省民营科技企业协会	2020年

#### 5、主持或参与制定国家标准、行业标准情况

公司作为主要起草单位之一参与制定国家标准《集成电路封装用低放射性球形氧化硅微粉》（GB/T 46381-2025）。集成电路封装用低放射性球形氧化硅微粉主要应用于人工智能、高性能计算等领域。随着相关领域的技术创新加速迭代，越来越多应用场景加速落地，推动硬件升级，对高端球形硅微粉的需求增加。上述标准系首个集成电路封装用低放射性球形氧化硅微粉国家标准。

#### 6、行业主管部门及行业协会鉴定意见

行业主管部门及行业协会对公司产品的鉴定意见如下：

序号	出具单位	鉴定文件	出具日期	产品类别	技术水平	主要鉴定意见内容
1	中国电子材料行业协会	《科学技术成果鉴定报告》	2024年11月	高端	国际领先	<p>①成果名称：扇出型板级封装用颗粒状环氧塑封料（KHG900G-A）</p> <p>②主要鉴定意见</p> <p>A. 该产品综合性能达到国外同类产品水平，可满足扇出型板级封装领域技术需求</p> <p>B. 经国内知名封测企业应用验证，产品性能可以满足扇出型板级封装产品使用要求，达到了国际知名品牌公司同类产品应用效果，实现了进口同类产品的替代，降低了被“卡脖子”的风险，取得了良好的社会和经济效益</p> <p>③鉴定结论：鉴定委员会一致认为，中科科化颗粒状环氧塑封料（KHG900G-A）产品可应用于扇出型板级封装产品封装，产品性能达到国际同类产品先进水平，填补国内空白</p>
2	江苏省工信厅	《新产品新技术鉴定验收证书》（苏工信鉴字[2023]566号）	2023年9月	中端	国内领先	<p>①新产品名称：新型高功率模块封装用环氧塑封料（KHG400GP）</p> <p>②主要鉴定意见：该产品优于国内同类产品性能，满足了快速发展的电动汽车、风电、光伏等新能源领域功率模块封装材料的市场需求</p> <p>③鉴定结论：鉴定委员会一致认为该产品性能达到国内领先水平，同意通过新产品鉴定</p>
3	江苏省工信厅	《新产品新技术鉴定验收证书》（苏工信鉴字[2020]543号）	2020年10月	中端	国内领先	<p>①新产品名称：环氧塑封料 KHG500</p> <p>②主要鉴定意见：该项目产品有效提升粘接性能；降低塑封料的弯曲模量，减小封装集成电路的内应力；提高了树脂体系与填料的界面相容性，提高了封装集成电路的可靠性</p> <p>③鉴定结论：鉴定委员会认为该产品技术达到国内领先水平，属国内首创，同意通过新产品鉴定</p>

### （三）发行人正在研发的项目

截至本招股说明书签署日，公司正在从事的主要研发项目情况如下：

序号	项目名称	研发内容和目标	拟达到的技术水平	进展情况
1	晶圆级/面板级封装用液体塑封料（LMC）的开发	本项目拟研发应用于晶圆级/面板级封装的液体环氧塑封料	对标外资厂商竞品，产品参数与性能达到国际先进水平	配方设计与测试已完成，待客户验证
2	SOT 封装用高可靠性环氧塑封料的开发	本项目拟开发 SOT 封装用高可靠性环氧塑封料，提高产品可靠性和连续成模性，拓宽产品使用窗口	对标外资厂商竞品，产品参数与性能至少达到国内领先水平	部分产品已量产，部分处于客户验证阶段
3	车规级器件/电路封装用高可靠性环氧塑封料的开发	本项目拟开发车规级器件/电路封装用高可靠性环氧塑封料，满足汽车电子对可靠性和耐久性的严苛要求	对标外资厂商竞品，产品参数与性能达到国际先进水平	部分产品已量产，部分处于客户验证阶段
4	第三代半导体器件封装用高端环氧塑封料的开发	本项目拟开发第三代半导体器件封装用高端环氧塑封料	对标外资厂商竞品，产品参数与性能达到国际先进水平	部分产品已量产，部分处于客户验证阶段
5	高导热型 IPM 封装用环氧模塑料的开发	本项目拟开发 IPM 封装用环氧模塑料，产品具有高导热等特点	对标外资厂商竞品，产品参数与性能达到国际先进水平	部分产品已量产，部分处于客户验证阶段
6	低翘曲型低应力 IPM 封装用环氧模塑料的开发	本项目拟开发 IPM 封装用环氧模塑料，产品具有低翘曲、低应力等特点	对标外资厂商竞品，产品参数与性能达到国际先进水平	部分产品已量产，部分处于客户验证阶段
7	高频高速设备用低损耗 EMC 的开发	本项目拟开发高频高速设备用环氧塑封料，产品具有低损耗等特点	对标外资厂商竞品，产品参数与性能达到国际先进水平	研发中

序号	项目名称	研发内容和目标	拟达到的技术水平	进展情况
8	高算力高功率芯片用高导热 EMC 的开发	本项目拟开发高算力高功率芯片封装用环氧塑封料，产品具有高导热等特点	对标外资厂商竞品，产品参数与性能达到国际先进水平	研发中
9	电感封装用高磁导率、低损耗 EMC 的开发	本项目拟开发电感封装用环氧塑封料，产品具有高磁导率、低损耗等特点	产品性能达到行业领先水平	研发中
10	高端声表面波滤波器（SAW）封装用 SMC 的开发	本项目拟开发高端声表面波滤波器封装用片状环氧塑封料	对标外资厂商竞品，产品参数与性能达到国际先进水平	研发中
11	高可靠性低应力功率器件用环氧塑封料的开发	本项目拟开发高可靠性低应力功率器件用环氧塑封料，提高半包封功率器件、光伏模块用环氧塑封料的可靠性、耐湿等级	对标外资厂商竞品，产品参数与性能达到国际先进水平	部分产品已量产，部分处于客户验证阶段
12	大功率器件用高导热低应力环氧塑封料的开发	本项目拟开发满足 TO-220F 用环氧塑封料，产品具有高可靠性	对标外资厂商竞品，产品参数与性能达到国际先进水平	部分产品已量产，部分处于客户验证阶段
13	高可靠性低应力电路封装用 EMC 的开发	本项目拟开发系列化的用于电路封装用环氧塑封料，提高产品的可靠性和连续成模性	对标外资厂商竞品，产品参数与性能达到国际先进水平	部分产品已量产，部分处于客户验证阶段
14	高性能 QFN/DFN 用 EMC 的开发	本项目拟开发高性能 QFN/DFN 用环氧塑封料，提高产品的可靠性和连续成模性	对标外资厂商竞品，产品参数与性能达到国际先进水平	部分产品已量产，部分处于客户验证阶段
15	LQFP 封装用 Low K EMC 的产品开发	本项目拟开发 LQFP 封装用 Low K 环氧塑封料，满足 Low K 芯片对低应力和低离子浓度的要求	对标外资厂商竞品，产品参数与性能达到国际先进水平	部分产品已量产，部分处于放量测试阶段
16	MUF 用 EMC 的制造技术研究	本项目拟开发满足 MUF 产品稳定连续化生产的设备与工艺组合技术及配方	对标外资厂商竞品，产品参数与性能达到国际先进水平	放量测试阶段
17	压缩封装用颗粒 EMC 的制造技术研究	本项目拟开发满足颗粒状环氧塑封料稳定连续化生产的设备与工艺组合技术及配方	对标外资厂商竞品，产品参数与性能达到国际先进水平	部分产品已量产，部分处于客户验证阶段
18	EMC 稳定生产工艺制造技术研究	本项目拟开发满足环氧塑封料批量稳定连续化生产的设备与工艺组合技术	一次检验合格率达到行业先进水平	研发中
19	环氧塑封料工艺性与可靠性测试技术开发	本项目拟开发适用于 EMC 典型应用工艺性和可靠性的标准测试评价方法	建立内部评价方法，不适用	研发中
20	半导体用特种环氧树脂的研发与产业化-高端芯片用国产化环氧塑封料的开发	本项目对应公司与圣泉集团联合申报的重大科技项目，拟开发使用国产特种环氧树脂的高端环氧塑封料	对进口环氧树脂进行国产化替代	研发中
21	双组份高 Tg 液体环氧塑封料的研制与开发	本项目针对车载 IGBT 封装技术要求，开发耐高温液态环氧塑封料，并根据公司需求，开展其他类型液体环氧塑封料的预研开发工作	对标外资厂商竞品，产品参数与性能达到国际先进水平	研发中

#### （四）发行人的研发投入情况

报告期内，公司研发投入情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
研发投入	929.83	1,806.33	1,641.83	1,123.94
研发投入占营业收入的比例	5.85	5.46	6.56	5.62

#### （五）发行人的合作研发情况

## 1、委托研发与合作研发情况

公司的研发活动以自主研发为主、委托研发和合作研发为辅。公司与中科院化学所、中国地质大学等外部科研机构建立了产学研合作关系。报告期内，公司在自主研发创新的基础之上，委托中科院化学所、中国地质大学进行部分技术的研究与开发。同时，公司还与高校以及半导体产业链企业联合申报重大科技项目，合作开展技术攻关。

截至本招股说明书签署日，公司委托和合作研发的具体情况如下：

序号	合作单位	目的	合同签署日期	研发成果归属约定	技术保密措施
1	中科院化学所	EMC 评价关键技术研究	2022 年 12 月	①双方共同享有执行此项合同产生的专利申请权。未经甲方（公司）同意，乙方（中科院化学所）不得单独实施或对外许可基于合同项下的技术或专利。甲方基于合同项下的技术或专利实施的收益归属甲方独有 ②甲方拥有项目所涉及的技术秘密的使用权。未经甲方同意，乙方不得向第三方授权、许可或转让该技术秘密	①保密内容：甲方委托乙方开发所涉及的技术资料以及项目的研究过程、试验记录、最终成果等一切相关技术资料。 ②涉密人员范围：项目所涉及的双方技术人员、管理人员及其他有关人员
		先进封装用 LMC 材料研制	2025 年 8 月		
2	中科院化学所、湖北硅元新材料股份有限公司	2025 年国家重点研发计划重点专项“先进高分子材料研发用关键单体试剂”项目	2024 年 11 月	①独自完成的科技成果及获得的知识产权归各方独自所有，相关成果被授予的奖励归各方独自所有 ②各方共同完成的科技成果及其形成的知识产权归各方共有，共同享有知识产权使用权，相关成果获得的荣誉和奖励归完成各方共有	课题执行期间，相关资料和数据仅限于各方的研究目的，任何方都不得将其他方未公开的材料和资料向其他方转移和泄露
3	山东圣泉新材料股份有限公司、湘潭大学、鲁东大学、上海本诺电子材料有限公司	2024 年山东省重点研发计划“半导体用特种环氧树脂研发及产业化”项目	2024 年 8 月	①完成单位享有独立申请专利、发表学术论文的权利 ②因实施本项目所产生，并由两个或两个以上单位共同完成的阶段性技术成果及其相关知识产权的权益分配，申请专利、发表学术论文的权利为合作完成项目的全部单位所共有 ③因实施本项目所产生的知识产权，涉及国家安全、国家利益和重大社会公共利益的，属于国家，项目责任单位有免费使用的权利	合作期间各方共同保守合作项目及企业的技术和商业秘密
4	中国地质大学	为高端环氧塑封料的开发提供研究支持	2021 年 7 月	-	-
5		液体塑封料的研制与开发	2025 年 5 月	本合同产生的技术成果及其知识产权归属甲方（公司）所有	-

## 2、受托开发情况

2022 年，客户 A 与公司进行合作，解决在磁性塑封料领域的技术瓶颈，助

力客户 A 开发全新产品。与现行传统封装材料相比，该磁性塑封料产品具有高磁通量和较低磁损耗，可以实现更高电磁转换效率，具有广阔的市场前景。公司通过在环氧塑封料领域的丰富经验和技术积累，顺利研发出符合客户 A 使用需求的磁性塑封料，助力其解决技术瓶颈。目前，公司已与客户 A 签署授权量产协议。公司受托开发的具体情况如下：

合作单位	研究目的	合作模式	合同签署日期	研发成果归属约定	技术保密措施
客户 A	磁塑封材料开发技术合作	受托开发	2022 年 1 月	①双方的背景知识产权归各自所有 ②本合同项下的全部开发成果和前景知识产权均自始归客户 A 所有；自本协议终止之日起的第三个周年日起客户 A 许可公司实施上述前景知识产权，但客户 A 有权撤回公司为向特定第三方销售产品或提供服务而实施上述前景知识产权的许可。除此以外，公司不得以任何形式实施开发成果或其他任何部分，亦不得以任何形式向任何第三方披露开发成果或其任何部分，包括但不限于自行申请或授意他人申请专利 ③本合同终止后 3 年内，在当前项目方案基础上二次开发的包含磁性填料的塑封材料的知识产权，均归属于客户 A，公司不得申请“含有磁性填料的塑封材料”相关领域的专利	双方签署《保密合同》并切实遵守相关保密条款，保密信息包括在合同有效期内由披露方向接收方披露的任何非公开的商业、财务、技术或其他信息

## （六）发行人的核心技术人员及研发人员情况

### 1、核心技术人员情况

公司研发团队由资深行业专家领衔。截至本招股说明书签署日，公司核心技术人员 5 名，拥有材料学、高分子化学与物理、物理化学、材料加工工程等专业背景，并拥有 15 年以上的环氧塑封料或相关领域从业经验，部分核心成员拥有国内外领先环氧塑封料企业任职经历，入选了省市级别的技术人才引进计划。

公司首席科学家李刚先生在大学毕业后即加入了国内环氧塑封料技术攻关先行者——中科院化学所孙忠贤团队，并在“七五”末期加入中科院化学所牵头的环氧塑封料攻关项目，是我国最早从事环氧塑封料技术攻关的研发人员之一，随后又参与了“八五”、“九五”环氧塑封料技术攻关项目、“十五”国家高技术研究发展计划（863 计划）以及“十一五”国家 02 科技重大专项项目。李刚先生作为主要起草人参与编制了《中华人民共和国电子行业标准 环氧模塑料》（SJ/T11197-1999）、《集成电路封装用低放射性球形氧化硅微粉》（GB/T 46381-2025）等标准。公司其他核心技术人员中，王善学先生曾参与国家 02 科技重大专项项目，现担任 2025 年国家重点研发计划重点专项项目的参与单位任务负责人；梅胡杰先生曾担任国家重点研发计划“高端芯片封装用塑封料（EMC）

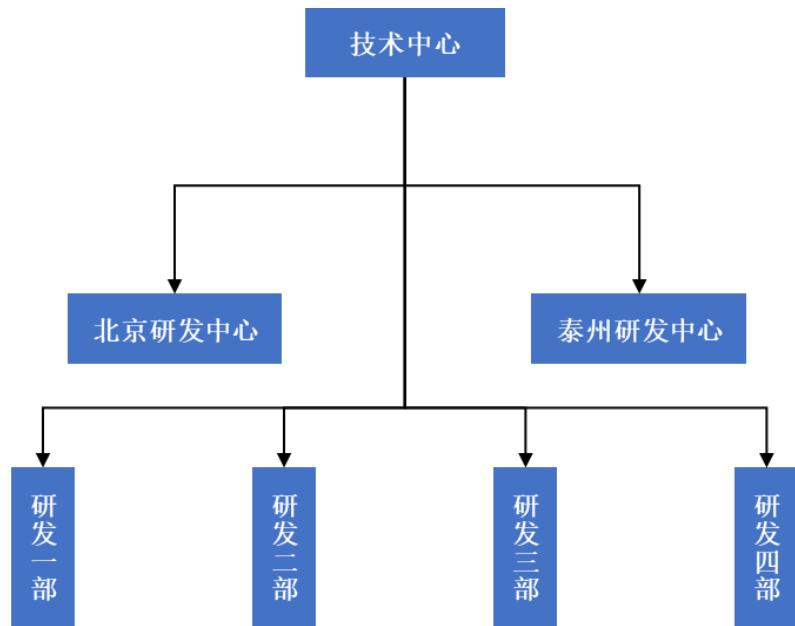
应用研究”项目的负责人，在环氧塑封料行业内具有较强的影响力。具体如下：

序号	姓名	专业背景及行业经验情况、对公司研发活动的贡献
1	王善学	毕业于天津大学材料学专业，硕士学位；现任公司技术中心主任；拥有 20 年以上环氧塑封料相关行业经验；曾作为主要人员参与了“十五”国家 02 科技重大专项项目，现担任国家科技部 2025 年国家重点研发计划重点专项项目的参与单位任务负责人 截至本招股说明书签署日，参与研发已授权发明专利 32 项、正在申请的发明专利 34 项
2	李刚	毕业于中国科技大学高分子物理专业，硕士学位；现任公司首席科学家；拥有 30 年以上环氧塑封料相关行业经验，毕业后即加入中科院化学所牵头的“七五”环氧塑封料攻关项目，是我国最早从事环氧塑封料技术攻关的研发人员之一；曾作为主要人员参与了国家“七五”至“九五”环氧塑封料重大攻关项目、“十五”国家高技术研究发展计划（863 计划）以及“十一五”国家 02 科技重大专项项目 截至本招股说明书签署日，参与研发已授权发明专利 32 项、正在申请的发明专利 30 项
3	梅胡杰	毕业于武汉大学高分子化学与物理专业，博士学位；现任公司研发总监；拥有 15 年以上环氧塑封料相关行业经验，曾任职于国内环氧塑封料领域头部企业之一的衡所华威电子有限公司。在衡所华威电子有限公司任职期间，担任国家重点研发计划“高端芯片封装用塑封料（EMC）应用研究”项目的负责人 截至本招股说明书签署日，参与研发正在申请的发明专利 7 项
4	张之魁	毕业于扬州大学物理化学专业纳米材料方向，硕士学位；现任公司技术总监；拥有 15 年以上环氧塑封料相关行业经验，曾任职于全球环氧塑封料领域领先企业日立化成集团（现更名为力森诺科）及韩国 KCC 集团 截至本招股说明书签署日，参与研发正在申请的发明专利 2 项
5	闵玉勤	毕业于浙江大学高分子化学与物理专业，博士学位；现任公司泰州研发中心资深高级工程师；具有 15 年以上环氧树脂相关领域技术开发与应用经验 截至本招股说明书签署日，参与研发已授权发明专利 2 项、正在申请的发明专利 4 项

## 2、研发组织架构和研发人员情况

### （1）研发组织架构

公司构建了以技术中心为核心的研发体系，技术中心统筹公司研发活动，下设北京、泰州两大研发中心以及四个专业研发部门，负责开展具体的研发工作。截至本招股说明书签署日，公司研发组织架构如下：



## (2) 研发人员情况

### ①研发人员的认定

公司根据员工所属部门及岗位职责界定研发人员，将与公司签订劳动合同、在研发部门主要从事研发活动的人员认定为研发人员，符合《监管规则适用指引——发行类第 9 号：研发人员及研发投入》中研发人员的相关定义。

### ②研发人员数量及学历构成情况

截至报告期末，公司拥有研发人员 46 名，占员工总数的 14.94%，50%以上的研发人员拥有硕士以上学历，具体情况如下：

单位：人、%

学历	2025 年 6 月末		2024 年末		2023 年末		2022 年末	
	人数	占比	人数	占比	人数	占比	人数	占比
博士	2	4.35	2	4.55	2	5.00	2	6.06
硕士	21	45.65	20	45.45	17	42.50	17	51.52
本科及以下	23	50.00	22	50.00	21	52.50	14	42.42
合计	46	100.00	44	100.00	40	100.00	33	100.00

## 3、发行人对核心技术人员实施的约束激励措施

公司已建立有效的约束激励机制，公司与核心技术人员签署了劳动合同和保密协议，对保密内容、核心技术人员的保密职责等事项进行严格规范。此外，公司通过股权激励方式对核心技术人员进行有效激励。

## （七）保持技术不断创新的机制、技术储备及技术创新的安排

### 1、保持技术不断创新的机制及安排

公司将技术创新与积累作为可持续发展的核心基础,建立健全了高效的研发体系。公司研发活动由技术中心具体负责管理,下设北京、泰州两大研发中心以及四个专业研发部门负责具体研发工作,保障了日常研发管理与技术创新的有序进行。同时,公司制定了《研发项目管理制度》等内部制度并有效运行,为研发工作提供制度支撑。

作为技术密集型、研发驱动型的高新技术企业,公司持续加强研发团队建设,通过提供具备竞争力的薪酬和职业发展路径,以及绩效考核、股权激励等多样化激励机制,充分调动研发人员的主观能动性和创新能力。同时,公司鼓励研发人员积极参加展会、论坛和学术会议,持续掌握行业动态,以保证公司的技术创新能够持续符合行业发展趋势。在研发支出方面,公司持续加大研发投入,保证研发经费充足,改善场地、设备等研发条件,以满足公司的持续创新需求。

公司在坚持自主研发、技术创新的基础上,积极与外部科研机构、高校以及半导体产业链企业开展交流与合作,共同攻关环氧塑封料及相关领域的技术难题,不断增强持续创新能力。

## 2、技术储备

公司锚定半导体封装材料高端化发展趋势,持续深化中高端环氧塑封料领域的技术布局。在持续巩固现有产品线的基础上,公司将重点开发先进封装用环氧塑封料,以及用于人工智能、汽车电子、工业控制等高端应用和第三代半导体等特殊应用的产品,持续完善中高端产品线,不断提升公司的技术实力和行业影响力。

## 七、公司的环境保护及安全生产情况

### (一) 公司环境保护情况

公司所处行业不属于重污染行业,生产经营中产生的废物、废水、废气较少。公司高度重视环境保护工作,制定了完备的环境管理制度,并配备了完善的环保处理设施。公司严格遵守国家、地方环保法律法规,努力将生产经营活动对环境的影响最小化。

公司生产经营中涉及的主要污染物及主要防治措施如下:

污染物类型	主要污染物	主要防治措施
废水	生活污水、冷却水	无工业污水,生活污水经化粪池收集处理后,接管至启迪浦华(泰州)水务有限公司;雨水

污染物类型	主要污染物	主要防治措施
废气	粉尘、非甲烷总烃、NO <sub>x</sub> 、SO <sub>2</sub> 、甲醛、苯酚、颗粒物等	配料、粉碎废气经烧结板式除尘器处理后经过15m高排气筒排放；挤出废气经二级活性炭吸附装置处理后经过15m高排气筒排放；混合、成型废气经烧结板式除尘器处理后经过15m高排气筒排放。天然气燃烧废气通过15m高排气筒排放
固体废弃物	废包装材料、含铁杂质、除尘器收尘、废擦拭布、质检废液、清洗废液、废活性炭、含沾染毒害性的废包装物、生活垃圾	废擦拭布、质检废液、清洗废液、废活性炭、含沾染毒害性的废包装物为危险废物，委托有资质单位处置；废包装材料、含铁杂质、除尘器收尘外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门定期清运处置
噪声	噪声	噪声源主要为挤出机、粉碎机、打饼机、风机等设备运行产生的噪声。公司通过加强管理、选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施来降低噪声对周围环境的影响

报告期内，公司严格遵守国家、地方相关环保法律法规，生产过程中排放的废水、废气和噪声均达到国家规定的排放标准，固体废弃物得到有效处置，不存在环保违法违规行为。根据泰州市生态环境局出具的《环境守法情况的复函》和《江苏省企业上市合法合规信息核查报告》，报告期内公司不存在环境保护领域的行政处罚。

报告期内，公司环保支出主要包括环保设备投入、污水及固废处理费用等，具体如下：

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
污水及固废处理费用	27.12	46.22	42.77	36.66
环保设备投入	18.43	46.28	115.42	-
合计	45.55	92.51	158.20	36.66

## （二）公司安全生产情况

公司不属于《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）规定的应当办理安全生产许可证的生产单位。报告期内，公司未发生安全生产事故。根据泰州市应急管理局出具的证明和《江苏省企业上市合法合规信息核查报告》，报告期内公司不存在安全生产、企业应急管理领域的行政处罚。

## 八、发行人境外经营情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在境外生产经营的情况。

## 第六节 财务会计信息与管理层分析

本节披露或引用的财务会计数据，非经特别说明，均引自经致同出具的标准无保留意见的《审计报告》（致同审字[2025]第 110A034818 号）。

本节的财务会计数据及有关的分析说明反映了公司 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日和 2025 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月的经营成果和现金流量以及财务报表附注的主要内容。

本节对财务报表的重要项目进行了说明，公司提醒投资者，如欲更详细地了解公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量情况，请关注本招股说明书备查文件财务报告及审计报告全文，获取更详尽的财务信息。

### 一、财务报表

#### （一）资产负债表

单位：万元

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	3,178.73	1,415.84	1,407.01	1,959.52
交易性金融资产	—	—	—	10,035.84
应收票据	5,581.42	5,599.83	3,954.73	3,371.85
应收账款	12,762.32	12,567.64	11,009.76	7,871.47
应收款项融资	3,650.45	3,625.89	1,541.79	1,110.00
预付款项	313.92	43.02	199.72	72.99
其他应收款	57.57	52.49	36.57	25.77
存货	3,446.99	2,924.02	2,624.36	2,770.61
一年内到期的非流动资产	—	4,365.52	—	—
其他流动资产	—	—	10.34	11.99
<b>流动资产合计</b>	<b>28,991.39</b>	<b>30,594.25</b>	<b>20,784.28</b>	<b>27,230.04</b>
<b>非流动资产：</b>				
固定资产	19,024.20	19,678.69	19,380.09	4,782.21
在建工程	103.02	178.85	44.87	9,341.96
使用权资产	454.65	530.71	299.70	432.80
无形资产	1,939.89	1,984.24	1,780.12	1,793.29
长期待摊费用	434.10	477.91	184.04	196.49
递延所得税资产	497.55	471.46	343.15	291.29
其他非流动资产	7,308.80	6,538.76	10,686.34	11,179.04
<b>非流动资产合计</b>	<b>29,762.20</b>	<b>29,860.63</b>	<b>32,718.32</b>	<b>28,017.08</b>
<b>资产总计</b>	<b>58,753.58</b>	<b>60,454.88</b>	<b>53,502.60</b>	<b>55,247.12</b>

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动负债:</b>				
短期借款	4,193.35	5,508.30	6,065.63	5,505.11
应付票据	—	1,347.26	620.00	600.00
应付账款	4,804.04	5,107.16	4,908.08	9,235.00
合同负债	8.61	2.54	0.64	56.49
应付职工薪酬	675.78	1,021.89	677.33	459.12
应交税费	478.90	893.85	324.73	519.97
其他应付款	70.50	54.56	121.49	98.07
一年内到期的非流动负债	259.54	185.90	138.52	172.67
其他流动负债	3,625.80	3,302.14	3,213.50	2,732.64
<b>流动负债合计</b>	<b>14,116.51</b>	<b>17,423.60</b>	<b>16,069.92</b>	<b>19,379.08</b>
<b>非流动负债:</b>				
长期借款	1,786.55	1,891.71	—	—
租赁负债	324.13	379.04	68.04	206.56
递延收益	1,876.24	1,852.89	1,660.02	1,464.70
递延所得税负债	—	—	—	—
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,986.93</b>	<b>4,123.65</b>	<b>1,728.06</b>	<b>1,671.26</b>
<b>负债合计</b>	<b>18,103.44</b>	<b>21,547.25</b>	<b>17,797.99</b>	<b>21,050.34</b>
<b>所有者权益:</b>				
股本	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00
资本公积	28,495.78	28,306.43	27,833.25	27,335.49
盈余公积	486.70	486.70	147.72	47.44
未分配利润	5,067.66	3,514.50	1,123.64	213.85
<b>所有者权益合计</b>	<b>40,650.14</b>	<b>38,907.63</b>	<b>35,704.61</b>	<b>34,196.77</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>58,753.58</b>	<b>60,454.88</b>	<b>53,502.60</b>	<b>55,247.12</b>

## (二) 利润表

单位: 万元

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
<b>营业收入</b>	<b>15,904.23</b>	<b>33,095.78</b>	<b>25,023.82</b>	<b>20,009.34</b>
减: 营业成本	11,023.74	23,227.19	18,507.84	15,470.35
税金及附加	146.97	230.08	156.05	134.88
销售费用	719.80	1,511.29	1,235.68	1,223.12
管理费用	1,437.55	2,921.93	2,456.06	1,944.67
研发费用	929.83	1,806.33	1,641.83	1,123.94
财务费用	-9.14	-79.64	-44.10	-59.19
加: 其他收益	382.54	1,122.39	195.62	418.26
投资收益	—	-14.71	248.14	180.21
公允价值变动收益	—	—	—	35.84
信用减值损失	-49.45	-608.53	-178.36	-35.42
资产减值损失	-147.21	-283.16	-238.28	-223.57
资产处置收益	—	262.30	-3.36	0.15
<b>营业利润</b>	<b>1,841.37</b>	<b>3,956.90</b>	<b>1,094.22</b>	<b>547.05</b>
加: 营业外收入	12.36	18.33	12.12	19.11
减: 营业外支出	76.04	76.97	5.67	16.47

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
利润总额	1,777.70	3,898.26	1,100.67	549.69
减：所得税费用	224.53	508.42	97.84	75.32
净利润	1,553.16	3,389.85	1,002.83	474.37
综合收益总额	1,553.16	3,389.85	1,002.83	474.37
每股收益	0.24	0.51	0.15	0.08

### (三) 现金流量表

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	8,612.03	14,433.70	8,789.09	9,433.64
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	212.16	1,264.63	423.39	1,498.26
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>8,824.19</b>	<b>15,698.33</b>	<b>9,212.48</b>	<b>10,931.90</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	4,631.11	7,010.08	6,290.64	5,368.74
支付给职工以及为职工支付的现金	2,894.63	4,896.41	4,031.66	3,760.16
支付的各项税费	1,328.01	710.20	452.28	605.62
支付其他与经营活动有关的现金	894.51	1,806.10	1,850.98	1,801.03
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>9,748.26</b>	<b>14,422.78</b>	<b>12,625.57</b>	<b>11,535.55</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-924.07</b>	<b>1,275.55</b>	<b>-3,413.09</b>	<b>-603.65</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	4,000.00	-	27,000.00	20,000.00
取得投资收益收到的现金	402.00	-	469.07	184.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.71	339.16	1.86	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>4,402.71</b>	<b>339.16</b>	<b>27,470.94</b>	<b>20,184.31</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	451.34	1,655.90	8,248.09	4,360.09
投资支付的现金	-	-	17,000.00	40,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>451.34</b>	<b>1,655.90</b>	<b>25,248.09</b>	<b>44,360.09</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,951.37</b>	<b>-1,316.74</b>	<b>2,222.84</b>	<b>-24,175.77</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	-	-	31,000.00
取得借款收到的现金	2,990.00	9,165.00	6,000.00	6,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	909.27	282.96	1,059.70
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,990.00</b>	<b>10,074.27</b>	<b>6,282.96</b>	<b>38,559.70</b>
偿还债务支付的现金	3,855.00	8,165.00	5,500.00	5,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99.17	877.70	180.82	1,646.18
支付其他与筹资活动有关的现金	292.09	148.28	201.78	5,712.11
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>4,246.25</b>	<b>9,190.98</b>	<b>5,882.61</b>	<b>12,758.29</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,256.25</b>	<b>883.29</b>	<b>400.35</b>	<b>25,801.41</b>

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8.16	0.78	0.46	-10.92
五、现金及现金等价物净增加额	1,762.88	842.88	-789.43	1,011.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,415.84	572.96	1,362.39	351.32
六、期末现金及现金等价物余额	3,178.73	1,415.84	572.96	1,362.39

## 二、审计意见

致同审计了公司报告期内的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 6 月 30 日的资产负债表，2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注，出具了标准无保留意见的《审计报告》（致同审字[2025]第 110A034818 号），审计意见如下：

公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

## 三、关键审计事项及重要性水平的判断标准

### （一）重要性水平的判断标准

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项计提金额占应收账款坏账准备总额的 10%以上且金额大于 100 万元
应收账款转回或收回金额重要的坏账准备	单项收回或转回金额大于人民币 100 万元
重要的在建工程	单项在建工程预算金额超过 1000 万元的在建工程认定为重要
重要的投资活动项目	单项投资预算金额超过 1000 万元的投资活动认定为重要

### （二）关键审计事项

关键审计事项是发行人会计师根据职业判断，认为报告期内财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，发行人会计师不对这些事项单独发表意见。发行人会计师确定的需要在审计报告中沟通的关键审计事项如下：

#### 1、主营业务收入的确认

相关会计期间：2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月。

### (1) 事项描述

发行人主要从事半导体封装材料的研发、生产和销售，主要产品为半导体封装用环氧塑封料，2022年度、2023年度、2024年度、2025年1-6月的主营业务收入分别为20,002.88万元、24,953.63万元、33,091.65万元、15,902.38万元。

由于发行人主营业务收入金额重大且为关键业绩指标之一，主营业务收入确认准确性存在潜在错报的固有风险等级较高，因此将主营业务收入的确认识别为关键审计事项。

### (2) 审计应对

2022年度、2023年度、2024年度和2025年1-6月财务报表审计中，针对主营业务收入的确认实施的主要审计程序包括：

①了解及评价与主营业务收入确认有关的内部控制设计的有效性，并测试关键控制运行的有效性。

②通过访谈发行人管理层及选取样本检查销售合同（订单），分析评估与主营业务收入确认有关的会计政策是否符合企业会计准则规定，包括分析履约义务的识别、交易价格的分摊、相关商品的控制权转移时点的确定等是否符合行业惯例等。

③选取样本检查与主营业务收入确认相关的支持性文件，包括销售合同（订单）、销售发票、产品发货运输清单、签收单、对账单、出口报关单、收款记录等，评价主营业务收入的确认是否符合发行人的会计政策。

④对主营业务收入及毛利率实施分析程序，判断其是否存在异常波动，并分析波动原因的合理性。

⑤结合应收账款审计程序，选取样本对各期交易额及应收账款余额进行函证，对未回函的客户执行替代性审计程序，并通过背景调查、实地走访等判断交易的真实性和业务实质。

⑥针对资产负债表日前后确认的主营业务收入，核对至产品发货运输清单、签收单等文件，以评估主营业务收入是否在恰当的期间确认。

## 2、应收账款坏账准备的计提

相关会计期间：2022年度、2023年度、2024年度、2025年1-6月。

### (1) 事项描述

截至 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 6 月 30 日，发行人的应收账款原值分别为 8,354.61 万元、11,674.17 万元、13,823.35 万元、14,078.85 万元，坏账准备分别为 483.13 万元、664.41 万元、1,255.71 万元、1,316.53 万元，应收账款账面价值分别为 7,871.47 万元、11,009.76 万元、12,567.64 万元、12,762.32 万元，各年末应收账款账面价值占资产总额的比例分别为 14.25%、20.58%、20.79%、21.72%。

由于应收账款的账面价值较为重大，且应收账款坏账准备的计提涉及发行人管理层的估计和判断，因此，将应收账款坏账准备的计提识别为关键审计事项。

## （2）审计应对

2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月财务报表审计中，针对应收账款坏账准备的计提实施的主要审计程序包括：

①了解并评价与应收账款坏账准备计提相关的内部控制设计的有效性，并测试关键内部控制运行的有效性。

②了解发行人的信用政策、行业特点及信用风险特征，复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等，判断管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征，并评估管理层对应收账款进行组合划分的合理性。

③对于单项评估的应收账款，复核管理层评估信用风险及预期信用损失金额的依据，评估管理层对预期收取现金流量预测的合理性。

④对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，复核管理层计算预期信用损失率的计算过程，并就信用减值损失计提的金额进行重新计算。

⑤选取样本对应收账款执行函证程序，对未回函的应收账款执行替代性审计程序。

⑥选取样本检查应收账款回款记录、银行回单等支持性文件，结合发行人历史回款、历史坏账、期后回款、客户信用情况、经营情况和还款能力等情况，评估管理层信用减值损失计提的充分性和准确性。

## 四、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况

### （一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及

其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。此外,公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定(2023 年修订)》披露有关财务信息。

公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。

## **(二) 合并财务报表范围及变化情况**

报告期内,公司无合并主体,无需编制合并报表。

## **五、重要会计政策、会计估计**

公司根据重要性原则,结合公司经营活动特点及关键审计事项等,列示对公司财务状况和经营成果有重大影响的会计政策和会计估计,其他一般性会计政策及会计估计请投资者阅读财务报告及审计报告(含附注)。

报告期内,公司采用的主要会计政策和会计估计如下:

### **(一) 收入确认原则和计量方法**

#### **1、一般原则**

公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的,公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时,属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:

- (1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益。
- (2) 客户能够控制公司履约过程中在建的商品。
- (3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,公司在客户取得相关商品或服务控制权时

点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，公司会考虑下列迹象：

①公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2、具体方法

公司收入确认的具体方法如下：

**按签收确认收入：**根据客户需求，当商品运送至客户指定的交付地点，由客户进行核对，客户验收无误后，公司按签收单确认的品种、数量和金额于签收日当期确认收入。

**按对账确认收入：**根据客户需求，将商品存放于客户处仓库但仍保留对商品的控制权，在与客户约定的对账日，双方核对无误后，公司按对账单实际领用确认收入。

**对于出口销售业务确认收入：**采用 DDP 结算方式，公司根据与客户签订的销售合同或订单，在产品运抵客户指定地点后，根据签收单确认产品销售收入。

## （二）金融资产减值

公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

（1）以摊余成本计量的金融资产；  
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债务工具投资；

（3）《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；  
（4）租赁应收款；  
（5）财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

## 1、预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。

### (1) 应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### ①应收票据

- A. 应收票据组合 1：银行承兑汇票
- B. 应收票据组合 2：商业承兑汇票

#### ②应收账款

- A. 应收账款组合 1：关联方组合
- B. 应收账款组合 2：账龄组合

对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算/逾期天数自信用期满之日起计算。

### (2) 其他应收款

公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- A. 其他应收款组合 1：员工借款
- B. 其他应收款组合 2：备用金
- C. 其他应收款组合 3：保证金、押金
- D. 其他应收款组合 4：其他

对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。

## 2、信用风险显著增加的评估

公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。公司考虑的信息包括：

- (1) 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- (2) 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- (3) 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- (4) 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

### 3、已发生信用减值的金融资产

公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

### 4、预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金

融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### 5、核销

如果公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

## （三）存货

### 1、存货的分类

公司存货分为原材料、自制半成品、库存商品、发出商品、合同履约成本、在途物资、委托加工物资等。

### 2、发出存货的计价方法

公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

### 3、存货跌价准备的确定依据和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### 4、存货的盘存制度

公司存货盘存制度采用永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

公司低值易耗品采用一次转销法摊销。

### （四）固定资产

#### 1、固定资产的确认条件

公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

#### 2、固定资产分类及折旧政策

公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10年、20年	5	9.50-4.75
机器设备	5-10年	5	19-9.50
运输工具	5年	5	19.00
电子设备及其他	3-5年	5	31.67-19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

#### 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法参见本节“五、重要会计政策、会计估计（七）资产减值”。

#### 4、每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残

值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

## 5、固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## （五）在建工程

公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法参见本节“五、重要会计政策、会计估计（七）资产减值”。

## （六）无形资产

公司无形资产包括土地使用权、软件、商标权、专利权等。

公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用期间	摊销方法
土地使用权	50年	直线法
软件	5-10年	直线法
专利权	预计使用年限、合同规定的受益年限、法律规定的有效年限三者孰短	直线法
商标权	预计使用年限、合同规定的受益年限、法律规定的有效年限三者孰短	直线法

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法参见本节“五、重要会计政策、会计估计（七）资产减值”。

## （七）资产减值

对固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## （八）股份支付

### 1、股份支付的种类

公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2、权益工具公允价值的确定方法

公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模

型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

### 3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

### 4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩

余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## （九）政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## （十）重要会计政策和会计估计变更说明

### 1、重要会计政策变更

#### （1）企业会计准则解释第15号

财政部于2021年12月发布《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）（以下简称“解释第15号”）。

解释第 15 号规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定分别进行会计处理。

该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售进行追溯调整。

解释第 15 号规定，在判断亏损合同时，企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行。企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

执行上述会计政策未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## （2）企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。

①解释第 16 号规定，对于分类为权益工具的永续债等金融工具，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。上述规定自 2022 年 11 月 30 日起实施。企业应当对发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，涉及所得税影响进行追溯调整。

解释第 16 号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理。上述规定自 2022 年 11 月 30 日起实施。企业应当对于 2022 年 1

月 1 日之前发生的该类交易调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。

执行上述会计政策未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

执行上述会计政策未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### （3）企业会计准则解释第 17 号

财政部于 2023 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称“解释第 17 号”）。

解释第 17 号规定，对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称“契约条件”）。企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估（如有的契约条件规定在资产负债表日之后基于资产负债表日财务状况进行评估），影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，进而影响该负债在资产负债表日的流动性划分。企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件（如有的契约条件规定基于资产负债表日之后 6 个月的财务状况进行评估），不影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。

负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果按照准则规定该选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

执行上述会计政策未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### （4）企业会计准则解释第 18 号

财政部于 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号，解释第 18 号）。

解释第 18 号规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

执行上述会计政策未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 2、重要会计估计变更

报告期内，公司不存在会计估计变更。

## 六、经注册会计师核验的非经常性损益表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》的规定，致同对公司非经常性损益明细表进行了核验，并出具了致同专字（2025）第 110A022321 号《非经常性损益的鉴证报告》。报告期内，公司非经常性损益的具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-26.82	214.86	-7.66	-16.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	116.64	140.75	134.94	375.95
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-	-	257.56	220.15
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-	-94.48	-101.07	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36.86	-11.19	10.76	19.10
<b>非经常性损益总额</b>	<b>52.96</b>	<b>249.95</b>	<b>294.52</b>	<b>598.89</b>
减：非经常性损益所得税影响数	15.33	56.09	59.54	89.83
<b>非经常性损益净额</b>	<b>37.63</b>	<b>193.85</b>	<b>234.98</b>	<b>509.05</b>

公司非经常性损益主要包括政府补助、结构性存款收益、一次性确认的股份支付费用、非流动性资产处置损益等。报告期内，公司的非经常性损益净额分别为 509.05 万元、234.98 万元、193.85 万元和 37.63 万元，占净利润的比例分别为 107.31%、23.43%、5.72% 和 2.42%，公司对非经常性损益不存在重大依赖。

## 七、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策

### （一）公司主要税种及税率

报告期内，公司适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	法定税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	6%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

### （二）公司所享受的税收优惠情况

#### 1、企业所得税

公司于 2021 年 11 月 3 日取得高新技术企业证书，有效期三年。2024 年 12 月 16 日，公司通过复审，重新取得高新技术企业证书，有效期延续至 2027 年 12 月 16 日。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等有关规定，报告期内，公司按 15% 的优惠税率缴纳企业所得税。

#### 2、研发费用加计扣除

2021 年 3 月 31 日，财政部、税务总局联合发布《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财税[2021]13 号）规定，制造业企业开展研发活动中实际发生的研究费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2021 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100% 在税前加计扣除。本条所称制造业企业，是指以制造业业务为主营业务，享受优惠当年主营业务收入占收入总额的比例达到 50% 以上的企业。

2023 年 3 月 26 日，财政部、税务总局联合发布《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 7 号）规定，企

业开展研发活动中实际发生的研究费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除。

报告期内，公司享受上述优惠政策，符合加计扣除范围的研发费用在按规定据实扣除的基础上加计 100%比例在应纳税所得额中扣除。

### 3、增值税

根据《财政部 税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财税[2023]17 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业，按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳增值税税额。公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月，享受上述增值税加计抵减优惠。

### （三）税收政策变化情况及税收优惠政策影响

报告期内，公司享受的主要税收优惠政策及其对财务状况的影响如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
高新技术企业税收优惠	167.08	424.48	99.80	137.57
研发费用加计扣除	117.72	231.56	206.81	136.12
增值税进项税额加计抵减	209.26	916.50	-	-
<b>税收优惠金额</b>	<b>494.05</b>	<b>1,572.55</b>	<b>306.61</b>	<b>273.69</b>
利润总额	1,777.70	3,898.26	1,100.67	549.69
<b>税收优惠占利润总额的比例</b>	<b>27.79%</b>	<b>40.34%</b>	<b>27.86%</b>	<b>49.79%</b>

2022 度，税收优惠占当期利润总额的比例为 49.79%，主要原因为当年度经营规模较小、利润总额较低；2024 度，税收优惠占当期利润总额的比例为 40.34%，主要原因为 2023-2024 年度的增值税加计抵减金额于 2024 年实际申报时抵减。

报告期内，公司税收政策不存在重大变化，公司适用的税收政策整体较为稳定。随着公司经营规模扩大及利润总额的提升，相关税收政策的变化不会对公司经营成果产生重大影响。

## 八、主要财务指标

### （一）财务指标

指标	2025年1-6月/ 2025年6月末	2024年度/ 2024年末	2023年度/ 2023年末	2022年度/ 2022年末
流动比率(倍)	2.05	1.76	1.29	1.41
速动比率(倍)	1.81	1.59	1.13	1.26
资产负债率(%)	30.81	35.64	33.27	38.10
归属于发行人股东的每股净资产(元)	6.16	5.90	5.41	5.18
归属于母公司所有者的净利润(万元)	1,553.16	3,389.85	1,002.83	474.37
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	1,515.53	3,195.99	767.85	-34.68
研发费用占营业收入的比例(%)	5.85	5.46	6.56	5.62
应收账款周转率(次)	1.14	2.60	2.50	2.31
存货周转率(次)	3.36	8.23	6.75	5.21
息税折旧摊销前利润(万元)	3,004.19	6,258.71	2,799.66	1,659.68
利息保障倍数(倍)	28.42	27.33	14.49	7.74
每股经营活动产生的现金流量(元)	-0.14	0.19	-0.52	-0.09
每股净现金流量(元)	0.27	0.13	-0.12	0.15

注：上述财务指标的计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产 / 流动负债
- 2、速动比率=(流动资产-存货) / 流动负债
- 3、资产负债率=负债总额 / 资产总额×100%
- 4、归属于发行人股东的每股净资产=归属于发行人股东的股东权益/期末股本总额
- 5、研发费用占营业收入的比例=研发费用/营业收入×100%
- 6、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- 7、存货周转率=营业成本/存货平均余额
- 8、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产折旧+使用权资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
- 9、利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息支出
- 10、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
- 11、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加/(减少)额/期末股本总额

## (二) 净资产收益率和每股收益

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》有关规定，报告期内公司加权平均净资产收益率和每股收益如下：

单位：%、元/股

项目	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2025年1-6月	3.90	0.24	0.24
	2024年度	9.10	0.51	0.51

项目	报告期间	加权平均净资产收益率	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
	2023 年度	2.87	0.15	0.15
	2022 年度	2.00	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2025 年 1-6 月	3.81	0.23	0.23
	2024 年度	8.58	0.48	0.48
	2023 年度	2.20	0.12	0.12
	2022 年度	-0.15	-0.01	-0.01

注：上述财务指标的计算公式如下：

1、加权平均净资产收益率= $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：  $P_0$  分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；  $NP$  为归属于公司普通股股东的净利润；  $E_0$  为归属于公司普通股股东的期初净资产；  $E_i$  为报告期内发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；  $E_j$  为报告期内回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；  $M_0$  为报告期月份数；  $M_i$  为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；  $M_j$  为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；  $E_k$  为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；  $M_k$  为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2、基本每股收益= $P_0 \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：  $P_0$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；  $S$  为发行在外的普通股加权平均数；  $S_0$  为报告期期初股份总数；  $S_1$  为报告期内因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；  $S_i$  为报告期内因发行新股或债转股等增加股份数；  $S_j$  为报告期内因回购等减少股份数；  $S_k$  为报告期内缩股数；  $M_0$  报告期月份数；  $M_i$  为增加股份数次月起至报告期期末的累计月数；  $M_j$  为减少股份数次月起至报告期期末的累计月数。

3、稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，  $P_1$  为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

报告期内，公司无稀释性潜在普通股。

## 九、分部信息

公司财务报表未包含分部信息。

## 十、经营成果分析

### (一) 经营成果概览

报告期内，公司主要经营成果情况如下：

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
营业收入	15,904.23	33,095.78	25,023.82	20,009.34
营业毛利	4,880.50	9,868.59	6,515.98	4,538.99
营业利润	1,841.37	3,956.90	1,094.22	547.05
利润总额	1,777.70	3,898.26	1,100.67	549.69
净利润	1,553.16	3,389.85	1,002.83	474.37
归属于母公司所有者的净利润	1,553.16	3,389.85	1,002.83	474.37
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	1,515.53	3,195.99	767.85	-34.68

### (二) 营业收入分析

#### 1、营业收入构成情况

报告期内，公司营业收入构成如下：

单位：万元、%

项目	2025年1-6月		2024年度		2023年度		2022年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	15,902.38	99.99	33,091.65	99.99	24,953.63	99.72	20,002.88	99.97
其他业务收入	1.86	0.01	4.12	0.01	70.18	0.28	6.46	0.03
合计	15,904.23	100.00	33,095.78	100.00	25,023.82	100.00	20,009.34	100.00

报告期内，公司营业收入分别为20,009.34万元、25,023.82万元、33,095.78万元和15,904.23万元；2022年至2024年快速增长，复合增长率达28.61%，最近一期保持平稳的增长态势。

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例均在99%以上，主营业务突出，主要为环氧塑封料产品的销售收入。其他业务收入主要为技术服务收入、处置废品或辅材收入等，金额及占比较小。

#### 2、主营业务收入构成分析

##### (1) 按产品类别分析

报告期内，公司主营业务收入来源于环氧塑封料的销售，按产品性能分为基础型、中端和高端三类，各类产品的销售收入如下：

单位：万元、%

产品类别	2025年1-6月		2024年度		2023年度		2022年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
基础型	3,034.74	19.08	7,056.32	21.32	6,740.90	27.01	6,380.14	31.90
中端	11,662.80	73.34	23,923.51	72.29	16,396.11	65.71	12,932.87	64.66
高端	1,204.84	7.58	2,111.82	6.38	1,816.63	7.28	689.86	3.45
合计	15,902.38	100.00	33,091.65	100.00	24,953.63	100.00	20,002.88	100.00

报告期内，公司主营业务收入分别为 20,002.88 万元、24,953.63 万元、33,091.65 万元和 15,902.38 万元，呈逐年增长的趋势，其中：中端环氧塑封料收入占比分别为 64.66%、65.71%、72.29% 和 73.34%，是公司最主要的收入来源且占比逐年提升；基础型环氧塑封料收入占比分别为 31.90%、27.01%、21.32% 和 19.08%，金额基本稳定但占比逐年下降；高端环氧塑封料的收入占比分别为 3.45%、7.28%、6.38% 和 7.58%，金额和占比均稳步提升。报告期内，随着产品结构的优化，公司中高端环氧塑封料的收入金额及占比均呈上升趋势。

报告期各类别产品的销量及单价情况如下：

单位：万元、%、吨、元/千克

期间	产品类别	收入	收入占比	销量	单价
2025年1-6月	基础型	3,034.74	19.08	1,253.00	24.22
	中端	11,662.80	73.34	3,150.51	37.02
	高端	1,204.84	7.58	226.46	53.20
	小计	15,902.38	100.00	4,629.97	34.35
2024年度	基础型	7,056.32	21.32	2,976.23	23.71
	中端	23,923.51	72.29	6,494.90	36.83
	高端	2,111.82	6.38	402.53	52.46
	小计	33,091.65	100.00	9,873.66	33.52
2023年度	基础型	6,740.90	27.01	2,803.89	24.04
	中端	16,396.11	65.71	4,573.72	35.85
	高端	1,816.63	7.28	318.14	57.10
	小计	24,953.63	100.00	7,695.74	32.43
2022年度	基础型	6,380.14	31.90	2,720.46	23.45
	中端	12,932.87	64.66	3,676.59	35.18
	高端	689.86	3.45	104.63	65.93
	小计	20,002.88	100.00	6,501.68	30.77

高端环氧塑封料由于性能优势显著，附加值更高，产品单价通常处于较高水平，中端环氧塑封料相对次之，而基础型环氧塑封料仅满足简单封装需求，单价相对较低。报告期内公司中高端产品销量和收入占比逐年增长，带动环氧塑封料产品的单位价格持续上升。

## （2）按销售区域分析

报告期内，公司主营业务收入按销售区域分类如下：

单位：万元、%

项目	2025年1-6月		2024年度		2023年度		2022年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
境内	15,752.09	99.05	32,907.51	99.44	24,917.82	99.86	20,000.85	99.99
其中：华东	7,943.58	49.95	16,316.49	49.31	12,190.06	48.85	10,553.86	52.76
华南	5,530.79	34.78	11,561.37	34.94	9,189.15	36.82	7,172.56	35.86
西南	1,049.04	6.60	2,135.70	6.45	1,227.17	4.92	798.22	3.99
西北	354.18	2.23	1,297.36	3.92	1,160.60	4.65	1,063.30	5.32
华中	620.39	3.90	1,203.04	3.64	614.78	2.46	164.20	0.82
东北	222.12	1.40	373.48	1.13	513.85	2.06	222.77	1.11
华北	31.98	0.20	20.07	0.06	22.20	0.09	25.94	0.13
境外	150.29	0.95	184.14	0.56	35.82	0.14	2.03	0.01
合计	15,902.38	100.00	33,091.65	100.00	24,953.63	100.00	20,002.88	100.00

报告期内，公司主营业务主要集中在境内市场，其中华东、华南地区的销售收入占比较高，合计分别为 88.62%、85.68%、84.24% 和 84.73%。公司下游客户主要为半导体封测厂商，主要分布在华东、华南等地区，与公司产品的销售区域基本一致。

报告期内，公司境外销售金额相对较低，主要为向保税区内客户的销售收入。

### （3）按季度分析

报告期内，公司主营业务收入按季度划分的情况如下：

单位：万元、%

项目	2025年1-6月		2024年度		2023年度		2022年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
第一季度	6,950.83	43.71	6,630.22	20.04	4,785.97	19.18	5,131.49	25.65
第二季度	8,951.55	56.29	9,324.95	28.18	6,321.52	25.33	5,344.25	26.72
第三季度	—	—	8,845.18	26.73	6,738.54	27.00	4,121.53	20.60
第四季度	—	—	8,291.30	25.06	7,107.60	28.48	5,405.61	27.02
合计	15,902.38	100.00	33,091.65	100.00	24,953.63	100.00	20,002.88	100.00

报告期内，公司各季度销售收入占比基本保持稳定，第一季度略低于其他季度，主要系受元旦、春节等假期的影响，其他季度的收入占比小幅波动，主要系受下游客户需求的影响，无明显的季节性特征。

### （4）按销售模式分析

报告期内，公司主营业务收入按销售模式划分的情况如下：

单位：万元、%

项目	2025年1-6月		2024年度		2023年度		2022年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
直销模式	14,089.36	88.60	29,353.96	88.71	22,887.94	91.72	18,772.47	93.85
其中：非寄售模式	13,800.81	86.78	28,641.55	86.55	22,312.56	89.42	18,130.27	90.64
寄售模式	288.55	1.81	712.41	2.15	575.37	2.31	642.20	3.21
贸易商模式	1,813.02	11.40	3,737.69	11.29	2,065.70	8.28	1,230.41	6.15
合计	15,902.38	100.00	33,091.65	100.00	24,953.63	100.00	20,002.88	100.00

公司采用直销为主、贸易为辅的销售模式，符合行业惯例。报告期内，直销收入占比分别为 93.85%、91.72%、88.71%和 88.60%；公司与个别客户的销售采用寄售模式，报告期内收入占比分别为 3.21%、2.31%、2.15%和 1.81%。此外，因终端客户采购规模持续扩大，公司通过贸易商实现的销售收入占比相应提升。

### （三）营业成本分析

#### 1、营业成本构成及变动分析

报告期内，公司营业成本构成如下：

单位：万元、%

项目	2025年1-6月		2024年度		2023年度		2022年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务成本	11,023.74	100.00	23,226.54	100.00	18,497.09	99.94	15,470.35	100.00
其他业务成本	-	-	0.65	0.00	10.75	0.06	-	-
合计	11,023.74	100.00	23,227.19	100.00	18,507.84	100.00	15,470.35	100.00

报告期内，公司主营业务成本占营业成本的比例均在 99%以上，与营业收入构成相匹配。

#### 2、主营业务成本构成及变动分析

##### （1）主营业务成本分产品类别分析

报告期内，公司主营业务成本按照产品类别分类情况如下：

单位：万元、%

项目	2025年1-6月		2024年度		2023年度		2022年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
基础型	2,362.30	21.43	5,541.16	23.86	5,597.05	30.26	5,728.13	37.03
中端	7,939.81	72.02	16,316.72	70.25	11,715.28	63.34	9,326.86	60.29
高端	721.63	6.55	1,368.66	5.89	1,184.77	6.41	415.37	2.68
合计	11,023.74	100.00	23,226.54	100.00	18,497.09	100.00	15,470.35	100.00

报告期内，公司各类产品的成本结构与主营业务收入构成相匹配。

##### （2）主营业务成本的明细构成分析

公司主营业务成本的明细构成如下：

单位：万元、%

项目	2025年1-6月		2024年度		2023年度		2022年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
直接材料	8,417.42	76.36	17,859.04	76.89	13,924.31	75.28	11,976.01	77.41
直接人工	662.74	6.01	1,221.54	5.26	1,071.44	5.79	954.26	6.17
制造费用	1,600.43	14.52	3,399.74	14.64	2,890.46	15.63	2,051.85	13.26
运输费用	343.15	3.11	746.22	3.21	610.87	3.30	488.23	3.16
合计	11,023.74	100.00	23,226.54	100.00	18,497.09	100.00	15,470.35	100.00

报告期内，公司主营业务成本由直接材料、直接人工、制造费用和运输费用等构成，以直接材料为主，占比分别为 77.41%、75.28%、76.89%和 76.36%。制造费用主要是与生产活动相关的间接人工、折旧摊销、燃气动力费、维修费等。报告期内，公司主营业务成本结构整体上保持稳定。

#### （四）毛利率分析

##### 1、毛利构成分析

###### （1）综合毛利构成情况

报告期内，公司综合毛利构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025年1-6月		2024年度		2023年度		2022年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务毛利	4,878.64	99.96	9,865.11	99.96	6,456.54	99.09	4,532.53	99.86
其他业务毛利	1.86	0.04	3.47	0.04	59.44	0.91	6.46	0.14
合计	4,880.50	100.00	9,868.59	100.00	6,515.98	100.00	4,538.99	100.00

报告期内，公司毛利主要来源于主营业务，主营业务毛利占综合毛利的比例在 99%以上，与营业收入的构成相匹配。

###### （2）主营业务毛利构成情况

报告期内，公司主营业务毛利按照产品类别划分情况如下：

单位：万元、%

项目	2025年1-6月		2024年度		2023年度		2022年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
基础型	672.44	13.78	1,515.16	15.36	1,143.85	17.72	652.02	14.39
中端	3,722.99	76.31	7,606.80	77.11	4,680.84	72.50	3,606.02	79.56
高端	483.21	9.90	743.16	7.53	631.86	9.79	274.50	6.06
合计	4,878.64	100.00	9,865.11	100.00	6,456.54	100.00	4,532.53	100.00

报告期内，公司主营业务毛利分别为 4,532.53 万元、6,456.54 万元、9,865.11 万元和 4,878.64 万元，呈逐年上升趋势，主要原因是收入规模不断增长、产品结构持续优化。公司主营业务毛利以中端环氧塑封料为主，报告期内占比分别为 79.56%、72.50%、77.11% 和 76.31%，与主营业务收入构成相匹配。

## 2、毛利率变动分析

### (1) 综合毛利率变动分析

报告期内，公司综合毛利率情况如下：

单位：%

项目	2025 年 1-6 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度
	毛利率	变动率	毛利率	变动率	毛利率	变动率	毛利率
主营业务毛利率	30.68	2.91	29.81	15.22	25.87	14.19	22.66
综合毛利率	30.69	2.91	29.82	14.51	26.04	14.79	22.68

报告期内，公司综合毛利率分别为 22.68%、26.04%、29.82% 及 30.69%，呈逐年上升趋势；公司主营业务占比较高，综合毛利率主要受主营业务毛利率影响，变动趋势基本一致。

### (2) 主营业务毛利率变动分析

报告期内，公司主营业务毛利率情况如下：

单位：%

项目	2025 年 1-6 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比	毛利率	收入占比
基础型	22.16	19.08	21.47	21.32	16.97	27.01	10.22	31.90
中端	31.92	73.34	31.80	72.29	28.55	65.71	27.88	64.66
高端	40.11	7.58	35.19	6.38	34.78	7.28	39.79	3.45
合计	30.68	100.00	29.81	100.00	25.87	100.00	22.66	100.00

报告期内，公司主营业务毛利率分别为 22.66%、25.87%、29.81% 和 30.68%，呈逐年上升趋势，主要得益于产品结构的优化，毛利率较高的中高端环氧塑封料的销售规模及收入占比持续增长。

#### ①基础型环氧塑封料

报告期内，基础型环氧塑封料的单位售价、单位成本及毛利率情况如下：

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
单位售价（元/千克）	24.22	23.71	24.04	23.45
单位成本（元/千克）	18.85	18.62	19.96	21.06
毛利率	22.16%	21.47%	16.97%	10.22%

报告期内，基础型环氧塑封料毛利率分别为 10.22%、16.97%、21.47%和 22.16%，持续上升，主要原因是产品结构调整和单位成本的下降。

2023 年公司调整产品结构，减少低单价产品的销售，单位售价上升；同时主要原材料价格降低，单位成本下降，综合导致基础型产品毛利率有较大幅度提升。2024 年毛利率持续提升，主要原因是原材料价格继续下降，同时随着产销量的增长，规模效应显现，单位产品分摊的折旧摊销等生产成本减少。2025 年 1-6 月毛利率与上年度基本持平，略有上升。

### ②中端环氧塑封料

报告期内，中端环氧塑封料的单位售价、单位成本及毛利率情况如下：

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
单位售价（元/千克）	37.02	36.83	35.85	35.18
单位成本（元/千克）	25.20	25.12	25.61	25.37
毛利率	31.92%	31.80%	28.55%	27.88%

中端环氧塑封料产品收入占比最高，是决定公司主营业务毛利率水平的主要因素。报告期内，中端环氧塑封料毛利率分别为 27.88%、28.55%、31.80% 和 31.92%，呈稳步上升趋势，主要是由于产品结构的优化，单位售价持续提升，而单位成本整体上保持稳定。

2023 年度，单位售价提升幅度略高于单位成本上升幅度，导致毛利率小幅增长。2024 年度，单位售价继续提升而单位成本下降，导致毛利率继续增长。2025 年 1-6 月毛利率与上年度基本持平，略有上升。

### ③高端环氧塑封料

报告期内，高端环氧塑封料的单位售价、单位成本及毛利率情况如下：

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
单位售价（元/千克）	53.20	52.46	57.10	65.93
单位成本（元/千克）	31.87	34.00	37.24	39.70
毛利率	40.11%	35.19%	34.78%	39.79%

报告期内，高端环氧塑封料毛利率分别为 39.79%、34.78%、35.19% 和 40.11%，整体保持在较高水平。

2023 年公司高端环氧塑封料产品销售收入显著增长，其中：单价相对较低的 KHG700 系列销量及占比大幅上升；此外，为加速渗透高端市场，公司采取适当的降价策略，综合导致单位售价降低。2024 年随着产品产销量的持续增长和

原材料的国产化替代，单位成本有效降低，毛利率有所回升。2025年1-6月毛利率进一步提升，主要原因是主要原材料的价格持续下降。

### 3、同行业可比公司毛利率对比分析

报告期内，公司与同行业可比上市公司的综合毛利率对比情况如下：

单位：%

公司名称	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
华海诚科	26.41	25.63	26.88	27.01
康强电子	14.06	11.98	12.85	15.75
飞凯材料	36.10	35.06	34.46	38.92
德邦科技	27.46	27.55	29.19	30.29
<b>平均值</b>	<b>26.01</b>	<b>25.06</b>	<b>25.84</b>	<b>27.99</b>
<b>发行人</b>	<b>30.69</b>	<b>29.82</b>	<b>26.04</b>	<b>22.68</b>

数据来源：同行业可比上市公司定期报告等公开资料。

公司毛利率处在同行业可比公司区间范围内。除华海诚科外，其余上市公司主营业务与公司存在较大差异。公司的综合毛利率略高于同行业可比公司平均值，主要系在产品种类、结构或应用领域等方面存在差异所致，具备合理性。

### （五）期间费用分析

报告期内，公司期间费用及占营业收入比例情况如下：

单位：万元、%

项目	2025年1-6月		2024年度		2023年度		2022年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
销售费用	719.80	4.53	1,511.29	4.57	1,235.68	4.94	1,223.12	6.11
管理费用	1,437.55	9.04	2,921.93	8.83	2,456.06	9.81	1,944.67	9.72
研发费用	929.83	5.85	1,806.33	5.46	1,641.83	6.56	1,123.94	5.62
财务费用	-9.14	-0.06	-79.64	-0.24	-44.10	-0.18	-59.19	-0.30
<b>合计</b>	<b>3,078.03</b>	<b>19.35</b>	<b>6,159.90</b>	<b>18.61</b>	<b>5,289.48</b>	<b>21.14</b>	<b>4,232.53</b>	<b>21.15</b>

报告期内，公司期间费用金额分别为4,232.53万元、5,289.48万元、6,159.90万元和3,078.03万元，占营业收入的比例分别为21.15%、21.14%、18.61%和19.35%。最近三年，期间费用金额整体呈增长趋势，受规模效应影响，期间费用率呈下降趋势，与公司营业收入的变动基本匹配。

#### 1、销售费用

##### （1）销售费用构成

报告期内，公司销售费用具体构成如下：

单位: 万元、%

项目	2025年1-6月		2024年度		2023年度		2022年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	271.03	37.65	643.90	42.61	509.18	41.21	444.56	36.35
业务招待费	255.31	35.47	395.70	26.18	376.53	30.47	304.24	24.87
差旅费	79.05	10.98	133.59	8.84	128.79	10.42	91.10	7.45
业务推广费	38.47	5.34	78.00	5.16	75.19	6.08	205.42	16.79
折旧及摊销	31.57	4.39	58.49	3.87	35.70	2.89	35.70	2.92
股份支付	31.24	4.34	156.96	10.39	82.12	6.65	67.61	5.53
其他	13.12	1.82	44.64	2.95	28.17	2.28	74.48	6.09
<b>合计</b>	<b>719.80</b>	<b>100.00</b>	<b>1,511.29</b>	<b>100.00</b>	<b>1,235.68</b>	<b>100.00</b>	<b>1,223.12</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司销售费用金额分别为 1,223.12 万元、1,235.68 万元、1,511.29 万元和 719.80 万元，呈逐年上升趋势；占营业收入的比例分别为 6.11%、4.94%、4.57% 和 4.53%。2023 年由于收入规模的增长，销售费用率有所下降；2024 年及 2025 年 1-6 月整体保持稳定。

公司销售费用主要由职工薪酬、业务招待费、差旅费、业务推广费等构成。

#### ①职工薪酬

报告期内，公司销售费用中职工薪酬分别为 444.56 万元、509.18 万元、643.90 万元和 271.03 万元，主要为销售人员的工资、奖金、社保和住房公积金等。报告期内职工薪酬持续增长，一方面是公司因业绩规模提升而增加了销售人员的工资奖金，另一方面是销售人员数量有所增加。

#### ②业务招待费

报告期内，公司销售费用中业务招待费分别为 304.24 万元、376.53 万元、395.70 万元和 255.31 万元，随着客户开拓力度的加大和经营规模的增长，业务招待支出有所增加。

#### ③差旅费

报告期内，公司销售费用中差旅费分别为 91.10 万元、128.79 万元、133.59 万元和 79.05 万元。公司持续加强市场开拓力度，业务范围覆盖全国主要市场，销售人员差旅支出逐年增加。

#### ④业务推广费

报告期内，公司销售费用中业务推广费分别为 205.42 万元、75.19 万元、78.00 万元和 38.47 万元，主要为公司通过第三方推广服务商开拓业务所支付的费用。公司持续加强自身销售渠道建设，提高销售团队的效率，减少与推广服务

商的合作，自 2023 年起相关费用支出明显降低。

### （2）同行业可比公司对比情况

报告期内，公司销售费用率与同行业可比上市公司对比如下：

单位：%

公司名称	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
华海诚科	4.75	5.04	4.76	3.07
康强电子	0.55	0.70	0.72	0.73
飞凯材料	5.31	5.55	4.97	4.57
德邦科技	6.46	6.29	5.66	5.29
<b>平均值</b>	<b>4.27</b>	<b>4.40</b>	<b>4.03</b>	<b>3.42</b>
<b>发行人</b>	<b>4.53</b>	<b>4.57</b>	<b>4.94</b>	<b>6.11</b>

数据来源：同行业可比上市公司定期报告等公开资料。

报告期内，公司销售费用率与同行业可比上市公司基本一致，不存在显著差异。2022 年公司销售费用率高于同行业可比上市公司平均值，主要原因是当期收入规模相对较小，随着营业收入的增长，公司销售费用率整体呈下降趋势。

## 2、管理费用

### （1）管理费用构成

报告期内，公司管理费用具体构成如下：

单位：万元、%

项目	2025 年 1-6 月		2024 年度		2023 年度		2022 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	745.58	51.86	1,461.81	50.03	1,235.36	50.30	1,079.68	55.52
折旧及摊销	347.24	24.16	653.95	22.38	449.23	18.29	120.28	6.19
专业服务费	145.76	10.14	314.52	10.76	264.36	10.76	281.47	14.47
股份支付	91.67	6.38	185.08	6.33	251.37	10.23	206.82	10.64
环境事务费	22.76	1.58	52.22	1.79	42.22	1.72	42.58	2.19
水电费	19.22	1.34	36.88	1.26	29.96	1.22	56.78	2.92
办公费	13.19	0.92	38.70	1.32	39.74	1.62	42.52	2.19
残疾人保障基金	11.42	0.79	22.83	0.78	33.55	1.37	28.72	1.48
差旅费	10.49	0.73	16.32	0.56	9.96	0.41	8.90	0.46
业务招待费	10.24	0.71	65.93	2.26	18.89	0.77	38.59	1.98
其他	19.97	1.39	73.69	2.52	81.42	3.32	38.32	1.97
<b>合计</b>	<b>1,437.55</b>	<b>100.00</b>	<b>2,921.93</b>	<b>100.00</b>	<b>2,456.06</b>	<b>100.00</b>	<b>1,944.67</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司管理费用金额分别为 1,944.67 万元、2,456.06 万元、2,921.93 万元和 1,437.55 万元，呈逐年上升的趋势；占营业收入的比例分别为 9.72%、9.81%、8.83% 和 9.04%，整体保持稳定。

公司管理费用主要由职工薪酬、折旧及摊销、专业服务费用、股份支付费用等构成。

①职工薪酬

报告期内，公司计入管理费用的职工薪酬分别为 1,079.68 万元、1,235.36 万元、1,461.81 万元和 745.58 万元，整体呈增长趋势，主要系公司经营规模持续扩张、管理人员数量增加及薪酬福利上涨所致。

②折旧及摊销

报告期内，公司计入管理费用的折旧及摊销分别为 120.28 万元、449.23 万元、653.95 万元和 347.24 万元，随着公司在建工程转固，计入管理费用的折旧金额有所增加。

③专业服务费

报告期内，公司计入管理费用的专业服务费分别为 281.47 万元、264.36 万元、314.52 万元和 145.76 万元，主要系公司日常经营及上市过程中聘请中介机构发生的审计费、评估费、咨询服务费等。

④股份支付费用

报告期内股份支付情况参见“第四节 发行人基本情况 十三、已经制定或实施的股权激励及相关安排”。

（2）同行业可比公司对比情况

报告期内，公司管理费用率与同行业可比上市公司对比如下：

单位：%

公司名称	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
华海诚科	11.20	7.65	7.40	5.09
康强电子	4.63	3.90	4.20	4.16
飞凯材料	8.90	9.30	11.10	8.51
德邦科技	7.85	8.30	7.66	6.28
平均值	8.15	7.29	7.59	6.01
发行人	9.04	8.83	9.81	9.72

数据来源：同行业可比上市公司定期报告等公开资料。

报告期内，公司管理费用率略高于同行业可比上市公司平均值，主要原因是各公司经营规模、管理模式存在差异，且报告期内公司支付的中介机构专业服务费和股份支付费用相对较高。

3、研发费用

### (1) 研发费用构成

报告期内，公司研发费用具体构成如下：

单位：万元、%

项目	2025年1-6月		2024年度		2023年度		2022年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
职工薪酬	486.52	52.32	942.54	52.18	867.50	52.84	640.41	56.98
材料费	110.74	11.91	252.09	13.96	240.11	14.62	166.25	14.79
折旧及摊销	199.63	21.47	323.14	17.89	232.61	14.17	155.74	13.86
股份支付	39.93	4.29	78.11	4.32	94.60	5.76	76.48	6.80
技术服务费	1.37	0.15	39.71	2.20	54.63	3.33	—	—
差旅费	39.61	4.26	76.10	4.21	63.44	3.86	18.36	1.63
其他	52.03	5.60	94.65	5.24	88.93	5.42	66.69	5.93
合计	929.83	100.00	1,806.33	100.00	1,641.83	100.00	1,123.94	100.00

报告期内，公司研发费用金额分别为 1,123.94 万元、1,641.83 万元、1,806.33 万元和 929.83 万元，呈持续增长趋势；占营业收入的比例分别为 5.62%、6.56%、5.46% 和 5.85%，整体保持稳定。

报告期内，公司不存在研发费用资本化的情形。公司研发费用主要由职工薪酬、材料费、折旧及摊销等构成。

#### ①职工薪酬

报告期内，公司研发费用中的职工薪酬分别为 640.41 万元、867.50 万元、942.54 万元和 486.52 万元。报告期内，公司持续加大研发投入，加强研发队伍建设，研发人员数量增加、薪酬增长。

#### ②材料费

报告期内，公司研发费用中的材料费分别为 166.25 万元、240.11 万元、252.09 万元和 110.74 万元。报告期内，公司持续开展新产品、新技术的开发，研发材料费相应增加。

#### ③折旧及摊销

报告期内，公司研发费用中的折旧及摊销金额分别为 155.74 万元、232.61 万元、323.14 万元和 199.63 万元，呈逐年上升趋势，主要系二期综合楼内研发办公场地、新建研发试验线及新购置的研发设备陆续转固并计提折旧摊销所致。

### (2) 研发项目情况

报告期内，公司主要研发项目研发费用投入情况如下：

单位：万元

序号	项目	报告期内 累计金额	2025年 1-6月	2024年度	2023年度	2022年度	实施进度
1	工艺和设备对环氧塑封料性能影响与研究	715.15	0.31	18.69	581.18	114.97	已结项
2	SOP 封装用环氧塑封料原材料国产化产品开发	472.19	1.98	234.03	236.18	—	已结项
3	SOT 封装用高可靠性环氧塑封料的开发	422.62	115.41	307.21	—	—	进行中
4	高可靠性无硫环氧塑封料产品开发	400.86	—	130.90	269.72	0.24	已结项
5	高粘接低吸湿性环氧塑封料产品开发	323.51	—	7.78	36.36	279.37	已结项
6	高可靠性低应力功率器件用环氧塑封料的开发	289.89	204.15	85.74	—	—	进行中
7	消费级半包封器件用高可靠性环氧塑封料产品开发	238.13	1.47	63.43	143.90	29.33	已结项
8	车规级器件/电路封装用高可靠性环氧塑封料的开发	235.82	54.21	181.61	—	—	进行中
9	大功率器件用高导热低应力环氧塑封料的开发	213.45	93.77	119.68	—	—	进行中
10	SOP/DPAK 封装用高可靠性环氧塑封料产品开发	202.70	0.31	11.82	130.15	60.42	已结项
11	工业级 T0220F 用环氧塑封料的开发	199.21	—	—	—	199.21	已结项
12	倒装芯片封装用 MUF 型环氧塑封料的开发	188.24	0.58	187.66	—	—	已结项
13	工业级 T0220/247 用环氧塑封料的开发	180.17	—	—	—	180.17	已结项
14	晶圆级/面板级压缩封装用颗粒状塑封料 (GMC) 产品开发	154.07	—	35.65	111.20	7.22	已结项
15	消费级 T0-220F 用高可靠性环氧塑封料产品开发	150.56	0.99	103.05	25.53	20.99	已结项
16	高可靠性低应力电路封装用 EMC 的开发	127.25	127.25	—	—	—	进行中
17	BGA 封装用环氧塑封料产品开发	119.95	—	—	—	119.95	已结项
18	高导热型 IPM 封装用环氧模塑料的开发	107.63	35.33	72.30	—	—	进行中
19	晶圆级/面板级封装用液体塑封料 (LMC) 的开发	104.59	46.50	58.09	—	—	进行中
20	第三代半导体器件封装用高端环氧塑封料的开发	103.79	45.86	57.93	—	—	进行中
21	低翘曲型低应力 IPM 封装用环氧模塑料的开发	101.63	32.29	69.34	—	—	进行中

注：所列项目为报告期内合计投入研发金额超过 100.00 万元的研发项目。

### (3) 同行业可比公司对比情况

报告期内，公司研发费用率与同行业可比上市公司对比如下：

单位：%

公司名称	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
华海诚科	9.74	7.96	8.71	6.03
康强电子	4.07	4.07	4.10	4.32
飞凯材料	6.21	6.23	6.94	6.36
德邦科技	5.47	5.73	6.65	5.03
<b>平均值</b>	<b>6.37</b>	<b>6.00</b>	<b>6.60</b>	<b>5.43</b>
<b>发行人</b>	<b>5.85</b>	<b>5.46</b>	<b>6.56</b>	<b>5.62</b>

数据来源：同行业可比上市公司定期报告等公开资料。

报告期内，公司研发费用率与同行业上市公司平均值基本一致，处于中等水平。

#### 4、财务费用

报告期内，公司财务费用具体构成如下：

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
利息支出	105.71	228.97	193.23	214.32
减：利息资本化	-	-	-	31.34
减：利息收入	124.62	314.78	244.33	259.39
汇兑损益	8.16	-0.78	-0.46	10.92
手续费及其他	1.61	6.95	7.46	6.30
<b>合计</b>	<b>-9.14</b>	<b>-79.64</b>	<b>-44.10</b>	<b>-59.19</b>

报告期内，公司财务费用分别为-59.19万元、-44.10万元、-79.64万元和-9.14万元，主要系银行借款产生的利息支出，购买银行理财产品、大额存单产生的利息收入以及汇兑损益等。报告期内，公司利息收入均高于利息支出，财务费用为负。

#### （六）利润表其他项目分析

##### 1、税金及附加

报告期内，公司税金及附加构成情况如下：

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
房产税	66.56	130.09	107.85	47.44
土地使用税	14.00	28.01	28.01	28.01
城市维护建设税	30.33	30.04	-	29.35
教育费附加	13.00	12.87	-	12.58
地方教育费附加	8.67	8.58	-	8.39
印花税	12.26	20.42	20.05	9.02

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
车船使用税	—	0.07	0.14	0.10
资源税	0.40	—	—	—
环境保护税	1.76	—	—	—
合计	146.97	230.08	156.05	134.88

报告期内，公司的税金及附加金额分别为134.88万元、156.05万元、230.08万元和146.97万元，主要包括房产税、城镇土地使用税、附加税和印花税等，随着公司业务规模增长而增加。

## 2、其他收益

报告期内，公司的其他收益情况如下：

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
<b>一、计入其他收益的政府补助</b>				
其中：与递延收益相关的政府补助（资产相关）	56.65	65.13	60.68	42.31
直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）	116.64	140.75	134.94	375.95
<b>二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目</b>				
其中：进项税加计抵减	209.26	916.50	—	—
<b>合计</b>	<b>382.54</b>	<b>1,122.39</b>	<b>195.62</b>	<b>418.26</b>

### （1）与资产相关的政府补助

报告期内，公司与资产相关的政府补助在收到时确认为递延收益，并分期计入其他收益，明细如下：

单位：万元

项目	计入当期损益的金额				备注
	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度	
海陵工业园区工业项目招商	15.80	31.60	31.60	31.60	与资产相关
倒装芯片封装用MUF型环氧塑封料研发及产业化	12.40	1.39	—	—	与资产相关
年产2万吨高端环氧塑封料智能工厂技术改造项目	8.49	1.42	—	—	与资产相关
第三代半导体器件封装用高端环氧塑封料的研发及产业化	9.05	2.74	—	—	与资产相关
新型高功率模块封装用环氧塑封料关键技术的研发	4.66	9.33	8.81	2.41	与资产相关
“环氧塑封料”专精特新培育升级项目	6.25	18.66	20.27	8.30	与资产相关
<b>合计</b>	<b>56.65</b>	<b>65.13</b>	<b>60.68</b>	<b>42.31</b>	<b>—</b>

### （2）与收益相关的政府补助

报告期内，公司取得的与收益相关的且用于补偿公司已发生的相关成本费用

或损失的政府补助明细如下：

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
省工业和信息产业转型升级专项资金	—	—	—	164.23
泰州市企业科技创新积分奖补资金	13.98	29.82	66.10	96.70
专精特新小巨人企业培育专项资金	—	—	—	50.00
高新技术企业认定奖励	—	—	—	20.00
中小企业发展专项资金	—	—	—	20.00
省中小企业服务专项资金运输补助	—	—	—	5.02
省中小企业服务专项设备购置补助	—	—	—	7.50
泰州市双创人才引进专项资助金	67.50	82.50	60.00	—
2024年度积分头部企业研发费用奖励	—	15.01	—	—
2023年市中小企业科技成果转化资金	20.00	—	—	—
科技创新十佳企业研发人员薪酬补贴	15.01			
2023年度海陵区知识产权转化运用奖补	—	4.50	—	—
海陵区工业园区2022年度留泰补贴	—	0.15	—	—
稳岗返还	—	8.68	8.09	8.82
就补资金	—	0.10	—	3.22
扩岗补贴	0.15	—	0.75	0.45
合计	116.64	140.75	134.94	375.95

### 3、投资收益

报告期内，公司投资收益情况如下：

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
应收票据贴现费用	—	-14.71	-9.41	-4.10
结构性存款收益	—	—	257.56	184.31
合计	—	-14.71	248.14	180.21

报告期内，公司投资收益金额分别为180.21万元、248.14万元、-14.71万元和0万元，主要为结构性存款收益及银行承兑汇票贴现利息。

### 4、公允价值变动收益

2022年度，公司公允价值变动收益金额为35.84万元；报告期其他各期均为0，主要系结构性存款的公允价值变动所致。

### 5、信用减值损失

报告期内，公司信用减值损失情况如下：

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
应收账款坏账损失	-60.82	-591.30	-181.27	-40.89
应收票据坏账损失	11.63	-16.38	3.48	3.71
其他应收款坏账损失	-0.27	-0.84	-0.57	1.76
合计	-49.45	-608.53	-178.36	-35.42

报告期内，公司信用减值损失分别为-35.42万元、-178.36万元、-608.53万元和-49.45万元，主要是公司计提的应收账款、应收票据和其他应收款坏账损失。

## 6、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失情况如下：

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
存货跌价损失	-147.21	-283.16	-238.28	-223.57
合计	-147.21	-283.16	-238.28	-223.57

报告期内，公司资产减值损失金额分别为-223.57万元、-238.28万元、-283.16万元和-147.21万元，系公司计提的存货跌价损失。

## 7、资产处置收益

报告期内，公司资产处置收益情况如下：

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
固定资产处置利得	-	-0.02	-3.36	-
专利处置利得	-	250.79	-	-
使用权资产处置利得	-	11.54	-	0.15
合计	-	262.30	-3.36	0.15

报告期内，公司资产处置收益分别为0.15万元、-3.36万元、262.30万元和0万元。2024年资产处置收益主要系公司向北京科化、首科化转让固定资产及无形资产形成。

## 8、营业外收入

报告期内，公司营业外收入情况如下：

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
违约赔偿收入	-	6.62	0.07	0.59
无法支付的应付款项	-	0.01	-	17.30
废品收入	12.36	11.70	12.05	1.22
合计	12.36	18.33	12.12	19.11

报告期内，公司营业外收入分别为 19.11 万元、12.12 万元、18.33 万元和 12.36 万元，主要包括违约赔偿收入、无法支付的应付款项及废品收入等。

## 9、营业外支出

报告期内，公司营业外支出构成如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
非流动资产毁损报废损失	26.82	47.45	4.30	16.46
捐赠支出	3.00	20.00	—	—
滞纳金	46.22	9.52	1.36	—
罚没支出	—	—	—	0.01
合计	76.04	76.97	5.67	16.47

报告期内，公司营业外支出分别为 16.47 万元、5.67 万元、76.97 万元和 76.04 万元，主要由非流动资产毁损报废损失、捐赠支出、滞纳金等构成。2025 年 1-6 月，公司因对 2022、2023、2024 年度的企业所得税进行纳税更正申报，补缴了企业所得税款及相关滞纳金。

## （七）报告期纳税情况

### 1、增值税缴纳情况

单位：万元

期间	期初未交数	本期应交数	本期已交数	期末未交数
2022 年度	365.46	357.57	328.04	395.00
2023 年度	395.00	-55.26	240.99	98.74
2024 年度	98.74	412.34	322.50	188.59
2025 年 1-6 月	188.59	454.49	445.72	197.36

### 2、企业所得税缴纳情况

单位：万元

期间	期初未交数	本期应交数	本期已交数	期末未交数
2022 年度	20.12	206.35	158.40	68.06
2023 年度	68.06	149.70	55.34	162.43
2024 年度	162.43	636.73	179.17	619.98
2025 年 1-6 月	619.98	250.62	722.63	147.97

## 十一、资产质量分析

### （一）资产结构分析

报告期各期末，公司资产构成及变化情况如下表所示：

单位: 万元、%

项目	2025年6月30日		2024年12月31日		2023年12月31日		2022年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	28,991.39	49.34	30,594.25	50.61	20,784.28	38.85	27,230.04	49.29
非流动资产	29,762.20	50.66	29,860.63	49.39	32,718.32	61.15	28,017.08	50.71
合计	58,753.58	100.00	60,454.88	100.00	53,502.60	100.00	55,247.12	100.00

报告期各期末,公司资产总额分别为 55,247.12 万元、53,502.60 万元、60,454.88 万元和 58,753.58 万元,随着业务规模的扩大,资产总额呈上升趋势。

报告期各期末,公司流动资产占总资产的比例分别为 49.29%、38.85%、50.61% 和 49.34%,主要为货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资和存货;公司非流动资产占总资产的比例分别为 50.71%、61.15%、49.39% 和 50.66%,主要为固定资产、在建工程、使用权资产和无形资产。

2023 年末公司流动资产占比下降,主要原因是二期综合楼工程完工建成,购入大量配套机器设备,导致非流动资产占比上升;2024 年末,公司非流动资产占比下降,主要原因是当期收入规模扩大,应收款项相应增长,导致流动资产占比上升。

## (二) 流动资产分析

单位: 万元、%

项目	2025年6月30日		2024年12月31日		2023年12月31日		2022年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	3,178.73	10.96	1,415.84	4.63	1,407.01	6.77	1,959.52	7.20
交易性金融资产	-	-	-	-	-	-	10,035.84	36.86
应收票据	5,581.42	19.25	5,599.83	18.30	3,954.73	19.03	3,371.85	12.38
应收账款	12,762.32	44.02	12,567.64	41.08	11,009.76	52.97	7,871.47	28.91
应收款项融资	3,650.45	12.59	3,625.89	11.85	1,541.79	7.42	1,110.00	4.08
预付款项	313.92	1.08	43.02	0.14	199.72	0.96	72.99	0.27
其他应收款	57.57	0.20	52.49	0.17	36.57	0.18	25.77	0.09
存货	3,446.99	11.89	2,924.02	9.56	2,624.36	12.63	2,770.61	10.17
一年内到期的非流动资产	-	-	4,365.52	14.27	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-	10.34	0.05	11.99	0.04
流动资产合计	28,991.39	100.00	30,594.25	100.00	20,784.28	100.00	27,230.04	100.00

报告期各期末,公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、存货和一年内到期的非流动资产构成,合计占比分别为 99.59%、98.81%、99.69% 和 98.72%。

### 1、货币资金

报告期各期末，公司货币资金情况如下：

单位：万元、%

项目	2025年6月30日		2024年12月31日		2023年12月31日		2022年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
库存现金	2.88	0.09	5.48	0.39	3.27	0.23	0.41	0.02
银行存款	3,175.85	99.91	1,410.36	99.61	569.70	40.49	1,361.98	69.51
其他货币资金	-	-	-	-	831.00	59.06	595.00	30.36
存款应计利息	-	-	-	-	3.04	0.22	2.13	0.11
合计	3,178.73	100.00	1,415.84	100.00	1,407.01	100.00	1,959.52	100.00

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 1,959.52 万元、1,407.01 万元、1,415.84 万元和 3,178.73 万元，主要由银行存款和其他货币资金构成，其他货币资金为公司的银行承兑汇票保证金、信用证保证金等。

## 2、交易性金融资产

2022年末公司交易性金融资产余额 10,035.84 万元，系购买的结构性存款，于 2023 年 2 月到期。报告期其他各期末均不存在交易性金融资产。

## 3、应收票据

单位：万元

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
银行承兑汇票	5,609.46	5,574.86	3,920.21	3,181.12
商业承兑汇票	-	64.66	57.82	217.51
合计	5,609.46	5,639.52	3,978.03	3,398.63
减：坏账准备	28.05	39.68	23.30	26.78
账面价值	5,581.42	5,599.83	3,954.73	3,371.85

报告期各期末，公司应收票据账面价值分别为 3,371.85 万元、3,954.73 万元、5,599.83 万元和 5,581.42 万元，随着营业收入的增长而增加。

报告期各期末，公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据情况如下：

单位：万元

项目	2025年6月30日		2024年12月31日		2023年12月31日		2022年12月31日	
	终止确认金额	未终止确认金额	终止确认金额	未终止确认金额	终止确认金额	未终止确认金额	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑票据	-	3,624.68	-	3,747.05	-	3,215.90	-	2,692.17
商业承兑票据	-	-	-	58.66	-	57.82	-	38.98
合计	-	3,624.68	-	3,805.71	-	3,273.71	-	2,731.15

报告期内，公司对商业承兑汇票和由信用等级一般的银行承兑汇票在背书或贴现时不予终止确认。

#### 4、应收账款

报告期各期末，公司应收账款情况如下：

单位：万元

项目	2025年6月30日 /2025年1-6月	2024年12月31日 /2024年度	2023年12月31日 /2023年度	2022年12月31日 /2022年度
应收账款余额	14,078.85	13,823.35	11,674.17	8,354.61
减：坏账准备	1,316.53	1,255.71	664.41	483.13
应收账款账面价值	12,762.32	12,567.64	11,009.76	7,871.47
营业收入	15,904.23	33,095.78	25,023.82	20,009.34
应收账款账面价值 占营业收入的比例	40.12%	37.97%	44.00%	39.34%

注：最近一期末数据已作简单年化处理。

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 7,871.47 万元、11,009.76 万元、12,567.64 万元和 12,762.32 万元，占营业收入的比例分别为 39.34%、44.00%、37.97% 和 40.12%。整体而言，公司应收账款余额与营业收入规模的增长趋势保持一致。

##### (1) 应收账款账龄情况

报告期各期末，公司应收账款账龄情况如下：

单位：万元、%

账龄	2025年6月30日		2024年12月31日		2023年12月31日		2022年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1年以内	13,155.77	93.44	13,317.12	96.34	11,439.20	97.99	8,206.94	98.23
1至2年	834.06	5.92	406.61	2.94	169.92	1.46	147.66	1.77
2至3年	33.46	0.24	45.52	0.33	65.06	0.56	—	—
3年以上	55.56	0.39	54.10	0.39	—	—	—	—
合计	14,078.85	100.00	13,823.35	100.00	11,674.17	100.00	8,354.61	100.00

报告期各期末，公司应收账款账龄主要集中在一年以内，占比分别为 98.23%、97.99%、96.34% 和 93.44%，应收账款账龄结构稳定、安全性较高、质量较好。

##### (2) 应收账款坏账准备计提情况

报告期各期末，公司应收账款按类别计提坏账准备的情况如下：

单位：万元、%

项目	2025年6月30日				账面价值	
	账面余额		坏账准备			
	金额	占比	金额	计提比例		
按单项计提坏账准备	687.48	4.88	583.29	84.84	104.19	
按组合计提坏账准备	13,391.37	95.12	733.24	5.48	12,658.13	
其中：账龄组合	13,391.37	95.12	733.24	5.48	12,658.13	
合计	14,078.85	100.00	1,316.53	9.35	12,762.32	

2024 年 12 月 31 日					
项目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	占比	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	757.11	5.48	546.55	72.19	210.55
按组合计提坏账准备	13,066.25	94.52	709.16	5.43	12,357.09
其中：账龄组合	13,066.25	94.52	709.16	5.43	12,357.09
合计	13,823.35	100.00	1,255.71	9.08	12,567.64
2023 年 12 月 31 日					
项目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	占比	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	54.07	0.46	54.07	100.00	-
按组合计提坏账准备	11,620.10	99.54	610.34	5.25	11,009.76
其中：账龄组合	11,620.10	99.54	610.34	5.25	11,009.76
合计	11,674.17	100.00	664.41	5.69	11,009.76
2022 年 12 月 31 日					
项目	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	占比	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	54.07	0.65	54.07	100.00	-
按组合计提坏账准备	8,300.54	99.35	429.07	5.17	7,871.47
其中：账龄组合	8,300.54	99.35	429.07	5.17	7,871.47
合计	8,354.61	100.00	483.13	5.78	7,871.47

报告期各期末，公司应收账款坏账准备分别为 483.13 万元、664.41 万元、1,255.71 万元和 1,316.53 万元，其中，2024 年末和 2025 年 6 月末，公司应收账款坏账准备有所增加，主要系公司结合个别客户经营情况对其应收账款单项计提坏账准备。

### ①按单项计提的应收账款情况

单位：万元、%

2025 年 6 月 30 日				
客户名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提依据
深圳市锐骏半导体股份有限公司	288.34	199.17	69.07	款项回收困难
四川蓝彩电子科技有限公司	281.93	281.93	100.00	预计无法收回
江西省吉晶微电子有限公司	54.07	54.07	100.00	预计无法收回
上海翔芯集成电路有限公司	33.09	33.09	100.00	预计无法收回
海口市锐骏微电子有限公司	30.05	15.02	50.00	款项回收困难
合计	687.48	583.29	84.84	-
2024 年 12 月 31 日				
客户名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提依据
深圳市锐骏半导体股份有限公司	398.34	199.17	50.00	款项回收困难
四川蓝彩电子科技有限公司	281.93	281.93	100.00	预计无法收回
江西省吉晶微电子有限公司	54.07	54.07	100.00	预计无法收回
海口市锐骏微电子有限公司	22.76	11.38	50.00	款项回收困难
合计	757.11	546.55	72.19	-

2023 年 12 月 31 日				
客户名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提依据
江西省吉晶微电子有限公司	54.07	54.07	100.00	预计无法收回
合计	54.07	54.07	100.00	-
2022 年 12 月 31 日				
客户名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提依据
江西省吉晶微电子有限公司	54.07	54.07	100.00	预计无法收回
合计	54.07	54.07	100.00	-

注: A. 江西省吉晶微电子有限公司与公司业务往来发生在报告期前, 双方已长期停止合作关系, 公司预计款项无法收回, 报告期各期末按照 100%的比例单项计提坏账准备。

B. 四川蓝彩电子科技有限公司因自身经营不善, 于 2024 年逐步停止经营; 上海翔芯集成电路有限公司 2025 年进入破产程序。公司预计上述款项无法收回, 分别于 2024 年末及 2025 年 6 月末, 按照 100%的比例单项计提坏账准备。

C. 深圳市锐骏半导体股份有限公司(以下简称“深圳锐骏”)因存在诉讼案件、实际控制人被限制高消费等因素, 信用风险发生明显变化, 公司于 2024 年末按照 50%的比例单项计提坏账准备; 2025 年 1-6 月, 深圳锐骏回款 110 万元, 应收账款余额减少, 公司按照原金额计提坏账准备, 导致计提比例有所提升。海口市锐骏微电子有限公司与深圳锐骏受同一实际控制人控制, 公司于 2024 年末、2025 年 6 月末按照 50%的比例单项计提坏账准备。

## ②按组合计提的应收账款情况

单位: 万元、%

账龄	2025 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	13,019.47	650.97	5.00
1 至 2 年	336.95	67.39	20.00
2 至 3 年	33.46	13.38	40.00
3 年以上	1.49	1.49	100.00
合计	13,391.37	733.24	5.48
账龄	2024 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	12,754.83	637.74	5.00
1 至 2 年	265.86	53.17	20.00
2 至 3 年	45.52	18.21	40.00
3 年以上	0.03	0.03	100.00
合计	13,066.25	709.16	5.43
账龄	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	11,439.20	571.96	5.00
1 至 2 年	169.92	33.98	20.00
2 至 3 年	10.99	4.40	40.00

3 年以上	-	-	100.00
合计	11,620.10	610.34	5.25
账龄	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	8,206.94	410.35	5
1 至 2 年	93.60	18.72	20
2 至 3 年	-	-	40
3 年以上	-	-	100
合计	8,300.54	429.07	5.17

公司主要客户资信情况良好，报告期内应收账款账龄主要集中在一年以内，应收账款质量较高。公司综合考虑客户业务规模、历史回款情况等因素，按账龄组合计提坏账。

### ③同行业可比公司坏账计提比例

截至 2025 年 6 月 30 日，公司应收账款坏账准备计提比例与同行业可比上市公司比较如下：

单位： %

公司名称	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
华海诚科	5.00	25.70	60.93	100.00	100.00	100.00
康强电子	5.00	10.00	20.00	50.00	50.00	100.00
飞凯材料	5.00	25.00	50.00	100.00	100.00	100.00
德邦科技	5.00	10.00	20.00	30.00	50.00	100.00
平均值	5.00	17.68	37.73	70.00	75.00	100.00
发行人	5.00	20.00	40.00	100.00	100.00	100.00

注：数据来源于同行业可比上市公司定期报告等公开资料。

公司应收账款坏账计提比例与同行业可比上市公司平均值不存在重大差异，公司应收账款坏账准备计提政策合理、谨慎，坏账准备计提充分。

### （3）应收账款余额前五名情况

报告期各期末，应收账款余额前五名情况如下：

单位： 万元、 %

2025 年 6 月 30 日				
序号	客户名称	应收账款余额	占比	坏账准备金额
1	研导电子	791.61	5.62	39.58
2	亚芯微电	622.57	4.42	31.13
3	金誉半导体	576.38	4.09	28.82
4	捷捷微电	535.94	3.81	26.80
5	兴航科技	448.10	3.18	22.41

<b>合计</b>	2,974.59	21.12	148.73
<b>2024 年 12 月 31 日</b>			
<b>序号</b>	<b>客户名称</b>	<b>应收账款余额</b>	<b>占比</b>
1	研导电子	863.98	6.25
2	金誉半导体	589.88	4.27
3	亚芯微电	559.07	4.04
4	捷捷微电	519.11	3.76
5	浙江锋华创芯微电子有限公司	461.28	3.34
<b>合计</b>		<b>2,993.33</b>	<b>21.65</b>
<b>2023 年 12 月 31 日</b>			
<b>序号</b>	<b>客户名称</b>	<b>应收账款余额</b>	<b>占比</b>
1	华天集团	746.78	6.40
2	研导电子	730.14	6.25
3	深圳锐骏	603.86	5.17
4	亚芯微电	468.19	4.01
5	金誉半导体	453.94	3.89
<b>合计</b>		<b>3,002.91</b>	<b>25.72</b>
<b>2022 年 12 月 31 日</b>			
<b>序号</b>	<b>客户名称</b>	<b>应收账款余额</b>	<b>占比</b>
1	华达微	445.89	5.34
2	蓝箭电子	408.84	4.89
3	华天集团	398.51	4.77
4	捷捷微电	397.56	4.76
5	金誉半导体	321.98	3.85
<b>合计</b>		<b>1,972.78</b>	<b>23.61</b>
<b>98.64</b>			

注：上表中客户名称均系包含受同一实际控制人控制企业的合并计算口径数据。

报告期各期末，公司应收账款五名客户账面余额合计占应收账款账面余额的比例分别为 23.61%、25.72%、21.65% 和 21.12%。

#### （4）期后回款情况

报告期各期末，公司应收账款期后回款情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
应收账款余额	14,078.85	13,823.35	11,674.17	8,354.61
期后回款金额	11,065.10	12,636.46	11,572.69	8,297.83
回款比例	78.59%	91.41%	99.13%	99.32%

截至 2025 年 10 月 31 日，报告期各期末应收账款期后回款率分别为 99.32%、99.13%、91.41% 和 78.59%，2025 年 6 月 30 日应收账款期后回款比例较低，主要系回款统计截至日距期末时间较短，公司应收账款期后回款整体情况良好。

## 5、应收款项融资

报告期各期末，公司应收款项融资情况如下：

单位：万元、%

项目	2025年6月30日		2024年12月31日		2023年12月31日		2022年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
银行承兑汇票	3,650.45	100.00	3,625.89	100.00	1,541.79	100.00	1,110.00	100.00
合计	3,650.45	100.00	3,625.89	100.00	1,541.79	100.00	1,110.00	100.00

公司将信用等级较高的银行承兑汇票计入应收款项融资科目，报告期各期末，应收款项融资金额分别为 1,110.00 万元、1,541.79 万元、3,625.89 万元和 3,650.45 万元，占流动资产的比例分别为 4.08%、7.42%、11.85% 和 12.59%。

## 6、预付款项

### (1) 预付账款账龄情况

单位：万元、%

账龄	2025年6月30日		2024年12月31日		2023年12月31日		2022年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内	313.92	100.00	35.38	82.25	199.29	99.79	72.99	100.00
1 至 2 年	-	-	7.64	17.75	0.43	0.21	-	-
合计	313.92	100.00	43.02	100.00	199.72	100.00	72.99	100.00

报告期各期末，公司预付账款余额分别为 72.99 万元、199.72 万元、43.02 万元和 313.92 万元，占公司流动资产的比例分别为 0.27%、0.96%、0.14% 和 1.08%，主要为预付原材料采购款，账龄主要在 1 年以内。

### (2) 预付账款前五名情况

报告期各期末，公司预付账款前五名情况如下：

单位：万元、%

2025年6月30日			
序号	公司名称	预付账款余额	占比
1	邦陆通商	198.36	63.19
2	山东森诺化学有限公司	37.80	12.04
3	上海博怀化工有限公司	21.93	6.99
4	北京荣大科技股份有限公司	11.50	3.66
5	上海矽艾迪会展科技有限公司	8.26	2.63
合计		277.85	88.51
2024年12月31日			
序号	公司名称	预付账款余额	占比
1	长春人造树脂厂股份有限公司	17.22	40.04

2	上海博怀化工有限公司	7.35	17.08
3	山东莱芜润达新材料有限公司	5.48	12.73
4	交洋翔贸易(上海)有限公司	4.40	10.23
5	石家庄金迈达机械有限公司	3.20	7.44
合计		37.64	87.51
2023 年 12 月 31 日			
序号	公司名称	预付账款余额	占比
1	宇部兴产	127.57	63.88
2	上海博怀化工有限公司	19.78	9.90
3	长春人造树脂厂股份有限公司	18.26	9.14
4	常州市中凯化工有限公司	8.50	4.26
5	上海睿哲化工有限公司	5.54	2.77
合计		179.65	89.95
2022 年 12 月 31 日			
序号	公司名称	预付账款余额	占比
1	上海博怀化工有限公司	31.73	43.48
2	KMC, KOREA	21.89	29.99
3	盐城华弘化工有限公司	8.50	11.65
4	山东新华万博化工有限公司	2.92	4.00
5	苏州益耐特电子工业有限公司	2.00	2.74
合计		67.05	91.86

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款构成情况

报告期各期末，公司其他应收款具体情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
员工借款	30.60	25.00	25.00	21.40
备用金	-	0.25	1.47	5.72
保证金、押金	30.00	30.00	5.25	-
其他	-	-	6.78	-
其他应收款余额	60.60	55.25	38.50	27.12
减：坏账准备	3.03	2.76	1.92	1.36
其他应收款账面价值	57.57	52.49	36.57	25.77

报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 25.77 万元、36.57 万元、52.49 万元和 57.57 万元，占流动资产的比例分别为 0.09%、0.18%、0.17% 和 0.20%，金额和占比较小，主要为员工借款、保证金、押金等，其中：员工借款主要为公司向部分员工提供的购车借款；保证金为公司与客户开展合作而支付的保证金；押金主要为公司租赁仓库所支付的押金。

## (2) 其他应收款账龄情况

报告期各期末，公司其他应收款账龄分布情况如下：

单位：万元

账龄	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
1年以内	10.00	44.50	23.95	14.62
1至2年	42.70	8.50	9.30	1.00
2至3年	7.15	-	-	11.50
3至4年	-	-	5.25	-
4至5年	-	2.25	-	-
5年以上	0.75	-	-	-
<b>小计</b>	<b>60.60</b>	<b>55.25</b>	<b>38.50</b>	<b>27.12</b>
<b>减：坏账准备</b>	<b>3.03</b>	<b>2.76</b>	<b>1.92</b>	<b>1.36</b>
<b>合计</b>	<b>57.57</b>	<b>52.49</b>	<b>36.57</b>	<b>25.77</b>

报告期各期末，公司根据其他应收款的风险特征，按照既定的会计政策对其他应收款计提了充足的坏账准备。

## 8、存货

### (1) 存货余额变动情况

报告期各期末，公司存货余额及变动情况如下：

单位：万元、%

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
存货余额	3,571.10	2,991.80	2,655.51	2,825.99
减：跌价准备	124.11	67.78	31.16	55.38
存货账面价值	3,446.99	2,924.02	2,624.36	2,770.61
营业成本	11,023.74	23,227.19	18,507.84	15,470.35
存货账面价值占营业成本的比例	15.63	12.59	14.18	17.91

注：最近一期末数据已作简单年化处理。

报告期各期末，公司存货余额整体呈上升趋势，存货账面价值分别为2,770.61万元、2,624.36万元、2,924.02万元和3,446.99万元，占流动资产的比例为10.17%、12.63%、9.56%和11.89%，占营业成本的比例分别为17.91%、14.18%、12.59%和15.63%。

报告期各期末，公司存货规模与生产经营规模相匹配，主要系公司采用“以销定产、合理库存”的销售模式，保证了采购、生产与市场需求的紧密对接。

### (2) 存货构成情况

报告期各期末，公司存货构成情况如下：

单位：万元

项目	2025年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,056.66	1.15	2,055.51
自制半成品	219.13	—	219.13
库存商品	1,234.91	122.96	1,111.95
委托加工物资	—	—	—
发出商品	20.32	—	20.32
合同履约成本	1.39	—	1.39
在途物资	38.67	—	38.67
合计	3,571.10	124.11	3,446.99
项目	2024年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,407.34	1.15	1,406.19
自制半成品	277.15	—	277.15
库存商品	1,121.03	66.63	1,054.40
委托加工物资	—	—	—
发出商品	12.67	—	12.67
合同履约成本	7.19	—	7.19
在途物资	166.40	—	166.40
合计	2,991.80	67.78	2,924.02
项目	2023年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,213.97	1.15	1,212.82
自制半成品	334.18	—	334.18
库存商品	971.01	30.01	941.00
委托加工物资	2.30	—	2.30
发出商品	24.04	—	24.04
合同履约成本	9.77	—	9.77
在途物资	100.25	—	100.25
合计	2,655.51	31.16	2,624.36
项目	2022年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,601.04	1.15	1,599.89
自制半成品	270.47	—	270.47
库存商品	746.35	54.23	692.12
委托加工物资	—	—	—
发出商品	25.87	—	25.87
合同履约成本	18.74	—	18.74
在途物资	163.52	—	163.52
合计	2,825.99	55.38	2,770.61

公司存货主要为原材料、自制半产品和库存商品。随着业务规模持续扩大，产能和产量不断提升，公司增加了对部分原材料及库存商品的备货，期末原材料及库存商品的账面余额有所增加。

### （3）存货跌价准备计提情况

报告期内，公司存货跌价准备的金额分别为 55.38 万元、31.16 万元、67.78 万元和 124.11 万元，占当期存货余额的比例分别为 1.96%、1.17%、2.27% 和 3.48%，公司存货质量状况良好。公司存货按照成本与可变现净值孰低原则计量，对成本大于可变现净值的存货计提跌价准备。

## 9、一年内到期的非流动资产

2024 年末，公司一年内到期的非流动资产 4,365.52 万元，为一年内到期的大额存单。

## 10、其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
待认证进项税额	-	-	10.34	11.99

## （三）非流动资产分析

报告期各期末，公司非流动资产构成情况如下：

单位：万元、%

项目	2025 年 6 月 30 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
固定资产	19,024.20	63.92	19,678.69	65.90	19,380.09	59.23	4,782.21	17.07
在建工程	103.02	0.35	178.85	0.60	44.87	0.14	9,341.96	33.34
使用权资产	454.65	1.53	530.71	1.78	299.70	0.92	432.80	1.54
无形资产	1,939.89	6.52	1,984.24	6.64	1,780.12	5.44	1,793.29	6.40
长期待摊费用	434.10	1.46	477.91	1.60	184.04	0.56	196.49	0.70
递延所得税资产	497.55	1.67	471.46	1.58	343.15	1.05	291.29	1.04
其他非流动资产	7,308.80	24.56	6,538.76	21.90	10,686.34	32.66	11,179.04	39.90
合计	29,762.20	100.00	29,860.63	100.00	32,718.32	100.00	28,017.08	100.00

报告期各期末，公司非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产和其他非流动资产构成，上述四项合计占公司非流动资产的比例分别为 96.71%、97.47%、95.04% 和 95.34%。

### 1、固定资产

### (1) 固定资产构成情况

报告期各期末，公司固定资产具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>固定资产原值</b>	<b>26,186.15</b>	<b>25,995.74</b>	<b>24,351.43</b>	<b>8,729.30</b>
房屋及建筑物	15,411.64	15,420.24	15,254.24	4,211.18
机器设备	9,212.43	9,045.73	7,628.23	3,383.81
运输工具	126.55	88.04	101.39	101.39
电子设备及其他	1,435.53	1,441.73	1,367.56	1,032.91
<b>累计折旧</b>	<b>7,161.95</b>	<b>6,317.05</b>	<b>4,971.34</b>	<b>3,947.09</b>
房屋及建筑物	3,493.04	3,091.38	2,304.65	1,835.20
机器设备	2,670.40	2,334.92	1,991.17	1,636.25
运输工具	59.71	51.19	63.41	53.10
电子设备及其他	938.80	839.56	612.10	422.54
<b>减值准备</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>账面价值</b>	<b>19,024.20</b>	<b>19,678.69</b>	<b>19,380.09</b>	<b>4,782.21</b>
房屋及建筑物	11,918.60	12,328.86	12,949.59	2,375.98
机器设备	6,542.04	6,710.81	5,637.07	1,747.56
运输工具	66.84	36.85	37.98	48.29
电子设备及其他	496.73	602.18	755.46	610.38

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 4,782.21 万元、19,380.09 万元、19,678.69 万元和 19,024.20 万元，占期末非流动资产的比例分别为 17.07%、59.23%、65.90% 和 63.92%。

2023 年末，公司固定资产账面价值较 2022 年末增长 14,597.89 万元，主要系二期综合楼工程由在建工程转入固定资产，并新增了一批配套机器设备。

报告期各期末，公司各项固定资产使用状况良好，不存在减值情况。

### (2) 固定资产折旧年限与同行业可比公司比较情况

报告期内，公司固定资产折旧年限与同行业可比上市公司对比情况如下：

单位：年

公司名称	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他
华海诚科	20-30	10	4	3-5
康强电子	10-30	5-10	5	5-10
飞凯材料	20	5-10	5-10	3-5
德邦科技	10-30	5-10	5	5-10
发行人	10、20	5-10	5	3-5

由上表可见，公司固定资产折旧年限与同行业可比上市公司相比不存在重大

差异。

## 2、在建工程

报告期各期末，公司在建工程情况如下：

单位：万元

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
二期综合楼工程	—	—	—	9,053.16
机器设备安装	77.97	178.85	21.84	288.80
装修工程	25.05	—	23.04	—
合计	103.02	178.85	44.87	9,341.96

报告期各期末，公司在建工程余额分别为 9,341.96 万元、44.87 万元、178.85 万元和 103.02 万元，占各期非流动资产的比例分别为 33.34%、0.14%、0.60% 和 0.35%。公司二期综合楼工程于 2023 年竣工转入固定资产，相关配套机器设备安装验收完毕，导致 2023 年末在建工程余额较 2022 年末大幅下降。

报告期内，公司在建工程均处于正常建设周期，未发生减值迹象，未计提减值准备。

2022 年度，公司在建工程借款费用资本化金额 31.34 万元，系公司二期综合楼工程占用一般借款资金的借款利息费用，资本化期间为 2022 年 1 月至 2022 年 12 月，该项目竣工转固后停止资本化。除上述情形外，公司不存在其他借款费用资本化情形。

## 3、使用权资产

报告期各期末，公司使用权资产情况如下：

单位：万元

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
账面原值	598.65	598.65	665.50	665.50
房屋及建筑物	552.90	552.90	619.75	619.75
运输设备	45.75	45.75	45.75	45.75
累计折旧	144.01	67.94	365.80	232.70
房屋及建筑物	111.98	40.49	347.50	223.55
运输设备	32.03	27.45	18.30	9.15
减值准备	—	—	—	—
账面价值	454.65	530.71	299.70	432.80
房屋及建筑物	440.92	512.41	272.25	396.20
运输设备	13.73	18.30	27.45	36.60

报告期各期末，公司使用权资产账面价值分别为 432.80 万元、299.70 万元、530.71 万元和 454.65 万元，主要系公司租赁的研发场地、仓库等。

#### 4、无形资产

报告期各期末，公司无形资产情况如下：

单位：万元

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
账面原值	2,489.17	2,481.21	2,212.97	2,169.15
土地使用权	2,064.96	2,064.96	2,064.96	2,064.96
软件	177.73	169.77	148.01	104.19
专利权	72.63	72.63	—	—
商标权	173.85	173.85	—	—
累计折旧	549.29	496.97	432.85	375.86
土地使用权	464.59	443.84	402.35	360.85
软件	61.20	49.77	30.50	15.01
专利权	2.52	0.36	—	—
商标权	20.98	3.00	—	—
减值准备	—	—	—	—
账面价值	1,939.89	1,984.24	1,780.12	1,793.29
土地使用权	1,600.37	1,621.12	1,662.62	1,704.11
软件	116.53	120.00	117.50	89.18
专利权	70.11	72.27	—	—
商标权	152.86	170.85	—	—

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为1,793.29万元、1,780.12万元、1,984.24万元和1,939.89万元，占非流动资产的比例分别为6.40%、5.44%、6.64%和6.52%，主要为土地使用权。

#### 5、长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用情况如下：

单位：万元

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
固定资产改良支出	61.06	74.89	45.50	56.42
装修费	373.04	403.03	138.54	140.06
合计	434.10	477.91	184.04	196.49

报告期各期末，公司长期待摊费用账面价值分别为196.49万元、184.04万元、477.91万元和434.10万元，主要为厂房及相关办公场所的装修费。

#### 6、递延所得税资产

报告期各期末，公司经抵消后的递延所得税资产金额分别为291.29万元、343.15万元、471.46万元和497.55万元，占非流动资产的比例分别为1.04%、1.05%、1.58%和1.67%，公司未经抵消的递延所得税资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2025年6月30日		2024年12月31日		2023年12月31日		2022年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,471.71	220.76	1,365.94	204.89	720.79	108.12	566.65	85.00
递延收益	1,876.24	281.44	1,852.89	277.93	1,660.02	249.00	1,464.70	219.71
租赁负债	423.67	63.55	454.95	68.24	206.56	30.98	379.23	56.88
合计	3,771.63	565.74	3,673.77	551.07	2,587.37	388.11	2,410.59	361.59

报告期各期末，公司未经抵消的递延所得税资产主要由资产减值准备、递延收益和租赁负债等产生的可抵扣暂时性差异构成。

公司未经抵消的递延所得税负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2025年6月30日		2024年12月31日		2023年12月31日		2022年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
使用权资产	454.65	68.20	530.71	79.61	299.70	44.96	432.80	64.92
交易性金融资产公允价值变动值	-	-	-	-	-	-	35.84	5.38
合计	454.65	68.20	530.71	79.61	299.70	44.96	468.64	70.30

报告期各期末，公司未经抵消的所得税负债主要由使用权资产的税会差异构成。

公司以抵消后净额列示的递延所得税资产或负债情况如下：

单位：万元

项目	2025年6月30日		2024年12月31日		2023年12月31日		2022年12月31日	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	68.20	497.55	79.61	471.46	44.96	343.15	70.30	291.29
递延所得税负债	68.20	-	79.61	-	44.96	-	70.30	-

## 7、其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产情况如下：

单位：万元

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
预付工程款	77.00	35.27	1.22	23.70
预付设备款	673.27	275.96	400.12	921.77
大额定期存单	6,312.49	6,227.53	10,285.00	10,233.57
上市费用	246.04	-	-	-

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
合计	7,308.80	6,538.76	10,686.34	11,179.04

报告期各期末，公司其他非流动资产分别为 11,179.04 万元、10,686.34 万元、6,538.76 万元和 7,308.80 万元，占非流动资产的比例分别为 39.90%、32.66%、21.90% 和 24.56%，主要为公司购买的大额定期存单和预付设备款。

#### （四）资产周转能力分析

##### 1、公司资产周转能力分析

报告期内，公司主要资产周转率情况如下：

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
应收账款周转率（次）	1.14	2.60	2.50	2.31
存货周转率（次）	3.36	8.23	6.75	5.21

报告期内，公司应收账款周转率分别为 2.31、2.50、2.60 和 1.14，公司重视应收账款管理，建立健全了应收账款管理制度，定期与客户对账与催收，应收账款周转率稳步提升。

报告期内，公司存货周转率分别为 5.21、6.75、8.23 和 3.36，公司对原材料实施精细化管理，强化了“以产定采、合理库存”的采购模式，同时公司构建了高效的产销衔接机制，压缩了产品的仓储周期，公司存货余额保持较低水平，随着公司收入规模的增长，存货周转率稳步提升。

##### 2、同行业可比公司比较分析

报告期内，公司资产周转率与同行业可比上市公司比较分析如下：

财务指标	公司名称	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
应收账款周转率（次）	华海诚科	1.17	2.39	2.17	2.42
	康强电子	1.72	3.88	4.40	4.19
	飞凯材料	1.46	2.97	3.05	3.56
	德邦科技	3.09	5.29	4.02	5.77
	平均值	1.86	3.63	3.41	3.99
	发行人	1.14	2.60	2.50	2.31
存货周转率（次）	华海诚科	1.56	3.01	2.82	3.25
	康强电子	1.86	3.89	3.71	3.54
	飞凯材料	1.30	2.82	2.55	2.50
	德邦科技	2.68	4.76	3.93	4.39
	平均值	1.85	3.62	3.25	3.42
	发行人	3.36	8.23	6.75	5.21

数据来源：同行业可比上市公司定期报告等公开资料。

报告期内，公司应收账款周转率略低于同行业可比上市公司平均值，主要系

除华海诚科外，公司与其他上市公司的产品和客户类型存在差异所致；公司应收账款周转率与华海诚科不存在重大差异。

报告期内，公司存货周转率高于同行业可比公司平均值，主要系公司对原材料采用精细化管理以及产品仓储周期较短所致。

## 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析

### （一）负债构成及变动情况分析

报告期各期末，公司负债构成如下：

单位：万元、%

项目	2025年6月30日		2024年12月31日		2023年12月31日		2022年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	14,116.51	77.98	17,423.60	80.86	16,069.92	90.29	19,379.08	92.06
非流动负债	3,986.93	22.02	4,123.65	19.14	1,728.06	9.71	1,671.26	7.94
合计	18,103.44	100.00	21,547.25	100.00	17,797.99	100.00	21,050.34	100.00

报告期各期末，公司负债以流动负债为主，占负债总额的比例分别为 92.06%、90.29%、80.86% 和 77.98%。2024 年末，公司非流动负债占比上升，主要系当年新增长期借款金额较大。

### （二）流动负债构成及变动情况分析

报告期各期末，公司流动负债构成如下：

单位：万元、%

项目	2025年6月30日		2024年12月31日		2023年12月31日		2022年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	4,193.35	29.71	5,508.30	31.61	6,065.63	37.75	5,505.11	28.41
应付票据	-	-	1,347.26	7.73	620.00	3.86	600.00	3.10
应付账款	4,804.04	34.03	5,107.16	29.31	4,908.08	30.54	9,235.00	47.65
合同负债	8.61	0.06	2.54	0.01	0.64	0.00	56.49	0.29
应付职工薪酬	675.78	4.79	1,021.89	5.86	677.33	4.21	459.12	2.37
应交税费	478.90	3.39	893.85	5.13	324.73	2.02	519.97	2.68
其他应付款	70.50	0.50	54.56	0.31	121.49	0.76	98.07	0.51
一年内到期的非流动负债	259.54	1.84	185.90	1.07	138.52	0.86	172.67	0.89
其他流动负债	3,625.80	25.68	3,302.14	18.95	3,213.50	20.00	2,732.64	14.10
合计	14,116.51	100.00	17,423.60	100.00	16,069.92	100.00	19,379.08	100.00

报告期各期末，公司流动负债主要由短期借款、应付账款和其他流动负债构成，上述三项占流动负债的比例分别为 90.16%、88.28%、79.88% 和 89.42%。

### 1、短期借款

报告期各期末，公司短期借款的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
保证借款	-	-	6,000.00	1,500.00
信用借款	4,190.00	5,000.00	-	4,000.00
未终止确认的应收票据	-	503.90	60.29	-
应计利息	3.35	4.40	5.33	5.11
<b>合计</b>	<b>4,193.35</b>	<b>5,508.30</b>	<b>6,065.63</b>	<b>5,505.11</b>

报告期各期末，公司短期借款余额分别为 5,505.11 万元、6,065.63 万元、5,508.30 万元和 4,193.35 万元，主要为保证借款、信用借款和未终止确认的已贴现未到期应收票据。

2022 年度，公司存在借款费用资本化 31.34 万元，具体参见本节“十一、资产质量分析（三）非流动资产分析 2、在建工程”。

### 2、应付票据

报告期各期末，公司应付票据情况如下：

单位：万元

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
银行承兑汇票	-	1,347.26	620.00	600.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>1,347.26</b>	<b>620.00</b>	<b>600.00</b>

报告期各期末，公司应付票据余额分别为 600.00 万元、620.00 万元、1,347.26 万元和 0 万元，占流动负债的比例为 3.10%、3.86%、7.73% 和 0%。公司应付票据均为银行承兑汇票。2025 年 1-6 月，公司更多采用票据背书转让的方式支付供应商款项，未开具银行承兑汇票。

### 3、应付账款

报告期各期末，公司应付账款情况如下：

单位：万元、%

项目	2025年6月30日		2024年12月31日		2023年12月31日		2022年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货款	4,043.58	84.17	3,986.45	78.06	3,892.47	79.31	3,493.78	37.83
工程款	284.72	5.93	527.80	10.33	451.30	9.20	5,508.61	59.65
设备款	243.04	5.06	338.77	6.63	379.83	7.74	68.43	0.74
服务费	137.86	2.87	183.94	3.60	129.74	2.64	125.85	1.36

项目	2025年6月30日		2024年12月31日		2023年12月31日		2022年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他	94.84	1.97	70.20	1.37	54.75	1.12	38.33	0.42
合计	4,804.04	100.00	5,107.16	100.00	4,908.08	100.00	9,235.00	100.00

公司应付账款主要为货款、工程款和设备款等。报告期各期末，公司应付账款余额分别为9,235.00万元、4,908.08万元、5,107.16万元和4,804.04万元，占流动负债的比例分别为47.65%、30.54%、29.31%和34.03%，整体呈下降趋势。2022年末，由于二期综合楼工程建设，公司应付工程款较高，随着2023年建成完工，应付工程款减少，应付账款余额相应下降。

#### 4、合同负债

报告期各期末，公司合同负债情况如下：

单位：万元

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
预收货款	8.61	2.54	0.64	11.49
预收项目款	-	-	-	45.00
合计	8.61	2.54	0.64	56.49

报告期各期末，公司合同负债余额分别为56.49万元、0.64万元、2.54万元和8.61万元，占流动负债的比例分别为0.29%、0.00%、0.01%和0.06%，主要为预收款，金额及占比均较低。

#### 5、应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
短期薪酬	666.00	1,014.09	669.55	450.79
离职后福利-设定提存计划	9.78	7.80	7.78	8.33
辞退福利	-	-	-	-
合计	675.78	1,021.89	677.33	459.12

报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为459.12万元、677.33万元、1,021.89万元和675.78万元，主要由期末计提的尚未支付的短期薪酬构成，随着公司经营规模的扩大呈增长趋势。

#### 6、应交税费

报告期各期末，公司应交税费的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
增值税	197.36	188.59	98.74	395.00
企业所得税	147.97	619.98	162.43	68.06
城市维护建设税	6.59	7.46	—	16.87
教育费附加	2.82	3.20	—	7.23
地方教育费附加	1.88	2.13	—	4.82
房产税	33.28	33.28	35.18	11.86
土地使用税	7.00	7.00	7.00	7.00
个人所得税	72.08	11.11	10.94	4.39
印花税	9.91	21.10	10.44	4.74
合计	478.90	893.85	324.73	519.97

报告期各期末，公司应交税费分别为 519.97 万元、324.73 万元、893.85 万元和 478.90 万元，主要由企业所得税、增值税和房产税等构成。

## 7、其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款情况如下：

单位：万元

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
员工报销款	38.65	34.21	30.04	27.09
单位往来	4.02	4.02	75.37	43.55
保证金	—	—	—	11.35
其他	27.83	16.33	16.08	16.08
合计	70.50	54.56	121.49	98.07

报告期各期末，公司其他应付款余额分别为 98.07 万元、121.49 万元、54.56 万元和 70.50 万元，占流动负债的比例分别为 0.51%、0.76%、0.31% 和 0.50%，主要系员工报销款和往来款。

## 8、一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债情况如下：

单位：万元

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
一年内到期的长期借款	160.00	110.00	—	—
一年内到期的租赁负债	99.54	75.90	138.52	172.67
合计	259.54	185.90	138.52	172.67

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债金额分别为 172.67 万元、138.52 万元、185.90 万元和 259.54 万元，主要为一年内到期的长期借款和租赁

负债。

### 9、其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债情况如下：

单位：万元

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
未终止确认已背书但尚未到期的应收票据	3,624.68	3,301.81	3,213.42	2,731.15
待转销项税额	1.12	0.33	0.08	1.49
合计	3,625.80	3,302.14	3,213.50	2,732.64

报告期各期末，公司其他流动负债余额分别为2,732.64万元、3,213.50万元、3,302.14万元和3,625.80万元，主要系公司未终止确认已背书但尚未到期的应收票据。

### （三）非流动负债构成及变动情况分析

报告期各期末，公司非流动负债构成如下：

单位：万元、%

项目	2025年6月30日		2024年12月31日		2023年12月31日		2022年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期借款	1,786.55	44.81	1,891.71	45.87	-	-	-	-
租赁负债	324.13	8.13	379.04	9.19	68.04	3.94	206.56	12.36
递延收益	1,876.24	47.06	1,852.89	44.93	1,660.02	96.06	1,464.70	87.64
合计	3,986.93	100.00	4,123.65	100.00	1,728.06	100.00	1,671.26	100.00

报告期各期末，公司非流动负债余额分别为1,671.26万元、1,728.06万元、4,123.65万元和3,986.93万元，主要由长期借款和递延收益构成。

#### 1、长期借款

2025年6月末，公司长期借款余额为1,786.55万元，占非流动负债的比例为44.81%。为适应业务规模的扩张需求，公司增加长期借款用以补充营运资金，公司长期借款为信用借款。

#### 2、租赁负债

报告期各期末，公司租赁负债情况如下：

单位：万元

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
租赁付款额	454.53	493.55	212.60	396.15
减：未确认的融资费用	30.86	38.61	6.04	16.92

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
小计	423.67	454.95	206.56	379.23
减：一年内到期的租赁负债	99.54	75.90	138.52	172.67
合计	324.13	379.04	68.04	206.56

报告期各期末，公司租赁负债金额分别为 206.56 万元、68.04 万元、379.04 万元和 324.13 万元，主要系公司租赁的办公场所、仓库等产生的租赁负债。

### 3、递延收益

报告期各期末，公司递延收益的情况如下：

单位：万元

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
政府补助	1,876.24	1,852.89	1,660.02	1,464.70
合计	1,876.24	1,852.89	1,660.02	1,464.70

报告期各期末，公司递延收益余额分别为 1,464.70 万元、1,660.02 万元、1,852.89 万元和 1,876.24 万元，占非流动负债比例分别为 87.64%、96.06%、44.93% 和 47.06%，均为政府补助。

报告期各期末，公司递延收益中涉及的政府补助项目情况如下：

单位：万元

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	与资产/收益相关
海陵工业园区工业项目招商	1,248.65	1,264.45	1,296.05	1,327.65	与资产相关
倒装芯片封装用 MUF 型环氧塑封料研发及产业化	234.21	246.61	248.00	-	与资产相关
“环氧塑封料”专精特新培育升级项目	62.29	68.53	87.20	107.47	与资产相关
年产 2 万吨高端环氧塑封料智能工厂技术改造项目	140.09	148.58	-	-	与资产相关
第三代半导体器件封装用高端环氧塑封料的研发及产业化	148.21	77.26	-	-	与资产相关
半导体用特种环氧树脂研发及产业化	28.00	28.00	-	-	与收益相关
新型高功率模块封装用环氧塑封料关键技术的研发	14.79	19.45	28.78	29.59	与资产相关
合计	1,876.24	1,852.89	1,660.02	1,464.70	-

注：公司作为合作单位之一参与 2024 年山东省重点研发计划“半导体用特种环氧树脂研发及产业化”项目，该项补助资金系用于补偿公司以后期间相关成本费用，属于与收益相关的政府补助。

## （四）偿债能力分析

### 1、主要偿债能力指标

公司主要偿债能力指标情况如下：

项目	2025年6月30日/ 2025年1-6月	2024年12月31日/ 2024年度	2023年12月31日/ 2023年度	2022年12月31日/ 2022年度
流动比率(倍)	2.05	1.76	1.29	1.41
速动比率(倍)	1.81	1.59	1.13	1.26
资产负债率(%)	30.81	35.64	33.27	38.10

报告期内，公司流动比率分别为1.41、1.29、1.76和2.05，速动比率分别为1.26、1.13、1.59和1.81，短期偿债能力较强，整体呈上升趋势。2023年，公司因二期综合楼工程建设及购置相关配套机器设备投入资金较大，导致流动比率和速动比率略有下滑。

报告期各期末，公司资产负债率分别为38.10%、33.27%、35.64%和30.81%，基本保持稳定。2024年，公司新增长期借款用以补充营运资金，导致资产负债率有所上升。

## 2、与同行业可比公司的比较分析

报告期各期末，公司偿债能力与同行业可比上市公司的对比情况如下：

财务指标	公司名称	2025年 6月30日	2024年 12月31日	2023年 12月31日	2022年 12月31日
流动比率(倍)	华海诚科	1.58	1.87	1.86	2.98
	康强电子	1.78	1.51	1.20	1.98
	飞凯材料	1.96	1.85	2.04	1.95
	德邦科技	2.87	3.20	3.72	6.42
	平均值	2.05	2.11	2.21	3.33
	发行人	2.05	1.76	1.29	1.41
速动比率(倍)	华海诚科	1.23	1.44	1.40	2.41
	康强电子	1.29	1.01	0.75	1.29
	飞凯材料	1.56	1.46	1.64	1.53
	德邦科技	2.53	2.92	3.27	5.96
	平均值	1.65	1.71	1.76	2.80
	发行人	1.81	1.59	1.13	1.26
资产负债率 (%)	华海诚科	28.62	25.90	16.51	25.09
	康强电子	41.84	41.51	44.13	35.72
	飞凯材料	27.35	36.91	39.10	39.45
	德邦科技	23.00	22.20	16.57	14.80
	平均值	30.20	31.63	29.08	28.76
	发行人	30.81	35.64	33.27	38.10

数据来源：同行业可比上市公司定期报告等公开资料。

整体而言，公司流动比率、速动比率低于可比上市公司平均水平、资产负债率略高于可比公司，主要原因是公司融资渠道单一，主要为银行贷款。公司募集资金到位后资产负债率预计将有所降低，流动比率和速动比率预计会有所上升，

公司的偿债能力将得到提升。

### （五）流动性风险分析

报告期内，公司资产负债率分别为 38.10%、33.27%、35.64% 和 30.81%，整体处于较低水平且呈下降趋势；公司流动比率分别为 1.41、1.29、1.76 和 2.05，速动比率分别为 1.26、1.13、1.59 和 1.81，流动比率与速动比率均大于 1，且呈上升趋势，公司偿债能力较强。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 -603.65 万元、-3,413.09 万元、1,275.55 万元和 -924.07 万元，随着业务规模的扩大和经营业绩的增长，公司经营活动现金流持续改善，进一步降低了流动性风险。

### （六）持续经营能力分析

报告期内，公司营业收入分别为 20,009.34 万元、25,023.82 万元、33,095.78 万元和 15,904.23 万元，主要来源于中高端环氧塑封料的业务收入。

受益于半导体产业的持续发展和封装材料国产化进程的加速，中高端环氧塑封料的市场需求总体呈增长态势，具有较大发展空间。公司自设立以来始终专注于环氧塑封料的研发创新和产业化，在技术积累、产品研发、生产工艺和质量保障等方面具备较强的竞争优势，与华润微、蓝箭电子、捷捷微电、银河微电、通富微电、华天科技、富满微、气派科技、日月新集团、韩国 KEC 集团等下游知名厂商建立了长期、稳定的合作关系。目前，公司在中端环氧塑封料领域已形成规模效应，成功替代部分日系厂商的国内市场份额；高端环氧塑封料已陆续通过下游封测厂商的考核验证，部分产品已实现量产并向客户供应。

公司持续提升产品品质与服务水平，市场份额不断扩大。依据公开数据测算，公司 2024 年环氧塑封料业务规模在内资厂商中位列第二，在中高端环氧塑封料国产替代方面的贡献名列前茅。公司经营业绩稳步增长，具备良好的持续经营能力。

## 十三、股利分配分析

报告期内，公司实施了两次股利分配，具体情况如下：

2022 年 3 月 2 日，公司召开股东会，同意向股东分配现金股利 660.00 万元。

2024 年 3 月 29 日，公司召开股东大会，审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，同意向全体股东每 10 股派 1 元现金，合计发放 660.00 万元现

金股利。

2025年9月22日,致同出具《专项审计报告》(致同专字[2025]第110C021362号),截至整体变更基准日2022年7月31日,公司净资产调整为33,764.73万元,其中实收资本为3,097.37万元、资本公积为31,110.49万元、盈余公积为450.38万元、未分配利润为-893.51万元。2025年9月22日、2025年10月11日,公司分别召开董事会、股东会,审议通过了《关于弥补因追溯调整而超额分配利润的议案》,因公司对整体变更的财务报表追溯调整,公司存在超额分配利润的情形,公司及股东确认对科化有限出现超额分配利润的情形,不再要求当时参与分红的股东返还超额分配的利润,对超额分配利润以公司日后实现的净利润进行弥补;科化有限确认公司整体变更为股份公司后,股份公司经营业绩和盈利能力整体保持良好水平,公司未分配利润为负的情形已消除,不会对股份公司持续经营和盈利能力造成重大影响。

根据致同出具的《审计报告》(致同审字[2025]第110A034818号),报告期内,公司实现的净利润分别为474.37万元、1,002.83万元、3,389.85万元和1,553.16万元,截至报告期末,公司未分配利润为5,067.66万元,已足额弥补上述超额分配的利润。

## 十四、现金流量分析

报告期内,公司现金流量基本情况如下:

单位:万元

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
经营活动产生的现金流量净额	-924.07	1,275.55	-3,413.09	-603.65
投资活动产生的现金流量净额	3,951.37	-1,316.74	2,222.84	-24,175.77
筹资活动产生的现金流量净额	-1,256.25	883.29	400.35	25,801.41
现金及现金等价物净增加额	1,762.88	842.88	-789.43	1,011.07
期末现金及现金等价物余额	3,178.73	1,415.84	572.96	1,362.39

### (一) 经营活动产生的现金流量

#### 1、经营活动现金流量变动情况

报告期内,公司经营活动产生的现金流量情况如下:

单位:万元

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
销售商品、提供劳务收到的现金	8,612.03	14,433.70	8,789.09	9,433.64

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	212.16	1,264.63	423.39	1,498.26
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>8,824.19</b>	<b>15,698.33</b>	<b>9,212.48</b>	<b>10,931.90</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	4,631.11	7,010.08	6,290.64	5,368.74
支付给职工以及为职工支付的现金	2,894.63	4,896.41	4,031.66	3,760.16
支付的各项税费	1,328.01	710.20	452.28	605.62
支付其他与经营活动有关的现金	894.51	1,806.10	1,850.98	1,801.03
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>9,748.26</b>	<b>14,422.78</b>	<b>12,625.57</b>	<b>11,535.55</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-924.07</b>	<b>1,275.55</b>	<b>-3,413.09</b>	<b>-603.65</b>

公司经营活动现金流量流入主要来自销售商品、提供劳务收到的现金；经营活动现金流出主要来自购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工的以及为职工支付的现金。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-603.65万元、-3,413.09万元、1,275.55万元和-924.07万元，2022年、2023年及2025年1-6月为负值，主要系公司销售环节票据结算比例较高，且收现规模低于付现规模所致。

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金与当期营业收入的比较情况如下：

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
销售商品、提供劳务收到的现金	8,612.03	14,433.70	8,789.09	9,433.64
营业收入	15,904.23	33,095.78	25,023.82	20,009.34
占比	54.15%	43.61%	35.12%	47.15%

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比例分别为47.15%、35.12%、43.61%和54.15%，整体占比较低，主要系公司日常经营过程中采用票据方式结算的比例较高，客户采用票据方式回款，公司后续多以背书转让方式向供应商付款，因而不体现在销售商品、提供劳务收到的现金中。

## 2、经营活动产生的现金流量净额与净利润的匹配情况

报告期内，公司净利润与经营活动产生的现金流量净额之间的比较情况如下：

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
经营活动产生的现金流量净额	-924.07	1,275.55	-3,413.09	-603.65
净利润	1,553.16	3,389.85	1,002.83	474.37
<b>差异</b>	<b>-2,477.24</b>	<b>-2,114.30</b>	<b>-4,415.92</b>	<b>-1,078.02</b>

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额与同期净利润的差额分别为-1,078.02万元、-4,415.92万元、-2,114.30万元和-2,477.24万元，主要受到信用减值损失、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、递延所得税资产、存货、经营性应收项目、经营性应付项目等因素的影响。

上述因素对净利润与经营性现金流之间差异的影响情况如下：

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
净利润	1,553.16	3,389.85	1,002.83	474.37
加：资产减值损失	147.21	283.16	238.28	223.57
加：信用减值损失	49.45	608.53	178.36	35.42
固定资产折旧	922.63	1,810.30	1,246.72	677.31
使用权资产折旧	76.06	155.89	133.10	140.39
无形资产摊销	52.32	64.12	56.99	23.80
长期待摊费用摊销	69.77	101.17	68.94	54.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-262.30	3.36	-0.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	26.82	47.45	4.30	16.46
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-	-	-35.84
财务费用（收益以“-”号填列）	-7.58	-79.86	-34.33	-39.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-	-257.56	-184.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-26.09	-128.31	-51.86	-131.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-670.18	-582.82	-92.02	63.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,678.86	-6,844.46	-8,515.86	388.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,628.13	2,239.67	2,107.90	-2,718.91
其他	189.35	473.18	497.77	408.45
经营活动产生的现金流量净额	-924.07	1,275.55	-3,413.09	-603.65

## （二）投资活动产生的现金流量

报告期内，公司投资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
收回投资收到的现金	4,000.00	-	27,000.00	20,000.00
取得投资收益收到的现金	402.00	-	469.07	184.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.71	339.16	1.86	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>4,402.71</b>	<b>339.16</b>	<b>27,470.94</b>	<b>20,184.31</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	451.34	1,655.90	8,248.09	4,360.09

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
投资支付的现金	-	-	17,000.00	40,000.00
投资活动现金流出小计	451.34	1,655.90	25,248.09	44,360.09
投资活动产生的现金流量净额	3,951.37	-1,316.74	2,222.84	-24,175.77

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-24,175.77万元、2,222.84万元、-1,316.74万元和3,951.37万元。公司投资活动现金流入主要为赎回理财产品收到的现金，投资活动现金流出主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及购买理财产品支付的现金。

### （三）筹资活动产生的现金流量

报告期内，公司的筹资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
吸收投资收到的现金	-	-	-	31,000.00
取得借款收到的现金	2,990.00	9,165.00	6,000.00	6,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	909.27	282.96	1,059.70
筹资活动现金流入小计	2,990.00	10,074.27	6,282.96	38,559.70
偿还债务支付的现金	3,855.00	8,165.00	5,500.00	5,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99.17	877.70	180.82	1,646.18
支付其他与筹资活动有关的现金	292.09	148.28	201.78	5,712.11
筹资活动现金流出小计	4,246.25	9,190.98	5,882.61	12,758.29
筹资活动产生的现金流量净额	-1,256.25	883.29	400.35	25,801.41

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为25,801.41万元、400.35万元、883.29万元和-1,256.25万元。公司筹资活动现金流入主要为吸收投资收到的现金和取得借款收到的现金，系公司通过股权融资、向银行借款等形式取得现金以满足营运资金的需求；公司筹资活动现金流出主要系偿还债务支付的现金和支付其他与筹资活动有关的现金，包括偿还借款及利息等。

## 十五、重大资本性支出分析

### （一）报告期内的重大资本支出情况

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为4,360.09万元、8,248.09万元、1,655.90万元和451.34万元，主要系厂房及办公楼建设支出、机器设备等购置支出。

### （二）未来可预见的重大资本性支出计划

公司计划将本次发行募集资金用于半导体封装用中高端环氧塑封料研发及产业化项目，具体参见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。

除本次发行募投项目外，公司未来的资本性支出计划将基于公司战略发展目标和业务发展的实际需要，综合考虑届时的行业情况、市场竞争状况等因素，合理安排并适当调整。

## **十六、资产负债日后事项、或有事项及其他重要事项**

### **(一) 资产负债表日后事项**

截至本招股说明书签署日，公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

### **(二) 或有事项及其他重要事项**

截至本招股说明书签署日，发行人不存在需要披露的重大或有事项。

### **(三) 其他重要事项**

截至本招股说明书签署日，发行人不存在需要披露的其他重要事项。

## **十七、盈利预测报告**

公司未编制盈利预测报告。

## 第七节 募集资金运用与未来发展规划

### 一、募集资金运用概况

#### （一）募集资金投资方向

经公司董事会和股东会审议通过，本次发行募集资金在扣除发行费用后的净额将用于与公司主营业务相关的投资项目，具体如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目		项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	半导体封装用中高端环氧塑封料研发及产业化项目	1.1 半导体封装用中高端环氧塑封料产业化项目	42,000.00	42,000.00
		1.2 半导体封装用中高端环氧塑封料研发中心建设项目	9,800.00	9,800.00
2	补充流动资金		8,000.00	8,000.00
合计			59,800.00	59,800.00

本次募集资金到位后，公司将根据实际经营情况，结合公司的财务状况、技术条件、管理能力、发展规划和发展目标等情况，并按项目的轻重缓急将募集资金投入各项目实施。本次募集资金到位前，公司可根据项目进度以自筹资金先行投入，待本次募集资金到位后予以置换。

若本次募集资金规模不能满足拟投资项目资金需求，公司将通过自筹资金解决差额部分；若有超出，超出部分将按照相关法律法规，以及中国证监会和上交所的有关规定履行相应程序后使用。

#### （二）募集资金使用管理制度

公司已经根据相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理、变更、监督等事项进行了明确规定。本次募集资金将存放于董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将严格按照中国证监会及上交所的相关规定使用募集资金，确保资金安全与高效。

#### （三）募集资金对发行人主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响、募集资金重点投向科技创新领域的具体安排

##### 1、募集资金对公司主营业务发展的贡献

公司自设立以来，始终致力于半导体封装材料的研发、生产和销售，自主研发、生产的中高端环氧塑封料已在下游核心客户处实现国产化。

通过实施本次募投项目，公司将进一步提升在中高端领域的综合竞争力和持续发展能力。一方面，通过建设自动化、智能化产线，公司将提高中高端产品产能，提升产品一致性与生产稳定性。另一方面，通过建设研发中心，公司将改善研发条件，加快推动产品技术创新，更好地满足下游客户的国产化需求。

## 2、募集资金对公司未来经营战略的影响

本次募投项目与公司发展战略紧密相关，本次募集资金的合理运用有助于公司突破技术壁垒，重点开发先进封装用环氧塑封料，以及用于人工智能、汽车电子、工业控制等高端应用和第三代半导体等特殊应用的产品，加速国产替代。同时，公司将增强规模优势，通过自动化产线与工艺优化，实现降本增效，提升公司盈利能力和市场竞争力。

## 3、募集资金重点投向科技创新领域的具体安排

公司将持续加大自主研发投入，并加强与外部科研机构合作，共同开展前沿技术研究，培养研发人才，推动技术创新及产业化应用，更好地满足下游客户的国产化需求。

## （四）募集资金投资项目的确定依据

本次募投项目紧密围绕公司主营业务，是公司在现有业务基础上，结合未来经营战略、国家产业政策、行业发展趋势、市场需求以及公司自身财务状况、技术条件、管理能力等因素综合确定。

公司已对募投项目的必要性、可行性进行了充分研究，并委托咨询机构编制可行性研究报告。同时，公司已召开董事会审议通过了相关议案，认为募投项目具备可行性，与公司现有规模及发展规划相匹配。

## （五）募集资金投资项目对同业竞争和独立性的影响

公司本次募投项目不涉及与他人合作，项目实施后不会产生同业竞争，亦不会对公司独立性产生不利影响。

## （六）募集资金项目备案及环评批复情况

本次募投项目已获得相关主管部门的备案和环评批复，具体情况如下：

序号	募集资金投资项目	项目备案	环评
----	----------	------	----

序号	募集资金投资项目		项目备案	环评
1	半导体封装用中高端环氧塑封料研发及产业化项目	1.1 半导体封装用中高端环氧塑封料产业化项目	泰海数备(2025)311号	泰环审(海陵)(2025)27号
		1.2 半导体封装用中高端环氧塑封料研发中心建设项目		
2	补充流动资金		-	-

## 二、募集资金投资项目可行性及与发行人主要业务、核心技术的关系

### (一) 募集资金投资项目实施的必要性

#### 1、提升中高端环氧塑封料国产化率，保障高端封装材料供应链的自主可控

面对日益复杂的国际环境和地缘政治格局，高端封装材料的自主可控已成为保障国家半导体产业链长期稳定的关键要素。作为少数具备中高端环氧塑封料研发生产能力的内资企业，公司将通过实施本次募投项目建设先进生产线，新增22,500吨/年中高端产品产能，并配套建设研发中心与检测平台。公司将重点开发先进封装用环氧塑封料，并同步开发用于人工智能、汽车电子、工业控制等高端应用和第三代半导体等特殊应用的产品。通过“技术研发+产能扩张”双轮驱动，使更多产品性能达到国际先进水平，推动国产化率快速提升，助力我国半导体产业向价值链高端跃升。

#### 2、加大人才队伍建设，打造一支技术实力强、经验丰富且具有持续创新活力的研发人才队伍

公司自设立以来，高度重视人才队伍的梯次培养与优秀人才的持续引进。通过实施本次募投项目，公司将提升研发软硬件水平，并增强资金实力，能够提供具有竞争力的薪酬和职业发展路径，“引得来”、“留得住”优秀人才，并通过建立一套以技术突破、成果转化为导向的激励体系，激发研发人员的创新潜能和工作热情，为实现高质量可持续发展提供最坚实的人才保障，从而确保公司的产品和技术始终处于行业领先地位。

#### 3、提升研发软硬件水平，打造一体化的研发平台，加速科技成果转化应用

为了积极响应封装技术发展趋势和客户需求，公司需要持续完善研发条件。通过实施本次募投项目，公司将利用现有厂房实施改造，重点建设现代化研发中心与研发中试线，同时引进高精度检测设备，打造符合国际标准的实验室环境。通过构建“研发-中试-产业化”一体化平台，公司将显著提升研发效率，缩短新产品开发周期，加速实现新产品、新技术的落地及商业化应用。

#### 4、获得生产经营所需资金，支撑公司长期可持续发展

随着业务规模的不断扩大，公司需要补充流动资金以支撑未来经营发展。通过对资源的科学配置与高效利用，公司将进一步提升生产运营效率，增强技术创新能力，促进公司长期健康可持续发展。

### （二）募集资金投资项目实施的可行性

#### 1、公司业务高度契合国家战略与产业政策，为项目实施提供政策支持

环氧塑封料主要应用于国家战略新兴产业政策重点发展的集成电路领域，是《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的建议》、《“十四五”原材料工业发展规划》、《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》等政策鼓励重点发展的关键材料。国家相关政策的出台为公司业务提供了良好的政策环境，为本次募投项目的顺利实施提供了坚实的政策支持。

#### 2、高效透明的治理结构与完善的生产、质量管理体系为项目实施提供制度保障

公司建立了现代企业制度，完善了由股东会、董事会及审计委员会等专门委员会、高级管理人员组成的法人治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责明确、相互制衡、规范运作、科学高效的公司治理机制。同时，公司已构建覆盖采购、生产、交付全流程的质量管理体系，以及工艺标准化、产线自动化、人员专业化的生产体系，为本次募投项目的顺利实施提供制度保障。

#### 3、广阔的市场前景与优质、稳定的客户基础有助于项目新增产能消化

受益于半导体产业的持续发展和封装材料国产化进程的加速，中高端环氧塑封料的市场需求总体呈增长态势，具有较大发展空间。公司自设立以来始终专注于环氧塑封料的研发创新和产业化，在技术积累、产品研发、生产工艺和质量保障等方面具备较强的竞争优势，市场认可度不断提升。公司拥有优质、稳定的客户基础，为本次募投项目新增产能的消化提供支持。

#### 4、公司具备扎实的研发基础及优秀的研发团队，为项目实施提供人才保障

公司建立了覆盖研发战略规划、研发立项与产品技术开发、客户应用与产品改进直至迭代升级的全流程研发管理体系。同时，公司还与外部科研机构合作，

共同开展前沿技术研究，培养研发人才。公司将凭借深厚的技术积淀，以及多层次的人才梯队与创新机制，为项目实施提供坚实的人才保障。

### （三）与发行人主要业务、核心技术的关系

本次募投项目是公司现有业务的延展与升级，募投项目的实施将进一步完善公司中高端产品线，增强技术实力，提升市场竞争力，持续推出满足下游客户使用需求的产品。

## 三、募集资金投资项目具体情况

### （一）半导体封装用中高端环氧塑封料产业化项目

#### 1、项目基本情况

本项目总投资额 42,000.00 万元，拟利用现有厂房建设先进生产线，预计建成后实现年产 22,500 吨中高端环氧塑封料的生产能力。

本项目的投资概算及实施进度计划参见本招股说明书“第十二节 附件 九、募集资金具体运用情况（一）半导体封装用中高端环氧塑封料产业化项目”。

#### 2、项目用地情况

本项目建设地点为泰州市海陵工业园区梅兰东路 70 号，拟利用现有厂房进行装修改造，土地性质为工业用地，场地房屋目前已取得不动产权证书（不动产权证：苏（2023）泰州市不动产权第 2671218 号）。

#### 3、项目备案及环评情况

本项目已取得泰州市海陵区数据局出具的《江苏省投资项目备案证》（备案证号：泰海数备[2025]311 号）。

本项目已取得泰州市生态环境局出具的《关于对江苏中科科化新材料股份有限公司半导体封装用中高端环氧塑封料研发及产业化项目环境影响报告表的批复》（泰环审（海陵）[2025]27 号）。

### （二）半导体封装用中高端环氧塑封料研发中心建设项目

#### 1、项目基本情况

本项目总投资 9,800.00 万元，拟利用现有厂房建设现代化研发中心及试验中试线。公司将根据项目研发课题的内容配置相应的研发设备和软件，提高研发软硬件条件，增强公司研发能力和研发手段，提升公司技术创新水平。

本项目的投资概算及实施进度计划参见本招股说明书“第十二节 附件 九、募集资金具体运用情况（二）半导体封装用中高端环氧塑封料研发中心建设项目”。

## 2、项目用地情况

本项目建设地点为泰州市海陵工业园区梅兰东路 70 号，拟利用公司现有厂房进行装修改造，具体参见本节“三、募集资金投资项目具体情况（一）半导体封装用中高端环氧塑封料产业化项目”。

## 3、项目备案及环评情况

本项目与“半导体封装用中高端环氧塑封料产业化项目”均为“半导体封装用中高端环氧塑封料研发及产业化项目”的子项目，备案及环评相同，具体参见本节“三、募集资金投资项目具体情况（一）半导体封装用中高端环氧塑封料产业化项目”。

## （三）补充流动资金

公司拟使用本次募集资金补充流动资金 8,000.00 万元，以满足公司未来经营发展所需的营运资金，增强公司抗风险能力。

# 四、未来发展规划

## （一）公司战略规划

公司积极响应国家创新驱动发展战略，深度融入新时代高质量发展格局，以新产品研发和工艺创新为驱动，通过增强技术优势、优化产品布局、深化产业链协同，致力于成为具有全球影响力的半导体封装材料供应商。

## （二）报告期内为实现战略目标已采取的措施及实施效果

报告期内，公司围绕“技术创新、产业生态、梯队建设”三大方向，系统性推进核心竞争力建设。

在技术创新领域，公司持续加大研发投入，最近三年累计研发投入占营业收入的比例达 5.85%。报告期内，公司承担国家级、省市级重大科技项目 4 项，成功开发出 KHG900G-A 等达到国际先进水平的产品，实现高端环氧塑封料的技术突破。截至本招股说明书签署日，公司拥有发明专利 34 项。

在产业生态构建方面，公司内部管理与外部合作并进。对内，公司深化质量

管理，顺利通过 ISO 9001、ISO 14001 等国际认证复审；对外，中高端产品成功进入部分主流封测厂商供应链，市场占有率稳步提升。同时，公司与联瑞新材、圣泉集团等本土原材料供应商开展深度合作，联合编制国家标准，联合申报省级重大科技项目，为公司持续稳定发展提供有力支持。

公司持续进行人才梯队建设，建立了具有竞争力的薪酬体系以及创新激励机制，报告期内研发、管理、生产和销售团队均保持较高的稳定性。此外，公司通过优化法人治理结构，构建了权责清晰的决策体系，为公司高质量发展提供制度保障。

### **（三）未来发展规划采取的措施**

#### **1、科创加速：持续加大研发投入力度，拓展核心技术与中高端产品开发**

公司将以现有技术体系为根基，坚持自主创新与“引进、消化、吸收、再创新”相结合的技术发展路径，深化与外部科研机构的合作，围绕半导体封装材料前沿技术，加速产品技术创新，拓展核心技术和中高端产品线，不断满足先进封装与高端应用领域的需求。

#### **2、合理融资：合理使用资本市场融资工具，为实现公司的总体发展战略提供资金保障**

围绕公司总体发展战略，公司拟借助本次科创板上市契机，为公司本次募投项目提供资金支持，进一步扩充公司中高端产品产能，同时建设现代化的研发中心和中试线，努力提高公司的技术水平、产品水平，促进公司的长期可持续发展。

#### **3、治理完善：严格执行上市公司规范运作要求**

公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规对上市公司的要求规范运作，持续优化公司治理结构，构建透明、高效、合规、符合市场发展的现代化企业治理体系，推动公司在质量提升、效率增强以及投资者回报等方面取得显著成效。同时，公司将加强内部控制制度建设，强化各项决策的透明度，确保公司各项业务规划按计划顺利实施。

## 第八节 公司治理与独立性

### 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况

报告期内，公司已按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，制定了《公司章程》，建立健全了股东会、董事会、独立董事、董事会秘书制度以及专门委员会制度，公司股东会、董事会、独立董事和董事会秘书依法规范运作，履行职责。报告期内，公司治理规范，不存在重大缺陷。

### 二、发行人内部控制制度情况

#### （一）公司管理层对内部控制的自我评价

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。此外，根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

#### （二）注册会计师对发行人内部控制的鉴证意见

致同已出具《内部控制审计报告》（致同审字[2025]第 110A034813 号），审计意见为：“中科科化于 2025 年 6 月 30 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”

#### （三）财务内控不规范情形及整改情况

##### 1、票据使用不规范

报告期内，发行人存在票据使用不规范的情形，具体如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
票据找零	-	-	-	655.37
票据分红	-	-	-	909.29
内部票据背书	-	2.50	79.91	115.23
票据退款	-	-	21.54	-
合计	-	2.50	101.45	1,679.89

##### （1）票据找零

公司与客户主要采用银行承兑汇票的形式结算货款。2022 年度，部分客户在交易结算时向公司支付的银行承兑汇票票面金额较大，超过其应付公司的货款，

导致公司以多笔较小票面金额的票据向其返还差额部分。2022 年度票据找零金额合计 655.37 万元，后续不存在票据找零的情形。

#### （2）票据分红

2022 年 3 月，公司采取以票据背书方式向股东支付股利 909.29 万元，其中 272.70 万元系支付 2021 年度宣告发放的现金股利，636.59 万元系支付 2022 年度宣告发放的现金股利。

#### （3）内部票据背书

报告期内，公司存在以票据背书方式向北京分公司支付往来款的情形，报告期各期金额分别为 115.23 万元、79.91 万元、2.50 万元及 0 万元，主要用于北京分公司的日常经营。北京分公司收到票据后，部分进行背书转让支付了设备款、材料款，部分待票据到期后进行了结算。

#### （4）票据退款

2023 年，公司存在零星与客户、供应商的票据退款，其中，以票据形式向客户退款 6.14 万元，收取供应商退款 15.41 万元。主要原因为原交易结算支付的票据均已使用，无法通过原票退回，因此使用了其他票据进行退款结算。

公司已对上述行为进行规范，相关票据均已到期承兑，不存在因票据背书转让后未实现兑付而承担相应的票据责任的情况，未造成任何经济纠纷和损失，亦不存在潜在纠纷。公司加强了票据管理，严格按照《票据法》等法律法规要求开具和使用票据，进一步完善了相关财务内控制度，并得到有效执行。

根据国家金融监督管理总局泰州监管分局、中国人民银行泰州市分行出具的证明和《江苏省企业上市合法合规信息核查报告》，报告期内公司未因票据使用不规范事项受到过行政处罚。

## 2、以与实际业务不符的发票报销支付薪酬及费用

报告期内，公司存在通过以与实际业务不符的发票报销的形式向员工支付奖金、支付外部顾问费用等不规范情形。

针对上述不规范情形，公司已按照相关费用的实际用途进行了还原，相关人员补缴了涉及的个人所得税，与实际用途不符的发票调增了应纳税所得额，并转出了相关的进项税额。

根据国家税务总局泰州市海陵区税务局出具的证明和《江苏省企业上市合法合规信息核查报告》，报告期内，公司不存在重大违法行为，不存在欠税情况。

### 3、关联方资金拆借

2022年1月，为满足项目建设及生产经营的资金周转需求，公司向关联方上海瓯立借入1,000万元无息借款，并于2022年4月全额归还。上述借款期限较短且为无息借款。具体参见本节“七、关联方及关联交易（二）关联交易”。

除上述情形外，公司报告期内不存在其他与关联方的资金拆借和资金占用行为。公司建立健全了《规范与关联方资金往来管理制度》等相关制度，进一步完善了资金管理内部控制。

## 三、发行人报告期内违法违规情况

2022年5月，北京分公司由于未按期申报纳税，根据《税收征收管理法》第六十二条的规定，被处以0.01万元罚款。该罚款金额较小，不属于处罚依据所规定的“情节严重”罚款金额，不属于重大违法违规。

报告期内，公司严格遵守相关法律法规开展生产经营活动，不存在重大违法违规行为，也不存在因重大违法违规行为而受到行政处罚的情形。

## 四、报告期内发行人资金占用和对外担保情况

### （一）资金占用

报告期内，公司不存在资金被控股股东及其控制企业占用的情况。

### （二）对外担保

截至本招股说明书签署日，公司不存在对外担保的情况。

## 五、面向市场独立持续经营的能力情况

公司已按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件的要求规范运作，建立健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东及其控制的其他企业，具有完整独立的业务体系和直接面向市场独立运营的能力。

### （一）资产完整情况

公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。公司不存在资金、

资产被控股股东及其控制的其他企业占用的情形。

## **(二) 人员独立情况**

公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业兼职。

## **(三) 财务独立情况**

公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司的财务管理制度；公司未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。

## **(四) 机构独立情况**

公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

## **(五) 业务独立情况**

公司的业务独立于控股股东及其控制的其他企业，与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，具体情况参见本节“六、同业竞争”及“七、关联方及关联交易”。

## **(六) 发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员的变动情况**

公司主营业务、控股股东、管理团队和核心技术人员保持稳定，最近两年均未发生重大不利变化。由于控股股东北京科化无实际控制人，公司无实际控制人。公司的股份权属清晰，最近两年控股股东未发生变更，公司不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

## **(七) 其他对持续经营有重大影响的事项**

公司不存在主要资产、核心技术、专利、商标的重大权属纠纷，不存在重大偿债风险、重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，不存在经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

## 六、同业竞争

### （一）同业竞争基本情况

#### 1、公司不存在同业竞争

截至本招股说明书签署日，公司控股股东为北京科化；除中科科化以外，北京科化控制的其他企业为首科化。报告期内，北京科化曾从事 LED 专用材料的研发、生产与销售，主要产品包括 LED 支架用塑封料和电子级液态硅橡胶。自 2023 年二季度起，上述业务主要由首科化进行，北京科化基本不再从事生产经营活动。自 2024 年一季度起，首科化开始专注于 LED 支架用塑封料业务，并逐步终止电子级液态硅橡胶业务。LED 支架用塑封料与公司的主要产品半导体封装用环氧塑封料同属于环氧塑封料大类，但公司与北京科化、首科化不构成同业竞争。

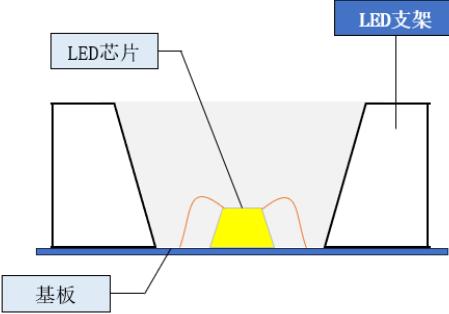
截至本招股说明书签署日，公司无实际控制人。公司控股股东北京科化的三名股东中：中科院化学所是以基础研究为主的多学科、综合性研究所，京泰君联为北京科化及公司的员工持股平台，泰富投资为外部投资机构，其控制的企业中不存在实际从事与公司相同或相似业务的情况，不存在同业竞争。

控股股东北京科化的三名股东控制的企业情况参见本招股说明书“第十二节 附件 三、中科院化学所、京泰君联、泰富投资控制企业情况”。

#### 2、公司与控股股东北京科化及其控制的首科化之间不构成同业竞争

环氧塑封料属于配方驱动型材料，其核心特点在于通过精密的多组分配方设计及工艺调控，适配不同应用领域的性能要求。尽管公司的主要产品与首科化的主要产品同属于环氧塑封料大类，但二者在所处产业链、应用领域、主要产品功能、性能指标体系、技术迭代路径等方面存在显著差异，具体情况如下：

序号	项目	半导体封装用环氧塑封料	LED 支架用塑封料
1	所处产业链	集成电路、分立器件	LED
2	应用领域	集成电路、分立器件等半导体封装	LED 支架
3	主要产品功能	保障半导体芯片免受外部环境影响，保证芯片的稳定性和可靠性	LED 支架系 LED 灯珠的底部基座，LED 支架用塑封料主要用于高端通用照明和部分特殊照明的灯珠封装
4	性能指标体系	①应用于集成电路封装的中高端环氧塑封料一般至少需要通过 MSL3 级潮湿敏感度认证，该标准由联合电子设备工程委员会（JEDEC）制定，在半导体行业具有较高权威性； ②根据不同客户需求，产品可能涉及高导热、低应力、高 Tg、低翘曲、高粘接、填充性、工艺可操作性等多种性能指标	不适用 JEDEC 制定的标准，性能要求更偏向于高反射率、抗黄变、耐热性等
5	技术迭代路径	持续向高导热、低应力、高 Tg、低翘曲、高导热等方向发展	主要提升耐高温老化性能

序号	项目	半导体封装用环氧塑封料	LED 支架用塑封料
6	产品应用图示		

多维度的差异导致半导体封装用环氧塑封料和 LED 支架用塑封料形成了独立的技术标准体系和细分市场，实质上属于完全不同的产品。因此，公司与控股股东北京科化及其控制的首科化之间不构成同业竞争。

## （二）避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争事宜，北京科化已出具《关于避免同业竞争的承诺》，具体情况参见本招股说明书“第十二节 附件 五、与投资者保护相关的承诺（八）控股股东避免同业竞争的承诺”。

## 七、关联方及关联交易

### （一）关联方及关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《科创板上市规则》等法律法规相关规定，公司主要的关联方及关联关系如下：

#### 1、发行人控股股东、实际控制人

北京科化为公司的控股股东，具体情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况 七、控股股东、实际控制人及持股 5%以上主要股东的基本情况（一）控股股东、实际控制人的基本情况”。公司无实际控制人。

#### 2、直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人

序号	关联方	关联关系
1	周宝祥	公司间接股东，通过泰富投资间接持有公司 13.14%股份，公司董事周峰的父亲
2	潘春年	公司间接股东，通过泰富投资间接持有公司 5.63%股份，公司董事周峰的配偶
3	阮荣光	公司间接股东，通过上海瓯立间接持有公司 6.48%股份；公司原监事，已于 2024 年 3 月卸任

#### 3、发行人董事、高级管理人员

公司董事、高级管理人员的情况参见本招股说明书“第四节 发行人基本情况 十二、发行人董事、高级管理人员及核心技术人员”。

报告期初至 2025 年 5 月，公司设置监事会。2025 年 5 月 10 日，公司召开股东大会，审议通过公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，审计委员会成员为洪磊、潘林、傅东升，由洪磊担任召集人。

#### 4、与第 1 项、第 2 项和第 3 项所述关联自然人关系密切的家庭成员

与第 1 项、第 2 项和第 3 项所述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母系公司的关联方。

#### 5、直接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织

除控股股东外，其他直接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织包括：

序号	关联方	关联关系
1	国科瑞华	持有公司 9.25%股份
2	上海瓯立	持有公司 6.54%股份
3	奋斗韶华	持有公司 6.46%股份

#### 6、直接或间接控制发行人的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员或其他主要负责人

公司的控股股东为北京科化，公司无实际控制人。北京科化的董事、监事、高级管理人员或其他主要负责人包括：

序号	关联方	关联关系
1	傅东升	北京科化的董事长
2	张晓伟	北京科化的董事、总经理
3	周峰	北京科化的董事
4	罗可	北京科化的监事会主席
5	王锐	北京科化的监事
6	王小华	北京科化的监事
7	谷雨擎	北京科化的财务负责人

#### 7、由第 1 项至第 6 项所列关联法人或关联自然人直接或者间接控制的，或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的除发行人以外的法人或其他组织

序号	关联方	关联关系
1	首科化	公司控股股东北京科化的全资子公司
2	京泰君联	公司及控股股东北京科化的员工持股平台，公司董事长、总经理卢绪奎持股 16.15%并担任执行董事，北京科化的董事、总经理张晓伟持股 0.77%并担任总经理，北京科化的财务负

序号	关联方	关联关系
		责人谷雨擎担任财务负责人的企业
3	北京国特杜仲科技发展有限公司	公司董事长、总经理卢绪奎担任总经理的企业（已吊销）
4	泰富投资	公司间接持股 5%以上股东周宝祥持股 70.00%并担任执行董事、总经理，潘春年持股 30.00%的企业
5	泰州嘉泰电子科技有限公司	公司董事周峰持股 100%的企业
6	泰州市嘉和中央厨房配餐有限公司	公司董事周峰持股 70.00%并担任监事的企业
7	泰州嘉和制衣有限公司	公司董事周峰持股 72.78%并担任总经理，其弟弟持股 27.22%的企业
8	泰州嘉利制衣有限公司	公司董事周峰担任执行董事、总经理的企业
9	泰州市润峰电子科技有限公司	公司董事周峰担任执行董事、总经理，泰富投资持股 100%的企业
10	泰州市海洋服装水洗有限公司	公司董事周峰持股 20.00%并担任总经理的企业（已吊销）
11	泰州嘉顺制衣有限公司	公司间接持股 5%以上股东周宝祥担任董事，公司董事周峰的弟弟担任董事长、总经理，泰州嘉和制衣有限公司持股 4.16%的企业
12	泰州东星精密机器有限公司	泰富投资持股 100%的企业
13	泰州泰富嘉园大酒店有限公司	公司间接持股 5%以上股东潘春年担任执行董事、总经理，泰州东星精密机器有限公司持股 100%股权的企业
14	南京嘉泰服饰有限公司	公司董事周峰的弟弟持股 100%并担任执行董事、总经理的企业
15	南京三林恒泰软件有限公司	公司董事周峰的弟弟持股 70.00%并担任执行董事、总经理的企业
16	泰州鑫之源机械加工有限公司	公司间接持股 5%以上股东潘春年的妹妹持股 50.00%的企业
17	海陵百佳餐饮管理经营部（个体工商户）	公司间接持股 5%以上股东潘春年妹妹的配偶经营的个体工商户
18	海陵百泰餐饮管理经营部（个体工商户）	公司间接持股 5%以上股东潘春年妹妹的配偶经营的个体工商户
19	泰州市创源蔬菜专业合作社	公司间接持股 5%以上股东潘春年妹妹的配偶担任法定代表人的农民专业合作社
20	邦凯控股集团有限公司	公司间接持股 5%以上股东阮荣光及其配偶持有 100%股权，阮荣光担任总经理，其配偶担任执行董事的企业
21	上海邦虎物业管理有限公司	公司间接持股 5%以上股东阮荣光持股 30.00%并担任执行董事，邦凯控股集团有限公司持股 70.00%的企业
22	上海雅纤材料有限公司	公司间接持股 5%以上股东阮荣光实际控制的企业
23	上海桦文贸易有限公司	公司间接持股 5%以上股东阮荣光实际控制的企业
24	荣生投资管理（上海）有限公司	公司间接持股 5%以上股东阮荣光的配偶持股 14.14%并担任执行董事，邦凯控股集团有限公司持股 85.86%的企业
25	上海邦珂投资咨询有限公司	邦凯控股集团有限公司持股 51.00%，公司间接持股 5%以上股东阮荣光的配偶担任执行董事的企业（已吊销）
26	上海瓯风新材料科技	公司间接持股 5%以上股东阮荣光的妹妹担任董事长，阮荣

序号	关联方	关联关系
	有限公司	光的儿子持股 3.50%并担任董事, 阮荣光的女儿持股 1.67%, 荣生投资管理(上海)有限公司持股 27.55%, 上海邦珂投资咨询有限公司持股 18.85%
27	荣升塑胶(上海)有限公司	公司间接持股 5%以上股东阮荣光担任董事长, 其儿子担任董事、总经理, 其女儿担任董事, 荣生投资管理(上海)有限公司持股 30.00%的企业
28	上海旭凯光伏电力有限公司	公司间接持股 5%以上股东阮荣光的儿子持股 100%并担任执行董事的企业
29	上海汇亿瑞企业管理有限公司	公司间接持股 5%以上股东阮荣光的儿子的配偶持股 100%并担任董事、财务负责人的企业
30	温州华际塑胶股份有限公司	公司间接持股 5%以上股东阮荣光的妹妹的配偶持股 27.66%并担任董事长、总经理的企业
31	瑞安市莘塍金利服装厂	公司间接持股 5%以上股东阮荣光的妹妹的配偶经营的个体工商户
32	苏州极刻光核科技有限公司	公司董事长、总经理卢绪奎的女婿持股 25.73%并担任董事长、总经理, 女婿的父亲担任董事, 卢绪奎的女儿曾担任董事的企业
33	上海徕刻科技有限公司	公司董事长、总经理卢绪奎的女婿担任董事长, 苏州极刻光核科技有限公司持股 100%的企业
34	苏州刻得不错光核科技有限公司	公司董事长、总经理卢绪奎的女婿担任执行董事, 苏州极刻光核科技有限公司持股 100%的企业
35	南京刻得不错光电科技有限公司	公司董事长、总经理卢绪奎的女婿担任执行董事, 苏州极刻光核科技有限公司持股 100%的企业
36	无锡刻得不错光电科技有限公司	公司董事长、总经理卢绪奎的女婿担任执行董事, 苏州极刻光核科技有限公司持股 100%的企业
37	诸暨极刻光电科技合伙企业(有限合伙)	公司董事长、总经理卢绪奎的女婿持有 70.00%出资额并担任执行事务合伙人的企业
38	北京中科北化科技管理有限公司	公司董事傅东升担任执行董事、总经理, 中科院化学所持股 100%的企业
39	北京新化正隆科技有限公司	公司董事傅东升担任董事长, 北京中科北化科技管理有限公司持股 100%的企业
40	山东中科恒联生物基材料有限公司	公司董事傅东升担任副董事长
41	广东中科华通新材料科技有限公司	公司董事傅东升担任副董事长
42	中科纳米技术工程中心有限公司	公司董事傅东升担任董事
43	浙江中科恒泰新材料科技有限公司	公司董事傅东升担任董事的企业
44	中科先行工程塑料国家工程研究中心股份有限公司	公司董事傅东升担任董事
45	南京集溢半导体科技有限公司	公司董事张文良担任董事的企业
46	大庆溢泰半导体材料有限公司	公司董事张文良担任董事的企业
47	深圳通锐微电子技术有限公司	公司董事张文良担任董事的企业
48	四川易冲科技有限公司	公司董事张文良持股 0.04%并担任董事的企业

序号	关联方	关联关系
49	司	
49	上海天正文化传媒有限公司	公司独立董事宋正奇的配偶持股 100%并担任执行董事
50	广东宝莱华家居实业股份有限公司	公司独立董事宋正奇的配偶的弟弟持股 10.00%并担任董事的企业
51	上海淇予品牌管理有限公司	公司独立董事宋正奇的配偶担任董事长的企业（已吊销）
52	佛山市禅城区湘多饱小吃店	公司独立董事宋正奇的配偶的弟弟经营的个体工商户
53	无锡鹤见技术服务有限公司	公司副总经理宋永成持股 50.00%，宋永成的配偶持股 50.00%并担任执行公司事务的董事、总经理的企业
54	无锡鹤见企业管理咨询有限公司	公司副总经理宋永成持股 50.00%，宋永成的配偶持股 50.00%并担任执行公司事务的董事、总经理的企业
55	泰州东成物业管理有限公司	公司控股股东北京科化的监事王小华担任执行董事的企业
56	泰州利丰投资管理有限公司	公司控股股东北京科化的监事王小华持股 100%并担任执行董事、总经理的企业（已吊销）

## 8、间接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织

序号	关联方	关联关系
1	中科院化学所	公司间接股东，通过北京科化间接持有公司 27.03%股份
2	泰富投资	公司间接股东，通过北京科化间接持有公司 18.77%股份
3	京泰君联	公司间接股东，通过北京科化间接持有公司 18.77%股份

## 9、报告期内曾经的主要关联方

### （1）关联法人

序号	关联方	关联关系
1	北京科化昌隆新技术开发公司	公司控股股东北京科化前身科化新技术公司的子公司，自北京科化改制设立起停止经营，已于 2024 年 12 月注销
2	泰州市绿企环境管理有限公司	公司间接持股 5%以上股东潘春年曾持股 50%并担任监事的企业，已于 2022 年 3 月注销
3	泰州凯利晟商贸有限公司	公司董事周峰及其配偶曾持有 100%股权，且周峰曾担任执行董事、总经理的企业，已于 2024 年 10 月转让股权并卸任
4	江苏海峰环保科技有限公司	公司董事周峰曾担任董事、总经理，泰州东星精密机器有限公司曾持股 49.00%股权的企业，已于 2024 年 10 月转让股权并卸任
5	泰州烯王新能源科技有限公司	公司董事周峰曾担任执行董事、总经理的企业，已于 2024 年 10 月卸任
6	泰州市凤城数字科技中等职业技术学校有限公司	公司间接持股 5%以上股东周宝祥、潘春年曾担任董事，泰富投资曾持股 30.00%的企业，已于 2025 年 11 月注销
7	海陵区吴筱雅火锅店	公司间接持股 5%以上股东潘春年妹妹的配偶曾经营的个体工商户，已于 2023 年 7 月注销
8	航科瓯立（淄博）创业投资合伙企业(有限合伙)	公司 5%以上股东上海瓯立曾持有 99.00%出资额的企业，已于 2024 年 8 月注销
9	北京玉英荣光商贸有限公司	公司间接持股 5.00%以上股东阮荣光及其配偶曾持有 100%

序号	关联方	关联关系
	限责任公司	股权, 阮荣光配偶曾担任该企业执行董事兼总经理的企业, 已于 2025 年 4 月注销
10	上海瓯越物业管理有限公司	公司间接持股 5%以上股东阮荣光曾持股 100%并担任执行董事的企业, 已于 2022 年 9 月转让股权并卸任
11	上海火神实业有限公司	公司间接持股 5%以上股东阮荣光及其配偶曾持有 100%股权, 阮荣光曾担任执行董事的企业, 已于 2023 年 4 月注销
12	瑞安狼威服饰有限公司	公司间接持股 5%以上股东阮荣光的妹妹的配偶曾持股 8%并担任执行董事、总经理、财务负责人的企业, 已于 2023 年 3 月转让股权并卸任
13	温州华加新材料有限公司	公司间接持股 5%以上股东阮荣光的妹妹的配偶曾持股 20%并担任执行董事、总经理的企业, 已于 2023 年 3 月转让股权并卸任
14	诸暨静德企业管理合伙企业(有限合伙)	公司董事长、总经理卢绪奎的女婿曾持有 0.22%出资额并担任执行事务合伙人的企业, 已于 2025 年 9 月退伙
15	中科宝辰(北京)科技有限公司	公司董事傅东升曾担任董事的企业, 已于 2024 年 3 月卸任
16	上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司	公司董事傅东升曾担任公司董事, 已于 2023 年 12 月卸任
17	北京永晶科技有限公司	公司董事傅东升曾担任公司董事, 已于 2023 年 1 月卸任
18	中船汉光科技股份有限公司	公司董事傅东升曾担任该企业董事, 已于 2025 年 7 月卸任
19	上海笛才建设项目管理中心	公司独立董事洪磊曾设立的个人独资企业, 已于 2023 年 5 月注销
20	保定市北市区诚信普田整体厨房销售部	公司副总经理姚克经营的个体工商户, 已于 2024 年 12 月注销
21	上海中易甑航科技有限公司	公司副总经理姚克的妹妹自 2023 年 11 月持股 100%并担任董事长的企业, 已于 2025 年 5 月转让股权并卸任

## (2) 关联自然人

序号	关联方	关联关系
1	孙丛姗	公司原董事, 已于 2023 年 4 月卸任
2	殷雅蓓	公司原监事, 已于 2024 年 6 月卸任
3	黄娟	公司原监事, 由于公司 2025 年 5 月取消监事会, 不再担任监事
4	曹延生	公司原副总经理, 已于 2023 年 7 月卸任
5	李刚	公司的首席科学家, 2022 年 11 月至 2024 年 6 月有效的公司章程将首席科学家认定为公司高级管理人员, 章程修改后, 不再是高级管理人员
6	杨淑霞	公司控股股东北京科化原董事长, 已于 2022 年 7 月卸任
7	张建伟	公司控股股东北京科化原董事长, 已于 2023 年 12 月卸任
8	薛兆弘	公司控股股东北京科化原监事会主席, 已于 2023 年 12 月卸任
9	张秋华	公司控股股东北京科化原监事, 已于 2023 年 12 月卸任
10	韩晓娜	公司控股股东北京科化原监事会主席, 已于 2025 年 7 月卸任。公司原监事会主席, 由于公司于 2025 年 5 月取消监事会, 不再担任公司监事

报告期内曾经的关联自然人直接或间接控制的, 或者其报告期内曾担任董事、高级管理人员的企业也属于公司曾经的关联方。

在交易发生之日前 12 个月内,或相关交易协议生效或安排实施后 12 个月内,具有前述所列情形之一的法人、其他组织或自然人,视同发行人的关联方。

## (二) 关联交易

### 1、报告期内关联交易总体情况

报告期内公司关联交易的简要汇总如下:

单位: 万元

关联交易类型		2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
经常性	支付关键管理人员及其他关联自然人薪酬	275.36	759.72	639.06	508.68
	向关联方采购商品	89.63	218.57	318.67	254.00
	向关联方采购服务	73.86	57.10	—	—
	房屋租赁(含物业费、水电费、餐费等)	71.06	137.91	134.41	139.73
偶发性	向关联方拆借资金	—	—	—	1,000.00
	向关联方购买资产	—	308.75	7.17	—
	向关联方转让资产	—	298.72	—	—
	委托研发、咨询服务	1.37	39.71	128.63	24.00
	通过关联方代缴社保等费用	28.73	42.23	39.55	37.76
	代关联方缴纳社保等费用	—	0.76	5.11	2.18
	零星关联采购	—	0.15	—	0.18
	零星关联销售	—	0.65	—	—
	向关联方捐赠	—	20.00	—	—
	无偿使用商标	公司曾无偿使用北京科化 2 项商标			
	无偿提供注册地	公司为持股平台奋斗韶华无偿提供注册地			
关联方为发行人担保		北京科化、卢绪奎为公司银行借款提供担保			
关联方代收代付		—	13.00	0.50	7.91

### 2、重大关联交易的判断标准

公司参照《科创板上市规则》和《公司章程》中规定的董事会审议关联交易事项的权限,将达到下列标准之一的关联交易界定为重大关联交易:

- (1) 与关联自然人发生的交易金额(包括承担的债务和费用)在 30 万元以上的交易(公司董事、取消监事会前在任监事和高级管理人员按照股东大会决议领取股息、红利或薪酬作为一般关联交易);
- (2) 与关联法人(或者其他组织)发生的交易金额(包括承担的债务和费用)在 300 万元以上,且占公司最近一期经审计总资产绝对值 0.1%以上的交易;
- (3) 其他虽未约定金额但从性质上判断对公司生产经营具有重大影响的关

联交易事项。

此外，关联方为公司提供担保等公司单方面获得利益的交易，关键管理人员及其他关联自然人的薪酬为公司正常经营活动的必要支出，均视作一般关联交易。

### 3、重大关联交易

#### (1) 重大经常性关联交易

报告期内，公司发生的重大经常性关联交易为向泰州嘉利制衣有限公司采购纸箱作为环氧塑封料的包装物，具体如下：

单位：万元

关联方	交易内容	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
泰州嘉利制衣有限公司	采购纸箱	89.63	218.57	318.67	254.00

报告期内，公司向泰州嘉利制衣有限公司采购纸箱金额分别为 254.00 万元、318.67 万元、218.57 万元和 89.63 万元，占当期原材料采购总额的比例分别为 2.15%、2.28%、1.18% 和 0.99%，整体占比较小。交易价格根据不同规格型号纸箱产品的市场价格协商确定，定价公允。

#### (2) 重大偶发性关联交易

报告期内公司发生的重大偶发性关联交易主要是 2022 年 1 月向股东上海瓯立拆借资金及 2024 年 12 月与控股股东北京科化及其子公司之间的资产转让，具体如下：

##### ①资金拆借

2022 年 1 月，为满足项目建设及生产经营的资金周转需求，公司向上海瓯立借入 1,000.00 万元无息借款，2022 年 4 月公司全额归还。

单位：万元

关联方	期间	期初余额	本期借入	本期归还	期末余额	利率
上海瓯立	2022 年度	-	1,000.00	1,000.00	-	无息

##### ②资产转让

为进一步确保公司的资产完整性和独立性，2024 年度，公司与控股股东北京科化及其子公司进行了资产转让：A. 公司向北京科化及其子公司首科化购买与公司生产经营相关的部分机器设备、软件、专利、注册商标；B. 公司将与主营业务不相关的部分机器设备、专利转让给首科化。

2024 年 12 月，公司与北京科化、首科化签订了资产转让协议，中京民信就

公司本次购买和出售的资产分别出具了京信评报字（2024）第435号、京信评报字（2024）第434号《资产评估报告》。本次资产转让的交易价格以评估价值为基础确定，具体如下：

单位：万元

交易内容	关联方	标的资产	交易价格	评估价值
购买资产	北京科化	16项机器设备、2项软件、1项共有专利、2项商标	303.16[注]	375.79
	首科化	7项机器设备	5.59	5.59
出售资产	首科化	21项机器设备、3项发明专利及2项申请中的发明专利	297.52	297.52

注：公司与北京科化原共有1项发明专利“一种环氧树脂材料及其制备方法与应用”（专利号：ZL202211113183.9），通过本次交易变更为公司单独享有，转让价格为该发明专利评估价值（145.26万元）的50%。

本次交易价格以评估价值为依据经交易各方协商确定，定价公允。

#### 4、一般关联交易

##### （1）一般经常性关联交易

报告期内，发行人发生的一般经常性关联交易如下：

单位：万元

交易类型	关联方	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
支付薪酬	关键管理人员及其他关联自然人	275.36	759.72	639.06	508.68
房屋租赁、物业费、食堂餐费	首科化	71.06	137.91	134.41	139.73
采购餐饮服务	海陵百泰餐饮管理经营部、海陵百佳餐饮管理经营部	73.86	57.10	-	-

##### ①关键管理人员及其他关联自然人薪酬

报告期内，公司关键管理人员、其他关联自然人薪酬总额如下：

单位：万元、%

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
关键管理人员薪酬	262.75	759.72	639.06	508.68
其他关联自然人薪酬	12.61	-	-	-
<b>合计</b>	<b>275.36</b>	<b>759.72</b>	<b>639.06</b>	<b>508.68</b>
利润总额	1,777.70	3,898.26	1,100.67	549.69
<b>占比</b>	<b>15.49</b>	<b>19.49</b>	<b>58.06</b>	<b>92.54</b>

注：关键管理人员涵盖报告期内的董事、监事（取消监事会前在任）和高级管理人员；

其他关联自然人在公司任职的关键管理人员关系密切的家庭成员；薪酬总额为相关人员当期全部薪酬，未含股份支付费用。

### ②房屋租赁、物业费、食堂餐费

报告期内，公司承租首科化位于北京市昌平区沙河镇松兰堡村沙河工业区临168号的研发楼及平房；同时，首科化向公司提供物业管理服务及水电供暖等服务，按月收取2万元/月（含税）固定费用；2024年起，公司按照人员用餐情况向首科化支付食堂餐费。具体如下：

单位：万元

关联方	交易内容	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
首科化	租赁费	48.09	104.48	104.48	104.48
	租赁负债利息支出	6.44	2.64	7.29	12.61
	物业及食堂餐费	16.53	30.79	22.64	22.64
	合计	71.06	137.91	134.41	139.73

注：公司已将上述房屋租赁在使用权资产进行核算，作为承租方承担租赁负债利息支出。

报告期初，公司租赁首科化的房屋建筑面积为2,080平方米，单价为1.50元/平方米/天，年租金为含税113.88万元；自2025年1月起，租赁建筑面积调整为1,915平方米，租赁单价未变化，年租金为含税104.85万元。

上述价格系双方参考北京市昌平区附近的办公用房租赁价格及物业、水电市场价格协商确定，具有公允性。

### ③采购餐饮服务

2024年7月，公司与海陵百泰餐饮管理经营部、海陵百佳餐饮管理经营部签署《食堂承包协议》，将职工食堂委托给上述主体经营，2024年度、2025年1-6月餐费支出分别为57.10万元、73.86万元。

### （2）一般偶发性关联交易

报告期内发行人发生的一般偶发性关联交易如下：

单位：万元

序号	交易类型	关联方	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
1	委托研发服务	中科院化学所	1.37	39.71	54.63	-
2	通过关联方代缴社保等费用	中科院化学所	28.73	41.28	39.55	36.93
		北京科化				0.83
		首科化		0.95		
3	代关联方缴纳社保等费用	北京科化	-	-	0.46	2.18
		首科化	-	0.76	4.65	-
4	捐赠	中科院化学所	-	20.00	-	-

序号	交易类型	关联方	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
5	购买资产	首科化	-	-	7.17	-
6	转让资产	姚克		1.20		
7	接受咨询服务	无锡鹤见材料科技有限公司	-	-	74.00	24.00
8	零星销售	首科化	-	0.65	-	-
9	零星采购	泰州市嘉和中央厨房配餐有限公司	-	-	-	0.18
		上海微谱检测科技集团股份有限公司	-	0.15	-	-
10	无偿使用商标	北京科化	公司曾无偿使用北京科化2项商标			
11	无偿提供场地	奋斗韶华	公司为持股平台奋斗韶华无偿提供注册地			
12	关联方提供担保	北京科化、卢绪奎	北京科化、卢绪奎为公司银行借款提供担保			
13	关联方代收代付	北京科化	-	-	0.50	-
		首科化	-	13.00	-	7.91

### ①委托研发服务

报告期内，公司与中科院化学所签订了《技术开发合同》，主要内容如下：

项目名称	EMC 评价关键技术研究
委托人	江苏中科科化新材料股份有限公司
研究开发人	中国科学院化学研究所
签订日期	2022年12月25日
标的技术的内容、范围及要求	1、开发 MUF 型 EMC 模流仿真相关参数测试技术，性能达到国外竞品水平，满足封测客户封装工艺要求； 2、针对典型 EMC 产品开发塑封料固化、流变、应力、浸润性能及组分分散均匀性评价技术。
研究开发经费	100.00 万元（含税）

根据合同约定，中科院化学所为公司提供技术服务，主要内容包括“MUF 型 EMC 模流仿真评价方法”、“典型 EMC 性能评价方法”、“典型 EMC 质量控制评价方法”的研究，以及 MUF 型 EMC 用促进剂的设计合成与优化研究。相关交易价格系中科院化学所根据项目经费预算及技术开发类项目管理费提取比例形成报价单，并经双方协商一致确定，定价公允合理。

### ②代缴社保、住房公积金等费用

报告期内，公司存在通过关联方代缴社保、住房公积金等费用，以及代关联方缴纳社保、住房公积金等费用的情况，具体如下：

单位：万元

交易内容	关联方	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
通过关联方代缴社保等费用	中科院化学所	28.73	41.28	39.55	36.93
	北京科化	-	-	-	0.83

交易内容	关联方	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
	首科化	-	0.95	-	-
代关联方缴纳社保等费用	北京科化	-	-	0.46	2.18
	首科化	-	0.76	4.65	-

注：A. 公司董事长、总经理卢绪奎、首席科学家李刚拥有中科院化学所编制，已办理离岗创业，其薪酬由公司承担并支付，其社保、住房公积金、职业年金等费用由中科院化学所代缴，实际费用由发行人承担并与中科院化学所结算。

B. 报告期内，北京分公司与北京科化、首科化之间存在个别员工劳动关系变更，由于社保、住房公积金账户变更不及时导致变更当月的社保、住房公积金由转出前单位代缴，相关成本费用由转出后单位承担并结算。

### ③捐赠支出

2024年8月，公司与中科院化学所签订《关于设立“中国科学院化学研究所中科科化奖学金”的协议》，公司每年提供“中科科化奖学金”20万元，为期5年。

### ④购买资产

2023年1月，公司与首科化签署了《设备采购合同》，向首科化以含税价8.10万元采购1台菊水打饼机。

### ⑤转让资产

2024年5月，公司将一辆自用汽车处置出售给副总经理姚克。该辆汽车于2015年9月购入，公司按照账面净值1.20万元出售。

### ⑥接受咨询服务

2021年2月，公司与无锡鹤见技术服务有限公司签署《经营管理咨询服务合同》，由其为公司提供企业经营管理咨询服务及品质技术咨询顾问服务，上述服务持续至2023年6月。2022年、2023年分别发生咨询服务费24万元、74万元。

### ⑦零星销售和采购

A. 2024年11月，首科化因生产需要临时从北京分公司调用氧化铝材料，价款金额为0.65万元。

B. 2022年5月，公司向泰州市嘉和中央厨房配餐有限公司采购一批快餐合计0.18万元。

C. 2024年11月，公司向上海微谱检测科技股份有限公司支付铁磁EMC

离子含量检测费 0.15 万元。

⑧无偿使用商标

报告期内，公司存在无偿使用北京科化 2 项商标的情形，使用商标的具体情况参见本招股说明书“第五节 业务与技术 五、发行人主要固定资产和无形资产（二）主要无形资产 3、商标”。

2024 年 12 月，北京科化已将上述 2 项商标转让给公司，具体情况参见本节“七、关联方及关联交易（二）关联交易 3、重大关联交易。”

⑨无偿提供场地

2021 年 7 月，公司出具《无偿使用证明》，同意将位于泰州市海陵区海陵工业园区梅兰东路 70 号的房屋无偿提供给奋斗韶华作为住所使用。奋斗韶华使用场地主要作为工商注册地址，未实际使用相关房产。

⑩关联担保

报告期内，存在关联方为公司提供担保的情况，具体如下：

单位：万元

担保方	债权人	担保合同金额	合同类型	签订日期	担保期间	主债权是否履行完毕
北京科化	中国农业银行股份有限公司泰州海陵支行	6,000.00	《最高额保证合同》32100520210017836	2021.8.3	自主合同项下的借款期限届满之日起三年	是
卢绪奎	中国农业银行股份有限公司泰州海陵支行	6,000.00	《最高额保证合同》32100520210017920	2021.8.4	自主合同项下的借款期限届满之日起三年	是
卢绪奎	中国农业银行股份有限公司泰州海陵支行	11,880.00	《最高额保证合同》32100520230015201	2023.7.13	自主合同项下的借款期限届满之日起三年	是

⑪关联方代收代付

2023 年 11 月，公司处置一台生产用设备开炼机，处置价款 0.50 万元。该设备系北京科化所有，公司收到处置价款后支付给北京科化。

2022 年 3 月，公司客户宁波永恩半导体科技有限公司误将货款 7.91 万元支付至首科化账户，首科化收到后当月转至公司账户。后经公司与客户沟通，双方协商将该笔货款退回后重新支付，因此公司于当月向首科化退还 7.91 万元，首科化退还给客户，并由客户当月重新付款。

2024年1月，公司向北京分公司支付日常经营资金13.00万元时误付至首科化账户，首科化当日退回。

### 5、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

报告期各期末，公司无应收关联方款项。

#### (2) 应付项目

单位：万元

项目名称	关联方	2025年6月末	2024年末	2023年末	2022年末
应付账款	首科化	29.44	18.12	—	—
	中科院化学所	—	47.17	—	—
	泰州嘉利制衣有限公司	34.26	35.86	94.88	132.06
其他应付款	中科院化学所	—	—	71.35	43.55

### (三) 关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司生产经营上不存在依赖关联方的情形。公司主要关联交易事项均按照市场原则定价，价格合理，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。公司报告期内发生的关联交易对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

### (四) 报告期内公司关联交易决策程序履行情况及独立董事意见

#### 1、关联交易履行的审议程序情况

公司召开第一届董事会第八次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于确认公司报告期内（2022年至2024年）关联交易的议案》。公司召开第一届董事会第九次会议和2024年年度股东会，审议通过《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》。

#### 2、独立董事意见

公司独立董事对报告期内公司的关联交易事项进行审核后发表独立意见，认为：报告期内发生的关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价依据与定价方法符合公开、公平、公正原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形。

### (五) 减少和规范关联交易的制度及措施

#### 1、制定完善并严格执行相关制度

公司已建立了完善的公司治理制度，在《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等制度中，

对关联交易的决策权限、审批程序等事项做出了严格规定。

## 2、控股股东、持股 5%以上的其他股东以及董事、高级管理人员关于减少和规范关联交易的承诺

公司控股股东、持股 5%以上的其他股东以及董事、高级管理人员均出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，具体情况参见本招股说明书“第二节 附件 六、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项（二）关于规范和减少关联交易的承诺”。

### （六）报告期内关联方的变化情况

公司报告期内曾经存在的关联方的具体情况参见本节“七、关联方及关联交易（一）关联方及关联关系”。

## 第九节 投资者保护

### 一、本次发行前滚存利润分配安排

经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，公司本次发行前的滚存利润由本次发行完成后的的新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有。

### 二、发行人股利分配政策

#### （一）本次发行前后股利分配政策的差异情况

本次发行前后，公司的股利分配政策不存在重大变化。

公司已承诺在审期间不进行现金分红，具体情况参见本招股说明书“第十二节 附件 六、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项（五）在审期间不进行现金分红的相关承诺”。

#### （二）本次发行后的股利分配政策

根据上市后适用的《公司章程（草案）》，本次发行后的股利分配政策如下：

##### 1、利润分配原则

公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下，公司实行积极、持续稳定的利润分配政策。

##### 2、利润分配的形式

公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先采取现金方式分配股利。

##### 3、利润分配的期间间隔

在符合条件的情况下，公司原则上每年至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

##### 4、现金分红条件及分红比例

（1）公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：

- ①公司当年盈利且累计未分配利润为正；
- ②公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；
- ③审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

(2) 公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：

- ①公司当年度未实现盈利；
- ②公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；
- ③公司期末资产负债率超过 70%；
- ④公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，且公司已在公开披露文件中对相关计划进行说明，进行现金分红将可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形：

- ①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过 3,000 万元；
- ②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5%。

(3) 现金分红比例的规定

公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以同时派发股票股利。

公司进行现金分红时，现金分红的比例也应遵照以下要求：

- ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
- ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
- ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资产支出安排和投资者回报等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。

公司在实际分红时根据具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

## 5、股票股利分配条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在

满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

## 6、利润分配的决策程序

(1) 董事会提交股东会的股利分配具体方案，应经董事会全体董事过半数表决通过，并经全体独立董事三分之二以上表决通过。

(2) 独立董事应对利润分配方案发表独立意见。

(3) 董事会审议通过利润分配方案后由股东会审议并经出席股东会的股东所持表决权的过半数通过，公告董事会决议时应同时披露独立董事的审核意见。

(4) 公司当年盈利董事会未提出现金利润分配预案的，应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表审核意见。

(5) 公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。公司将通过多种途径（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）听取、接受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。

## 7、现金分红的决策程序

董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件等事宜，董事会提交股东会的现金分红的具体方案，应经董事会全体董事过半数表决通过，并经全体独立董事三分之二以上表决通过，由股东会审议并经出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

## 8、利润分配政策调整决策程序

公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性。如因公司自身经营情况、投资规划和长期发展的需要或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，提交股东会审议并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，在股东会提案时须进行详细论证和说明原因。

董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见。董事会审议通过调整利润分配政策议案的，应经董事会全体董事过半数表决通过，经全体独立董事三分之二以上表决通过。独立董事须发表独立意见，并及时予以披露。

### 9、利润分配政策的披露

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

- (1) 是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求；
- (2) 分红标准和比例是否明确和清晰；
- (3) 相关的决策程序和机制是否完备；
- (4) 公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等；
- (5) 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

公司若当年不进行或低于《公司章程（草案）》规定的现金分红比例进行利润分配的，公司董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对未分红原因、未分红的资金留存公司的用途发表独立意见，有关利润分配的议案需经公司董事会审议后提交股东会批准，并在股东会提案中详细论证说明原因及留存资金的具体用途。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

### （三）上市后三年的股东分红回报规划

公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《江苏中科科化新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内股东分红回报规划》，主要内容为：

#### 1、股东回报规划制定考虑因素

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾

公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司的长期可持续发展，综合考虑公司所处行业发展趋势、公司实际经营情况、未来发展规划、公司现金流状况、股东对于分红回报的意见和诉求等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

## 2、股东回报规划制定原则

公司的股东回报规划应充分考虑和听取独立董事、股东特别是中小股东的意愿和要求，实行持续、稳定的现金股利和股票股利相结合的利润分配政策，并兼顾公司的可持续发展。

## 3、公司上市后三年股东回报规划

### (1) 利润分配形式及间隔期:

公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先采取现金方式分配股利。

在符合条件的情况下，公司原则上每年至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

### (2) 现金分红条件及比例

公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：

- ①公司当年盈利且累计未分配利润为正；
- ②公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；
- ③审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：

- ①公司当年度未实现盈利；
- ②公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；
- ③公司期末资产负债率超过 70%；
- ④公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，且公司已在公开披露文件中对相关计划进行说明，进行现金分红将可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形：

- ①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过 3,000 万元；
- ②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超

过公司最近一期经审计总资产的 5%。

#### 现金分红比例的规定

公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以同时派发股票股利。

公司进行现金分红时，现金分红的比例也应遵照以下要求：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资产支出安排和投资者回报等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。

公司在实际分红时根据具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（3）股票股利分配条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

#### 4、分红回报规划的制定周期和决策机制

公司至少每三年重新审议一次股东分红回报三年规划，公司董事会应根据股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该段时间的股东回报计划，并提交股东会表决。

公司若当年不进行或低于《公司章程（草案）》规定的现金分红比例进行利润分配的，公司董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对未分红原因、未分红的资金留存公司的用途发表独立意见，有关利润分配的议案需经公司董事会审议后提交股东会批准，并在股东会提案中详细论证说明原因及留存资金的具体用途。

董事会提交股东会的股利分配具体方案，应经董事会全体董事过半数表决通过，并经全体独立董事三分之二以上表决通过。独立董事应对利润分配方案发表

独立意见。董事会审议通过利润分配方案后由股东会审议并经出席股东会的股东所持表决权的过半数通过，公告董事会决议时应同时披露独立董事的审核意见。

公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性。如因公司自身经营情况、投资规划和长期发展的需要或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，提交股东会审议并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，在股东会提案时须进行详细论证和说明原因。

董事会拟定调整利润分配政策议案过程中，应当充分听取股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见。董事会审议通过调整利润分配政策议案的，应经董事会全体董事过半数表决通过，经全体独立董事三分之二以上表决通过。独立董事须发表独立意见，并及时予以披露。

### **三、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，不存在尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情况**

截至本招股说明书签署日，公司不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，不存在尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情形。

## 第十节 其他重要事项

### 一、重大合同

#### (一) 重大销售合同

重大销售合同是指公司与前五大客户签订的销售框架合同,或者双方合作过程中未签订框架合同情况下金额超过 100 万元的订单。截至报告期末,公司已履行和正在履行的重大销售合同如下:

单位: 万元

序号	客户名称 (合并口径)	客户名称 (单体)	合同类型	合同金额	履行期限/签订日期	履行情况
1	华润微	无锡华润华晶微电子有限公司	框架合同	以实际订单为准	2023.07-2025.06	已于 2025 年 7 月到期, 双方已签署新合同
			框架合同	以实际订单为准	2021.09-2023.06	履行完毕
		无锡华润安盛科技有限公司	框架合同	以实际订单为准	2023.12-2026.12	正在履行
		华润润安科技(重庆)有限公司	框架合同	以实际订单为准	2023.08-2026.08	正在履行
		杰群电子科技(东莞)有限公司	框架合同	以实际订单为准	2024.01-2026.12	正在履行
2	捷捷微电	江苏捷捷微电子股份有限公司	框架合同	以实际订单为准	2025.01-2026.12, 合同到期后双方无异议自动顺延 1 年	正在履行
			框架合同	以实际订单为准	2024.01-2024.12	履行完毕
			框架合同	以实际订单为准	2023.01-2023.12	履行完毕
			框架合同	以实际订单为准	2022.01-2022.12	履行完毕
		捷捷半导体有限公司	框架合同	以实际订单为准	2025.01-2026.12, 合同到期后双方无异议自动顺延 1 年	正在履行
			框架合同	以实际订单为准	2024.01-2024.12	履行完毕
			框架合同	以实际订单为准	2022.01-2022.12	履行完毕
3	蓝箭电子	佛山市蓝箭电子股份有限公司	框架合同	以实际订单为准	2025.02-2027.02, 合同到期后双方无异议自动延长	正在履行
			框架合同	以实际订单为准	2024.01-2025.02	履行完毕
			框架合同	以实际订单为准	2022.01-2023.12	履行完毕
4	研导电子	东莞市研导电子材料有限公司	框架合同	以实际订单为准	2025.04-2027.04, 合同到期后双方无异议自动延长	正在履行
			框架合同	以实际订单为准	2023.10-2025.04	履行完毕
			框架合同	以实际订单为准	2022.01-2023.10	履行完毕
		东莞市晶浦电子材料有限公司	框架合同	以实际订单为准	2020.03-2023.03	履行完毕
		东莞市晶浦电子科技有限公司	框架合同	以实际订单为准	2025.03-2027.03, 合同到期后双方无异议自动延长	正在履行
			框架合同	以实际订单为准	2024.07-2025.03	履行完毕

序号	客户名称 (合并口径)	客户名称 (单体)	合同类型	合同金额	履行期限/签订日期	履行情况
		东莞市莞半微电子科技有限公司	框架协议	以实际订单为准	2023.11-2024.07	履行完毕
			框架协议	以实际订单为准	2024.07-2026.07, 合同到期后双方无异议自动延长	正在履行
			框架协议	以实际订单为准	2024.04-2024.07	履行完毕
5	华天集团	华羿微电子股份有限公司	框架协议	以实际订单为准	2023.04-2025.04, 协议到期后自动延续1年	正在履行
			框架协议	以实际订单为准	2020.03-2023.03	履行完毕
		天水华天科技股份有限公司	框架协议	预计金额 262.45 万元, 具体以订单为准	2025.05 至双方重新签订合同为止	正在履行
			框架协议	预计金额 262.45 万元, 具体以订单为准	2024.06-2025.05	履行完毕
			框架协议	预计金额 202.97 万元, 具体以订单为准	2023.05-2024.06	履行完毕
		广东韶华科技有限公司	框架协议	预计金额 268.97 万元, 具体以订单为准	2021.11-2023.05	履行完毕
			框架协议	以实际订单为准	2025.01-2026.12, 合同到期后双方无异议自动延长	正在履行
6	亚芯微电	浙江亚芯微电子股份有限公司	框架协议	以实际订单为准	2025.03-2027.03, 合同到期后双方无异议自动延长	正在履行
			框架协议	以实际订单为准	2023.01-2025.03	履行完毕
			框架协议	以实际订单为准	2020.03-2022.12	履行完毕
		安徽亚芯微电子有限公司	框架协议	以实际订单为准	2025.03-2027.03, 合同到期后双方无异议自动延长	正在履行
		贵州亚芯微电子有限公司	框架协议	以实际订单为准	2025.03-2027.03, 合同到期后双方无异议自动延长	正在履行
7	华达微	南通华达微电子集团股份有限公司	框架协议	以实际订单为准	2025.03-2027.03, 合同到期后双方无异议自动延长	正在履行
			框架协议	以实际订单为准	2023.01-2025.03	履行完毕
			框架协议	以实际订单为准	2020.03-2022.12	履行完毕
		通富微电子股份有限公司	框架协议	以实际订单为准	2025.03-2027.03, 合同到期后双方无异议自动延续1年	正在履行
8	兴航科技	郑州兴航科技有限公司	订单	297.00	2024.08	履行完毕
			订单	299.75	2024.05	履行完毕
			订单	299.75	2024.02	履行完毕
			订单	136.25	2024.01	履行完毕
			订单	163.50	2023.12	履行完毕
			订单	190.75	2023.05	履行完毕
			订单	190.75	2023.02	履行完毕

注：1、以上销售合同的销售内容均为环氧塑封料。

2、公司与无锡华润华晶微电子有限公司签署的《封装材料采购合同》（即框架合

同)约定：“若供需双方达成寄售服务的，则按买卖双方另行签署的寄售合同执行”。在此基础上，双方已另行签订《寄售合约》，有效期覆盖2020年4月至2027年3月。

## (二) 重大原材料采购合同

重大原材料采购合同是指公司与前五大供应商签订的采购框架合同，或者双方合作过程中未签订框架合同情况下金额超过100万元人民币(或等值外币)的订单。截至报告期末，公司已履行和正在履行的重大原材料采购合同如下：

序号	供应商名称(合并口径)	供应商名称(单体)	合同类型	采购内容	合同金额	合同期限/签订日期	履行情况
1	联瑞新材	江苏联瑞新材料股份有限公司	框架合同	硅微粉	以实际订单为准	2025.05-2028.05, 合同到期后双方未另行签订终止协议，自动延续两年	正在履行
2	圣泉集团	山东圣泉新材料股份有限公司	框架合同	环氧树脂 酚醛树脂	以实际订单为准	2025.05-2028.05, 合同到期后双方未另行签订终止协议，自动延续两年	正在履行
		山东圣泉电子材料有限公司	框架合同		以实际订单为准	2025.05-2028.05, 合同到期后双方未另行签订终止协议，自动延续两年	正在履行
3	衡封新材	上海衡封新材料科技有限公司	框架合同	酚醛树脂	以实际订单为准	2025.05-2028.05, 合同到期后双方未另行签订终止协议，自动延续两年	正在履行
4	中恒新材	蚌埠中恒新材料科技有限责任公司	框架合同	硅微粉	以实际订单为准	2025.05-2028.05, 合同到期后双方未另行签订终止协议，自动延续两年	正在履行
5	邦陆通商	邦陆通商株式会社	订单	环氧树脂 酚醛树脂	18.23万美元	2025.01	履行完毕
			订单		17.28万美元	2024.07	履行完毕
			订单		16.36万美元	2024.06	履行完毕
			订单		15.08万美元	2024.05	履行完毕
			订单		13.02万美元	2023.10	履行完毕
			订单		14.07万美元	2023.04	履行完毕
			订单		13.17万美元	2022.12	履行完毕
			订单		13.41万美元	2022.06	履行完毕
			订单		14.60万美元	2022.04	履行完毕
			订单		16.41万美元	2022.04	履行完毕
6	宇部兴产	宇部兴产(上海)有限公司	订单	酚醛树脂	127.37万元人民币	2024.12	履行完毕
			订单		105.96万元人民币	2024.07	履行完毕
			订单		143.49万元人民币	2024.05	履行完毕
			订单		273.23万元人民币	2024.01	履行完毕
			订单		137.22万元人民币	2023.12	履行完毕
			订单		127.57万元人民币	2023.11	履行完毕
			订单		117.50万元人民币	2023.06	履行完毕
			订单		163.58万元人民币	2023.02	履行完毕
			订单		185.20万元人民币	2023.01	履行完毕

序号	供应商名称 (合并口径)	供应商名称 (单体)	合同类型	采购内容	合同金额	合同期限/签订日期	履行情况
			订单		137.42 万元人民币	2022.12	履行完毕
			订单		131.18 万元人民币	2022.06	履行完毕
			订单		103.03 万元人民币	2022.05	履行完毕
			订单		126.82 万元人民币	2022.03	履行完毕
			订单		128.72 万元人民币	2022.03	履行完毕
			订单		125.77 万元人民币	2022.01	履行完毕
			订单		150.37 万元人民币	2021.12	履行完毕

### (三) 重大借款合同

重大借款合同是指公司签订的金额超过 1,000 万元的借款合同。截至报告期末，公司已履行和正在履行的重大借款合同如下：

单位：万元

序号	贷款银行	合同金额	担保方式	借款日	还款日	履行情况
1	中国农业银行泰州海陵支行	4,400.00	卢绪奎与北京科化提供最高额连带责任保证担保； 发行人提供不动产最高额抵押	2021.08.23 [注 1]	2022.05.06	履行完毕
		1,000.00	卢绪奎与北京科化提供最高额连带责任保证担保	2022.05.26	2022.08.31	履行完毕
		1,500.00	卢绪奎提供最高额连带责任保证担保	2022.05.30	2023.04.12	履行完毕
		4,000.00	无	2022.08.24 [注 2]	2023.08.31	履行完毕
		1,500.00	卢绪奎提供最高额连带责任保证担保	2023.04.27 [注 3]	2024.04.16	履行完毕
		1,500.00	卢绪奎提供最高额连带责任保证担保	2023.07.13 [注 4]	2024.07.01	履行完毕
		1,200.00	卢绪奎提供最高额连带责任保证担保	2023.07.24	2024.07.23	履行完毕
		1,800.00	卢绪奎提供最高额连带责任保证担保	2023.09.07	2024.09.03	履行完毕
		1,200.00	卢绪奎提供最高额连带责任保证担保	2024.07.22	2024.10.28	履行完毕
		1,200.00	无	2024.10.22	2025.10.15	已于 2025 年 10 月履行完毕
2	建设银行泰州新区支行	1,000.00	无	2025.01.14	2026.01.13	正在履行
		1,000.00	无	2025.03.25	2026.03.24	正在履行
		1,800.00	无	2024.08.30	2027.08.30	正在履行

注：1、公司于 2021 年 8 月 23 日提款 3,000 万元，于 2022 年 5 月 6 日全部还款；公司于 2021 年 9 月 1 日提款 1,400 万元，分别于 2022 年 4 月 29 日还款 1,100 万元、于 2022 年 5 月 6 日还款 300 万元。

2、公司于 2022 年 8 月 24 日提款 2,200 万元，分别于 2023 年 7 月 20 日还款 1,200 万元、于 2023 年 7 月 25 日还款 1,000 万元；公司于 2022 年 9 月 5 日提款 1,800 万元，于 2023 年 8 月 31 日全部还款。

3、公司于 2023 年 4 月 27 日提款 500 万元，于 2024 年 4 月 16 日全部还款；公司

于 2023 年 6 月 25 日提款 1,000 万元，于 2024 年 2 月 29 日全部还款。

4、公司于 2023 年 7 月 13 日提款 500 万元，于 2024 年 4 月 16 日全部还款；公司于 2023 年 7 月 19 日提款 1,000 万元，于 2024 年 7 月 1 日全部还款。

#### （四）重大建设工程合同

截至报告期末，公司已履行和正在履行的合同金额超过 500 万元的重大建设工程合同如下：

单位：万元

序号	合同相对方名称	合同类型	合同内容	合同金额	签订日期	履行情况
1	江苏大都建设工程有限公司	工程合同及补充协议	公司半导体封装材料工厂二期工程	10,415.30	2022.04	除质保金以外其他已履行完毕
				237.78	2023.01	
2	泰州市兴泰制冷设备有限公司、泰兴市机电设备安装有限公司	工程合同	公司一期恒温恒湿空调系统	578.00	2022.11	履行完毕

## 二、对外担保情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在对外担保的情形。

## 三、重大诉讼或仲裁情况

### （一）发行人重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在标的金额超过 1,000 万元的尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁。公司存在 5 宗标的金额超过 100 万元的未决诉讼或仲裁，具体情况如下：

1、原告蚌埠市诚信商品混凝土有限公司与被告中科科化、第三人江苏大都建设工程有限公司债权人代位权纠纷一案

2025 年 4 月，蚌埠市诚信商品混凝土有限公司（以下简称“蚌埠诚信”）主张江苏大都建设工程有限公司（以下简称“大都建设”）尚欠其货款、违约金及利息 210.00 万元，认为大都建设作为中科科化建设项目总承包方，中科科化尚有 283.75 万元质量保证金未向大都建设支付，蚌埠诚信据此以债权人代位权纠纷为由，将中科科化诉至泰州市海陵区人民法院，请求判令中科科化代替大都建设向蚌埠诚信支付货款、违约金及利息 210.00 万元及相应的逾期付款违约金、逾期利息、迟延履行期间的债务利息。

2025 年 7 月 22 日，泰州市海陵区人民法院作出《民事判决书》（（2025）苏 1202 民初 2855 号），判决：（1）中科科化于判决生效之日起十日内给付蚌

埠诚信 46.00 万元及利息；（2）驳回蚌埠诚信的其他诉讼请求。

中科科化不服上述判决，向泰州市中级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决，依法改判，判令驳回蚌埠诚信在一审的全部诉讼请求或发回一审法院，重新审理。

截至本招股说明书签署日，本案二审尚在审理中。

## 2、原告中科科化与被告大都建设工程施工合同纠纷一案

大都建设为中科科化半导体封装材料工厂二期工程项目总承包方，系前述蚌埠诚信与中科科化债权人代位权纠纷一案的第三人，中科科化对大都建设尚有 3% 工程款即质量保证金 283.75 万元未支付。

2025 年 10 月，中科科化以案涉工程在缺陷责任期内出现质量问题，而大都建设未履行维修义务为由，主张案涉工程的维修费用应该在前述 3% 工程款余款中进行扣减，超过部分大都建设应予以赔偿，将大都建设诉至泰州市海陵区人民法院，请求判令大都建设支付中科科化因工程质量问题造成的损失，扣除质保金后支付 27.40 万元。

截至本招股说明书签署日，本案尚在审理中。

## 3、原告东莞市通科电子有限公司与被告中科科化买卖合同纠纷一案

2025 年 2 月，东莞市通科电子有限公司（以下简称“通科电子”）以 2021 年 10 月至 2022 年 3 月期间向中科科化采购的 1 吨产品（总货款 3.82 万元）存在质量问题而导致通科电子遭受损失为由，将中科科化诉至泰州市海陵区人民法院，请求判令中科科化赔偿 169.13 万元。

截至本招股说明书签署日，本案尚在审理中。

## 4、原告中科科化与被告深圳锐骏买卖合同纠纷一案

2025 年 8 月，中科科化以深圳锐骏拖欠货款为由，将深圳锐骏诉至深圳市南山区人民法院，请求判令深圳锐骏支付拖欠的货款 268.34 万元及利息。

截至本招股说明书签署日，本案尚在审理中。

## 5、原告中科科化与被告江苏摩派半导体有限公司买卖合同纠纷一案

2025 年 10 月，中科科化以江苏摩派半导体有限公司（以下简称“江苏摩派”）拖欠货款为由，将江苏摩派诉至泰州市海陵区人民法院，请求判令江苏摩派支付拖欠的货款 113.30 万元及利息。

截至本招股说明书签署日，本案尚在审理中。

上述案件涉案金额占发行人最近一年经审计净资产的比例较低，对发行人的持续经营不构成重大不利影响。

## **（二）发行人控股股东、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项**

截至本招股说明书签署日，发行人不存在控股股东、董事、监事（监事会取消前在任）、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人可能对发行人产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书签署日，发行人控股股东北京科化存在一项向最高人民法院上诉的未决诉讼，请求最高人民法院撤销北京知识产权法院作出的一份《行政判决书》；发行人董事长、总经理卢绪奎存在一宗民间借贷未决诉讼，相关情况如下：

### **1、北京科化诉讼情况**

（1）昭和电工材料株式会社曾以北京科化销售的一款 LED 支架用塑封料侵害其发明专利为由，起诉北京科化专利侵权

2021 年 3 月，昭和电工材料株式会社（以下简称“昭和电工”）以北京科化销售的一款 LED 支架用塑封料侵害其在相关领域申请的中国发明专利“光反射用热固化性树脂组合物及其制造方法、及使用了所述树脂组合物的光半导体元件搭载用基板及光半导体装置”（专利号为 ZL 200780042463.2，以下简称“涉案专利”）为由，将北京科化诉至北京知识产权法院，请求判令：①北京科化立即停止实施侵害“涉案专利”的行为，包括停止制造、许诺销售和销售侵权产品，销毁侵权产品的制造模具和专用设备，以及从市场上撤回并销毁所有侵权产品；②北京科化向昭和电工赔偿 100.00 万元；③北京科化赔偿昭和电工在本案中制止侵权的合理支出 20.00 万元；④北京科化承担本案的诉讼费用。

（2）经北京科化申请，国家知识产权局宣告“涉案专利”全部无效，昭和电工遂撤回对北京科化的专利侵权之诉

2021 年 5 月，北京科化向国家知识产权局提出了针对“涉案专利”的无效宣告请求。

2022 年 1 月，国家知识产权局作出《无效宣告请求审查决定》（第 53229 号），宣告“涉案专利”全部无效。

昭和电工拥有的“涉案专利”被宣告全部无效后，昭和电工遂向北京知识产权法院申请撤回对北京科化的前述专利侵权起诉。2022年1月，北京知识产权法院作出《民事裁定书》（[2021]京73民初374号），准许昭和电工撤回对北京科化的起诉。

（3）昭和电工不服国家知识产权局作出的专利无效宣告决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼请求判决撤回专利无效宣告决定，一审支持昭和电工

昭和电工不服国家知识产权局作出的《无效宣告请求审查决定》（第53229号），以国家知识产权局为被告，北京科化为第三人，向北京知识产权法院提起行政诉讼，请求法院撤销《无效宣告请求审查决定》（第53229号），责令国家知识产权局重新作出决定。

2023年3月27日，北京知识产权法院作出《行政判决书》（（2022）京73行初6072号），判决：①撤销国家知识产权局作出的《无效宣告请求审查决定》（第53229号）；②国家知识产权局就北京科化针对“涉案专利”提出的无效宣告请求重新作出审查决定。

（4）北京科化不服北京知识产权法院作出的行政判决，向最高人民法院提起上诉

2023年4月，北京科化不服北京知识产权法院作出的《行政判决书》（（2022）京73行初6072号），向最高人民法院提起上诉，请求撤销北京知识产权法院于2023年3月27日作出的《行政判决书》（（2022）京73行初6072号）。

截至本招股说明书签署日，北京科化的上诉尚在审理中，原专利侵权之诉原告已撤诉。

北京科化所涉上述案件系因其生产销售LED支架用塑封料所引发的法律纠纷，与公司主营业务不相关，且原专利侵权之诉涉案金额较小，对北京科化亦不构成重大不利影响。

## 2、卢绪奎诉讼情况

2025年5月，梁雪庄以卢绪奎未偿还借款为由，将卢绪奎诉至上海市徐汇区人民法院，请求判令卢绪奎返还借款本金185.00万元及利息。

截至本招股说明书签署日，本案尚在审理中。

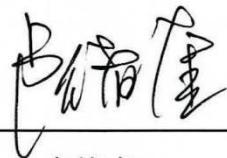
卢绪奎所涉上述案件系债权债务纠纷，不会对其在公司的任职资格产生重大不利影响。

## 第十一节 声明

### 一、发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

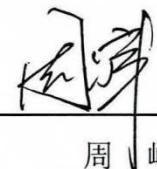
全体董事签字：



卢绪奎



傅东升



周 峰



王善学



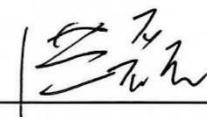
张文良



王 锐



潘 林



洪 磊



宋正奇

江苏中科科化新材料股份有限公司



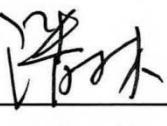
## 一、发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体审计委员会成员签字：



洪 磊



潘 林



傅东升

江苏中科科化新材料股份有限公司

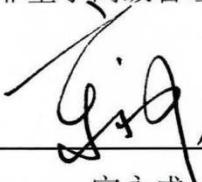
2025年11月30日



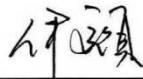
## 一、发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体非董事高级管理人员签字：

  
宋永成

  
姚 克

  
伊高领

江苏中科科化新材料股份有限公司

2015年11月30日



## 二、发行人控股股东声明

本公司承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。



北京科化新材料科技有限公司

法定代表人（签字）：张晓伟

张晓伟

2025年11月30日

### 三、保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行核查，确认招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人： 胡兆腾

胡兆腾

保荐代表人： 黄文雯

黄文雯

李思博

李思博

法定代表人： 霍达

霍达



**保荐人（主承销商）董事长、总经理声明**

本人已认真阅读江苏中科科化新材料股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

总经理：



朱江涛

法定代表人、董事长：



霍 达



#### 四、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

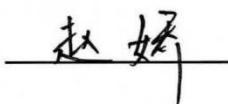
经办律师：



单震宇



吴江涛



赵 娇

律师事务所负责人：



颜克兵





致同会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号  
赛特广场 5 层 邮编 100004  
电话 +86 10 8566 5588  
传真 +86 10 8566 5120  
www.grantthornton.cn

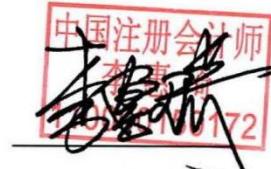
### 审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读江苏中科科化新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、内部控制审计报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制审计报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：



会计师事务所负责人：



## 六、资产评估机构声明

本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字资产评估师：



资产评估机构负责人：

陈圣龙

中京民信（北京）资产评估有限公司





致同会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号  
赛特广场 5 层 邮编 100004  
电话 +86 10 8566 5588  
传真 +86 10 8566 5120  
www.grantthornton.cn

### 验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读江苏中科科化新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：



傅智勇

张林福（已离职）

会计师事务所负责人：



李惠琦

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

2025 年 11 月 30 日





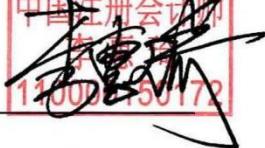
致同会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号  
赛特广场 5 层 邮编 100004  
电话 +86 10 8566 5588  
传真 +86 10 8566 5120  
www.grantthornton.cn

## 关于签字注册会计师离职的说明

本机构作为江苏中科科化新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的验资机构，出具了《验资报告》（致同验字（2022）第110C000702号），签字注册会计师为傅智勇和张林福同志。

张林福同志已从本机构离职，故无法在《江苏中科科化新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》之“验资机构声明”中签字。

会计师事务所负责人：



1100000072741

李惠琦





致同会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号  
赛特广场 5 层 邮编 100004  
电话 +86 10 8566 5588  
传真 +86 10 8566 5120  
www.grantthornton.cn

### 验资复核机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读江苏中科科化新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书，确认招股说明书与本机构出具的验资复核报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资复核报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：



会计师事务所负责人：



## 第十二节 附件

### 一、备查文件及文件查阅方式

#### （一）备查文件

- 1、发行保荐书；
- 2、上市保荐书；
- 3、法律意见书；
- 4、财务报告及审计报告；
- 5、公司章程（草案）；
- 6、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况；
- 7、与投资者保护相关的承诺；
- 8、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项；
- 9、内部控制审计报告；
- 10、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
- 11、股东会、董事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明；
- 12、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明；
- 13、募集资金具体运用情况；
- 14、其他与本次发行有关的重要文件。

#### （二）备查时间和地点

投资者于本次发行承销期间，可直接在上交所网站查询，也可到发行人和保荐机构（主承销商）的办公地点查询。查阅时间：工作日上午 9:30-11:30；下午 13:30-17:00。

## 二、公司专利情况

序号	发明名称	专利类型	专利申请日	专利号	专利权人	取得方式	权利限制
1	用于半导体器件封装的环氧树脂组合物及其制备方法	发明专利	2010. 8. 12	ZL 201010251906. 2	中科科化	自北京科化受让取得, 北京科化系原始取得该专利	无
2	包含一水合氧化铝的环氧树脂组合物	发明专利	2010. 9. 1	ZL 201010269969. 0	中科科化	自北京科化及其子公司受让取得, 北京科化及其子公司系原始取得该专利	无
3	一种半导体封装用的环氧树脂组合物的二次混炼方法	发明专利	2014. 12. 18	ZL 201410799095. 8	中科科化	原始取得	无
4	用于全包封器件的高导热环氧树脂组合物及其制备方法	发明专利	2014. 12. 22	ZL 201410805891. 8	中科科化	原始取得	无
5	小尺寸半导体封装用环保型环氧树脂组合物的制备方法	发明专利	2014. 12. 22	ZL 201410805292. 6	中科科化	原始取得	无
6	一种半导体封装用环保型环氧树脂组合物的制备方法	发明专利	2014. 12. 22	ZL 201410805158. 6	中科科化	原始取得	无
7	一种半导体封装用高粘接环氧塑封料	发明专利	2016. 12. 30	ZL 201611252886. 4	中科科化	原始取得	无
8	一种使用搅拌机制备的环氧树脂组合物制备方法	发明专利	2017. 12. 25	ZL 201711421518. 2	中科科化	原始取得	无
9	一种提高环氧树脂组合物封装的半导体器件可靠性的方法	发明专利	2018. 10. 31	ZL 201811288377. 6	中科科化	原始取得	无
10	一种半导体封装用超耐热、高导热环氧塑封料	发明专利	2018. 10. 31	ZL 201811290986. 5	中科科化	原始取得	无
11	一种半导体封装用超耐热、高导热环氧塑封料的制备方法	发明专利	2018. 10. 31	ZL 201811297744. 9	中科科化	原始取得	无

序号	发明名称	专利类型	专利申请日	专利号	专利权人	取得方式	权利限制
12	一种模塑料用环氧树脂组合物及其制备方法	发明专利	2018.10.31	ZL 201811288575.2	中科科化	原始取得	无
13	一种半导体封装用高导热低应力环氧塑封料	发明专利	2019.12.23	ZL 201911338577.2	中科科化	原始取得	无
14	一种有机膨润土改性半导体封装用高强度高耐热环氧塑封料及其制备方法	发明专利	2019.12.23	ZL 201911337660.8	中科科化	原始取得	无
15	一种半导体封装用浅色耐黄变的环氧树脂组合物	发明专利	2019.12.27	ZL 201911374079.3	中科科化	原始取得	无
16	一种用于封装电感的热固性环氧树脂组合物及其制备方法	发明专利	2020.7.28	ZL 202010735145.1	中科科化	原始取得	无
17	一种高耐热、低应力环氧塑封料及其制备方法	发明专利	2020.10.21	ZL 202011131475.6	中科科化	原始取得	无
18	一种高功率模块封装用高导热环氧塑封料及其制备方法	发明专利	2020.10.21	ZL 202011129912.0	中科科化	原始取得	无
19	一种半导体封装用轻质环氧树脂组合物	发明专利	2020.12.23	ZL 202011539332.9	中科科化	原始取得	无
20	一种改善半导体封装外观的环氧树脂组合物及其制备方法	发明专利	2020.12.23	ZL 202011535185.8	中科科化	原始取得	无
21	一种利用废旧塑封料制备透水砖的方法	发明专利	2020.12.23	ZL 202011535130.7	中科科化	原始取得	无
22	环氧树脂组合物、环氧树脂塑封料及其制备方法和应用	发明专利	2021.12.29	ZL 202111642682.2	中科科化	原始取得	无
23	环氧树脂组合物及其应用、环氧树脂及其制备方法	发明专利	2021.12.30	ZL 202111654717.4	中科科化	原始取得	无
24	环氧树脂组合物及其制备方法与应用、环氧树脂及其应用	发明专利	2021.12.30	ZL 202111650856.X	中科科化	原始取得	无
25	环氧树脂组合物及其制备方法和应用	发明专利	2021.12.30	ZL 202111656963.3	中科科化	原始取得	无
26	环氧树脂组合物及其应用、环氧树脂及其制备方法与应用	发明专利	2021.12.30	ZL 202111652386.0	中科科化	原始取得	无
27	环氧树脂组合物及其应用、环氧树脂及其制备方法与应用	发明专利	2021.12.31	ZL 202111660267.X	中科科化	原始取得	无

序号	发明名称	专利类型	专利申请日	专利号	专利权人	取得方式	权利限制
28	一种环氧树脂材料及其制备方法	发明专利	2022. 9. 1	ZL 202211065184. 0	中科科化	原始取得	无
29	一种环氧树脂成型材料及其制备方法与应用	发明专利	2022. 9. 5	ZL 202211077532. 6	中科科化	原始取得	无
30	一种环氧树脂材料及其制备方法	发明专利	2022. 9. 5	ZL 202211077534. 5	中科科化	原始取得	无
31	一种环氧树脂材料及其制备方法与应用	发明专利	2022. 9. 14	ZL 202211113183. 9	中科科化	原为北京科化及 发行人原始取得 的共有专利，后变 更为发行人单独 享有	无
32	一种以废旧塑封料为原料进行硅粉再生的方 法、再生硅粉、TO 封装用环氧塑封料	发明专利	2022. 10. 25	ZL 202211308617. 0	中科科化	原始取得	无
33	一种氧化聚乙烯蜡改性固化剂及其制备方法 和环氧塑封料及其应用	发明专利	2022. 12. 27	ZL 202211684852. 8	中科科化	原始取得	无
34	一种有机磷化合物的制备方法、环氧塑封料 及其应用	发明专利	2022. 12. 29	ZL 202211713296. 2	中科科化	原始取得	无
35	一种粉料收集器	实用新型专利	2018. 10. 31	ZL 201821783135. X	中科科化	原始取得	无
36	一种微型雾化喷头	实用新型专利	2019. 11. 26	ZL 201922065910. 9	中科科化	原始取得	无
37	除粉装置	实用新型专利	2016. 4. 29	ZL 201620376328. 8	中科科化	原始取得	无
38	转盘式自动除铁器	实用新型专利	2016. 4. 29	ZL 201620376330. 5	中科科化	原始取得	无
39	注塑机用模具辅助治具	实用新型专利	2022. 11. 15	ZL 202223040734. 1	中科科化	原始取得	无
40	一种饼料排队出料装置	实用新型专利	2024. 8. 23	ZL 202422056943. 8	中科科化	原始取得	无
41	一种颗粒或粉料破拱装置	实用新型专利	2024. 8. 23	ZL 202422056946. 1	中科科化	原始取得	无
42	一种注塑机注塑压力稳定装置	实用新型专利	2024. 8. 28	ZL 202422091481. 3	中科科化	原始取得	无
43	一种树脂混料磨料装置	实用新型专利	2024. 9. 4	ZL 202422165882. 9	中科科化	原始取得	无
44	一种模塑料料片提升装置	实用新型专利	2024. 9. 4	ZL 202422165886. 7	中科科化	原始取得	无
45	一种离心造粒装置	实用新型专利	2024. 9. 9	ZL 202422200912. 5	中科科化	原始取得	无

### 三、中科院化学所、京泰君联、泰富投资控制企业情况

#### (一) 中科院化学所直接或间接控制的企业

序号	企业名称	成立日期	注册资本(万元)	持股比例	主营业务	是否与公司从事相同或相似业务
1	北京中科北化科技管理有限公司	2021年10月21日	500.00	中科院化学所持股100%	技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询；计算机系统服务；企业管理；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；市场调查；经济贸易咨询；教育咨询（中介服务除外）；文化咨询；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；会议服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	否
2	北京新化正隆科技有限公司	1997年5月21日	115.00	北京中科北化科技管理有限公司持股100%	制造叶面肥；农产品及叶面肥的技术开发、技术服务、技术咨询；生产有机肥料及微生物肥料制造、其他肥料制造（限外阜从事生产经营活动）；销售化肥、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	否

#### (二) 京泰君联直接或间接控制的企业

截至本招股书签署日，京泰君联无直接或间接控制的企业。

### (三) 泰富投资直接或间接控制的企业

序号	企业名称	成立日期	注册资本(万元)	持股比例	经营范围	是否与公司从事相同或相似业务
1	泰州东星精密机器有限公司	2004年4月26日	4,852.92	泰富投资持股100%	生产精密冲压件、精密电器零部件、模具标准件、敏感元器件，道路普通货运；瓦楞纸板、纸质包装箱、木制包装箱、通用机械零部件制造、加工、销售；包装装潢印刷品印刷；海绵、泡沫制品、塑料包装袋、塑料板及型材销售；金属材料销售。 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：太阳能热发电产品销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；金属制品研发；五金产品研发；机械设备研发；食品添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	否
2	泰州泰富嘉园大酒店有限公司	2019年6月20日	50.00	泰州东星精密机器有限公司持股100%	食品经营（按《食品经营许可证》所列项目经营）；住宿服务；洗浴服务；酒店管理；会议服务；卷烟零售；服装、鞋帽、箱包、皮革制品、工艺美术品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	否
3	泰州市润峰电子科技有限公司	2018年8月13日	1,000.00	泰富投资持股100%	电子产品、计算机软硬件、通信设备、工业自动化设备、防爆电器研发、销售；一般经济信息咨询（不含投资、理财、金融）；计算机系统集成、通信工程、建筑智能化工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。纸制品制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；海绵制品销售；钢压延加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	否

## 四、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况查阅时间和地点

### （一）落实投资者关系管理相关规定的安排

为了加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司制定了上市后适用的《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，建立起符合上市要求的信息披露和投资者关系管理体系，以确保信息披露的真实、完整、准确、及时。

#### 1、信息披露制度和流程

为规范公司信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，发行人根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程（草案）》的有关规定，制定了《信息披露管理制度》，明确了公司管理人员在信息披露中的责任和义务。该制度有助于加强公司与投资者之间的信息沟通，提升规范运作和公司治理水平，为投资者尤其是中小投资者提供了制度保障。

本次发行上市后，发行人将严格执行上述制度与办法，保障投资者的知情权、决策参与权，切实保护投资者的合法权益。

#### 2、投资者沟通渠道的建立情况

公司第一届董事会第八次会议审议通过了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的目的和原则、内容和方式、组织与实施等进行了明确规定，以加强公司与投资者之间的信息沟通，切实建立公司与投资者的良好沟通平台，完善公司治理，切实保护投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系。

#### 3、未来开展投资者关系管理的规划

公司将按照《投资者关系管理制度》的相关要求，以充分披露信息、合规披露信息、投资者机会均等、诚实守信、高效低耗、互动沟通为原则，通过充分的

信息披露与交流，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。

## （二）股利分配决策程序

公司股利分配决策程序具体情况参见本招股说明书“第九节 投资者保护 二、发行人股利分配政策”。

## （三）股东投票机制建立情况

公司第一届董事会第八次会议，2025年第二次临时股东大会审议通过了《公司章程（草案）》《股东会议事规则》《累积投票制实施细则》《股东会网络投票实施细则》等相关制度，就累积投票制、中小投资者单独计票机制、网络投票机制、征集投票制等内容作了详细的规定，在治理制度层面上对投资者依法享有参与重大决策和选择管理者的权利进行有效保障。

### 1、累计投票制

股东会就选举董事进行表决时，根据法律、法规、《公司章程》的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。公司在选举二名及以上董事时应实行累积投票制度。股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。

### 2、中小投资者单独计票机制

股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。

### 3、网络投票方式安排

公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东会提供便利。公司股东会采用网络或其他方式的，应当在股东会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。

### 4、征集投票权的相关安排

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

## 五、与投资者保护相关的承诺

### （一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺

#### 1、控股股东承诺

公司控股股东北京科化承诺：

##### （1）关于股份锁定相关承诺

①自发行人股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由发行人回购本公司持有的该部分股份。若因发行人进行权益分派等导致本公司持有的发行人股份发生变化的，本公司仍遵守上述承诺。

②发行人股票上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票时的发行价（以下简称“发行价”），或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于发行价，上述锁定期自动延长 6 个月。如发行人发生分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价按照相关规定作相应调整。

③发行人上市当年较上市前一年净利润（以扣除非经常性损益后归母净利润为准，下同）下滑 50%以上的，延长本公司届时所持股份锁定期限 6 个月；发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延长本公司届时所持股份锁定期限 6 个月；发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前两项基础上延长本公司届时所持股份锁定期限 6 个月。

前述“届时所持股份”分别指本公司上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年发行人年报披露时仍持有的股份。

④若发行人存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本公司不减持直接或间接所持发行人股份。

⑤如法律、法规或证券监管机构对股份锁定期等事项另有规定的，本公司承诺将同时遵守该等规定。

##### （2）持股意向及减持意向

①本公司看好发行人的业务发展前景并全力支持发行人的发展，拟长期持有

发行人股份，在锁定期内，不会进行任何违反相关规定及承诺的股份减持行为。在所持发行人股份锁定期届满后，本公司仍将继续秉承长期持有、不轻易减持的原则，严格遵守有关法律法规、中国证监会、上海证券交易所相关规则，审慎制定合理的股票减持计划，并及时、准确地履行信息披露义务。

#### ②减持的前提条件

如本公司在锁定期届满后 24 个月内拟减持发行人首发前股份的，应满足以下前提条件：

- A. 上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有则顺延；
- B. 未发生相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所业务规则所规定的上市公司控股股东不得减持股份的情形。

#### ③减持方式

本公司减持所持发行人股份的方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本公司承诺相关减持安排将符合相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所业务规则的规定。

#### ④减持价格

本公司在锁定期届满后 24 个月内减持发行人首发前股份的，减持价格不低于发行价。如发行人发生分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价按照相关规定作相应调整。

#### ⑤减持数量

A. 本公司在锁定期届满后 24 个月内减持发行人首发前股份的，每 12 个月减持股份数量不超过本公司所持发行人股份总数的 20%，且确保发行人有明确的控制权安排。

B. 本公司减持所持有的发行人首发前股份的数量将遵守届时适用的法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所的相关规定：（a）采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 1%；（b）采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 2%；（c）采取协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于发行人股份总数的 5%。如前述法律法规、监管规则发生变化，则本公司在减持发行人股份时将执行届时适用的最新法律法规、监管规则。

⑥本公司承诺本公司在持有发行人股份高于 5%期间减持发行人股票的，将

根据中国证监会、上海证券交易所届时有效的相关法律、法规对信息披露的规定，在减持前 3 个交易日予以公告。通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易首次减持股份的 15 个交易日前向上海证券交易所报告并预先披露减持计划，通过其他方式减持公司股份时，将按照中国证监会、上海证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。本公司持有发行人股份低于 5%以下减持时，不再受前述约束，将按照中国证监会、上海证券交易所届时有效的、适用的相关规则进行减持。

⑦本公司承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。如相关法律法规、监管规则发生变化，则本公司在减持发行人股份时将执行届时适用的最新法律法规、监管规则。

以上承诺为本公司的真实意思表述。本公司违反上述承诺减持发行人股份的，所获得的收益归发行人所有；如因本公司未履行上述承诺给发行人或者其他投资者造成损失的，本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

## 2、持有公司股份的董事、高级管理人员关于所持股份流通限制及自愿锁定的承诺

持有公司股份的董事、高级管理人员卢绪奎、周峰、王善学、张文良、王锐、宋永成、姚克、伊高领承诺：

(1) 自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由发行人回购本人所持有的该等股份。若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍遵守上述承诺。

(2) 发行人股票上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票时的发行价（以下简称“发行价”），或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于发行价，上述锁定期自动延长 6 个月。如发行人发生分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价按照相关规定作相应调整。

(3) 若发行人存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定

或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本人不减持直接或间接所持发行人股份。

(4) 如法律、法规或证券监管机构对股份锁定期等事项另有规定的，本人承诺将同时遵守该等规定。

(5) 本人在锁定期届满后 24 个月内减持发行人首发前股份的，减持价格不低于发行价。如发行人发生分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价按照相关规定作相应调整。

(6) 上述锁定期届满后，在本人担任发行人董事和/或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%。离职后 6 个月内，本人不转让持有的发行人股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，本人应继续遵守前述规定及相关法律、法规、规范性文件关于董事、高级管理人员转让股份的其他规定。如本人为发行人的核心技术人员，自本人所持发行人首发前股份限售期满之日起 4 年内，本人每年转让的首发前股份不超过上市时所持发行人首发前股份总数的 25%（该减持比例可以累积使用）；离职后 6 个月内，本人不转让发行人首发前股份。（同时担任董事/高级管理人员和核心技术人员，每年可减持的股份数量以本条中较少的为准）

(7) 本人承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。如相关法律法规、监管规则发生变化，则本人在减持发行人股份时将执行届时适用的最新法律法规、监管规则。

(8) 本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。

以上承诺为本人的真实意思表示。本人违反上述承诺减持发行人股份的，减持所得归发行人所有；如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

### 3、持有公司股份的非董事、高级管理人员的核心技术人员关于所持股份流通限制及自愿锁定的承诺

持有公司股份的核心技术人员（非董事、高级管理人员）李刚、梅胡杰、张

之魁、闵玉勤承诺：

(1) 自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由发行人回购本人所持有的该等股份。若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍遵守上述承诺。

(2) 上述锁定期届满后，作为核心技术人员，本人离职后 6 个月内不转让所持有的发行人首发前股份；自本人所持发行人首发前股份限售期满之日起 4 年内，本人每年转让的首发前股份不超过上市时所持发行人首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。

(3) 本人承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。如相关法律法规、监管规则发生变化，则本人在减持发行人股份时将执行届时适用的最新法律法规、监管规则。

(4) 本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。

以上承诺为本人的真实意思表示。本人违反上述承诺减持发行人股份的，减持所得归发行人所有；如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

#### 4、持股 5%以上的股东国科瑞华承诺

(1) 关于股份锁定相关承诺

①自发行人股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人首次公开发行前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由发行人回购本企业所持有的该等股份。若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人股份发生变化的，本企业仍遵守上述承诺。

②如法律、法规或证券监管机构对股份锁定期等事项另有规定的，本企业承诺将同时遵守该等规定。

(2) 持股意向及减持意向

①本企业看好发行人的业务发展前景，持股意向明确，在锁定期内，不会进行任何违反相关规定及承诺的股份减持行为。在所持发行人股份锁定期届满后，

本企业将严格遵守有关法律法规、中国证监会、上海证券交易所相关规则，结合证券市场及本企业的经营发展等情况，制定合理的股票减持计划，逐步减持发行人部分或全部股份。

#### ②减持的前提条件

如本企业在锁定期届满后 24 个月内拟减持发行人首发前股份的，应满足以下前提条件：

- A. 上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有则顺延；
- B. 未发生相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所业务规则所规定的不得减持股份的情形。

#### ③减持方式

本企业减持所持发行人股份的方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本企业承诺相关减持安排将符合相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所业务规则的规定。

#### ④减持价格

本企业在锁定期满后 24 个月内减持发行人首发前股份的，减持价格根据届时的二级市场价格确定，且不低于届时法律、法规及规范性文件规定的价格下限。

#### ⑤减持数量

本企业减持所持有的发行人首发前股份的数量将遵守届时适用的法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所的相关规定：A. 采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 1%；B. 采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 2%；C. 采取协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于发行人股份总数的 5%。如前述法律法规、监管规则发生变化，则本企业在减持发行人股份时将执行届时适用的最新法律法规、监管规则。如本企业符合适用《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》及《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》的要求，则该等规定及细则的减持规定将优先于其他监管规则适用于本企业的减持。

⑥本企业承诺本企业在持有发行人股份高于 5%期间减持发行人股票的，将根据中国证监会、上海证券交易所届时有效的相关法律、法规对信息披露的规定，在减持前 3 个交易日予以公告。通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易首次

减持股份的 15 个交易日前向上海证券交易所报告并预先披露减持计划，通过其他方式减持公司股份时，将按照中国证监会、上海证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。本企业持有发行人股份低于 5%以下减持时，不再受前述约束，将按照中国证监会、上海证券交易所届时有效的、适用的相关规则进行减持。

⑦本企业承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。如相关法律法规、监管规则发生变化，则本企业在减持发行人股份时将执行届时适用的最新法律法规、监管规则。

以上承诺为本企业的真实意思表述。本企业违反上述承诺减持发行人股份的，所获得的收益归发行人所有；如因本企业未履行上述承诺给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

## 5、持股 5%以上的股东上海屹立承诺

### (1) 关于股份锁定相关承诺

①自发行人股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人首次公开发行前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由发行人回购本企业所持有的该等股份。若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人股份发生变化的，本企业仍遵守上述承诺。

②如法律、法规或证券监管机构对股份锁定期等事项另有规定的，本企业承诺将同时遵守该等规定。

### (2) 持股意向及减持意向

①本企业看好发行人的业务发展前景，持股意向明确，在锁定期内，不会进行任何违反相关规定及承诺的股份减持行为。在所持发行人股份锁定期届满后，本企业将严格遵守有关法律法规、中国证监会、上海证券交易所相关规则，结合证券市场及本企业的经营发展等情况，制定合理的股票减持计划，逐步减持发行人部分或全部股份。

### ②减持的前提条件

如本企业在锁定期届满后 24 个月内拟减持发行人首发前股份的，应满足以

下前提条件：

- A. 上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有则顺延；
- B. 未发生相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所业务规则所规定的不得减持股份的情形。

③减持方式

本企业减持所持发行人股份的方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本企业承诺相关减持安排将符合相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所业务规则的规定。

④减持价格

本企业在锁定期满后 24 个月内减持发行人首发前股份的，减持价格根据届时的二级市场价格确定，且不低于届时法律、法规及规范性文件规定的价格下限。

⑤减持数量

本企业减持所持有的发行人首发前股份的数量将遵守届时适用的法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所的相关规定：A. 采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 1%；B. 采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 2%；C. 采取协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于发行人股份总数的 5%。如前述法律法规、监管规则发生变化，则本企业在减持发行人股份时将执行届时适用的最新法律法规、监管规则。

⑥本企业承诺本企业在持有发行人股份高于 5%期间减持发行人股票的，将根据中国证监会、上海证券交易所届时有效的相关法律、法规对信息披露的规定，在减持前 3 个交易日予以公告。通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易首次减持股份的 15 个交易日前向上海证券交易所报告并预先披露减持计划，通过其他方式减持公司股份时，将按照中国证监会、上海证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。本企业持有发行人股份低于 5%以下减持时，不再受前述约束，将按照中国证监会、上海证券交易所届时有效的、适用的相关规则进行减持。

⑦本企业承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《上

海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。如相关法律法规、监管规则发生变化，则本企业在减持发行人股份时将执行届时适用的最新法律法规、监管规则。

以上承诺为本企业的真实意思表述。本企业违反上述承诺减持发行人股份的，所获得的收益归发行人所有；如因本企业未履行上述承诺给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

## 6、持股 5%以上的股东奋斗韶华承诺

### (1) 关于股份锁定相关承诺

①自发行人股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人首次公开发行前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不由发行人回购本企业所持有的该等股份。若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人股份发生变化的，本企业仍遵守上述承诺。

②如法律、法规或证券监管机构对股份锁定期等事项另有规定的，本企业承诺将同时遵守该等规定。

### (2) 持股意向及减持意向

①本企业作为发行人的员工持股平台，看好发行人的业务发展前景并全力支持发行人的发展，拟长期持有发行人股份，在锁定期内，不会进行任何违反相关规定及承诺的股份减持行为。在所持发行人股份锁定期届满后，本企业将严格遵守有关法律法规、中国证监会、上海证券交易所相关规则，审慎制定合理的股票减持计划，逐步减持。

### ②减持的前提条件

如本企业在锁定期届满后 24 个月内拟减持发行人首发前股份的，应满足以下前提条件：

- A. 上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有则顺延；
- B. 未发生相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所业务规则所规定的不得减持股份的情形。

### ③减持方式

本企业减持所持发行人股份的方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本企业承诺相关减持安排将符合相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所业务规则的规定。

④减持价格

本企业在锁定期满后 24 个月内减持发行人首发前股份的，减持价格根据届时的二级市场价格确定，且不低于届时法律、法规及规范性文件规定的价格下限。

⑤减持数量

A. 本企业在锁定期届满后 24 个月内减持发行人首发前股份的，每 12 个月减持股份数量不超过本企业所持发行人股份总数的 25%。

B. 本企业减持所持有的发行人首发前股份的数量将遵守届时适用的法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所的相关规定：（a）采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 1%；（b）采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的 2%；（c）采取协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于发行人股份总数的 5%。如前述法律法规、监管规则发生变化，则本企业在减持发行人股份时将执行届时适用的最新法律法规、监管规则。

⑥本企业承诺本企业在持有发行人股份高于 5%期间减持发行人股票的，将根据中国证监会、上海证券交易所届时有效的相关法律、法规对信息披露的规定，在减持前 3 个交易日予以公告。通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易首次减持股份的 15 个交易日前向上海证券交易所报告并预先披露减持计划，通过其他方式减持公司股份时，将按照中国证监会、上海证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。本企业持有发行人股份低于 5%以下减持时，不再受前述约束，将按照中国证监会、上海证券交易所届时有效的、适用的相关规则进行减持。

⑦本企业承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。如相关法律法规、监管规则发生变化，则本企业在减持发行人股份时将执行届时适用的最新法律法规、监管规则。

以上承诺为本企业的真实意思表述。本企业违反上述承诺减持发行人股份的，所获得的收益归发行人所有；如因本企业未履行上述承诺给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

## 7、其他股东的承诺

(1) 自发行人股票上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业所持有的该等股份。若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人股份发生变化的，本企业仍遵守上述承诺。

(2) 如法律、法规或证券监管机构对股份锁定期等事项另有规定的，本企业承诺将同时遵守该等规定。

(3) 本企业持有发行人股份期间，若股份锁定和股份变动（包括减持）的法律、法规、规范性文件或证券监管机构的规定发生变化，则本企业同意自动适用更新后的法律、法规、规范性文件及证券监管机构的规定。

以上承诺为本企业的真实意思表述。本企业违反上述承诺减持发行人股份的，所获得的收益归发行人所有；如因本企业未履行上述承诺给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

## (二) 稳定股价的措施和承诺

根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等有关规定，为稳定公司股价，保护中小股东和投资者利益，发行人制定了稳定公司股价的预案，发行人、控股股东、在发行人任职并领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员就发行人首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市后稳定股价的预案作出相关承诺，关于稳定公司股价的措施和承诺如下：

### 1、启动股价稳定措施的条件

自发行人股票上市之日起三年内，如非因不可抗力因素所致，发行人股票连续 20 个交易日（第 20 个交易日为“触发稳定股价措施日”；该等 20 个交易日的期限自发行人披露最近一期经审计的净资产之日起开始计算，如期间发行人披露了新的最近一期经审计的净资产，则该等 20 个交易日的期限需自发行人披露新的最近一期经审计的净资产之日起重新开始计算）的收盘价均低于发行人最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等导致发行人净资产或股份总数出现变化的事项的，则相应调整每股净资产，下同）时，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护发行人股价稳定，发行人将启动稳定股价的预案。

## 2、股价稳定的具体措施

### （1）稳定股价措施的实施顺序

当上述启动股价稳定措施的条件触发时，将按如下优先顺序采取部分或全部股价稳定措施，直至触发稳定股价预案的条件消除：

- ①发行人回购股票；
- ②发行人控股股东增持股票；
- ③在发行人任职并领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员增持发行人股票。

### （2）稳定股价措施的具体内容

当启动稳定股价措施的条件成就时，发行人及相关主体将按照如下措施稳定股价：

#### ①发行人回购股票

触发启动股价稳定措施条件成就的，发行人应当在相关条件成就之日起十个交易日内，召开董事会审议回购股票方案。发行人用于回购股票的资金总额不低于上一年度归属于母公司股东净利润的 10%，不超过上一年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%。发行人连续 12 个月内回购股票不超过发行人上一年度末股份总额的 2%。

发行人应在董事会作出实施回购股票决议之日起三十个交易日内召开股东大会，审议实施回购股票的议案，发行人股东会对实施回购股票作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

发行人应在股东会决议作出之日起 30 日内按照股东会决议通过的回购价格区间、回购数量、回购程序等实施完成回购，但出现以下情形的可提前终止回购：

- A. 通过实施回购股票，发行人股票连续五个交易日的收盘价均不低于发行人上一年度末经审计的每股净资产；
- B. 继续回购股票将导致发行人不满足法定上市条件。

单次实施回购股票完毕或终止后，就本次回购的发行人股票，发行人将按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定办理。

#### ②发行人控股股东增持股票

触发控股股东增持发行人股票条件成就的，发行人控股股东应当在相关条件成就之日起十个交易日内披露增持计划并在 30 日内启动增持股票程序。控股股

东增持股票应当符合法律、法规以及规范性文件的要求并及时履行信息披露义务，增持金额原则上不低于上一会计年度从发行人获得现金分红金额的 10%，不超过上一会计年度从发行人获得现金分红金额的 30%。控股股东连续 12 个月内增持股票不超过发行人上一会计年度末股份总额的 2%。发行人不得为控股股东实施股票增持计划提供任何形式的资金支持。

出现以下情形的，控股股东可提前终止继续股票增持计划：

- A. 通过增持发行人股票，发行人股票连续五个交易日的收盘价均不低于发行人上一会计年度末经审计的每股净资产；
- B. 继续增持股票将导致发行人不满足上市条件；
- C. 继续增持股票将触发控股股东要约收购义务。

③在发行人任职并领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员增持发行人股票

触发在发行人任职并领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员增持发行人股票条件成就的，上述人员应当在相关条件成就之日起十个交易日内披露增持计划并在 30 日内启动增持股票程序。在发行人任职并领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员增持股票应当符合法律、法规以及规范性文件的要求并及时履行信息披露义务，增持金额原则上不低于上一会计年度从发行人领取税后薪酬和股票现金分红（如有）的 10%，不超过上一会计年度从发行人领取税后薪酬和股票现金分红（如有）的 30%。

出现以下情形的，在发行人任职并领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员可提前终止股票增持计划：

- A. 通过增持发行人股票，发行人股票连续五个交易日的收盘价均不低于发行人上一会计年度末经审计的每股净资产；
- B. 继续增持股票将导致发行人不满足法定上市条件；
- C. 继续增持股票将触发要约收购义务。

### 3、约束保障措施

#### （1）控股股东约束措施

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如控股股东未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在发行人股东会及中国证监会指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如果控股

股东未履行上述承诺的，将在前述事项发生之日起停止在发行人处领取股东分红，同时控股股东持有的发行人股份将不得转让，直至控股股东按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。

（2）在发行人任职并领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员的约束措施

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如在发行人任职并领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，将在发行人股东会及中国证监会指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如果在发行人任职并领取薪酬的董事（不含独立董事）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，则其将在前述事项发生之日起5个工作日内停止在发行人处领取薪酬或股东分红（如有），同时其持有的发行人股份（如有）不得转让，直至其按上述预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。

（3）发行人的约束措施

在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东会及中国证监会指定媒体上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东会审议，尽可能地保护公司投资者利益。

### （三）股份回购和股份买回的措施和承诺

#### 1、发行人承诺

（1）如发行人首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，对判断发行人是否符合法律规定发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股。

（2）自中国证监会或其他有权部门认定发行人首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的招股说明书存在上述情形之日起五个工作日内，发行人董事会将召集股东会审议关于回购首次公开发行的全部股票的议案。股东会审议

通过回购方案后，发行人将按照回购方案依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息。若发行人本次发行上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，回购价格将相应进行调整。

(3) 如法律、法规、规章、规范性文件另有规定或证券监管机构、证券交易所另有要求的，发行人将按照届时有效的相关法律、法规、规章、规范性文件或者证券监管机构、证券交易所的要求履行回购义务。

## 2、控股股东承诺

控股股东北京科化承诺：

(1) 如经中国证监会、上海证券交易所或其他有权部门认定，发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，对判断发行人是否符合法律法规规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，且本公司将购回已转让的原限售股股份（如有）。

(2) 如经中国证监会、上海证券交易所或其他有权部门认定，发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将严格遵守《证券法》等法律法规的规定，按照中国证监会、上海证券交易所或其他有权部门认定或者裁定，依法赔偿投资者损失，尽可能保护投资者的权益。

## （四）对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺

### 1、发行人承诺

(1) 保证发行人首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

(2) 如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，发行人将在本次发行上市被中国证监会或其他有权部门认定为欺诈发行的5个工作日内启动股份回购程序，回购发行人本次发行上市的全部新股。回购价格为发行价格（指发行人首次公开发行股票的发行价格）加上首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息。若发行人本次发行上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，回购价格将相应进行调整。如届时相关法律、法规、规章、规范性文件对欺诈发行股份回购事宜另有规定的，

发行人将遵守相关规定。

## 2、控股股东承诺

控股股东北京科化承诺：

(1) 保证发行人首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

(2) 如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在发行人本次发行上市被中国证监会或其他有权部门认定为欺诈发行的5个工作日内启动股份回购程序，回购发行人本次发行上市的全部新股。回购价格为发行价格（指发行人首次公开发行股票的发行价格）加上首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息。若发行人本次发行上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，回购价格将相应进行调整。如届时相关法律、法规、规章、规范性文件对欺诈发行股份回购事宜另有规定的，本公司将遵守相关规定。

## （五）填补被摊薄即期回报的措施及承诺

### 1、发行人的措施及承诺

#### (1) 填补被摊薄即期回报的措施

##### ①保证募集资金规范、有效使用

本次发行募集资金到账后，发行人将根据董事会决议开设募集资金专项账户，并与开户行、保荐机构签订募集资金三方监管协议，确保募集资金专款专用。同时，发行人将严格遵守募集资金管理制度的规定，积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金规范、有效使用，合理防范募集资金使用风险。

##### ②积极、稳妥地实施募集资金投资项目，力争实现项目预期回报

本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、行业发展趋势与发行人发展战略，可进一步提高发行人的盈利能力与综合竞争力。本次募集资金到位后，发行人将加快推进募集资金投资项目的实施，争取尽早实现预期效益。

##### ③坚持技术创新，加大市场开发力度

发行人将积极推进产品优化、研发及生产流程的改进、技术设备的改造升级，加强精细化管理，持续提升运营效率，不断降低损耗。同时，发行人将加强预算

管理，控制发行人费用率。

发行人将在现有业务基础上完善并扩大经营业务布局，致力于为更多客户提供可靠的产品和优质的服务。发行人将不断改进和完善产品、技术及服务体系，凭借一流的技术和服务促进市场拓展，从而优化发行人的战略布局。

#### ④保持和优化利润分配制度，强化投资回报机制

为完善发行人利润分配政策，推动发行人建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，发行人根据中国证监会制定的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关要求，制定了《公司章程（草案）》，对利润分配政策进行了明确，确保发行人股东特别是中小股东的利益得到保护。

### 2、实施上述措施的承诺

发行人承诺将积极履行填补被摊薄即期回报的措施，如违反相关承诺，将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于发行人的原因外，将向发行人股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或者替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在发行人股东会审议通过后实施补充承诺或者替代承诺。

### 3、控股股东承诺

控股股东北京科化承诺：

（1）本公司不会滥用控股股东地位，不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益；

（2）本公司不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益；

（3）本公司承诺切实履行发行人制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本公司作出的有关填补被摊薄即期回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给发行人或者投资者造成损失的，本公司愿意依法对发行人或者投资者承担赔偿责任；

（4）作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给发行人造成损失的，依法承担补偿责任，并按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，承担相应的处罚或者监管措施。

#### 4、董事、高级管理人员承诺

董事、高级管理人员承诺：

- (1) 不滥用董事、高级管理人员地位，不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益；
- (2) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用违法违规的方式损害发行人利益；
- (3) 约束并控制本人的职务消费行为；
- (4) 不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
- (5) 本人同意，由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；
- (6) 本人同意，如发行人未来拟对本人实施股权激励，发行人股权激励的行权条件与发行人填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；
- (7) 本人承诺切实履行发行人制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本人作出的有关填补被摊薄即期回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给发行人或者投资者造成损失的，本人愿意依法对发行人或者投资者承担赔偿责任；
- (8) 作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给发行人造成损失的，依法承担补偿责任，并按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，承担相应的处罚或者监管措施。

#### （六）利润分配政策的承诺

##### 1、发行人承诺

发行人将严格按照发行人股东会审议通过的上市后适用的《公司章程(草案)》及《江苏中科科化新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内股东分红回报规划》规定的利润分配政策（包括现金分红政策）履行利润分配决策程序，并实施利润分配。

如发行人违反上述承诺给投资者造成损失的，发行人将依照中国证监会、上海证券交易所的规定承担相应责任。

##### 2、控股股东承诺

控股股东北京科化承诺：

(1) 本公司承诺将采取一切必要的合理措施，促使发行人按照届时有效的《公司章程》、《江苏中科科化新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内股东分红回报规划》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和股东分红回报规划。

(2) 在审议发行人利润分配预案的股东会会议上，本公司将对符合发行人利润分配政策和股东分红回报规划要求的利润分配预案投赞成票，并督促发行人根据相关决议及时进行利润分配。

(3) 若本公司未能依照本承诺严格执行利润分配政策，本公司将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。

## **(七) 依法承担赔偿责任的承诺**

### **1、发行人承诺**

(1) 发行人出具的首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(2) 如经中国证监会、上海证券交易所或其他有权部门认定，发行人出具的首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律、法规及相关规范性文件规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将在有权监管机构或司法机构作出的认定生效后 5 个工作日内提出股份回购预案，并提交董事会、股东会审议，依法回购本次发行上市的全部新股，其中：

①对于首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易的，发行人将按照发行价并加算银行同期活期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款；

②对于首次公开发行的新股已完成上市交易的，回购价格为发行价格加上首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息，具体程序根据相关法律、法规的规定办理。若发行人在本次发行上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，回购价格应相应调整。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。

(3) 如经中国证监会、上海证券交易所或其他有权部门认定，发行人出具的首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔

偿投资者损失。

(4) 如发行人违反上述承诺，发行人将在股东会及中国证监会指定的信息披露媒体上公开说明未采取上述股份回购和购回措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并依法向投资者进行赔偿，尽可能保护投资者的权益。

## 2、控股股东承诺

控股股东北京科化承诺：

(1) 保证发行人出具的首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(2) 如经中国证监会、上海证券交易所或其他有权部门认定，发行人出具的首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律、法规及相关规范性文件规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股（如发行人首次公开发行股票并上市后发生除权事项的，上述回购数量相应调整），且本公司将购回已转让的原限售股股份。

(3) 如经中国证监会、上海证券交易所或其他有权部门认定，发行人出具的首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

## 3、董事、高级管理人员承诺

(1) 保证发行人出具的首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

(2) 若有权部门认定发行人出具的首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将促成发行人依法回购首次公开发行的全部股票。

(3) 若发行人出具的首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

## （八）控股股东避免同业竞争的承诺

控股股东北京科化承诺：

1、截至承诺函出具之日，本公司在中国境内或境外未直接或间接以任何形式从事或参与任何与发行人构成竞争或可能构成竞争的业务及活动，或者拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，本公司与发行人之间不存在同业竞争。

2、自承诺函出具之日起，本公司不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家企业或其他组织的股份以及其他权益）直接或间接参与对发行人构成竞争的任何业务或活动。

3、自承诺函出具之日起，如发行人进一步拓展其业务范围，本公司承诺将不直接或间接与发行人拓展后的业务相竞争；如出现可能与发行人拓展后的业务产生竞争的情形，本公司及本公司控制的其他企业或其他组织将采取下列措施中的一项或多项以避免同业竞争的发生：（1）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的资产或业务以合法方式置入发行人；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）采取其他对维护发行人权益有利的行动以消除同业竞争。

4、如本公司及本公司控制的其他企业或其他组织获得从事新业务的商业机会，而该等新业务可能与发行人产生同业竞争的，本公司及本公司控制的其他企业或其他组织将在符合国家行业政策及审批要求的条件下，优先将上述新业务的商业机会提供给发行人进行选择，并尽最大努力促使该等新业务的商业机会具备在合理和公平的前提下转移给发行人的条件。

5、如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司愿意承担由此产生的法律责任，赔偿或补偿给发行人造成的损失。

本承诺函自本公司出具之日起生效，在本公司作为发行人控股股东期间，上述承诺持续有效且不可撤销。

## （九）关于未能履行承诺时约束措施的承诺

### 1、发行人承诺

（1）如发行人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等发行人无法控制的客观原因导致

的除外)，发行人将采取以下措施：

①在证券监管部门指定的信息披露媒体上及时、充分披露发行人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因，并向投资者公开道歉。

②发行人将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴（如该等人员在发行人领薪）等措施。

③向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。

④发行人违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者承担赔偿责任。

(2) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等发行人无法控制的客观原因导致发行人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，发行人将采取以下措施：

①在发行人股东会及证券监管部门指定的信息披露媒体上及时、充分披露发行人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因。

②向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护其投资者的权益。

(3) 如发行人在其他相关承诺中已明确了约束措施的，对发行人亦具有约束力。

## 2、控股股东承诺

控股股东北京科化承诺：

(1) 如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外），本公司将采取以下措施：

①在证券监管部门指定的信息披露媒体上及时、充分披露本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因，并向投资者公开道歉。

②向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。

③本公司因违反承诺所产生的收益归发行人所有；本公司违反承诺给发行人或投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿，具体措施如下：

A. 发行人有权暂扣本公司应得的现金分红，同时本公司不得转让直接或间接持有的发行人股份，直至将违规收益足额交付发行人为止；

B. 将本公司应得的现金分红由发行人直接用于执行本公司未履行的承诺或用于赔偿因本公司未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失；

C. 若本公司在赔偿完毕前进行股票减持，则需将减持所获资金交由发行人董事会监管并专项用于履行本公司承诺或用于赔偿，直至本公司承诺履行完毕或弥补完发行人、投资者的损失为止。

(2) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：

①在发行人股东会及证券监管部门指定的信息披露媒体上及时、充分披露本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因。

②向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。

(3) 如本公司在其他相关承诺中已明确了约束措施的，对本公司亦具有约束力。

### 3、董事、高级管理人员、核心技术人员承诺

(1) 如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：

①在证券监管部门指定的信息披露媒体上及时、充分披露本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因，并向投资者公开道歉。

②向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。

③本人因违反承诺所产生的收益归发行人所有；本人违反承诺给发行人或投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿，具体措施如下：

A. 发行人有权暂扣本人应得的现金分红（如有），同时本人不得转让直接或间接持有的发行人股份（如有），直至将违规收益足额交付发行人为止；

B. 发行人有权调减或停发本人薪酬或津贴（如本人在发行人领薪），直至将违规收益足额交付发行人为止；

C. 将本人应得的现金分红（如有）由发行人直接用于执行本人未履行的承诺或用于赔偿因本人未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失；

D. 若本人在赔偿完毕前进行股票减持（如本人直接持有发行人股份），则需将减持所获资金交由发行人董事会监管并专项用于履行本人承诺或用于赔偿，直

至本人承诺履行完毕或弥补完发行人、投资者的损失为止。

(2) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：

①在发行人股东会及证券监管部门指定的信息披露媒体上及时、充分披露本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因。

②向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。

(3) 如本人在其他相关承诺中已明确了约束措施的，对本人亦具有约束力。

#### **4、国科瑞华、上海瓯立、奋斗韶华、泰州东泽、金玉诺科、南京合翼、国科正道的承诺**

(1) 如本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致的除外），本企业将采取以下措施：

①在证券监管部门指定的信息披露媒体上及时、充分披露本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因，并向投资者公开道歉。

②向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。

③本企业因违反承诺所产生的收益归发行人所有；本企业违反承诺给发行人或投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿，具体措施如下：

A. 发行人有权暂扣本企业应得的现金分红，同时本企业不得转让直接或间接持有的发行人股份，直至将违规收益足额交付发行人为止；

B. 将本企业应得的现金分红由发行人直接用于执行本企业未履行的承诺或用于赔偿因本企业未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失；

C. 若本企业在赔偿完毕前进行股票减持，则需将减持所获资金交由发行人董事会监管并专项用于履行本企业承诺或用于赔偿，直至本企业承诺履行完毕或弥补完发行人、投资者的损失为止。

(2) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本企业将采取以下措施：

①在发行人股东会及证券监管部门指定的信息披露媒体上及时、充分披露本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因。

②向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。

(3) 如本企业在其他相关承诺中已明确了约束措施的，对本企业亦具有约束力。

## 5、中化创新、中福泉州的承诺

(1) 如本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致的除外），本企业将采取以下措施：

①在证券监管部门指定的信息披露媒体上及时、充分披露本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因，并向投资者公开道歉。

②向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。

③本企业因违反承诺所产生的收益归发行人所有；本企业违反承诺给发行人或投资者造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿。

(2) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本企业将采取以下措施：

①在发行人股东会及证券监管部门指定的信息披露媒体上及时、充分披露本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因。

②向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。

(3) 如本企业在其他相关承诺中已明确了约束措施的，对本企业亦具有约束力。

## 六、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项

### （一）关于股东信息披露的专项承诺

1、发行人股东均具备持有发行人股份的主体资格，不存在法律、法规规定禁止持股的主体直接或者间接持有发行人股份的情形。

2、发行人控股股东历史沿革中存在的股权代持行为已依法解除，发行人历史沿革中不存在股权代持、委托持股等情形。

3、发行人各股东所持发行人股份不存在被质押、冻结或者设定其他第三者权益的情形，不存在股权争议或者潜在纠纷等情形。

4、发行人股东不存在违规入股、入股价格明显异常的情形，不存在以发行人股权进行不当利益输送的情形。

5、除本招股说明书已披露情形外，本次发行上市的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有发行人股份的情形。

6、发行人不存在中国证监会系统离职人员入股的情形。

7、发行人已及时向为本次发行上市而聘请的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了中介机构开展尽职调查，依法在本次发行上市的招股说明书等申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。

发行人确认上述承诺真实、有效，并愿意承担相应的法律责任。

### （二）关于规范和减少关联交易的承诺

#### 1、控股股东承诺

控股股东北京科化承诺：

(1)本公司已严格按照法律、法规及规范性文件的要求对本公司的关联方、关联关系以及与发行人之间的关联交易情况进行了真实、准确、完整、详尽的披露。除发行人本次发行上市的招股说明书等申请文件中已经披露的关联交易外，本公司以及本公司控制的其他企业或其他组织与发行人之间不存在其他任何应披露而未披露的关联交易。并且，本公司以及本公司控制的其他企业或其他组织不存在影响发行人独立性或者显失公平的关联交易。

(2) 本公司以及本公司控制的其他企业或其他组织将尽量避免和减少与发行人之间发生关联交易。对于因客观原因无法规避或有合理理由的关联交易，保证遵循平等、自愿、公平、公允和等价有偿的原则，按照公平合理和正常商业交易的条件进行。本公司以及本公司控制的其他企业或其他组织将与发行人签署关联交易协议，遵循市场化的定价原则，交易价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费标准；本公司及本公司控制的其他企业或其他组织将严格按照相关法律法规、规范性文件、发行人公司章程及相关关联交易管理制度的规定履行交易程序及信息披露义务。

(3) 本公司保证将严格遵守法律法规、规范性文件和发行人公司章程及相关关联交易管理制度中关于关联交易事项的回避规定，严格遵守发行人关联交易的决策程序，保证不利用发行人控股股东的地位和影响，通过关联交易损害发行人以及其他股东的合法权益。

(4) 本公司将促使本公司控制的其他企业或其他组织遵守上述承诺，如本公司或本公司控制的其他企业或其他组织违反上述承诺而导致发行人或其他股东的权益受到损害，本公司将依法承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人或者其他股东造成的一切实际损失。

本承诺函自本公司出具之日起生效，在本公司作为发行人控股股东期间，上述承诺持续有效且不可撤销。

## 2、持股 5%以上的其他股东承诺

持股 5%以上的其他股东国科瑞华、上海瓯立、奋斗韶华承诺：

(1) 本企业已严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求对本企业的关联方、关联关系以及与发行人之间的关联交易进行了真实、准确、完整、详尽地披露。除发行人本次发行上市的招股说明书等申请文件中已经披露的关联交易外，本企业以及本企业控制的其他企业或其他组织与发行人之间不存在其他任何应披露而未披露的关联交易。并且，本企业以及本企业控制的其他企业或其他组织不存在影响发行人独立性或者显失公平的关联交易。

(2) 本企业以及本企业控制的其他企业或其他组织将尽量避免和减少与发行人之间发生关联交易。对于因客观原因无法规避或有合理理由的关联交易，保证遵循平等、自愿、公平、公允和等价有偿的原则，按照公平合理和正常商业交易的条件进行。本企业以及本企业控制的其他企业或其他组织将与发行人签署关

联交易协议，遵循市场化的定价原则，交易价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费标准；本企业及本企业控制的其他企业或其他组织将严格按照相关法律法规、规范性文件、发行人公司章程及相关关联交易管理制度的规定履行交易程序及信息披露义务。

（3）本企业保证将严格遵守法律法规、规范性文件和发行人公司章程及相关关联交易管理制度中关于关联交易事项的回避规定，严格遵守发行人关联交易的决策程序，保证不通过关联交易损害发行人以及其他股东的合法权益。

（4）本企业将促使本企业控制的其他企业或其他组织遵守上述承诺，如本企业或本企业控制的其他企业或其他组织违反上述承诺而导致发行人或其他股东的权益受到损害，本企业将依法承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人或者其他股东造成的一切实际损失。

本承诺函自出具之日起生效，在本企业作为发行人持股 5%以上股东期间，上述承诺持续有效且不可撤销。

### 3、董事、高级管理人员承诺

（1）本人已严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求对本人的关联方、关联关系以及与发行人之间的关联交易进行了真实、准确、完整、详尽地披露。除发行人本次发行上市的招股说明书等申请文件中已经披露的关联交易外，本人以及本人直接或者间接控制的，或者由本人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的除发行人以外的法人或其他组织（以下简称“本人关联方”）与发行人之间不存在其他任何应披露而未披露的关联交易。并且，本人以及本人关联方不存在影响发行人独立性或者显失公平的关联交易。

（2）本人以及本人关联方将尽量避免和减少与发行人之间发生关联交易。对于因客观原因无法规避或有合理理由的关联交易，保证遵循平等、自愿、公平、公允和等价有偿的原则，按照公平合理和正常商业交易的条件进行。本人以及本人关联方将与发行人签署关联交易协议，遵循市场化的定价原则，交易价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费标准；本人以及本人关联方将严格按照相关法律法规、规范性文件、发行人公司章程及相关关联交易管理制度的规定履行交易程序及信息披露义务。

（3）本人保证将严格遵守法律法规、规范性文件和发行人公司章程及相关关联交易管理制度中关于关联交易事项的回避规定，严格遵守发行人关联交易的

决策程序，保证不通过关联交易损害发行人以及其他股东的合法权益。

(4) 如本人以及本人关联方违反上述承诺而导致发行人或其他股东的权益受到损害，本人将依法承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人或其他股东造成的损失。

(5) 本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。

本承诺函自本人出具之日起生效，在本人作为公司董事、高级管理人员期间，上述承诺持续有效且不可撤销。

### **(三) 关于避免资金占用及违规担保的承诺**

#### **1、控股股东承诺**

控股股东北京科化承诺：

(1) 本公司目前不存在以任何形式占用或使用发行人资金的行为，也未违规要求发行人为本公司及本公司控制的其他企业或其他组织的借款或其他债务提供担保。

(2) 自本承诺出具之日起，本公司及本公司控制的其他企业或其他组织将严格遵守法律、法规、规范性文件以及发行人公司章程等相关规章制度的规定，不以任何方式违规占用或使用发行人的资金、资产和资源，不会违规要求发行人为本公司及本公司控制的其他企业或其他组织的借款或其他债务提供担保，亦不会以任何其他直接或者间接的方式从事损害或可能损害发行人及其他股东利益的行为。

(3) 本公司的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员及该等人士控制或投资的企业或其他组织也将遵守上述承诺。

(4) 如因违反上述承诺而导致发行人或其他股东的权益受到损害，本公司将依法承担相应的赔偿责任。

#### **2、持股 5%以上的其他股东承诺**

持股 5%以上的其他股东国科瑞华、上海瓯立、奋斗韶华承诺：

(1) 本企业目前不存在以任何形式占用或使用发行人资金的行为，也未违规要求发行人为本企业及本企业控制的其他企业或其他组织的借款或其他债务提供担保。

(2) 自本承诺出具之日起，本企业及本企业控制的其他企业或其他组织将

严格遵守法律、法规、规范性文件以及发行人公司章程等相关规章制度的规定，不以任何方式违规占用或使用发行人的资金、资产和资源，不会违规要求发行人为本企业及本企业控制的其他企业或其他组织的借款或其他债务提供担保，亦不会以任何其他直接或者间接的方式从事损害或可能损害发行人及其他股东利益的行为。

(3) 本企业执行事务合伙人及其董事、监事、高级管理人员、前述自然人关系密切的家庭成员及该等人士控制或投资的企业或其他组织也将遵守上述承诺。

(4) 如因违反上述承诺而导致发行人或其他股东的权益受到损害，本企业将依法承担相应的赔偿责任。

### 3、董事、高级管理人员承诺

(1) 本人目前不存在以任何形式占用或使用发行人资金的行为，也未违规要求发行人为本人及本人控制的其他企业或其他组织的借款或其他债务提供担保。

(2) 自本承诺出具之日起，本人及本人控制的其他企业或其他组织将严格遵守法律、法规、规范性文件以及发行人公司章程等相关规章制度的规定，不以任何方式违规占用或使用发行人的资金、资产和资源，不会违规要求发行人为本人及本人控制的其他企业或其他组织的借款或其他债务提供担保，亦不会以任何其他直接或者间接的方式从事损害或可能损害发行人及其他股东利益的行为。

(3) 如本人及本人控制的其他企业或其他组织违反上述承诺而导致发行人或其他股东的权益受到损害，本人将依法承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人或其他股东造成的损失。

(4) 本人保证本人关系密切的家庭成员及其控制的其他企业或其他组织也遵守以上承诺。

### (四) 控股股东关于保持发行人资产、人员、财务、机构和业务独立的承诺

控股股东北京科化承诺：

1、本公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章及公司章程等的相关规定行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东地位谋取不当利益，

维护发行人独立性，保证发行人在资产完整、人员独立、财务独立、机构独立及业务独立。

2、如因违反上述承诺而导致发行人或其他股东的权益受到损害，本公司将依法承担相应的赔偿责任。

#### **(五) 在审期间不进行现金分红的相关承诺**

发行人承诺：

自发行人申请首次公开发行股票并在科创板上市至完成上市前即在审期间，公司承诺不进行现金分红。

## 七、股东会、董事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

### （一）股东会的运行情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司制定了《股东会议事规则》（《股东大会议事规则》）。

股份公司设立以来，公司历次股东（大）会均按照《公司章程》、《股东（大）会议事规则》及其他相关法律、法规规定的程序召集和召开，严格按照相关规定进行表决、形成决议，出席会议的股东人数符合法律规定，相关决议内容合法、有效。

### （二）董事会的运行情况

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司制定了《董事会议事规则》。

股份公司设立以来，公司历次董事会均按照《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关法律、法规规定的程序召集和召开，严格按照相关规定进行表决、形成决议，出席会议的董事人数符合法律规定，相关决议内容合法、有效。

### （三）独立董事制度的建立健全及运行情况

2024年6月20日，公司召开股东大会，审议通过《关于选举独立董事的议案》、《关于设立董事会专门委员会的议案》及《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》，选举了3名独立董事，其中1名为会计专业人士，建立了独立董事制度。目前，公司董事会成员为9人，其中3人为独立董事，占董事会人数三分之一，并有一名会计专业人士，符合相关规定。

自公司聘任独立董事以来，独立董事按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的要求，履行独立董事职责。公司独立董事积极出席公司董事会会议，参与讨论决策有关重大事项。随着独立董事制度的建立，独立董事在公司法人治理机构的完善、公司发展方向和战略的选择、内部控制制度的完善以及中小股东权益的保护等方面发挥了重要作用。

### （四）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

公司设董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。董事会秘书为公司的高级管

理人员，对董事会负责，负责公司股东会和董事会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书自受聘以来，按照《公司章程》、《董事会秘书工作细则》的相关规定筹备董事会和股东会，勤勉尽职地履行了其职责。

## 八、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

根据《公司章程》，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，各董事会专门委员会的构成情况如下：

委员会名称	召集人	委员
战略委员会	卢绪奎 (董事长)	卢绪奎(董事长) 傅东升(董事) 潘林(独立董事)
审计委员会	洪磊 (会计专业独立董事)	洪磊(会计专业独立董事) 潘林(独立董事) 傅东升(董事)
提名委员会	宋正奇 (独立董事)	宋正奇(独立董事) 潘林(独立董事) 卢绪奎(董事长)
薪酬与考核委员会	潘林 (独立董事)	潘林(独立董事) 洪磊(会计专业独立董事) 卢绪奎(董事长)

公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会自成立以来，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定履行职责。

## 九、募集资金具体运用情况

经公司董事会和股东会审议通过，本次发行募集资金在扣除发行费用后的净额将用于与公司主营业务相关的投资项目，具体如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目		项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	半导体封装用中高端环氧塑封料研发及产业化项目	1.1 半导体封装用中高端环氧塑封料产业化项目	42,000.00	42,000.00
		1.2 半导体封装用中高端环氧塑封料研发中心建设项目	9,800.00	9,800.00
2	补充流动资金		8,000.00	8,000.00
合计			59,800.00	59,800.00

### （一）半导体封装用中高端环氧塑封料产业化项目

#### 1、项目投资概算

本项目拟使用募集资金 42,000.00 万元，具体投资构成如下：

单位：万元、%

序号	项目			投资金额	占本项目拟使用募集资金的比例		
1	建设投资	建筑工程费		1,320.00	3.14		
2		设备及安装工程费、软件购置费		35,085.58	83.54		
3		工程建设其他费用		311.87	0.74		
4		预备费		734.35	1.75		
5	铺底流动资金			4,548.20	10.83		
6	合计			42,000.00	100.00		

#### 2、项目实施进度计划

本项目实施主体为中科科化，建设期 48 个月，预计实施进度如下：

序号	内容	进度安排											
		4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48
1	厂房装修改造	△	△	△	△								
2	设备软件购置、安装及调试		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
3	人员招聘及培训		△	△	△	△	△	△	△	△	△		
4	正式投产			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△

### （二）半导体封装用中高端环氧塑封料研发中心建设项目

#### 1、项目投资概算

本项目拟使用募集资金 9,800.00 万元, 具体投资构成如下:

单位: 万元、%

序号	项目	投资金额	占本项目拟使用募集资金的比例
1	建筑工程费	504.60	5.15
2	设备及安装工程费、软件购置费	8,809.84	89.90
3	工程建设其他费用	63.55	0.65
4	预备费	422.01	4.31
5	合计	9,800.00	100.00

## 2、项目实施进度计划

本项目实施主体为中科科化, 建设期 24 个月, 预计实施进度如下:

序号	内容	进度安排(月)											
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	建筑装修改造	△	△	△	△	△							
2	设备与软件采购、安装及调试				△	△	△	△	△	△	△		
3	人员招聘、培训										△	△	△
4	研发工作准备												△

## (三) 补充流动资金

随着业务规模的不断扩大, 公司需要补充流动资金以支撑未来经营发展。通过对资源的科学配置与高效利用, 公司将进一步提升生产运营效率, 增强技术创新能力, 促进公司长期健康可持续发展。公司拟使用本次募集资金补充流动资金 8,000.00 万元, 以满足公司未来经营发展所需的营运资金, 增强公司抗风险能力。